创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

广东德聚技术股份有限公司

Guangdong CollTech Technology Co., Ltd.

（广东省东莞市石排镇向沙路石排段 14 号）

首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书

（申报稿）

本公司的发行申请尚需深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐机构（主承销商）

中信证券股份有限公司

CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

致投资者的声明

一、发行人上市的目的

公司是一家专注于电子专用高分子材料研发、生产和销售的国家重点“小巨人”企业，主要产品为电子胶粘剂，并围绕客户具体用胶场景提供配套应用方案。自成立以来，公司持续围绕高性能电子胶粘剂产品开展研发及产业化，形成了从原材料的开发与修饰、产品配方设计到生产工艺优化的体系化研发能力，产品主要布局智能终端、新能源、半导体、通信等战略性新兴产业。

电子胶粘剂是电子制造中实现元器件可靠连接、功能防护和性能承载的关键功能性材料，也是电子制造领域自主配套的重要基础材料。围绕智能终端、新能源、半导体、通信等下游产业升级方向，公司坚持以客户应用需求为牵引，持续推进电子胶粘剂产品开发和产业化应用，保障关键电子材料的供应链安全。

本次申请在创业板上市，是公司在长期技术积累和业务规模持续提升的基础上，进一步借助资本市场提升综合竞争力的重要举措。公司拟通过本次发行上市拓宽直接融资渠道，增强资本实力，持续提升核心技术研发、规模化生产、快速响应及客户服务能力，更好地满足下游客户对高性能电子胶粘剂产品日益提升的应用需求。同时，公司将以本次上市为契机，进一步完善治理结构和规范运作机制，提升信息披露质量、品牌影响力和人才吸引力，为持续规范经营和长期价值创造奠定基础。

二、发行人现代企业制度的建立健全情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，建立健全了由股东会、董事会和高级管理层构成的公司治理架构；董事会下设审计委员会等专门委员会，负责在董事会授权范围内履行相应职责，形成了权责明确、运作规范、相互制衡的治理机制，现代企业制度能够得到有效执行，切实保障公司规范运作和投资者合法权益。

三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划

公司本次募集资金主要投向“德聚高端复合功能材料生产项目”“德聚北方

总部产研一体化项目”“东莞研发中心及信息化项目”“营销服务及技术支持中心建设项目”及补充流动资金。该等项目均围绕公司主营业务和未来发展规划开展，服务于公司电子胶粘剂产品的产能建设、研发能力、客户服务网络完善和运营资金需求。

其中，“德聚高端复合功能材料生产项目”和“德聚北方总部产研一体化项目”将以现有主营业务和核心技术为基础，提升智能终端、新能源、半导体等领域电子胶粘剂的产业化能力，以及环氧树脂胶粘剂、丙烯酸酯胶粘剂和有机硅树脂胶粘剂的研发及应用转化能力，增强公司规模化交付和区域化服务能力；“东莞研发中心及信息化项目”有助于提升研发测试条件、信息化管理水平和研发协同效率，助力公司持续开展产品和技术的纵向迭代和横向储备，巩固技术竞争优势；“营销服务及技术支持中心建设项目”有助于加强公司在重点区域和重点客户周边的技术服务与市场响应能力；补充流动资金有助于满足公司日常运营资金需求，使公司能够进一步落实业务发展战略。

四、发行人持续经营能力及未来发展规划

报告期内，公司营业收入分别为 35,139.21 万元、38,489.05 万元和 45,786.50 万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 4,335.45 万元、7,724.90 万元和 12,457.28 万元，收入规模和盈利水平持续提升，经营成果主要由核心技术产业化转化形成，具备良好的持续经营能力。

未来，公司将继续聚焦电子专用高分子材料领域，秉承“坦诚守诺、精益求精、直面挑战、合作互赢”的企业价值观，以持续技术创新和前期技术积累为基础，致力于为客户提供“高技术难度、高附加值”的产品及应用方案。一方面，公司将巩固既有客户基础和应用经验积累，着力推进成熟产品迭代升级，并在现有客户体系内拓展新产品、新用胶点和新应用场景；另一方面，公司将围绕已通过或正在推进验证的智能终端、新能源、半导体、通信等领域客户，积极把握先进封装自主配套加速、光模块和 AI 服务器等新兴应用带来的功能性材料需求提升机遇，加快相关产品的客户导入、量产验证和订单转化，推动公司技术储备和客户验证成果逐步转化为规模化收入贡献。

（本页无正文，为《致投资者的声明》之签署页）

实际控制人、董事长签字：

黄成生

广东德聚技术股份有限公司

2026年6月25日

重要声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A 股）
发行股数	本次拟发行不超过 2,446.90 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），不低于发行后总股本的 25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	人民币【】元
预计发行日期	【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所和板块	深圳证券交易所创业板
发行后股本总额	不超过 9,787.60 万股
保荐人（主承销商）	中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期	【】年【】月【】日

目 录

致投资者的声明 1

一、发行人上市的目的 1

二、发行人现代企业制度的建立健全情况 1

三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 1

四、发行人持续经营能力及未来发展规划 2

重要声明 4

发行概况 5

目 录 6

第一节 释义 10

一、普通术语 10

二、专业术语 14

第二节 概览 19

一、重大事项提示 19

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 21

三、本次发行的概况 21

四、发行人主营业务经营情况 23

五、发行人板块定位情况 25

六、发行人报告期主要财务数据和财务指标 30

七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息 31

八、发行人选择的具体上市标准 31

九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 31

十、募集资金用途 31

十一、其他对发行人有重大影响的事项 33

第三节 风险因素 34

一、与公司相关的风险 34

二、与行业相关的风险 37

三、其他风险.....38
第四节 发行人基本情况.....39
一、发行人基本情况.....39
二、发行人设立及重大资产重组情况.....39
三、发行人股权结构及控股子公司、分公司、参股公司情况.....53
四、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.....59
五、发行人股本情况.....65
六、董事、监事会取消前监事、高级管理人员及其他核心人员.....85
七、发行人已制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排.....95
八、发行人员工情况.....100
第五节 业务与技术.....102
一、公司主营业务、主要产品或服务情况.....102
二、公司所处行业情况.....128
三、公司销售情况和主要客户.....157
四、公司采购情况和主要供应商.....159
五、公司主要固定资产、无形资产及经营性资产情况.....162
六、公司拥有的特许经营权情况.....177
七、公司研发及核心技术情况.....178
八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.....194
九、公司境外经营情况.....195
第六节 财务会计信息与管理层分析.....196
一、财务报表.....196
二、审计意见和关键审计事项.....202
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.....204
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.....206
五、重要的会计政策、会计估计变更.....242
六、非经常性损益.....244
七、主要税项及税收优惠.....245
八、主要财务指标.....247

九、盈利预测及报告.....248
十、经营成果分析.....248
十一、资产质量分析.....282
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.....303
十三、报告期内的重大投资或资本性支出.....317
十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项.....317
第七节 募集资金运用与未来发展规划.....319
一、募集资金运用概况.....319
二、未来发展规划.....321
第八节 公司治理与独立性.....325
一、概述.....325
二、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.....325
三、公司内部控制制度的自我评估和审计意见.....326
四、公司报告期内违法违规情况.....326
五、发行人报告期内的资金占用和违规担保情况.....327
六、发行人独立性情况.....327
七、同业竞争情况.....329
八、关联交易情况.....330
第九节 投资者保护.....340
一、本次发行完成前滚存利润的分配和已履行的决策程序.....340
二、本次发行前后股利分配政策的差异情况.....340
三、公司关于特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排及尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情况.....346
第十节 其他重要事项.....347
一、发行人重大合同.....347
二、对外担保情况.....351
三、诉讼或仲裁事项.....351
第十一节 声明.....352
一、发行人及其全体董事、高级管理人员声明.....352
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....353

三、保荐人（主承销商）声明.....354
四、保荐人（主承销商）董事长声明.....355
五、保荐人（主承销商）总经理声明.....356
六、发行人律师声明.....357
七、审计机构声明.....358
八、验资复核机构声明.....359
九、出资复核机构声明.....360
十、承担评估业务的资产评估机构声明.....361
第十二节 附件 363
一、备查文件目录.....363
二、备查文件查阅.....363
附件一：投资者关系的主要安排及股东投票机制的建立情况.....365
附件二：与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项.....367
附件三：股东会、董事会、监事会（取消前）、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.....391
附件四：募集资金具体运用情况.....395

第一节 释义

本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

一、普通术语

公司/本公司/德聚技术/发行人	指	广东德聚技术股份有限公司
德聚有限	指	东莞市德聚胶接技术有限公司，系发行人前身
赣州德熙	指	赣州市德熙企业管理咨询合伙企业（有限合伙），曾用名“东莞市德茂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”，系公司员工持股平台及发行人股东
赣州德益	指	赣州市德益企业管理咨询合伙企业（有限合伙），曾用名“东莞市德益企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”，系公司员工持股平台及赣州德熙的有限合伙人
赣州德悦	指	赣州市德悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙），曾用名“东莞市德志企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”，系公司员工持股平台及发行人股东
德森伯格/上海德森伯格	指	上海德森伯格企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台及发行人股东
赣州御朗	指	赣州市御朗企业管理合伙企业（有限合伙），发行人历史股东
南通聚芯	指	南通聚芯半导体科技中心（有限合伙），系发行人子公司员工持股平台
英特尔	指	英特尔亚太研发有限公司，发行人股东
全德学镂科芯	指	全德学镂科芯创业投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙），发行人股东
镂科芯二期	指	南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
全德学亨芯	指	全德学亨芯创业投资（平潭）合伙企业（有限合伙），发行人股东
全德学资本	指	全德学镂科芯创业投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）、全德学亨芯创业投资（平潭）合伙企业（有限合伙）及南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙）的合称
德利润兴	指	新余德利润兴创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名“成都德利润兴创业投资合伙企业（有限合伙）”，发行人历史股东
嘉兴弘玺	指	嘉兴弘玺股权投资合伙企业（有限合伙），发行人历史股东
美桐十一期	指	厦门市美桐十一期股权投资合伙企业（有限合伙），发行人历史股东
九州舜创	指	杭州九州舜创股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
鹏鼎投资	指	鹏鼎控股投资（深圳）有限公司，发行人股东
青岛生润	指	青岛生润私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东

鑫弘元通	指	嘉兴鑫弘元通创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
勤合投资	指	东莞勤合创业投资中心（有限合伙），发行人股东
勤道投资	指	深圳市勤道东创投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
东莞科创	指	东莞科创智造专精与特新创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
高梧启明	指	天津高梧启明创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
广东省半导体基金	指	广东省半导体及集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
邦信同盈	指	苏州邦信同盈创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
立夏一号	指	深圳市立夏一号创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
昆仑鼎天	指	深圳昆仑鼎天投资有限公司，发行人股东
厚雪投资	指	上海厚雪私募投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
创盈健科	指	广州创盈健科投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
厦门汇桥	指	厦门汇桥科创二期股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
广东立湾	指	广东立湾股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
宁波高易	指	宁波高易三期创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
宁波立湾	指	宁波立湾倍增五号创业投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
远智芯创投	指	广东远智芯创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
东证常平	指	东莞市东证常平新兴产业股权投资企业（有限合伙），发行人股东
东莞科创接力	指	东莞科创接力创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
东莞科创知产	指	东莞科创知识产权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
东莞柏凯	指	东莞市柏凯物业投资有限公司，发行人股东
元禾璞华	指	江苏南通元禾璞华战新创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
国企创新	指	广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
越秀甬元	指	宁波越秀甬元股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
韦豪泰达	指	天津韦豪泰达海河股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
韦豪镇鑫	指	宁波韦豪镇鑫一期创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
中广投资	指	珠海德聚中广创业投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
海盐鋆昊	指	海盐鋆昊臻选股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
五方九派	指	湖北五方九派股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
深圳美科泰	指	深圳市美科泰科技有限公司，发行人子公司
上海濠茂	指	上海濠茂科技有限公司，发行人子公司

苏州美科泰	指	苏州美科泰制程电子科技有限公司，发行人子公司
上海锐朗	指	上海锐朗光电材料有限公司，发行人子公司
青岛德聚	指	青岛德聚胶接技术有限公司，发行人子公司
江苏德聚	指	江苏德聚新材料科技有限公司，发行人子公司
南通德聚半导体	指	南通德聚半导体材料有限公司，发行人子公司
南通德聚精密膜材	指	南通德聚精密膜材料有限公司，发行人子公司
德聚埔材	指	广州德聚埔材半导体技术有限公司，发行人原子公司，已于 2024 年 11 月注销
如东德聚	指	如东德聚胶粘技术有限公司，发行人子公司
德聚化学	指	德聚化学材料（深圳）有限公司，发行人原子公司，已于 2024 年 12 月注销
德道天成	指	东莞市德道天成科技有限公司，发行人原参股公司，已于 2025 年 12 月转让
美科泰贸易	指	美科泰贸易有限公司（MCOTI TRADING CO., LIMITED），发行人子公司，位于中国香港地区
北美德聚	指	德聚北美公司（CollTech North America），发行人子公司，位于美国
欧洲德聚	指	德聚欧洲公司（CollTech Europe GmbH），发行人子公司，位于德国
韩国德聚	指	德聚科技有限公司（CollTech Technology Co.,Ltd.），发行人子公司，位于韩国
新加坡德聚	指	德聚新加坡公司（COLLTECH SOUTH ASIA PTE. LTD.），发行人子公司，位于新加坡
马来西亚德聚	指	德聚马来西亚公司（COLLTECH MALAYSIA SDN. BHD.），发行人子公司，位于马来西亚
越南美科泰	指	美科泰科技越南有限公司（MCOTI VIETNAM TECHNOLOGY CO., LTD），发行人子公司，位于越南
德聚技术北京分公司	指	广东德聚技术股份有限公司北京分公司，已于 2024 年 10 月注销
香港诺氏	指	诺氏（香港）控股有限公司（NOBELS （HONG KONG） HOLDINGS LIMITED），系发行人实际控制人黄成生控制的其他企业，已于 2024 年 8 月注销
美科泰科技	指	美科泰科技有限公司（MCOTI TECHNOLOGY LIMITED），原系股东王延鲲控制的企业，已于 2023 年 4 月注销
伯乐通	指	深圳市伯乐通企业管理咨询有限公司，曾用名“德聚（深圳）胶接技术有限公司”“深圳市诺贝诺胶接技术有限公司”，发行人原股东，已于 2023 年 11 月注销
汉高（Henkel）	指	Henkel AG & Co. KgaA，法兰克福证券交易所上市公司，证券代码 HEN.DF
富乐（H.B.Fuller）	指	H.B. Fuller Company，纽约证券交易所上市公司，证券代码 FUL.N
陶氏化学（Dow）	指	DOW Inc.，纽约证券交易所上市公司，证券代码 DOW.N
3M 公司	指	Minnesota Mining and Manufacturing Corporation，纽约证券交易所上市公司，证券代码 MMM.N
洛德（Lord）	指	LORD Corporation，纽约证券交易所上市公司 Parker Hannifin Corporation（证券代码 PH.N）的子公司

纳美仕（Namics）	指	NAMICS Corporation（ナミックス株式会社）
好乐（Dr. Hönle）	指	Dr. Hönle AG，法兰克福证券交易所上市公司，证券代码 HNL.DF
戴马斯（Dymax）	指	Dymax Corporation
日本东丽（Toray）	指	Toray Industries, Inc，日本东丽株式会社
东京电气化学（TDK）	指	Tokyo Denkikagaku Kogyo K.K，东京电气化学工业株式会社，东京交易所上市公司，证券代码：6762.T
日本富士	指	FUJIFILM Holdings Corporation，富士胶片株式会社，东京交易所上市公司，证券代码：4901.T
安费诺	指	Amphenol Corporation，纽约证券交易所上市公司，证券代码 APH.N
Panacol	指	好乐集团下属的胶粘剂品牌
德邦科技	指	烟台德邦科技股份有限公司，上海证券交易所科创板上市公司，证券代码 688035.SH
回天新材	指	湖北回天新材料股份有限公司，深圳证券交易所创业板上市公司，证券代码 300041.SZ
华海诚科	指	江苏华海诚科新材料股份有限公司，上海证券交易所科创板上市公司，证券代码 688535.SH
世华科技	指	苏州世华新材料科技股份有限公司，上海证券交易所科创板上市公司，证券代码 688093.SH
旗胜电子	指	Nippon Mektron, Ltd.，隶属于日本 NOK 集团，NOK 集团系东京证券交易所上市公司，证券代码 7240.T
东山精密	指	苏州东山精密制造股份有限公司，深圳证券交易所主板上市公司，证券代码 002384.SZ
和硕	指	和硕联合科技股份有限公司，中国台湾证券交易所上市公司，证券代码 4938.TW
鹏鼎控股	指	鹏鼎控股（深圳）股份有限公司，深圳证券交易所主板上市公司，证券代码 002938.SZ
阳光电源	指	阳光电源股份有限公司，深圳证券交易所创业板上市公司，证券代码 300274.SZ
台郡科技	指	台郡科技股份有限公司，中国台湾证券交易所上市公司，证券代码 6269.TW
立讯精密	指	立讯精密工业股份有限公司，深圳证券交易所主板上市公司，证券代码 002475.SZ
富士康	指	鸿海精密工业股份有限公司，中国台湾证券交易所上市公司，证券代码 2317.TW
Sanmina	指	Sanmina Corporation，美国纳斯达克证券交易所上市公司，证券代码 SANM
米麒科技	指	深圳市米麒科技有限公司
十五五	指	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《创业板股票上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》	指	现行有效的《广东德聚技术股份有限公司章程》

《公司章程（草案）》	指	发行人股东会审议通过并将于本次发行后生效的《广东德聚技术股份有限公司章程（草案）》
本次发行	指	公司本次申请在境内首次公开发行不超过 24,469,000 股人民币普通股（A 股）
本次发行上市	指	公司本次申请在境内首次公开发行不超过 24,469,000 股人民币普通股（A 股）并在深交所创业板上市
本招股说明书	指	《广东德聚技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
保荐人/保荐机构/主承销商/中信证券	指	中信证券股份有限公司
发行人律师/华商律所	指	广东华商律师事务所
审计机构/中兴华/中兴华会计师/发行人会计师	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
大华会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构/中联国际	指	中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司，曾用名“中联国际评估咨询有限公司”
报告期/最近三年	指	2023 年度、2024 年度、2025 年度
报告期各期末	指	2023 年末、2024 年末、2025 年末
元、万元、亿元	指	除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、专业术语

电子专用材料	指	用于电子元器件、组件及系统制备的专用电子功能材料、互联与封装材料、工艺及辅助材料
高分子材料	指	以高分子化合物为基体，再配有其他助剂所构成的材料，也称为聚合物材料
胶粘剂	指	通过粘附力和内聚力的作用将连接物粘合的粘性物质
电子胶粘剂	指	用于电子相关产品的电子元器件保护、电气连接、结构粘接和密封、热管理、电磁屏蔽等功能的胶粘剂
树脂	指	受热后有软化或熔融范围，软化时在外力作用下有流动倾向，常温下是固态、半固态或液态的有机聚合物，系胶粘剂配方中的主体
助剂	指	为满足特定的物理化学特性加入的各种辅助成分
填料	指	为改善胶粘剂性能而加入的无机或有机颗粒、粉体、纤维等材料
触变剂	指	加入树脂中，能使树脂胶液在静止时有较高的稠度，在外力作用下又变成低稠度流体的物质
催化剂	指	在化学反应中能改变反应速率，而本身的质量和组成在反应后保持不变的物质
固化剂	指	一类增进或控制固化反应的物质或混合物

交联剂	指	含有活性基团，加入后在一定条件下发生化学反应，使线型或轻度支化的分子结构形成三维网状结构的物质
抑制剂	指	一种用来阻滞或降低化学反应速度的物质
增韧剂	指	能增加胶粘剂固化后胶体柔韧性的物质
热固化	指	一种在加热或红外辐射等的热作用下产生化学交联的固化方式。根据加热温度的不同，可分为低温固化、中温固化和高温固化
湿气固化	指	与空气中的水汽发生聚合反应达到固化的方式
UV 固化	指	紫外光固化方式，是一种在紫外光或可见光的照射下，光引发剂吸收特定波长的光子，产生自由基或阳离子，引发单体和低聚物发生聚合和交联反应，在极短时间内完成的固化方式
双重固化	指	光固化与其他固化方式结合起来的固化技术
点胶	指	通过点胶设备将胶粘剂按设定位置、路径、胶量和形貌施加至基材或元器件表面的工艺，是实现精密施胶和功能成型的方式
涂布	指	将液态或浆料状材料均匀施加于膜材、基板等载体表面，并经固化、干燥等处理形成特定厚度功能层的工艺
流变特性	指	材料在外力作用下的流动和变形特性，体现为粘度、触变性、剪切变稀、定型性等
导热界面材料、TIM	指	Thermal Interface Material，用于填充发热器件与散热器、壳体或其他散热结构之间微小间隙的导热材料，主要用于降低界面热阻、提升热量传导效率
芯片固晶胶膜、DAF	指	Die Attach Film，用于在芯片封装过程中镭射切割时，晶片可一起切割与分离，以及用于连接半导体芯片与封装基板、芯片与芯片的超薄型高性能胶膜
反应型聚氨酯热熔胶、PUR	指	Polyurethane Reactive，兼具热熔和反应胶粘的胶粘剂
各向异性导电胶膜、ACF	指	Anisotropic Conductive Film，是一种透明的聚合物连接材料，具有粘接、垂直向导电和水平向绝缘三个特点
表面贴装技术、SMT	指	Surface Mount Technology，将片式元器件贴装至 PCB 或 PCBA 表面，通过回流焊等工艺实现电气连接和机械固定的电子组装技术
回流焊、无铅回流焊	指	回流焊是通过加热使焊膏熔融并完成元器件与 PCB 焊盘连接的焊接工艺；无铅回流焊系使用无铅焊料的回流焊工艺，其峰值温度通常高于传统含铅工艺，对胶粘剂耐热性和工艺适配性要求高
PCB	指	印制电路板（Printed Circuit Board），是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电性能连接的载体
PCBA	指	印刷电路板装配（Printed Circuit Board Assembly），即 PCB 经过 SMT 贴片、DIP 插件、焊接等整个制程后的产品
FPC	指	柔性电路板（Flexible Printed Circuit），一种具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好等特性的印刷电路板
TWS	指	真无线立体声（True Wireless Stereo）
AR	指	增强现实（Augmented Reality）技术
VR	指	虚拟现实（Virtual Reality）技术
新能源汽车“三电系统”	指	新能源汽车的动力电池、电机及电控
CCS	指	集成母排/电池连接系统（Cell Contact System），用于动力电池、储能电池等电池系统中电芯连接、信号采集和温度采集等功能的

		组件
光伏逆变器、逆变器	指	太阳能光伏发电系统中的核心部件之一，其作用是将光伏电池发出的直流电转化为符合电网电能质量要求的交流电
晶圆	指	硅晶棒在经过切片、研磨、抛光后，形成制作硅半导体电路所用的硅晶圆片
封装	指	芯片安装、固定、密封的工艺过程。发挥着实现芯片电路管脚与外部电路的连接，并防止外界杂质腐蚀芯片电路的作用
先进封装	指	在传统封装基础上，通过倒装芯片、晶圆级封装、系统级封装、2.5D/3D 封装等方式提升芯片互连密度、电性能、散热能力和系统集成度的封装技术路径
封装基板	指	直接用于搭载芯片的电路板，可为芯片提供电连接、保护、支撑、散热、组装等功效，以实现多引脚化，缩小封装产品体积、改善电性能及散热性、超高密度或多芯片模块化的目的
固晶	指	通过胶体把晶片粘结在引线框架、基板的指定区域，形成热通路或电通路，为后序的打线连接提供条件的工序
引线框架	指	一种借助于键合材料（金丝、铝丝、铜丝）实现芯片内部电路引出端与外引线的电气连接，形成电气回路的关键结构件，起到和外部导线连接的桥梁作用
倒装芯片、Flip Chip	指	在基板上沉积锡铅球，然后将芯片翻转加热利用熔融的锡铅球与陶瓷基板相接合。此技术替换常规打线接合，逐渐成为封装的主流方式，可分为 FCBGA 和 FCCSP 两种形式
BGA	指	球栅阵列封装（Ball Grid Array Package）
CSP	指	芯片尺寸封装（Chip Scale Package），封装体尺寸接近芯片本身尺寸的一类小型化封装形式，适用于轻薄化、高密度电子产品
FOG	指	Film on Glass，显示模组中的一种贴装和互连方式，通常指将 FPC 等柔性线路通过 ACF 等材料直接连接至玻璃基板，以实现驱动信号传输
AA 制程	指	主动对位制程（Active Alignment），应用于摄像头模组精密对位耦合，其通过六轴平台控制并调整镜片组和成像芯片的相对位置与姿态，精确控制镜片组的光轴中心、镜片组的位姿，包括光学焦距等关键参数，使其与成像芯片的位置得到精确控制，最终使对位耦合出来的摄像头模组成品获得最佳的成像效果
IGBT	指	绝缘栅双极型晶体管（Insulated Gate Bipolar Transistor），是由双极型晶体管（Bipolar Junction Transistor，简称“BJT”）和绝缘栅型场效应管（Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor，简称“MOSFET”）组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件
功率器件	指	用于电能转换、控制和保护的半导体器件，主要包括 IGBT、MOSFET、二极管等，广泛应用于新能源汽车、光伏、储能、工业控制等领域
射频、RF	指	Radio Frequency，指用于无线通信、信号传输和感测等场景的高频电磁波频段及相关电路、器件或系统
MEMS	指	微机电系统（Micro-Electro Mechanical System），是一种将机械结构与电子系统同时集成制造在一颗芯片上的技术，其特征尺寸一般在微米甚至纳米量级
LCD	指	液晶显示面板（Liquid Crystal Display），是在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体，透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向，将光线折射出来产生画面

应力	指	物体由于外因例如受力、湿度、温度等而变形时，在物体内各部分之间产生相互作用的内力，以抵抗外因的作用，并试图使物体从变形后的位置恢复到变形前的位置
模量	指	材料受力变形时应力与应变之间关系的参数，反映材料抵抗弹性变形的能力，模量越高通常刚性越强、柔韧性越弱
断裂延伸率	指	材料被拉断以后被拉长增加的长度与初始长度的比值，系衡量材料塑性的指标
介电常数	指	又称电容率，表征材料在电场中储存电能和极化能力的物理量，通常以相对介电常数表示；介电常数越低，材料对高频信号传输的介质影响通常越小
体积电阻率	指	材料单位体积对电流通过的阻碍能力，用于表征材料绝缘性能，数值越高通常绝缘性能越好
介电强度	指	材料在电场作用下不发生击穿所能承受的最大电场强度，是衡量绝缘材料耐电压能力的重要指标
热稳定性	指	材料在受热或温度变化条件下保持化学结构、物理形态和关键性能稳定的能力
热阻	指	热量在热流路径上遇到的阻力，反映介质或介质间的传热能力的大小
导热系数	指	在稳定传热条件下，单位厚度材料两侧单位温差时单位时间通过单位面积的热量，是衡量材料导热能力的重要指标
双 85	指	85℃温度和 85%湿度的老化测试条件
RH	指	相对湿度（Relative Humidity），表示空气中实际水汽含量与同温度下饱和水汽含量的比值
ppm	指	百万分之一（parts per million），用于表示浓度、含量、杂质水平等微量指标
dB	指	分贝（decibel），用于表示两个物理量之间比例关系的对数量纲单位，在电磁屏蔽等场景中常用于表征屏蔽效能
IP68	指	IEC 60529 等标准下的外壳防护等级，其中“6”表示防尘等级达到最高级别，“8”表示在规定条件下具备持续浸水防护能力
UL94 V-0	指	美国 UL 94 塑料材料燃烧性能测试中的垂直燃烧等级，V-0 为该垂直燃烧测试中的较高阻燃等级，要求样品在规定燃烧条件下自熄时间短且不得滴落引燃棉花
CTE、热膨胀系数	指	Coefficient of Thermal Expansion，材料温度每变化单位温度时尺寸变化量与原尺寸的比值，用于表征材料随温度变化发生胀缩的程度
Tg、玻璃态转化温度	指	Glass Transition Temperature，由玻璃态转变为高弹态所对应的温度。玻璃化转变是非晶态高分子材料固有的性质，是高分子运动形式转变的宏观体现，直接影响到材料的使用性能和工艺性能
ABS	指	丙烯腈丁二烯苯乙烯嵌段共聚物，是一种热塑性塑料合成聚合物树脂，它的平衡性能很好，能被裁剪以适合特殊需求
PA	指	尼龙、聚酰胺（Polyamide），是一种用途广泛的通用工程塑料
PC	指	聚碳酸酯，是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物
LCP	指	液晶聚合物（Liquid Crystal Polymer），一种具有高耐热、低吸湿、良好尺寸稳定性和高频电性能的高性能工程塑料，常用于电子连接器、天线、模组结构件等场景
PI	指	聚酰亚胺（Polyimide），主链上含有酰亚胺环（-CO-N-CO-）的

		一类聚合物
PSPI、光敏聚酰亚胺	指	Photosensitive Polyimide，分子结构含有光敏基团的一类聚酰亚胺，具有感光性和耐高温的特点
VOCs	指	挥发性有机物（Volatile Organic Compounds）

注：正文中若出现合计数与分项数值总和不符，均为四舍五入所致

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、重大事项提示

本公司提请投资者认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”章节全部内容，并特别提醒投资者注意以下风险因素：

（一）特别风险提示

1、下游行业竞争加剧的风险

公司电子胶粘剂主要应用于智能终端、新能源、半导体、通信等领域，受下游行业景气度影响较大。在智能终端领域，随着下游市场竞争加剧，客户对材料性能与价格竞争力提出更高标准，可能导致公司面临产品价格下行与毛利空间收窄的压力。在新能源领域，随着新能源汽车与可再生能源行业步入规模化发展阶段，竞争强度持续提升，可能影响电子胶粘剂产品的整体定价水平。在半导体领域，尽管当前电子胶粘剂国产化率仍较低、替代空间较大，但随着更多国内企业切入该赛道，以及国际龙头企业为维护市场份额采取更具竞争性的策略，若公司无法在技术性能、稳定性与综合成本方面持续保持优势，可能面临市场份额拓展不及预期的风险。综上，若电子胶粘剂下游主要应用行业竞争加剧，将对公司的经营业绩及持续成长能力产生不利影响。

2、毛利率下降的风险

公司凭借对化学材料的理解、应用经验积累及持续创新能力，使得公司产品保持较高的毛利率水平。报告期内，公司主营业务毛利率分别为 77.29%、74.74%和 77.06%。但若未来出现市场竞争进一步加剧、公司新产品开发和迭代速度放缓、产品价格及原材料采购价格发生重大不利变化、上下游行业供需情况发生重大不利变化、与客户价格条款发生重大不利变化等负面情形，则公司毛利率存在下降的风险，将对公司的经营业绩造成不利影响。

3、客户集中风险

报告期各期，公司前五大客户销售收入合计分别为 18,217.34 万元、19,808.81 万元及 25,310.75 万元，占当期营业收入总额的比例分别为 51.84%、51.47%及 55.28%，占比相对较高。同时，公司产品对应的终端品牌商较为集中，主要包括苹果、特斯拉、OPPO、华为及阳光电源等，若未来公司与主要直接客户或终端品牌商合作关系发生变化，或客户经营状况出现变化，将会对公司销售收入产生不利影响。

4、市场开拓不及预期的风险

由于电子胶粘剂对于终端产品的各项功能实现、可靠性、生产成本及效率均有关键性的影响，下游客户选择产品需要经过严苛的测试，因此倾向于与原有供应商长期合作。目前国内高性能电子胶粘剂市场主要由国外品牌主导，在公司扩展市场过程中，如果下游目标客户已有稳定供应商且更换供应商意愿较弱或国产化的意愿不足，将不利于公司开拓新客户。另一方面，公司重点拓展的新能源及半导体领域市场具有技术水平要求高的特点，若公司产品无法满足客户要求，将对公司未来业绩增长造成不利影响。

5、技术迭代、新产品研发风险

智能终端、新能源、半导体、通信等领域的终端产品迭代速度快，对电子胶粘剂的性能和品质不断提出新要求，而且不同下游应用领域的产品用胶点和功能需求存在较大差异，需要电子胶粘剂企业具有快速、高效的产品研发能力。若公司无法准确地把握下游行业的发展趋势并根据下游发展趋势进行研发创新，或者公司的技术储备无法满足客户生产应用场景需求，将导致公司无法及时研发并生产出与下游客户需求适配的产品，对公司的业务开拓和盈利能力将造成不利影响。

（二）本次发行相关的重要承诺

本公司提示投资者认真阅读公司及实际控制人、持股 5%以上的其他股东、董事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺，具体承诺事项请详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件二：与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”。

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

（一）发行人基本情况			
发行人名称	广东德聚技术股份有限公司	**成立日期**	2016 年 5 月 5 日
注册资本	7,340.70 万元	**法定代表人**	黄成生
注册地址	广东省东莞市石排镇向沙路石排段 14 号	**主要生产经营地址**	广东省东莞市石排镇向沙路石排段 14 号
控股股东	黄成生	**实际控制人**	黄成生
行业分类	C3985 电子专用材料制造	**在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况**	-
（二）本次发行的有关中介机构			
保荐人	中信证券股份有限公司	**主承销商**	中信证券股份有限公司
发行人律师	广东华商律师事务所	**其他承销机构**	无
审计机构	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	**评估机构**	中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司
发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系		截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行的中介机构之间不存在直接或间接的股权关系和其他权益关系，各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员未持有发行人股份，与发行人也不存在其他权益关系	
（三）本次发行其他有关机构			
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	**收款银行**	**【】**
其他与本次发行有关的机构		无	

三、本次发行的概况

（一）本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股（A 股）		
每股面值	1.00 元		
发行股数	不超过 24,469,000 股	**占发行后总股本比例**	不低于 25%
其中：发行新股数量	不超过 24,469,000 股	**占发行后总股本比例**	不低于 25%
股东公开发售股份数量	不适用	**占发行后总股本比例**	不适用
发行后总股本	不超过 97,876,000 股		
每股发行价格	**【】**元/股		
发行市盈率	**【】**倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算，发行后每股收益按照发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）		

发行前每股净资产	【】元/股	**发行前每股收益**	【】元/股
发行后每股净资产	【】元/股	**发行后每股收益**	【】元/股
发行市净率	【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算，每股净资产按截至报告期末经审计的归属于母公司股东的权益与募集资金净额之和除以发行后总股本计算）		
发行方式	网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或证券监管部门认可的其他方式，包括但不限于向战略投资者配售股票		
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所创业板开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止的认购者除外），或中国证监会、深圳证券交易所规定的其他对象		
承销方式	余额包销		
拟公开发售股份股东名称	不适用		
发行费用的分摊原则	不适用		
募集资金总额	【】万元		
募集资金净额	【】万元		
募集资金投资项目	德聚高端复合功能材料生产项目		
	德聚北方总部产研一体化项目		
	东莞研发中心及信息化项目		
	营销服务及技术支持中心建设项目		
	补充流动资金		
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元，包括：保荐及承销费【】万元、律师费用【】万元、审计及验资费用【】万元、发行手续费用及其他【】万元		
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况	【】		
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	【】		
拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则（如有）	不适用		
（二）本次发行上市的重要日期			
刊登发行公告日期	【】年【】月【】日		
开始询价推介日期	【】年【】月【】日		
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日		
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日		
股票上市日期	【】年【】月【】日		

四、发行人主营业务经营情况

（一）主要业务及主要产品

公司是一家专注于电子专用高分子材料的研发、生产和销售的国家重点“小巨人”企业，主要产品为电子胶粘剂，并围绕客户具体用胶场景提供配套应用方案，已形成覆盖智能终端、新能源、半导体、通信等领域的产品布局。

在各应用领域中，公司已形成以收入占比较高，或已导入客户体系具有代表性的产品为核心的产品矩阵：智能终端领域主要包括元器件包封胶、结构粘接密封胶、高可靠性环氧胶等；新能源领域主要包括磁芯粘接胶、包封补强胶、密封胶、三防漆等；半导体领域主要包括导热界面材料、底部填充胶、AA 制程胶、芯片塑封隔离膜、芯片固晶胶膜（DAF）、各向异性导电胶膜（ACF）等；通信领域主要包括电磁屏蔽胶、光模块密封胶、AI 电源模组导热粘接胶等。该等产品广泛应用于智能手机、可穿戴设备、新能源汽车、半导体功率器件、半导体芯片、5G 基站、高速光模块、AI 服务器等各类终端产品与核心设备。

（二）采购情况和重要供应商

报告期内，公司采购物料主要包括电子胶粘剂生产所需原材料、辅助材料、以及用于贸易业务的电子胶粘剂成品、胶粘剂配套设备及零配件等。其中，原材料主要用于公司自产电子胶粘剂产品生产，为公司采购物料的重要构成，主要包括环氧树脂、镍包石墨粉、丙烯酸树脂、有机硅树脂、封装用球形二氧化硅、球形氧化铝、聚氨酯树脂等。报告期内，公司采购丙烯酸树脂、镍包石墨粉、封装用球形二氧化硅、球形氧化铝、聚氨酯树脂等均价相对稳定，环氧树脂、有机硅树脂等产品均价波动主要系各期采购不同性能特性原材料的占比结构差异。总体而言，报告期内公司主要原材料供应较为稳定，主要原材料单价不存在重大波动。

报告期内，公司前五大物料供应商采购金额占当期物料采购总额的比例分别为 47.28%、42.34%和 40.72%，不存在向单一供应商采购比例超过当期采购总额 50%的情形，具体情况参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“四、公司采购情况和主要供应商”。

（三）销售模式和渠道及重要客户

目前，公司采取直销为主、经销及贸易商销售为辅的销售模式。

直销模式下，公司与耗用公司产品的生产商客户直接进行交易。对于个别直销客户，根据其库存管理及响应要求，公司采用寄售的模式。经销及贸易商销售模式下，公司将产品销售给经销商或贸易商客户后再由其销售给直接耗用公司产品的终端厂商。经销及贸易商销售模式系对公司直销模式的补充，主要目的系进一步拓宽销售渠道、扩大客户覆盖范围。经销商和贸易商的区别主要在于经销商与公司签订了经销协议，接受公司的经销管理。

公司的销售流程主要包括客户资源开发、售前服务、产品认证测试、产品交付、技术支持及售后服务。直销模式下，公司承担客户资源开发、售前服务、产品认证测试、产品交付、技术支持及售后服务的职能；经销及贸易商销售模式下，经销商及贸易商主要承担客户资源开发及产品交付的职能，产品认证测试、技术支持及售后服务仍主要由公司负责。

为了强化区域覆盖能力和服务效率，公司在东莞、深圳、苏州、上海、南通、美国、德国、韩国等地均设立了销售中心，形成点多面广、营运高效、服务优良的营销网络和售后服务体系，便于为客户提供高效、高质量的售前和售后服务。

报告期内，公司前五大客户销售金额占营业收入的比例分别为 51.84%、51.47%及 55.28%，公司主要客户包括东山精密、立讯精密、鹏鼎控股、安费诺、旗胜电子、Sanmina 等全球知名电子制造厂商或其产业链客户，具体情况参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“三、公司销售情况和主要客户”。

（四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

公司是国内主要电子胶粘剂生产商之一，专注于电子专用高分子材料的研发、生产和销售，主要为客户提供电子胶粘剂产品及配套应用方案。公司是行业内少数拥有自主开发原材料及配方能力的国家级高新技术企业，凭借研发实力、产品性能、质量稳定性，是国内少数能与汉高、陶氏化学、3M 等世界级巨头展开直接竞争，并持续推进高性能电子胶粘剂自主配套的企业之一。中国胶粘剂和胶粘带工业协会提供的资料显示，公司产品性能获得市场认可，声誉较高，已成为我国电子胶粘剂市场的领军企业，2025 年公司在中国境内市场的占有率约 1.5%，在中国境内市场的国内厂商中位居前四。

（五）主要生产模式

公司实行“以销定产、需求预测”相结合的生产模式。生产部根据销售订单及销售预测情况滚动制定生产月计划及周计划并按生产计划进行领料、生产实施；品质部负责进行制程控制。

公司电子胶粘剂产品的主要工艺流程包含原料预处理、配料称量、混合搅拌、真空搅拌、取样检测、分装、离心脱泡、入库八个环节。公司主要产品的具体工艺流程参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“一、公司主营业务、主要产品或服务情况”之“（七）主要产品工艺流程图”。

五、发行人板块定位情况

（一）公司符合创业板行业领域

公司专注于电子专用高分子材料的研发、生产和销售，主要为客户提供电子胶粘剂产品及配套应用方案，产品主要应用于智能终端、新能源、半导体、通信等领域。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为电子专用材料制造（C3985）。根据《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，公司产品所属的电子专用材料制造及相关电子级化学品和材料列入“3 新材料产业”之“3.3 先进石化化工新材料”之“3.3.6 专用化学品及材料制造”。

公司所处行业不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第五条规定的行业，不属于产能过剩行业或《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的淘汰类行业，亦不属于学前教育、学科类培训、类金融业务的企业。

（二）公司符合创业板定位相关指标要求

根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》的规定，“本所支持和鼓励符合下列标准之一的成长型创新创业企业申报在创业板发行上市：

（一）最近三年研发投入复合增长率不低于 15%，最近一年投入金额不低于 1,000 万元，且最近三年营业收入复合增长率不低于 25%；

（二）最近三年累计研发投入金额不低于 5,000 万元，且最近三年营业收入

复合增长率不低于 25%；

（三）属于制造业优化升级、现代服务业或者数字经济等现代产业体系领域，且最近三年营业收入复合增长率不低于 30%。

最近一年营业收入金额达到 3 亿元的企业，或者按照《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》等相关规则申报创业板的已境外上市红筹企业，不适用前款规定的营业收入复合增长率要求。”

公司符合上述第二款创业板定位相关指标要求，具体如下：

指标内容	是否符合	公司具体实现情况
最近三年累计研发投入金额不低于 5,000 万元	☑是 □否	公司最近三年累计研发费用金额为 19,688.33 万元
最近三年营业收入复合增长率不低于 25%	不适用	2025 年，公司营业收入为 4.58 亿元，大于 3 亿元，不适用营业收入复合增长率要求
最近一年营业收入金额达到 3 亿元的企业，或者按照《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》等相关规则申报创业板的已境外上市红筹企业，不适用前款规定的营业收入复合增长率要求	☑是 □否	

综上所述，公司符合创业板定位相关指标要求。

（三）公司自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况

1、公司围绕原材料开发与修饰、产品配方设计、生产工艺优化构建了“协同联动、交替迭代”的研发体系

电子胶粘剂属于典型的配方型、应用型功能材料，其性能取决于从原材料开发与修饰到生产工艺的多环节协同。公司围绕原材料开发与修饰、产品配方设计、生产工艺优化构建了“协同联动、交替迭代”的研发体系，实现从底层材料到终端应用的系统性研发能力闭环。

在原材料开发与修饰方面，公司围绕下游客户对产品连接、防护、导热散热、导电绝缘、应力缓冲等性能要求，通过定制合成、分子结构设计、原材料修饰等方式提升基础材料性能，进而拓展通用材料在电子制造场景中的应用边界，为差异化产品开发构建底层原材料基础。

在产品配方设计方面，公司依托丙烯酸酯、环氧树脂、有机硅、聚氨酯、改

性硅烷、杂化等六大化学体系积累，围绕客户具体用胶点，对树脂、填料、助剂等多元材料进行高效复配与动态优化，在粘接强度、模量、热膨胀系数、导热性、绝缘性、耐湿热性、工艺适配性等多性能约束下实现平衡。公司的配方设计能力建立在对客户潜在需求、产品结构、可靠性要求与具体应用场景的深度理解之上，而这一能力离不开与核心客户长期稳定的合作关系。公司凭借长期的技术积累切入客户关键项目并持续获取应用反馈，在样品开发、可靠性验证、产线适配和量产验证的反复迭代过程中形成高频互动与正反馈机制，进而又反哺公司的技术积累、需求洞察、方案适配和产品迭代，构筑“技术突破—客户绑定—能力迭代”的良好体系。

在生产工艺优化方面，公司在流体力学和多相体系共混的理论基础上，围绕材料改性、体系兼容性转变、液-液混合、固-液混合、分散、脱除空气以及非必要小分子、精确分装、检测等关键环节进行工艺控制与持续优化，使材料体系和配方设计能够转化为符合客户量产要求的产品。同时，公司产品导入需经过样品开发、客户测试、可靠性验证、小批量试用及量产验证等环节，进一步体现电子胶粘剂产品较高的技术门槛与客户认证壁垒。

依托上述“协同联动、交替迭代”的研发体系，公司有能力与全球头部客户深度协同，能够将客户应用需求、底层材料开发、配方设计和生产工艺持续联动，为公司在智能终端、新能源、半导体及通信等领域持续推出高性能电子胶粘剂产品提供研发与创新能力支撑。

2、公司以产品创新推动电子制造关键环节升级，体现新旧产业融合特征

电子胶粘剂是实现电子元器件连接的关键功能性材料。随着下游智能终端、新能源、半导体及通信等领域终端产品的迭代发展，高性能电子胶粘剂在多个制造环节中发挥着替代传统工艺、提升产品可靠性和优化生产效率的重要作用。公司将高分子材料技术与制造工艺深度结合，相关产品嵌入下游客户产品设计、生产工艺等过程，助力电子制造向高精度、高可靠性和材料功能复合化方向升级，推动核心技术在电子制造环节实现产业化应用。

在智能终端领域，随着下游产品向轻薄化、柔性化、多功能化等方向发展，FPC、PCBA 及功能模组等核心器件对电子胶粘剂的性能、可靠性及工艺适配性

提出更高要求。针对客户提出的“无丙烯酸致敏物”及“FPC 阴影区完全固化”等严苛要求，公司在兼顾多项性能指标的前提下，通过自主研发的 UV-湿气双重固化技术，开发出兼具快速固化、高粘接强度与优异柔韧性的元器件包封胶产品，系统性提升了耐化学性、生物相容性与可靠性，已成为相关产业链中的核心材料。在核心组件粘接环节，公司开发的耐高温粘接材料有效解决了传统粘接胶在无铅回流焊高温制程中普遍存在性能衰减、多基材浸润性差等问题，支撑了下游产品的高精度组装需求。

在新能源领域，围绕新能源汽车对高可靠、轻量化的核心需求，公司通过产品创新推动客户传统工艺制程革新，以性能更优的材料方案替代传统工艺方案，提升客户生产效率与产品可靠性。例如，公司通过引入络合技术，对高分子链进行自主改性，实现环氧低温快速凝胶，以胶接工艺革新传统焊接方案，已成功导入国际领先电动汽车供应链并成为关键材料。

在半导体领域，为适配半导体产业向高功率、高热密度、高可靠性发展的技术需求，公司开发出高效导热的导热界面材料。该产品达到 UL94 V-0 级无卤阻燃的高标准，在相关应用场景中成功替代传统“导热凝胶+机械固定”的分体方案，有效降低热阻并提升器件运行可靠性。

在通信领域，针对 5G 基站、数据中心等通信设备的电磁屏蔽需求，公司研制出具有低硬度、高屏蔽效能的点胶成型屏蔽导电胶。该产品依托公司自主开发的低硬度点胶成型屏蔽导电胶核心技术，解决了传统电磁屏蔽材料装配压缩力过高和屏蔽性能衰减的痛点，满足轻质复杂结构器件的特殊装配要求，以及在极端环境下长期可靠屏蔽性的要求。

3、公司以技术成果实现产业化转化，创新成果形成规模化经营贡献

公司始终重视技术研发和技术成果产业化，截至 2025 年末拥有 120 人的研发团队，占员工总数比例为 26.03%。报告期内，公司研发费用分别为 5,952.94 万元、6,936.12 万元和 6,799.27 万元，占营业收入的比例分别为 16.94%、18.02%及 14.85%。截至本招股说明书签署日，公司已获发明专利授权 65 项、实用新型专利授权 49 项，公司荣膺工业和信息化部的新一轮第一批国家重点“小巨人”企业及第三批专精特新“小巨人”企业，经广东省科学技术厅认定为“广东省新

型高端电子胶粘剂（德聚）工程技术研究中心”，经广东省工业和信息化厅认定为“第 22 批省级企业技术中心”和“2024 年广东省省级制造业单项冠军企业-丙烯酸电子胶粘剂”。

公司创新成果已形成规模化经营贡献。报告期内，公司自产电子胶粘剂收入分别为 31,851.90 万元、36,308.20 万元和 43,787.91 万元，持续增长。公司经营成果主要来源于自主研发、自主生产的电子胶粘剂产品，已通过客户导入和规模化应用将核心技术转化为主营业务收入。

（四）公司的成长性及其表征

报告期内，公司主营业务收入分别为 35,075.78 万元、38,438.74 万元、45,696.55 万元，扣非后归属母公司股东的净利润分别为 4,335.45 万元、7,724.90 万元及 12,457.28 万元，业务规模和盈利能力持续提升。

从现有业务基础看，公司已形成以智能终端、新能源、半导体、通信等领域协同拓展的产品和客户结构。公司主要向东山精密、鹏鼎控股、立讯精密、安费诺、旗胜电子、Sanmina、台郡科技、和硕、富士康等全球知名电子制造厂商直接供货，产品最终应用于苹果、特斯拉、OPPO、华为、阳光电源、比亚迪、vivo、小米、三星、宁德时代等知名终端品牌商或其产业链客户，形成了覆盖智能终端、新能源、半导体、通信等领域的规模化应用能力。由于电子胶粘剂产品需经过客户样品开发、可靠性验证、产线适配、小批量试用及量产验证等环节，客户导入周期较长，一旦进入客户供应体系并实现稳定供货，通常具备较强的客户粘性和持续迭代空间，为公司成熟产品持续放量、现有客户体系内拓展新产品和新用胶点提供了重要支撑。

从产品延展能力看，公司依托原材料开发与修饰、产品配方设计、生产工艺优化“协同联动、交替迭代”的研发体系，已在多个应用场景中形成代表性产品成果。公司原创开发的柔性电路板（FPC）用元器件包封胶已实现规模化应用；自主研发的磁芯粘接胶已导入国际领先电动汽车供应链并成为关键材料，报告期内相关产品收入实现较快增长；在半导体领域，公司亦是国内少数实现芯片级底部填充胶在倒装芯片（Flip Chip）封装等先进封装工艺中产业化应用的厂商。上述代表性产品从智能终端、新能源汽车到芯片封装场景逐步延展，形成了沿技术

门槛、可靠性要求和产品附加值持续提升的纵向应用布局。

从未来增长储备看，随着终端产品迭代、先进封装自主配套加速及新兴算力基础设施建设等需求提升，下游客户对高可靠性粘接、导热、密封、电气连接和功能防护材料的需求不断增加。公司已有多项新产品实现出货或进入客户导入后的爬坡放量阶段，包括 AI 电源粘接导热胶、光模块密封胶、导电银胶、AR 眼镜结构粘接胶、电池组粘接保护胶等，相关产品对应的客户或终端品牌商均为行业知名企业。公司将积极把握上述新兴应用带来的功能性材料需求提升机遇，在现有应用领域内，持续推动公司技术储备和客户验证成果逐步转化为规模化收入贡献，围绕新终端形态、新产品结构、新用胶点和更高可靠性要求进行横向延展。

综上所述，公司依靠核心技术开展生产经营，主营业务突出，业务规模持续增长，公司主营业务属于新产业、新业态、新模式；公司不属于原则上不支持申报在创业板发行上市的行业范围内，公司具备创新、创造、创意特征，具有良好的成长性和较强的自主创新能力，符合《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》等法律、法规或规范性文件对创业板定位的要求。

六、发行人报告期主要财务数据和财务指标

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额（万元）	130,931.95	115,469.76	101,080.92
归属于母公司所有者权益（万元）	99,610.31	86,286.22	78,728.64
资产负债率（合并）	24.74%	25.89%	22.41%
营业收入（万元）	45,786.50	38,489.05	35,139.21
净利润（万元）	12,307.74	6,745.44	4,212.79
归属于母公司所有者的净利润（万元）	12,783.97	7,164.96	4,466.50
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	12,457.28	7,724.90	4,335.45
基本每股收益（元）	1.74	0.98	0.64
稀释每股收益（元）	1.74	0.98	0.64
加权平均净资产收益率	13.75%	8.68%	6.78%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	14,465.95	10,798.25	6,663.63
现金分红（万元）	-	-	7,600.00 注

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
研发投入占营业收入的比例	14.85%	18.02%	16.94%
流动比率（倍）	4.81	2.62	5.36
速动比率（倍）	4.56	2.47	5.11
应收账款周转率（次/年）	3.06	2.63	2.49
存货周转率（次/年）	3.35	3.47	3.05

注：2023 年 1 月 30 日，发行人召开股东大会，决议以截至 2022 年末母公司报表口径的累计未分配利润为基数，向全体股东分配现金红利共计 7,600 万元（含税）。

七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息

截至本招股说明书签署日，公司经营状况良好。公司的经营模式、主要原材料采购、技术研发、生产及销售等业务、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化，公司并未编制盈利预测报告。

八、发行人选择的具体上市标准

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.2 条第（一）项规定的上市标准：最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1 亿元，且最近一年净利润不低于 6,000 万元。

公司 2024 年度和 2025 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为 7,164.96 万元和 12,457.28 万元，满足所选择的上市标准。

九、发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份、协议控制架构等公司治理特殊安排。

十、募集资金用途

（一）募集资金主要用途

公司本次发行募集资金均围绕主营业务进行投资安排，扣除发行费用后，全部用于公司主营业务相关的项目。公司于 2026 年 4 月 10 日召开第二届董事会第二次会议，于 2026 年 4 月 28 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关

于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。本次募集资金扣除发行费用后，公司将按照实际经营管理需要及市场情况有序实施以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	德聚高端复合功能材料生产项目	49,206.08	35,378.63
2	德聚北方总部产研一体化项目	21,114.57	13,498.55
3	东莞研发中心及信息化项目	16,517.05	16,517.05
4	营销服务及技术支持中心建设项目	14,653.90	14,653.90
5	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		**121,491.60**	**100,048.13**

公司将严格按照有关规定管理和使用募集资金。若募集资金不足时，缺口部分资金将由公司自筹解决。如本次发行实际募集资金净额超过预计募集资金数额的，公司将根据监管机构的有关规定使用。在完成本次公开发行前，公司将根据实际生产经营需要，以自有资金对上述项目进行前期投入，在募集资金到位后，将使用募集资金置换该部分自有资金。

公司关于本次发行募集资金拟投资项目获得相关主管部门备案或批复的具体情况如下：

序号	项目名称	投资项目备案编号	环评批复文号
1	德聚高端复合功能材料生产项目	2207-441900-04-01-379661	东环建〔2023〕10945 号
2	德聚北方总部产研一体化项目	2303-370271-89-02-694554	青环高新审〔2022〕4 号、 青环审（高新）〔2023〕15 号
3	东莞研发中心及信息化项目	2605-441900-04-01-656462	不适用
4	营销服务及技术支持中心建设项目	2605-441900-04-01-249819	不适用
5	补充流动资金	不适用	

根据生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，“东莞研发中心及信息化项目”“营销服务及技术支持中心建设项目”和“补充流动资金”实施过程均不涉及对环境可能造成重大影响的因素，无需办理环境影响评价审批手续。

（二）未来发展规划

公司将继续聚焦电子专用高分子材料领域，以电子胶粘剂为主线，围绕客户具体用胶场景推进产品迭代和产业化应用。未来，公司将依托原材料开发与修饰、产品配方设计、生产工艺优化“协同联动、交替迭代”的研发体系，持续提升连接、防护、导热散热、导电绝缘、应力缓冲等功能材料开发能力。

一方面，公司将巩固既有客户基础和应用经验积累，着力推进成熟产品迭代升级，并在现有客户体系内拓展新产品、新用胶点和新应用场景；另一方面，公司将围绕已通过或正在推进验证的智能终端、新能源、半导体、通信等领域客户，积极把握终端产品迭代、先进封装自主配套加速及新兴算力基础设施需求提升带来的功能性材料需求增长机遇，加快相关产品的客户导入、量产验证和订单转化，推动公司技术储备和客户验证成果逐步转化为规模化收入贡献。

公司将以本次募集资金投资项目建设为契机，进一步提升核心技术研发、规模化生产、快速响应及客户服务能力，更好地满足下游客户对高性能电子胶粘剂产品日益提升的应用需求。公司将长期致力于为客户提供“高技术难度、高附加值”的电子胶粘剂产品及应用方案，持续推进高性能电子胶粘剂本土化发展。

公司未来发展规划的详细情况，参见本招股说明书之“第七节 募集资金运用与未来发展规划”之“二、未来发展规划”。

十一、其他对发行人有重大影响的事项

截至本招股说明书签署之日，不存在其他对公司有重大影响的事项。

第三节 风险因素

投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。以下风险因素可能直接或间接对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生不利影响。下列风险是根据重要性原则或可能影响投资者投资决策程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

一、与公司相关的风险

（一）经营风险

1、客户集中风险

报告期各期，公司前五大客户销售收入合计分别为 18,217.34 万元、19,808.81 万元及 25,310.75 万元，占当期营业收入总额的比例分别为 51.84%、51.47%及 55.28%，占比相对较高。同时，公司产品对应的终端品牌商较为集中，主要包括苹果、特斯拉、OPPO、华为及阳光电源等，若未来公司与主要直接客户或终端品牌商合作关系发生变化，或客户经营状况出现变化，将会对公司销售收入产生不利影响。

2、市场开拓不及预期的风险

由于电子胶粘剂对于终端产品的各项功能实现、可靠性、生产成本及效率均有关键性的影响，下游客户选择产品需要经过严苛的测试，因此倾向于与原有供应商长期合作。目前国内高性能电子胶粘剂市场主要由国外品牌主导，在公司扩展市场过程中，如果目标下游客户已有稳定供应商且更换供应商意愿较弱或国产化的意愿不足，将不利于公司开拓新客户。另一方面，公司重点拓展的新能源及半导体领域市场具有技术水平要求高的特点，若公司产品无法满足客户要求，将对公司未来业绩增长造成不利影响。

3、原材料价格波动和供应风险

公司电子胶粘剂产品的主要原材料包括树脂、填料、助剂等，在电子胶粘剂的生产成本中占比较高，因此原材料价格波动将直接影响公司产品的生产成本。

同时，高性能电子胶粘剂对于原材料的性能和质量要求较高，目前部分国产原材料的性能和质量与国外仍存在一定差距，因此公司部分主要原材料需采购境外品牌产品。如果未来相关原材料供应、国际贸易环境或进口政策发生不利变化，将增加公司原材料采购难度和成本，从而影响公司的产品生产和经营业绩。

（二）技术及创新风险

1、技术迭代、新产品研发风险

智能终端、新能源、半导体、通信等领域的终端产品迭代速度快，对电子胶粘剂的性能和品质不断提出新要求，不同下游应用领域的产品用胶点和功能需求存在较大差异，需要电子胶粘剂企业具有快速、高效的产品研发能力。若公司无法准确地把握下游行业的发展趋势并根据下游发展趋势进行研发创新，或者公司的技术储备无法满足客户生产应用场景需求，将导致公司无法及时研发并生产出与下游客户需求适配的产品，对公司的业务开拓和盈利能力将造成不利影响。

2、研发人员流失风险

电子专用高分子材料行业是人才密集型行业。电子胶粘剂产品的研发是基于实验数据不断进行配方调试的过程，研发人员需要具备深刻的学科知识理解和丰富的行业应用经验。截至 2025 年末，公司有研发人员 120 人，占当期末员工总数比例 26.03%，优质且稳定的研发人员对公司生产经营具有重要作用。如未来公司薪酬水平与同行业竞争对手相比失去竞争优势，或内部晋升、激励制度得不到有效执行，可能导致研发人员的流失，从而影响公司的新产品开发进度，并对公司经营产生不利影响。

3、核心技术泄漏风险

电子专用高分子材料行业是技术密集型行业。电子胶粘剂产品的核心技术是配方以及关键的生产工艺参数，配方设计直接影响到产品的性能、成本以及公司的市场竞争力。当前公司有多项技术和产品处于在研阶段，核心技术保密对于公司尤为重要。如果未来公司在经营过程中因技术信息保管不善、技术人员流失、个别员工工作疏忽或违规操作等导致核心技术泄密，将对公司发展产生不利影响。

（三）财务风险

1、毛利率下降的风险

公司凭借对化学材料的理解、应用经验积累及持续创新能力，使得公司产品保持较高的毛利率水平。报告期内，公司主营业务毛利率分别为 77.29%、74.74%和 77.06%。但若未来出现市场竞争进一步加剧、公司新产品开发和迭代速度放缓、产品价格及原材料采购价格发生重大不利变化、上下游行业供需情况发生重大不利变化、与客户价格条款发生重大不利变化等负面情形，则公司毛利率存在下降的风险，将对公司的经营业绩造成不利影响。

2、固定资产折旧及减值风险

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 13,756.95 万元、28,187.14 万元和 34,543.90 万元，占总资产的比例分别为 13.61%、24.41%及 26.38%；公司在建工程账面价值分别为 13,044.17 万元、9,541.65 万元和 11,751.37 万元，占总资产的比例分别为 12.90%、8.26%及 8.98%。随着公司募投项目相关在建工程转入固定资产，新增机器设备等固定资产投入使用后将相应增加折旧费用。若相关产能释放、产品销售或经营效益未达预期，新增折旧费用将对公司盈利水平产生不利影响。同时，若固定资产实际使用情况或预计可收回金额低于账面价值，公司存在对相关固定资产计提减值准备的风险，从而对公司的利润造成不利影响。

3、应收账款无法收回的风险

报告期各期末，公司应收账款的账面价值分别为 14,750.80 万元、14,513.88 万元和 15,410.22 万元，占各期末流动资产的比例为 26.74%、27.98%及 24.56%。虽然公司客户主要系境内外上市公司及其子公司，资信和回款能力良好，但随着公司营业收入规模的不断提高、新应用场景的进一步拓展，公司客户数量及应收账款余额或将持续增长，如果部分客户支付能力不及预期，出现拖延付款等现象，公司将面临无法及时收回货款的风险。

4、商誉减值风险

报告期内，公司于 2023 年对子公司深圳美科泰和上海锐朗分别计提商誉减值 2,683.45 万元和 331.23 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司商誉为 648.95 万元，如果后续宏观经济环境或下游行业出现趋势性下降，被收购公司未来运营和

盈利状况未达预期，则公司商誉可能面临继续减值的风险。

5、存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 2,619.36 万元、3,003.00 万元及 3,284.11 万元，占各期末流动资产比重分别为 4.75%、5.79%和 5.23%。存货账面价值整体呈上升趋势，主要因为公司生产经营规模的提升，公司加大生产备货所致。报告期内，公司已按照存货成本与可变现净值孰低原则计提了相应的存货跌价准备。未来，如果因客户或市场需求变动，公司不能及时消化现有库存或主要产品的价格出现下滑，可能导致存货出现滞销以及减值的风险，将对公司的现金流转与财务状况造成不利影响。

6、汇率波动风险

公司采购及销售活动均存在使用美元、欧元、韩元和日元等外币交易的情形，导致因汇率波动产生的汇兑损益。报告期各期，公司汇兑损益分别为-118.67 万元、-15.60 万元和 126.10 万元，虽然对公司业绩影响较小，但随着公司生产经营规模的扩大，其影响规模可能呈上升趋势。若未来人民币兑外币汇率波动幅度扩大，可能导致公司产生金额较大的汇兑损益，进而影响公司利润。

7、税收优惠政策变化的风险

公司为高新技术企业，享受减按 15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。公司现行有效的高新技术企业证书将于 2027 年 12 月到期，若相关证书到期后，未能被重新认定为高新技术企业，或国家关于高新技术企业的税收优惠政策发生变化，公司经营业绩将受到一定影响。

（四）法律风险

目前，公司部分租赁房屋的出租方因历史原因未办理租赁房屋的产权证书，部分租赁房屋因出租方等原因未能办理租赁备案。若公司后续无法继续租赁前述房屋，则会对公司生产经营的稳定性产生不利影响。

二、与行业相关的风险

（一）下游行业竞争加剧的风险

公司电子胶粘剂主要应用于智能终端、新能源、半导体、通信等领域，受下

游行业景气度影响较大。在智能终端领域，随着下游市场竞争加剧，客户对材料性能与价格竞争力提出更高标准，可能导致公司面临产品价格下行与毛利空间收窄的压力。在新能源领域，随着新能源汽车与可再生能源行业步入规模化发展阶段，竞争强度持续提升，可能影响电子胶粘剂产品的整体定价水平。在半导体领域，尽管当前电子胶粘剂国产化率仍较低、替代空间较大，但随着更多国内企业切入该赛道，以及国际龙头企业为维护市场份额采取更具竞争性的策略，若公司无法在技术性能、稳定性与综合成本方面持续保持优势，可能面临市场份额拓展不及预期的风险。综上，若电子胶粘剂下游主要应用行业竞争加剧，将对公司的经营业绩及持续成长能力产生不利影响。

三、其他风险

（一）发行失败风险

公司本次申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，发行结果将受到证券市场整体情况、国内外宏观经济环境、公司发展前景、投资者对本次发行方案的认可程度及股票价格未来趋势判断等多种因素的影响，可能存在因投资者认购不足而导致发行失败的风险。

（二）募集资金投资项目实施及新增产能不能被有效消化的风险

公司本次募集资金拟投资于“德聚高端复合功能材料生产项目”、“德聚北方总部产研一体化项目”、“东莞研发中心及信息化项目”、“营销服务及技术支持中心建设项目”等。这些项目的可行性是基于当前市场环境和行业发展趋势的判断。在项目实施过程中，可能面临因宏观经济变化、产业政策调整、市场竞争加剧等因素导致的项目延期或投资回报不及预期的风险。项目建成后，公司的产能将大幅提升，固定资产规模及折旧费用亦将相应增加。如果届时市场需求增长不及预期，或公司市场开拓不力，新增产能将面临无法被有效消化的风险，从而对公司的经营成果和盈利能力产生不利影响。

第四节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称	广东德聚技术股份有限公司
英文名称	Guangdong CollTech Technology Co., Ltd.
注册资本	7,340.70 万元
法定代表人	黄成生
有限公司成立日期	2016 年 5 月 5 日
股份有限公司成立日期	2023 年 5 月 30 日
公司住所	广东省东莞市石排镇向沙路石排段 14 号
邮政编码	523331
联系电话	0769-89066909
传真	0769-89066901
互联网网址	http://www.colltechgroup.cn
电子信箱	ir@colltech.cn
负责信息披露和投资者关系的部门	证券事务部
董事会秘书	姚进
联系电话	0769-89066909

二、发行人设立及重大资产重组情况

发行人设立及报告期初至本招股说明书签署日的股本、股东变化的简要情况如下：

有限公司设立情况			
时间	**事项**	**股东**	**具体变动**
2016 年 5 月	有限公司设立（注册资本 1,000 万元）	伯乐通 100%	-
报告期期初至今股东和股本变化以及股份有限公司设立情况			
时间	**事项**	**股东**	**具体变动**
报告期期初	注册资本 6,683.8851 万元	黄成生 32.8527% 余珩 19.6369% 王延鲲 16.2613% 赣州德熙 10.1556% 德利润兴 9.0493%	-

		英特尔 5.2280% 全德学镂科芯 3.4853% 赣州德悦 1.8708% 赣州御朗 0.8264% 全德学亨芯 0.6337%	
2023 年 2 月	股权转让（注册资本 6,683.8851 万元）	黄成生 32.8527% 余珩 15.9160% 王延鲲 14.9825% 赣州德熙 10.1556% 德利润兴 9.0493% 英特尔 5.2280% 全德学镂科芯 3.4853% 嘉兴弘玺 3.2248% 赣州德悦 1.8708% 美桐十一期 1.7749% 赣州御朗 0.8264% 全德学亨芯 0.6337%	1、王延鲲将其持有的 1.2788%股权（对应注册资本 85.4735 万元）以 2,302.00 万元的价格转让给美桐十一期； 2、余珩将其持有的 0.4961%股权（对应注册资本 33.1588 万元）以 893.00 万元的价格转让给美桐十一期； 3、余珩将其持有的 3.2248%股权（对应注册资本 215.5419 万元）以 5,805.00 万元的价格转让给嘉兴弘玺。
2023 年 5 月	整体变更设立股份有限公司（注册资本 6,683.8851 万元）	黄成生 32.8527% 余珩 15.9160% 王延鲲 14.9825% 赣州德熙 10.1556% 德利润兴 9.0493% 英特尔 5.2280% 全德学镂科芯 3.4853% 嘉兴弘玺 3.2248% 赣州德悦 1.8708% 美桐十一期 1.7749% 赣州御朗 0.8264% 全德学亨芯 0.6337%	德聚技术设立
2023 年 6 月	增资（注册资本 7,340.7000 万元）	黄成生 29.9131% 余珩 14.4919% 王延鲲 13.6419% 赣州德熙 9.2469% 德利润兴 8.2396% 英特尔 4.7602% 全德学镂科芯 3.1735% 嘉兴弘玺 2.9363% 赣州德悦 1.7034% 美桐十一期 1.6161% 九州舜创 1.2416% 鹏鼎投资 1.0347% 青岛生润 0.8278% 鑫弘元通 0.8278% 赣州御朗 0.7525% 勤合投资 0.6208% 勤道投资 0.6208% 东莞科创 0.6208%	鹏鼎投资、九州舜创、青岛生润、鑫弘元通、勤合投资、勤道投资、东莞科创、高梧启明、广东省半导体基金、邦信同盈、立夏一号、镂科芯二期、昆仑鼎天、厚雪投资、创盈健科及苏明合计认缴新增注册资本 656.8149 万元

		高梧启明 0.6208% 全德学亨芯 0.5770% 苏明 0.5380% 广东省半导体基金 0.4967% 邦信同盈 0.4139% 立夏一号 0.4139% 镂科芯二期 0.2069% 昆仑鼎天 0.2069% 厚雪投资 0.2069% 创盈健科 0.0493%	
2024 年 12 月至 2026 年 1 月	股权转让（注册资本 7,340.7000 万元）	黄成生 29.9131% 余珩 14.4919% 王延鲲 9.7498% 赣州德熙 9.2469% 英特尔 4.7602% 全德学镂科芯 3.1735% 赣州德悦 1.7034% 九州舜创 1.2416% 鹏鼎投资 1.0347% 青岛生润 0.8277% 鑫弘元通 0.8277% 勤合投资 0.6208% 勤道投资 0.6208% 东莞科创 0.6208% 高梧启明 0.6208% 全德学亨芯 0.5770% 苏明 0.5380% 广东省半导体基金 0.4967% 邦信同盈 0.4139% 立夏一号 0.4139% 镂科芯二期 0.2069% 昆仑鼎天 0.2069% 厚雪投资 0.2069% 创盈健科 0.0493% 厦门汇桥 1.3796% 广东立湾 0.6898% 宁波高易 0.4599% 宁波立湾 0.9657% 远智芯创投 1.6095% 东证常平 0.2299% 东莞科创接力 0.6898% 东莞科创知产 0.4599% 东莞柏凯 0.4599% 元禾璞华 2.2993% 国企创新 1.3796% 越秀甬元 1.3796% 韦豪泰达 0.4599% 韦豪镇鑫 0.4599% 中广投资 1.0655%	德利润兴、嘉兴弘玺、美桐十一期、赣州御朗、王延鲲 5 名股东向厦门汇桥、广东立湾等 17 名投资者转让股份

		海盐鋆昊 2.7592% 五方九派 0.6898%	
2026 年 4 月	股权转让（注册资本 7,340.7000 万元）	黄成生 29.4863% 余珩 14.4919% 王延鲲 9.7498% 赣州德熙 9.2469% 英特尔 4.7602% 全德学镂科芯 3.1735% 赣州德悦 1.7034% 九州舜创 1.2416% 鹏鼎投资 1.0347% 青岛生润 0.8277% 鑫弘元通 0.8277% 勤合投资 0.6208% 勤道投资 0.6208% 东莞科创 0.6208% 高梧启明 0.6208% 全德学亨芯 0.5770% 苏明 0.5380% 广东省半导体基金 0.4967% 邦信同盈 0.4139% 立夏一号 0.4139% 镂科芯二期 0.2069% 昆仑鼎天 0.2069% 厚雪投资 0.2069% 创盈健科 0.0493% 厦门汇桥 1.3796% 广东立湾 0.6898% 宁波高易 0.4599% 宁波立湾 0.9657% 远智芯创投 1.6095% 东证常平 0.2299% 东莞科创接力 0.6898% 东莞科创知产 0.4599% 东莞柏凯 0.4599% 元禾璞华 2.2993% 国企创新 1.3796% 越秀甬元 1.3796% 韦豪泰达 0.4599% 韦豪镇鑫 0.4599% 中广投资 1.0655% 海盐鋆昊 2.7592% 五方九派 0.6898% 德森伯格 0.4268%	黄成生向员工持股平台德森伯格转让股份

（一）设立情况及设立方式

1、有限责任公司的设立情况

公司前身为成立于 2016 年 5 月 5 日的德聚有限。

2016 年 4 月 27 日，伯乐通签署了《东莞市德聚胶接技术有限公司章程》，同意设立德聚有限，注册资本为 1,000 万元，全部由伯乐通认缴。

2016 年 5 月 5 日，东莞工商行政管理局核准德聚有限设立。

德聚有限设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	伯乐通	1,000.00	100.00
合计		**1,000.00**	**100.00**

根据东莞市欣瑞会计师事务所（普通合伙）2021 年 12 月 27 日出具的《验资报告》（欣瑞验字[2021]第 A2009 号），伯乐通已向德聚有限实际缴纳出资额 1,000 万元，出资形式均为货币。

2、股份有限公司的设立情况

德聚技术系由德聚有限以整体变更的方式发起设立。

2023 年 4 月 25 日，大华会计师出具了《审计报告》（大华审字[2023]002241 号），截至审计基准日 2023 年 2 月 28 日，德聚有限经审计的净资产值为 49,643.8525 万元。

2023 年 4 月 26 日，中联国际出具了《资产评估报告》（中联国际评字[2023]第 XHMPB0362 号），截至评估基准日 2023 年 2 月 28 日，德聚有限净资产评估值为 51,924.6849 万元。

2023 年 4 月 27 日，德聚有限召开股东会，同意德聚有限整体变更为股份有限公司，以德聚有限截至 2023 年 2 月 28 日经审计净资产值 49,643.8525 万元按照 1:0.1346 的折股比例折为股本 6,683.8851 万股，股份有限公司的注册资本为 6,683.8851 万元，其余 42,959.9674 万元计入股份有限公司的资本公积金，股份有限公司所有发起人股东按照德聚有限关于整体变更为股份有限公司的股东会召开之日登记在册的各自在德聚有限的出资比例持有相应的股份数额。

2023 年 4 月 27 日，德聚有限全体股东签署《发起人协议》，同意将德聚有限整体变更为股份有限公司。

2023 年 5 月 12 日，德聚技术召开创立大会暨 2023 年第一次临时股东大会，

全体发起人出席了会议，审议通过了与公司设立相关的议案。

根据大华会计师2023年5月12日出具的《广东德聚技术股份有限公司（筹）验资报告》（大华验字[2023]000274号），截至2023年5月12日，德聚技术已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计6,683.8851万元，均系以德聚有限截至2023年2月28日的净资产折股投入，共计6,683.8851万股，每股面值1元，净资产折合股本后的余额转为资本公积。

2023年5月30日，东莞市市场监督管理局出具《登记通知书》对上述变更事宜进行了核准，并向德聚技术核发了《营业执照》（91441900MA4UP9LB6X）。

德聚技术设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	黄成生	2,195.8344	32.8527
2	余珩	1,063.8091	15.9160
3	王延鲲	1,001.4122	14.9825
4	赣州德熙	678.7867	10.1556
5	德利润兴	604.8454	9.0493
6	英特尔	349.4335	5.2280
7	全德学镂科芯	232.9557	3.4853
8	嘉兴弘玺	215.5419	3.2248
9	赣州德悦	125.0396	1.8708
10	美桐十一期	118.6323	1.7749
11	赣州御朗	55.2387	0.8264
12	全德学亨芯	42.3556	0.6337
合计		**6,683.8851**	**100.0000**

（二）报告期期初至今的股本和股东变化情况

1、报告期期初，发行人的股本及股东情况

报告期期初，德聚有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	黄成生	2,195.8344	2,195.8344	32.8527
2	余珩	1,312.5098	1,312.5098	19.6369
3	王延鲲	1,086.8857	1,086.8857	16.2613

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
4	赣州德熙	678.7867	678.7867	10.1556
5	德利润兴	604.8454	604.8454	9.0493
6	英特尔	349.4335	349.4335	5.2280
7	全德学镂科芯	232.9557	232.9557	3.4853
8	赣州德悦	125.0396	125.0396	1.8708
9	赣州御朗	55.2387	55.2387	0.8264
10	全德学亨芯	42.3556	42.3556	0.6337
合计		**6,683.8851**	**6,683.8851**	**100.0000**

2、2023 年 2 月，德聚有限股权转让

2023 年 2 月 20 日，德聚有限股东会作出决议，同意王延鲲将其持有的 1.2788%股权（对应注册资本 85.4735 万元）以 2,302.00 万元的价格转让给美桐十一期，同意余珩将其持有的 0.4961%股权（对应注册资本 33.1588 万元）以 893.00 万元的价格转让给美桐十一期，同意余珩将其持有的 3.2248%股权（对应注册资本 215.5419 万元）以 5,805.00 万元的价格转让给嘉兴弘玺，转让价格均为 26.93 元/注册资本。

2023 年 2 月 20 日，王延鲲与美桐十一期签署了《股权转让协议》，余珩分别与美桐十一期、嘉兴弘玺签署了《股权转让协议》，就上述股权转让事宜进行了约定。

2023 年 2 月 28 日，德聚有限依法在东莞市市场监督管理局办理完毕变更登记手续。

本次股权转让完成后，德聚有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	黄成生	2,195.8344	2,195.8344	32.8527
2	余珩	1,063.8091	1,063.8091	15.9160
3	王延鲲	1,001.4122	1,001.4122	14.9825
4	赣州德熙	678.7867	678.7867	10.1556
5	德利润兴	604.8454	604.8454	9.0493
6	英特尔	349.4335	349.4335	5.2280

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
7	全德学镂科芯	232.9557	232.9557	3.4853
8	嘉兴弘玺	215.5419	215.5419	3.2248
9	赣州德悦	125.0396	125.0396	1.8708
10	美桐十一期	118.6323	118.6323	1.7749
11	赣州御朗	55.2387	55.2387	0.8264
12	全德学亨芯	42.3556	42.3556	0.6337
合计		**6,683.8851**	**6,683.8851**	**100.0000**

3、2023 年 5 月，德聚有限整体变更为股份有限公司

德聚有限于 2023 年 5 月整体变更为股份有限公司，具体参见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“二、发行人设立及重大资产重组情况”之“（一）设立情况及设立方式”之“2、股份有限公司的设立情况”。

4、2023 年 6 月，股份公司设立后增资

2023 年 5 月 27 日及 2023 年 6 月 12 日，公司分别召开第一届董事会第二次会议及 2023 年第二次临时股东大会并作出决议，同意将德聚技术注册资本由 6,683.8851 万元增至 7,340.7000 万元，新增注册资本 656.8149 万元，由鹏鼎投资、九州舜创、青岛生润、鑫弘元通、勤合投资、勤道投资、东莞科创、高梧启明、广东省半导体基金、邦信同盈、立夏一号、镂科芯二期、昆仑鼎天、厚雪投资、创盈健科及苏明以现金 21,619.0631 万元认缴，溢价部分计入资本公积。

根据大华会计师出具的《广东德聚技术股份有限公司历次出资复核报告》（大华核字[2023]0014771 号），截至 2023 年 6 月 19 日，德聚技术已收到鹏鼎投资、九州舜创、青岛生润、鑫弘元通、勤合投资、勤道投资、东莞科创、高梧启明、广东省半导体基金、邦信同盈、立夏一号、镂科芯二期、昆仑鼎天、厚雪投资、创盈健科及苏明缴纳的出资额合计 21,619.0631 万元，其中，656.8149 万元计入股本，20,962.2482 万元计入资本公积，均以货币形式出资。

2023 年 6 月 27 日，公司依法在东莞市市场监督管理局办理完毕变更登记手续。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1	黄成生	21,958,344	29.9131
2	余珩	10,638,091	14.4919
3	王延鲲	10,014,122	13.6419
4	赣州德熙	6,787,867	9.2469
5	德利润兴	6,048,454	8.2396
6	英特尔	3,494,335	4.7602
7	全德学镂科芯	2,329,557	3.1735
8	嘉兴弘玺	2,155,419	2.9363
9	赣州德悦	1,250,396	1.7034
10	美桐十一期	1,186,323	1.6161
11	九州舜创	911,439	1.2416
12	鹏鼎投资	759,532	1.0347
13	青岛生润	607,626	0.8278
14	鑫弘元通	607,626	0.8278
15	赣州御朗	552,387	0.7525
16	勤合投资	455,719	0.6208
17	勤道投资	455,719	0.6208
18	东莞科创	455,719	0.6208
19	高梧启明	455,719	0.6208
20	全德学亨芯	423,556	0.5770
21	苏明	394,957	0.5380
22	广东省半导体基金	364,576	0.4967
23	邦信同盈	303,813	0.4139
24	立夏一号	303,813	0.4139
25	镂科芯二期	151,906	0.2069
26	昆仑鼎天	151,906	0.2069
27	厚雪投资	151,906	0.2069
28	创盈健科	36,173	0.0493
合计		**73,407,000**	**100.0000**

5、2024 年 12 月至 2026 年 1 月期间的股份转让

2024 年 12 月 12 日，美桐十一期与厦门汇桥签署《股权转让协议》，约定美桐十一期将其持有的公司 1.3796%股份（对应注册资本 101.2710 万元）以

3,000.00 万元的价格转让给厦门汇桥。

2025 年 3 月 13 日，赣州御朗与广东立湾签署《股权转让协议》，约定赣州御朗将其持有的公司 0.6898%股份（对应注册资本 50.6355 万元）以 1,500.00 万元的价格转让给广东立湾。

2025 年 3 月 23 日，嘉兴弘玺与宁波高易签署《股权转让协议》，约定嘉兴弘玺将其持有的公司 0.4599%股份（对应注册资本 33.7570 万元）以 1,000.00 万元的价格转让给宁波高易。

2025 年 5 月 12 日，赣州御朗与宁波立湾签署《股权转让协议》，约定赣州御朗将其持有的公司 0.0627%股份（对应注册资本 4.6032 万元）以 136.3630 万元的价格转让给宁波立湾。

2025 年 5 月 12 日，嘉兴弘玺与宁波立湾签署《股权转让协议》，约定嘉兴弘玺将其持有的公司 0.4599%股份（对应注册资本 33.7570 万元）以 1,000.00 万元的价格转让给宁波立湾。

2025 年 5 月 12 日，王延鲲与宁波立湾签署《股权转让协议》，约定王延鲲将其持有的公司 0.4431%股份（对应注册资本 32.5295 万元）以 963.6370 万元的价格转让给宁波立湾。

2025 年 6 月 10 日，嘉兴弘玺与远智芯创投签署《股权转让协议》，约定嘉兴弘玺将其持有的公司 1.6095%股份（对应注册资本 118.1495 万元）以 3,500.00 万元的价格转让给远智芯创投。

2025 年 6 月 27 日，嘉兴弘玺与东证常平签署《股权转让协议》，约定嘉兴弘玺将其持有的公司 0.2299%股份（对应注册资本 16.8785 万元）以 500.00 万元的价格转让给东证常平。

2025 年 6 月 30 日，嘉兴弘玺与东莞科创知产签署《股权转让协议》，约定嘉兴弘玺将其持有的公司 0.1771%股份（对应注册资本 12.9999 万元）以 385.1020 万元的价格转让给东莞科创知产。

2025 年 6 月 30 日，美桐十一期与东莞科创知产签署《股权转让协议》，约定美桐十一期将其持有的公司 0.2365%股份（对应注册资本 17.3613 万元）以

514.3025 万元的价格转让给东莞科创知产。

2025 年 6 月 30 日，德利润兴与东莞科创知产签署《股权转让协议》，约定德利润兴将其持有的公司 0.0463%股份（对应注册资本 3.3958 万元）以 100.5955 万元的价格转让给东莞科创知产。

2025 年 6 月 30 日，德利润兴与东莞科创接力签署《股权转让协议》，约定德利润兴将其持有的公司 0.6898%股份（对应注册资本 50.6355 万元）以 1,500.00 万元的价格转让给东莞科创接力。

2025 年 7 月 7 日，德利润兴与东莞柏凯签署《股权转让协议》，约定德利润兴将其持有的公司 0.4599%股份（对应注册资本 33.7570 万元）以 1,000.00 万元的价格转让给东莞柏凯。

2025 年 7 月 16 日，德利润兴与元禾璞华签署《股权转让协议》，约定德利润兴将其持有的公司 2.2993%股份（对应注册资本 168.7848 万元）以 5,000.00 万元的价格转让给元禾璞华，分两次完成转让：首次转让所持公司 1.6555%股份（对应注册资本 121.5251 万元），转让对价为 3,600.00 万元；第二次转让所持公司 0.6438%股份（对应注册资本 47.2597 万元），转让对价为 1,400.00 万元。

2025 年 7 月 31 日，德利润兴与越秀甬元签署《股权转让协议》，约定德利润兴将其持有的公司 1.3796%股份（对应注册资本 101.2710 万元）以 3,000.00 万元的价格转让给越秀甬元。

2025 年 7 月 31 日，德利润兴与国企创新签署《股权转让协议》，约定德利润兴将其持有的公司 1.3796%股份（对应注册资本 101.2710 万元）以 3,000.00 万元的价格转让给国企创新。

2025 年 8 月 8 日，德利润兴与韦豪泰达签署《股权转让协议》，约定德利润兴将其持有的公司 0.4599%股份（对应注册资本 33.7570 万元）以 1,000.00 万元的价格转让给韦豪泰达。

2025 年 8 月 8 日，德利润兴与韦豪镇鑫签署《股权转让协议》，约定德利润兴将其持有的公司 0.4599%股份（对应注册资本 33.7570 万元）以 1,000.00 万元的价格转让给韦豪镇鑫。

2025 年 10 月 29 日，德利润兴与中广投资签署《股权转让协议》，约定德利润兴将其持有的公司 1.0655%股份（对应注册资本 78.2163 万元）以 2,317.0406 万元的价格转让给中广投资。

2025 年 12 月 31 日，王延鲲与海盐鋆昊签署《股权转让协议》，约定王延鲲将其持有的公司 2.7592%股份（对应注册资本 202.5420 万元）以 6,000.00 万元的价格转让给海盐鋆昊。

2025 年 12 月 31 日，王延鲲与五方九派签署《股权转让协议》，约定王延鲲将其持有的公司 0.6898%股份（对应注册资本 50.6355 万元）以 1,500.00 万元的价格转让给五方九派。

上述股份转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1	黄成生	21,958,344	29.9131
2	余珩	10,638,091	14.4919
3	王延鲲	7,157,052	9.7498
4	赣州德熙	6,787,867	9.2469
5	英特尔	3,494,335	4.7602
6	全德学镂科芯	2,329,557	3.1735
7	赣州德悦	1,250,396	1.7034
8	九州舜创	911,439	1.2416
9	鹏鼎投资	759,532	1.0347
10	青岛生润	607,626	0.8277
11	鑫弘元通	607,626	0.8277
12	勤合投资	455,719	0.6208
13	勤道投资	455,719	0.6208
14	东莞科创	455,719	0.6208
15	高梧启明	455,719	0.6208
16	全德学亨芯	423,556	0.5770
17	苏明	394,957	0.5380
18	广东省半导体基金	364,576	0.4967
19	邦信同盈	303,813	0.4139
20	立夏一号	303,813	0.4139

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
21	镂科芯二期	151,906	0.2069
22	昆仑鼎天	151,906	0.2069
23	厚雪投资	151,906	0.2069
24	创盈健科	36,173	0.0493
25	厦门汇桥	1,012,710	1.3796
26	广东立湾	506,355	0.6898
27	宁波高易	337,570	0.4599
28	宁波立湾	708,897	0.9657
29	远智芯创投	1,181,495	1.6095
30	东证常平	168,785	0.2299
31	东莞科创接力	506,355	0.6898
32	东莞科创知产	337,570	0.4599
33	东莞柏凯	337,570	0.4599
34	元禾璞华	1,687,848	2.2993
35	国企创新	1,012,710	1.3796
36	越秀甬元	1,012,710	1.3796
37	韦豪泰达	337,570	0.4599
38	韦豪镇鑫	337,570	0.4599
39	中广投资	782,163	1.0655
40	海盐鋆昊	2,025,420	2.7592
41	五方九派	506,355	0.6898
合计		**73,407,000**	**100.0000**

6、2026 年 4 月的股权转让

2026 年 3 月 20 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议了《关于公司实施股权激励的议案》的议案。同意公司设立员工持股平台上海德森伯格企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对公司的高级管理人员和核心骨干实施股权激励。黄成生将其持有的公司 313,332 股的股份（股份占比 0.4268%）转让给上海德森伯格，参考公司已有三个员工持股平台的增资价格 4.48 元/股，本次转让价格为 4.50 元/股，激励对象通过认缴员工持股平台财产份额方式间接持有公司股份。本次股权激励的激励对象为姚进、杜武林、尹建明。

2026 年 3 月 23 日，黄成生与德森伯格签署《股权转让协议》，约定黄成生

将其持有的公司 0.4268%股份（对应注册资本 31.3332 万元）以 141.00 万元的价格转让给德森伯格，德森伯格于 2026 年 4 月 9 日支付股份转让价款。

上述股份转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1	黄成生	21,645,012	29.4863
2	余珩	10,638,091	14.4919
3	王延鲲	7,157,052	9.7498
4	赣州德熙	6,787,867	9.2469
5	英特尔	3,494,335	4.7602
6	全德学镂科芯	2,329,557	3.1735
7	赣州德悦	1,250,396	1.7034
8	九州舜创	911,439	1.2416
9	鹏鼎投资	759,532	1.0347
10	青岛生润	607,626	0.8277
11	鑫弘元通	607,626	0.8277
12	勤合投资	455,719	0.6208
13	勤道投资	455,719	0.6208
14	东莞科创	455,719	0.6208
15	高梧启明	455,719	0.6208
16	全德学亨芯	423,556	0.5770
17	苏明	394,957	0.5380
18	广东省半导体基金	364,576	0.4967
19	邦信同盈	303,813	0.4139
20	立夏一号	303,813	0.4139
21	镂科芯二期	151,906	0.2069
22	昆仑鼎天	151,906	0.2069
23	厚雪投资	151,906	0.2069
24	创盈健科	36,173	0.0493
25	厦门汇桥	1,012,710	1.3796
26	广东立湾	506,355	0.6898
27	宁波高易	337,570	0.4599
28	宁波立湾	708,897	0.9657
29	远智芯创投	1,181,495	1.6095

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
30	东证常平	168,785	0.2299
31	东莞科创接力	506,355	0.6898
32	东莞科创知产	337,570	0.4599
33	东莞柏凯	337,570	0.4599
34	元禾璞华	1,687,848	2.2993
35	国企创新	1,012,710	1.3796
36	越秀甬元	1,012,710	1.3796
37	韦豪泰达	337,570	0.4599
38	韦豪镇鑫	337,570	0.4599
39	中广投资	782,163	1.0655
40	海盐鋆昊	2,025,420	2.7592
41	五方九派	506,355	0.6898
42	德森伯格	313,332	0.4268
合计		**73,407,000**	**100.0000**

本次股份转让完成后至本招股说明书签署日，公司的股本及股东未发生变化。

（三）发行人报告期内重大资产重组情况

报告期内，公司未发生重大资产重组。

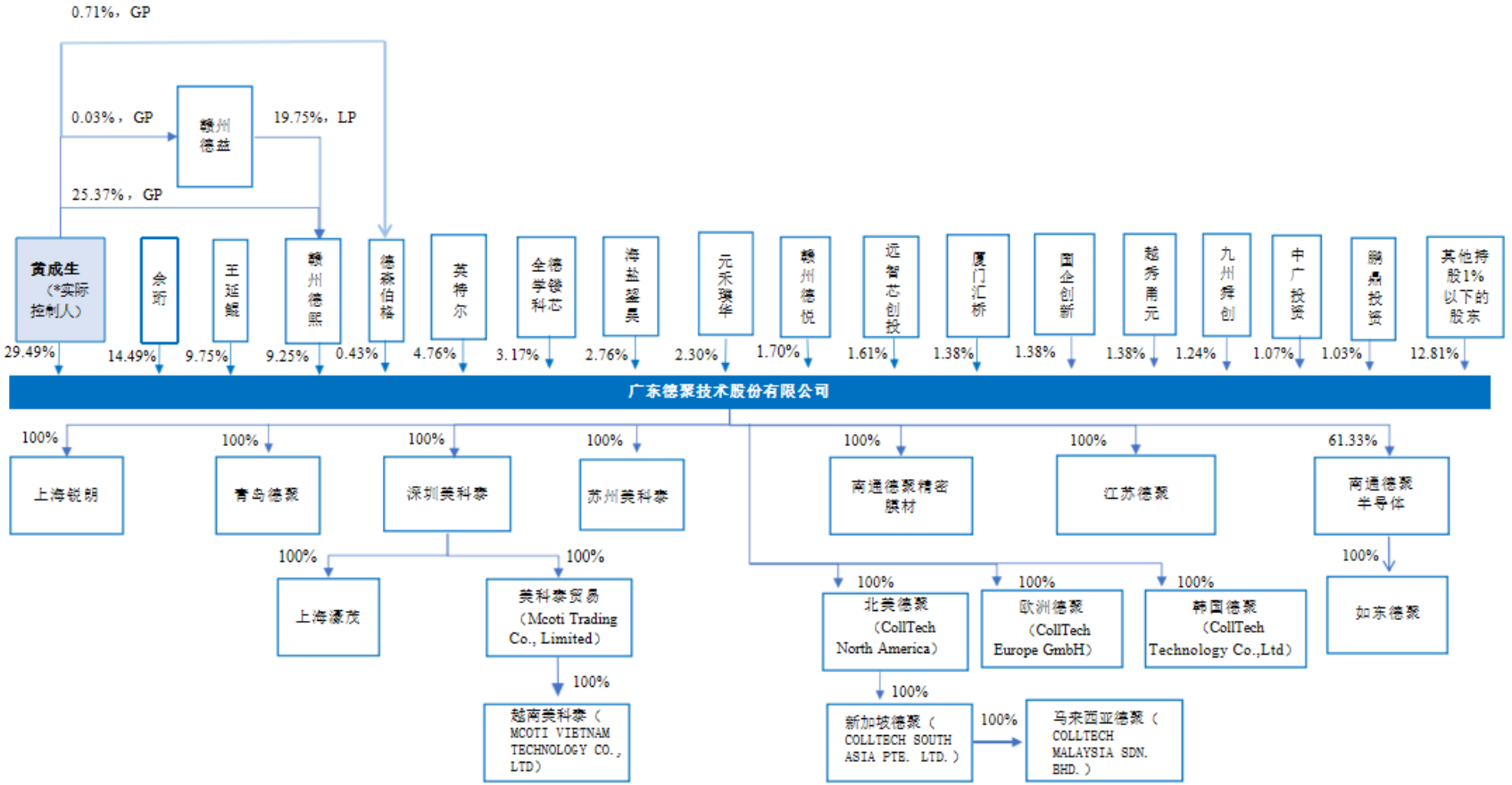
（四）发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况

截至本招股说明书签署日，公司未在其他证券市场上市或挂牌。公司 2023 年曾申报科创板上市并于 2023 年 12 月 29 日获得上海证券交易所正式受理，于 2024 年 5 月 9 日撤销上市申请，上海证券交易所于 2024 年 6 月 24 日终止审核。

三、发行人股权结构及控股子公司、分公司、参股公司情况

（一）发行人股权结构图

截至本招股说明书签署日，公司股权结构如下：



（二）发行人控股子公司、分公司、参股公司情况

截至本招股说明书签署日，公司拥有 16 家控股子公司，无参股公司。此外，公司报告期内注销 2 家控股子公司、1 家分公司以及转让 1 家参股公司。上述子公司、分公司、参股公司基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本	持股比例	成立时间	入股时间	主营业务
1	深圳美科泰	500 万元	公司持股 100%	2008-11-28	2020-12-25 收购	电子胶粘剂材料、胶粘剂施用和固化设备的销售服务
2	苏州美科泰	500 万元	公司持股 100%	2022-03-10	2022-03-10 成立	电子胶粘剂材料、胶粘剂施用和固化设备的销售服务
3	上海锐朗	800 万元	公司持股 100%	2005-07-19	2022-12-27 收购	通信领域电子胶粘剂产品的研发、生产和销售
4	青岛德聚	1,100 万元	公司持股 100%	2019-05-10	2019-05-10 成立	电子胶粘剂研发与生产
5	江苏德聚	5,000 万元	公司持股 100%	2022-09-28	2022-09-28 成立	电子胶粘剂、胶膜及树脂产品的研发和生产
6	南通德聚半导体	1,125 万元	公司持股 61.3333%	2022-08-24	2022-08-24 成立	半导体专用新型高端电子胶粘剂、胶膜的研发和销售服务
7	南通德聚精密膜材	1,000 万元	公司持股 100%	2022-12-27	2022-12-27 成立	精密半导体用膜材的研发和销售服务
8	如东德聚	1,000 万元	南通德聚半导体持股 100%	2023-05-05	2023-05-05 成立	DAF 芯片粘接膜等高端半导体胶膜产品的研发、生产
9	美科泰贸易	10,000 港元	公司持股 100%	2020-06-29	2020-12-25 收购	电子材料、电子设备、工业自动化软硬体开发、销售及进出口业务
10	北美德聚	100 美元	公司持股 100%	2021-10-07	2021-10-07 成立	电子胶粘剂产品的生产及北美区域销售
11	欧洲德聚	350,000 欧元	公司持股 100%	2022-03-10	2022-03-10 成立	电子胶粘剂产品的欧洲区域销售
12	韩国德聚	9 亿韩元	公司持股 100%	2022-06-22	2022-06-22 成立	电子胶粘剂产品的韩国区域销售
13	新加坡德聚	15,000 新加坡元	北美德聚持股 100%	2025-09-15	2025-09-15 成立	电子胶粘剂业务
14	马来西亚德聚	100 林吉特	新加坡德聚持股 100%	2025-09-19	2025-09-19 成立	电子胶粘剂业务
15	越南美科泰	33.96 亿越南盾	美科泰贸易持股 100%	2026-06-05	2026-06-05 成立	电子胶粘剂材料、胶粘剂施用和固化

序号	公司名称	注册资本	持股比例	成立时间	入股时间	主营业务
						设备的销售服务
16	上海濠茂	500 万元	深圳美科泰持股 100%	2018-11-28	2020-12-25 收购	研发原材料的采购
17	德聚技术北京分公司	-	分公司	2022-05-20	-	已于 2024 年 10 月注销
18	德聚埔材	5,000 万元	公司持股 60%	2022-10-12	2022-10-12 成立	已于 2024 年 11 月注销
19	德聚化学	500 万元	江苏德聚持股 100%	2023-07-31	2023-07-31 成立	已于 2024 年 12 月注销
20	德道天成	100 万元	公司持股 10%	2025-02-05	2025-02-05 成立	已于 2025 年 12 月转让

以子公司最近一年的资产总额、营业收入或者利润总额占公司最近一年合并口径资产总额、营业收入或利润总额的比例超过 5%为标准，截至本招股说明书签署日，公司的重要子公司为深圳美科泰、北美德聚、苏州美科泰、上海锐朗、青岛德聚和南通德聚半导体，具体情况如下：

1、深圳美科泰

企业名称	深圳市美科泰科技有限公司	
法定代表人	王延鲲	
成立时间	2008 年 11 月 28 日	
注册资本	500 万元	
实收资本	500 万元	
注册地址及主要经营地	深圳市宝安区西乡街道劳动社区西乡大道 300 号华丰金源商务大厦 A 座 210	
主营业务	电子胶粘剂材料、胶粘剂施用和固化设备的销售服务	
在发行人业务板块中定位	电子胶粘剂材料、胶粘剂施用和固化设备的销售服务子公司	
股东构成	发行人持有 100%股权	
最近一年主要财务数据（单位：万元）	**项目**	**2025 年 12 月 31 日/2025 年度**
	总资产	15,804.92
	净资产	11,264.73
	营业收入	12,043.49
	净利润	1,466.29
	审计情况	上述数据均已经中兴华会计师审计

2、北美德聚

企业名称	德聚北美公司（CollTech North America）	
负责人	张芬	
成立时间	2021 年 10 月 7 日	
注册资本	100 美元	
实收资本	100 美元	
注册地址	160 E Tasman Dr SAN JOSE, California 95134	
主要经营地	3066 Scott Boulevard, Santa Clara, California 95054	
主营业务	电子胶粘剂产品的生产及北美区域销售	
在发行人业务板块中定位	负责电子胶粘剂产品的生产及北美区域销售，位于美国	
股东构成	发行人持有 100%股权	
最近一年主要财务数据（单位：万元）	**项目**	**2025 年 12 月 31 日/2025 年度**
	总资产	3,414.15
	净资产	-788.59
	营业收入	4,863.14
	净利润	889.81
	审计情况	上述数据均已经中兴华会计师审计

3、苏州美科泰

企业名称	苏州美科泰制程电子科技有限公司	
法定代表人	王延鲲	
成立时间	2022 年 3 月 10 日	
注册资本	500 万元	
实收资本	500 万元	
注册地址及主要经营地	江苏省苏州市相城区高铁新城西公田路 69 号 5 幢 5-101 号 1 层	
主营业务	电子胶粘剂材料、胶粘剂施用和固化设备的销售服务	
在发行人业务板块中定位	电子胶粘剂材料、胶粘剂施用和固化设备的销售子公司	
股东构成	发行人持有 100%股权	
最近一年主要财务数据（单位：万元）	**项目**	**2025 年 12 月 31 日/2025 年度**
	总资产	5,205.52
	净资产	1,255.48
	营业收入	4,440.62

	净利润	10.70
	审计情况	上述数据均已经中兴华会计师审计

4、上海锐朗

企业名称	上海锐朗光电材料有限公司	
法定代表人	柴莹	
成立时间	2005 年 7 月 19 日	
注册资本	800 万元	
实收资本	800 万元	
注册地址及主要经营地	上海市松江区三浜路 261 号 2 幢 5 层	
主营业务	通信领域电子胶粘剂产品的研发、生产和销售	
在发行人业务板块中定位	通信领域电子胶粘剂产品的研发、生产和销售子公司	
股东构成	发行人持有 100%股权	
最近一年主要财务数据（单位：万元）	**项目**	**2025 年 12 月 31 日/2025 年度**
	总资产	5,714.18
	净资产	3,351.60
	营业收入	2,760.64
	净利润	72.13
	审计情况	上述数据均已经中兴华会计师审计

5、青岛德聚

企业名称	青岛德聚胶接技术有限公司	
法定代表人	黄成生	
成立时间	2019 年 5 月 10 日	
注册资本	1,100 万元	
实收资本	1,100 万元	
注册地址及主要经营地	山东省青岛市高新区锦汇路 1 号蓝湾创业园 A5 号楼	
主营业务	电子胶粘剂研发与生产	
在发行人业务板块中定位	电子胶粘剂研发与生产子公司	
股东构成	发行人持有 100%股权	
最近一年主要财务数据（单位：万元）	**项目**	**2025 年 12 月 31 日/2025 年度**
	总资产	7,086.85
	净资产	653.76

	营业收入	1,256.21
	净利润	-85.92
	审计情况	上述数据均已经中兴华会计师审计

6、南通德聚半导体

企业名称	南通德聚半导体材料有限公司	
法定代表人	黄成生	
成立时间	2022 年 8 月 24 日	
注册资本	1,125 万元	
实收资本	1,125 万元	
注册地址及主要经营地	江苏省南通市开发区新兴东路 1 号 9#	
主营业务	半导体专用新型高端电子胶粘剂、胶膜的研发和销售服务	
在发行人业务板块中定位	半导体专用新型高端电子胶粘剂、胶膜的研发和销售服务子公司	
股东构成	发行人持有 61.3333%股权	
最近一年主要财务数据（单位：万元）	**项目**	**2025 年 12 月 31 日/2025 年度**
	总资产	6,719.46
	净资产	-2,372.53
	营业收入	1,135.02
	净利润	-1,387.12
	审计情况	上述数据均已经中兴华会计师审计

四、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况

（一）控股股东、实际控制人

1、公司控股股东及实际控制人

截至本招股说明书签署日，黄成生直接持有公司 29.4863%的股份，通过担任赣州德熙、德森伯格的执行事务合伙人间接控制公司 9.2469%股份、0.4268%股份对应的表决权，合计控制公司 39.1600%股份对应的表决权，为公司控股股东及实际控制人。

报告期内，黄成生始终控制公司 30%以上股份对应的表决权，该控股情况最近两年未发生变更。

2、控股股东、实际控制人基本情况

黄成生先生，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 430104197208******，硕士研究生学历。1994 年 9 月至 1997 年 5 月，任韶关冶炼厂助理工程师；1997 年 6 月至 1998 年 8 月，任珠海经济特区联谊机电工程有限公司设计工程师；1998 年 9 月至 2000 年 6 月，任威明实业（深圳）有限公司工业工程师；2000 年 7 月至 2003 年 5 月，任美亚电子科技有限公司技术支持工程师；2003 年 6 月至 2008 年 10 月，任汉高乐泰（中国）有限公司技术支持工程师；2008 年 11 月至 2013 年 2 月，任洛德国际贸易（上海）有限公司华南区客户经理；2013 年 6 月至 2023 年 11 月，任伯乐通执行董事兼总经理；2016 年 5 月至 2023 年 5 月，任德聚有限执行董事兼经理；2020 年 12 月至今，任赣州德熙执行事务合伙人；2021 年 6 月至今，任赣州德益执行事务合伙人；2023 年 5 月至今，任公司董事长、总经理；2026 年 3 月至今，任德森伯格执行事务合伙人。

（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业的基本情况

截至本招股说明书签署日，除公司外，公司控股股东、实际控制人黄成生控制的其他企业情况参见本招股说明书之“第八节 公司治理与独立性”之“八、关联交易情况”。

（三）实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人直接或间接持有公司的股份不存在质押或其他有争议的情况。

（四）控股股东、实际控制人合法合规情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人黄成生不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

（五）其他持有发行人 5%以上股份的主要股东

截至本招股说明书签署日，除控股股东外，持有公司 5%以上（含）股份的股东如下：

1、余珩

截至本招股说明书签署日，余珩直接持有公司 14.4919%股份，其基本情况如下：

余珩女士，1972 年 7 月出生，中国国籍，拥有德国永久居留权，身份证号码 610102197207******，本科学历，历任西安市中医院医师（1996 年 7 月-2004 年 4 月）、德国不来梅中医研究院（Institut für Chinesische Medizin, DRK Kreisverband Bremen e. V.）医师（2006 年 3 月-2009 年 5 月）、德国陈博士骨科医院（Orthopädische Privatpraxis Dr. Med. Eduard Chen）医师（2010 年 6 月-2016 年 12 月）。余珩女士于 2004 年 5 月至 2006 年 2 月间，2009 年 6 月至 2010 年 5 月，以及 2017 年 1 月至今从事自由职业。

2、王延鲲

截至本招股说明书签署日，王延鲲直接持有公司 9.7498%股份，其基本情况如下：

王延鲲先生，1976 年 7 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，身份证号码 620104197607******，本科学历。1999 年 10 月至 2001 年 1 月，任东莞市鸿骐电子科技有限公司技术服务工程师；2001 年 2 月至 2004 年 1 月，任西门子德马泰克生产与物流自动化系统（中国）有限公司技术服务工程师；2004 年 2 月至 2005 年 1 月，任汉高乐泰（中国）有限公司销售工程师；2005 年 2 月至 2006 年 1 月，任克鲁勃润滑剂（上海）有限公司销售经理；2006 年 2 月至 2008 年 10 月，任迈图高新材料（中国）有限公司销售经理。2008 年 11 月至今，任深圳美科泰执行董事及总经理；2022 年 3 月至今，任苏州美科泰执行董事；2023 年 5 月至 2026 年 1 月，任公司董事。

3、赣州德熙、德森伯格

赣州德熙、德森伯格系公司员工持股平台。截至本招股说明书签署日，赣州

德熙直接持有公司 9.2469%股份，德森伯格直接持有公司 0.4268%股份，二者的执行事务合伙人均为实际控制人黄成生，黄成生、赣州德熙、德森伯格构成一致行动关系。

（1）赣州德熙

截至本招股说明书签署日，赣州德熙的基本情况如下：

企业名称	赣州市德熙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	黄成生
成立时间	2020 年 12 月 21 日
认缴出资额	3,040 万元
实缴出资额	3,040 万元
注册地址及主要生产经营地	江西省赣州市赣州经济技术开发区数字金融产业园华昌科技园 Z1 办公楼 7 层 7005-49 室
经营范围	企业管理咨询服务；技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	为公司员工持股平台
主营业务与发行人主营业务之间的关系	无

截至本招股说明书签署日，赣州德熙的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	黄成生	普通合伙人	771.3840	25.3745
2	赣州市德益企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	600.3360	19.7479
3	张盈	有限合伙人	120.0800	3.9500
4	陈小云	有限合伙人	120.0800	3.9500
5	邱国明	有限合伙人	120.0800	3.9500
6	郑微	有限合伙人	120.0800	3.9500
7	张芬	有限合伙人	120.0800	3.9500
8	王忠利	有限合伙人	100.0160	3.2900
9	韩火年	有限合伙人	79.9520	2.6300
10	梁加亮	有限合伙人	79.9520	2.6300
11	王剑飞	有限合伙人	59.8880	1.9700
12	张宝华	有限合伙人	59.8880	1.9700
13	马龙钢	有限合伙人	59.8880	1.9700

序号	合伙人姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
14	张朝红	有限合伙人	59.8880	1.9700
15	李阳洋	有限合伙人	63.1280	2.0766
16	冉祥兰	有限合伙人	40.1280	1.3200
17	何培林	有限合伙人	40.1280	1.3200
18	杨崇	有限合伙人	40.1280	1.3200
19	肖守松	有限合伙人	30.0960	0.9900
20	付丽珍	有限合伙人	24.0960	0.7926
21	蒋中碧	有限合伙人	63.0640	2.0745
22	易磊	有限合伙人	20.0640	0.6600
23	朱可新	有限合伙人	20.0640	0.6600
24	于映宴	有限合伙人	16.1120	0.5300
25	张海龙	有限合伙人	10.0320	0.3300
26	侯志成	有限合伙人	10.0320	0.3300
27	王婷	有限合伙人	6.0800	0.2000
28	刘文斌	有限合伙人	6.5320	0.2149
29	田克旭	有限合伙人	4.0320	0.1326
30	张宇	有限合伙人	3.0000	0.0987
31	于淼	有限合伙人	3.0000	0.0987
32	丁建果	有限合伙人	3.0000	0.0987
33	陈双涌	有限合伙人	2.5320	0.0833
34	唐鹏	有限合伙人	2.5000	0.0822
35	王木平	有限合伙人	2.5000	0.0822
36	彭中景	有限合伙人	3.3440	0.1100
37	孙佳乐	有限合伙人	3.3440	0.1100
38	孙强	有限合伙人	3.3440	0.1100
39	陈文	有限合伙人	4.0000	0.1316
40	刘少锋	有限合伙人	4.0000	0.1316
41	许海东	有限合伙人	2.0640	0.0679
42	虞敏敏	有限合伙人	40.1280	1.3200
43	王振兴	有限合伙人	33.080	1.0882
44	朱宁香	有限合伙人	5.0000	0.1645
45	段治国	有限合伙人	59.8560	1.9690
合计			3,040.0000	100.0000

注 1：公司原董事、财务负责人邱国明已于 2024 年 9 月 30 日因个人原因离职，其在持股平台内的合伙份额保留。
注 2：段治国已于 2025 年 4 月 30 日离职，鉴于其暂时无法签署相关文件，且工商变更需全体合伙人签字，故无法办理其退出及财产份额转让手续。受上述事项影响，赣州德熙存在工商登记与实际合伙人及出资情况不一致的情形。

（2）赣州德益

赣州德熙合伙人中，赣州德益同为公司的员工持股平台。截至本招股说明书签署日，赣州德益的基本情况如下：

企业名称	赣州市德益企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	黄成生
成立时间	2021 年 6 月 23 日
认缴出资额	600.336 万元
实缴出资额	600.336 万元
注册地址及主要生产经营地	江西省赣州市赣州经济技术开发区数字金融产业园华昌科技园 Z1 办公楼 7 层 7005-51 室
经营范围	企业管理咨询服务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	为公司员工持股平台
主营业务与发行人主营业务之间的关系	无

截至本招股说明书签署日，赣州德益的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	黄成生	普通合伙人	0.1920	0.0320
2	Junjun Wu（吴俊珺）	有限合伙人	310.0000	51.6377
3	钱原贵	有限合伙人	60.0000	9.9944
4	Steven Shigeji Suzuki（铃木·慈二·史蒂文）	有限合伙人	59.8880	9.9757
5	Lee Young-Seok（李永锡）	有限合伙人	40.1280	6.6843
6	Stefan Georg Sauer（萨奥尔·乔治·史蒂芬）	有限合伙人	40.1280	6.6843
7	WU YILIANG（吴贻良）	有限合伙人	60.0000	9.9944
8	KEH-CHYOU CHANG（张克裘）	有限合伙人	30.0000	4.9972
合计			**600.3360**	**100.0000**

（3）德森伯格

截至本招股说明书签署日，德森伯格的基本信息如下：

企业名称	上海德森伯格企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91310113MAK9NT1C04
成立时间	2026-03-19
出资额	141 万元
执行事务合伙人	黄成生
住所	上海市宝山区环镇北路 936 号 1 幢 8 层 807 室
经营范围	一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务	为公司员工持股平台
主营业务与发行人主营业务之间的关系	无

截至本招股说明书签署日，德森伯格的合伙人和出资比例情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	黄成生	普通合伙人	1.0000	0.7092
2	姚进	有限合伙人	100.0000	70.9220
3	杜武林	有限合伙人	20.0000	14.1844
4	尹建明	有限合伙人	20.0000	14.1844
合计			**141.0000**	**100.0000**

（六）发行人特别表决权或类似安排及协议控制架构情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排及协议控制架构的情况。

五、发行人股本情况

（一）发行前后股本结构

公司本次发行前的总股本为73,407,000股，拟发行新股不超过24,469,000股，公开发行的股份不低于发行后总股本的25%。本次发行前后，公司股本结构情况如下：

序号	股东名称	本次发行前（均为普通股）		本次发行后（均为普通股）	
		持股数额（股）	持股比例（%）	持股数额（股）	持股比例（%）
1	黄成生	21,645,012	29.4863	21,645,012	22.1147

序号	股东名称	本次发行前（均为普通股）		本次发行后（均为普通股）	
		持股数额（股）	持股比例（%）	持股数额（股）	持股比例（%）
2	余珩	10,638,091	14.4919	10,638,091	10.8689
3	王延鲲	7,157,052	9.7498	7,157,052	7.3124
4	赣州德熙	6,787,867	9.2469	6,787,867	6.9352
5	英特尔	3,494,335	4.7602	3,494,335	3.5702
6	全德学镂科芯	2,329,557	3.1735	2,329,557	2.3801
7	海盐鋆昊	2,025,420	2.7592	2,025,420	2.0694
8	元禾璞华	1,687,848	2.2993	1,687,848	1.7245
9	赣州德悦	1,250,396	1.7034	1,250,396	1.2775
10	远智芯创投	1,181,495	1.6095	1,181,495	1.2071
11	厦门汇桥	1,012,710	1.3796	1,012,710	1.0347
12	国企创新	1,012,710	1.3796	1,012,710	1.0347
13	越秀甬元	1,012,710	1.3796	1,012,710	1.0347
14	九州舜创	911,439	1.2416	911,439	0.9312
15	中广投资	782,163	1.0655	782,163	0.7991
16	鹏鼎投资	759,532	1.0347	759,532	0.7760
17	宁波立湾	708,897	0.9657	708,897	0.7243
18	青岛生润	607,626	0.8277	607,626	0.6208
19	鑫弘元通	607,626	0.8277	607,626	0.6208
20	广东立湾	506,355	0.6898	506,355	0.5173
21	东莞科创接力	506,355	0.6898	506,355	0.5173
22	五方九派	506,355	0.6898	506,355	0.5173
23	勤合投资	455,719	0.6208	455,719	0.4656
24	勤道投资	455,719	0.6208	455,719	0.4656
25	东莞科创	455,719	0.6208	455,719	0.4656
26	高梧启明	455,719	0.6208	455,719	0.4656
27	全德学亨芯	423,556	0.5770	423,556	0.4327
28	苏明	394,957	0.5380	394,957	0.4035
29	广东省半导体基金	364,576	0.4967	364,576	0.3725
30	宁波高易	337,570	0.4599	337,570	0.3449
31	东莞科创知产	337,570	0.4599	337,570	0.3449
32	东莞柏凯	337,570	0.4599	337,570	0.3449

序号	股东名称	本次发行前（均为普通股）		本次发行后（均为普通股）	
		持股数额（股）	持股比例（%）	持股数额（股）	持股比例（%）
33	韦豪泰达	337,570	0.4599	337,570	0.3449
34	韦豪镇鑫	337,570	0.4599	337,570	0.3449
35	邦信同盈	303,813	0.4139	303,813	0.3104
36	立夏一号	303,813	0.4139	303,813	0.3104
37	东证常平	168,785	0.2299	168,785	0.1724
38	镂科芯二期	151,906	0.2069	151,906	0.1552
39	昆仑鼎天	151,906	0.2069	151,906	0.1552
40	厚雪投资	151,906	0.2069	151,906	0.1552
41	创盈健科	36,173	0.0493	36,173	0.0370
42	德森伯格	313,332	0.4268	313,332	0.3201
43	公众投资者	-	-	24,469,000	25.0000
合计		**73,407,000**	**100.0000**	**97,876,000**	**100.0000**

（二）本次发行前的前十名股东

本次发行前，公司前十大股东的持股情况如下：

序号	股东名称	股份数（股）	持股比例（%）
1	黄成生	21,645,012	29.4863
2	余珩	10,638,091	14.4919
3	王延鲲	7,157,052	9.7498
4	赣州德熙	6,787,867	9.2469
5	英特尔	3,494,335	4.7602
6	全德学镂科芯	2,329,557	3.1735
7	海盐鋆昊	2,025,420	2.7592
8	元禾璞华	1,687,848	2.2993
9	赣州德悦	1,250,396	1.7034
10	远智芯创投	1,181,495	1.6095
合计		**58,197,073**	**79.2800**

（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在公司担任的职务

本次发行前的前十名自然人股东中，公司仅有 4 名直接持股的自然人股东，其持股及在公司主要任职情况如下：

序号	股东名称	股份数（股）	持股比例（%）	在公司任职情况
1	黄成生	21,645,012	29.4863	董事长、总经理
2	余珩	10,638,091	14.4919	未在公司任职
3	王延鲲	7,157,052	9.7498	任深圳美科泰执行董事及总经理，曾任公司董事
4	苏明	394,957	0.5380	未在公司任职

（四）国有股份或外资股份情况

1、国有股份情况

截至本招股说明书签署日，公司股东中有 7 名国有出资的有限合伙企业，为广东省半导体基金、东莞科创、东莞科创接力、东莞科创知产、东证常平、国企创新和越秀甬元。其中，广东省半导体基金持有公司 36.4576 万股，持股比例为 0.4967%；东莞科创持有公司 45.5719 万股，持股比例为 0.6208%；东莞科创接力持有公司 50.6355 万股，持股比例为 0.6898%；东莞科创知产持有公司 33.7570 万股，持股比例为 0.4599%；东证常平持有公司 16.8785 万股，持股比例为 0.2299%；国企创新持有公司 101.2710 万股，持股比例为 1.3796%；越秀甬元持有公司 101.2710 万股，持股比例为 1.3796%。

根据《上市公司国有股权监督管理办法》第七十八条的规定，国有出资的有限合伙企业不作国有股东认定，故广东省半导体基金、东莞科创、东莞科创接力、东莞科创知产、东证常平、国企创新及越秀甬元无需申请办理国有股东标识管理。

2、外资股份情况

截至本招股说明书签署日，不存在直接持有公司股份的外资股东。

（五）公司申报前十二个月新增股东的情况

1、公司申报前十二个月新增股东持股情况

公司申报前十二个月新增股东为东证常平、东莞科创接力、东莞科创知产、东莞柏凯、元禾璞华、国企创新、越秀甬元、韦豪泰达、韦豪镇鑫、中广投资、海盐鋆昊、五方九派及德森伯格等 13 名股东。

上述新增股东入股具体情况参见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“二、发行人设立及重大资产重组情况”之“（二）报告期期初至今的股本和

股东变化情况”。

2、新增股东基本情况

（1）东证常平

截至本招股说明书签署日，东证常平持有公司 0.2299%股份，其基本情况如下：

企业名称	东莞市东证常平新兴产业股权投资企业（有限合伙）				
统一社会信用代码	91441900MACE4DGM0Q				
执行事务合伙人	东证锦信投资管理有限公司				
注册资本	5,000 万元				
企业类型	有限合伙企业				
住所	广东省东莞市常平镇木棉创业二路 22 号 1002 室				
设立日期	2023 年 3 月 27 日				
营业期限	2023 年 3 月 27 日至无固定期限				
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）				
合伙人认缴出资情况	**序号**	**合伙人名称/姓名**	**认缴出资额（万元）**	**出资比例（%）**	**合伙人类别**
	1	东证锦信投资管理有限公司	2,500	50.00	普通合伙人
	2	东莞市大京九实业投资集团有限公司	2,500	50.00	有限合伙人
	合计		**5,000.00**	**100.00**	**-**
私募基金备案情况	已备案，基金编号：SZU961				

（2）东莞科创接力

截至本招股说明书签署日，东莞科创接力持有公司 0.6898%股份，其基本情况如下：

企业名称	东莞科创接力创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91441900MAE8M7DR27
执行事务合伙人	东莞市科创资本投资管理有限公司
注册资本	20,000 万元
企业类型	有限合伙企业
住所	广东省东莞市松山湖园区新城路 5 号 1 栋 904 室
设立日期	2025 年 1 月 2 日

营业期限		2025 年 1 月 2 日至无固定期限			
经营范围		一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
合伙人认缴出资情况	**序号**	**合伙人名称/姓名**	**认缴出资额（万元）**	**出资比例（%）**	**合伙人类别**
	1	东莞市科创资本投资管理有限公司	100.00	0.50	普通合伙人
	2	东莞市创新创业投资母基金合伙企业（有限合伙）	18,000.00	90.00	有限合伙人
	3	东莞科创专精与特新股权投资合伙企业（有限合伙）	1,900.00	9.50	有限合伙人
	合计		**20,000.00**	**100.00**	**-**
私募基金备案情况	已备案，基金编号：SASC79				

（3）东莞科创知产

截至本招股说明书签署日，东莞科创知产持有公司 0.4599%股份，其基本情况如下：

企业名称		东莞科创知识产权投资合伙企业（有限合伙）			
统一社会信用代码		91441900MA5710J413			
执行事务合伙人		东莞市科创资本投资管理有限公司			
出资总额		10,000 万元			
企业类型		有限合伙企业			
住所		广东省东莞市松山湖园区新城路 5 号 1 栋 901 室			
设立日期		2021 年 8 月 20 日			
营业期限		2021 年 8 月 20 日至无固定期限			
经营范围		一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
合伙人认缴出资情况	**序号**	**合伙人名称**	**认缴出资额（万元）**	**出资比例（%）**	**合伙人类别**
	1	东莞市科创资本投资管理有限公司	100.00	1.00	普通合伙人
	2	东莞市科创资本产业发展投资有限公司	4,900.00	49.00	有限合伙人
	3	东莞科技创新投资集团有限公司	4,000.00	40.00	有限合伙人
	4	东莞市东资经济贸易有限公司	1,000.00	10.00	有限合伙人

	合计	**10,000.00**	**100.00**	**-**
私募基金备案情况	已备案，基金编号：SSL432			

（4）东莞柏凯

截至本招股说明书签署日，东莞柏凯持有公司 0.4599%股份，其基本情况如下：

企业名称	东莞市柏凯物业投资有限公司			
统一社会信用代码	91441900MA54CP1K3U			
法定代表人	欧阳林辉			
注册资本	200 万元			
企业类型	有限责任公司			
住所	广东省东莞市南城街道鸿福路 200 号第一国际汇一城 5 栋 510 室			
设立日期	2020 年 3 月 6 日			
营业期限	2020 年 3 月 6 日至无固定期限			
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；汽车零配件批发；家具零配件销售；建筑材料销售；非居住房地产租赁；房地产咨询；企业管理咨询；物业管理；房地产经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
股东认缴出资情况	**序号**	**股东名称**	**认缴出资额（万元）**	**出资比例（%）**
	1	欧阳林辉	150.00	75.00
	2	欧阳耀庭	50.00	25.00
	合计		**200.00**	**100.00**
成员	执行董事、经理、财务负责人		欧阳林辉	
	监事		欧阳耀庭	
私募基金备案情况	不适用			

（5）元禾璞华

截至本招股说明书签署日，元禾璞华持有公司 2.2993%股份，其基本情况如下：

企业名称	江苏南通元禾璞华战新创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320691MAEE9NME14
执行事务合伙人	上海天集芯企业管理合伙企业（有限合伙）
出资总额	102,930 万元
企业类型	有限合伙企业

住所		江苏省南通市海门区海门街道长江路 909 号			
设立日期		2025 年 3 月 11 日			
营业期限		2025 年 3 月 11 日至无固定期限			
经营范围		一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
合伙人认缴出资情况	**序号**	**合伙人名称**	**认缴出资额（万元）**	**出资比例（%）**	**合伙人类别**
	1	江苏南通新一代信息技术产业专项母基金（有限合伙）	30,000.00	29.1460	有限合伙人
	2	苏州元禾控股股份有限公司	25,000.00	24.2884	有限合伙人
	3	南通产业链发展基金（有限合伙）	20,000.00	19.4307	有限合伙人
	4	南通海门謇创产业发展基金合伙企业（有限合伙）	15,000.00	14.5730	有限合伙人
	5	成都交子中赢创新发展基金合伙企业（有限合伙）	5,000.00	4.8577	有限合伙人
	6	上海禾诚瑞企业管理有限公司	3,000.00	2.9146	有限合伙人
	7	江苏长江口开发集团有限公司	2,900.00	2.8174	有限合伙人
	8	上海天集芯企业管理合伙企业（有限合伙）	1,030.00	1.0007	普通合伙人
	9	共青城华屹私募基金管理有限公司	1,000.00	0.9715	有限合伙人
	合计		**102,930.00**	**100.00**	**-**
私募基金备案情况	已备案，基金编号：SAYJ32				

（6）国企创新

截至本招股说明书签署日，国企创新持有公司 1.3796%股份，其基本情况如下：

企业名称	广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440101MA59E9H033
执行事务合伙人	广州越秀产业投资基金管理股份有限公司
出资总额	261,000 万元
企业类型	有限合伙企业
住所	广州市花都区新华街迎宾大道 95 号 108 房
设立日期	2016 年 8 月 11 日
营业期限	2016 年 8 月 11 日至无固定期限

经营范围		广州市花都区新华街迎宾大道 95 号 108 房			
合伙人认缴出资情况	序号	合伙人名称/姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类别
	1	广州越秀产业投资基金管理股份有限公司	200.00	0.0766	普通合伙人
	2	广州珠江实业集团有限公司	21,000.00	8.0460	有限合伙人
	3	广州岭南商旅投资集团有限公司	20,000.00	7.6628	有限合伙人
	4	广州汽车工业集团有限公司	20,000.00	7.6628	有限合伙人
	5	广州越秀集团股份有限公司	20,000.00	7.6628	有限合伙人
	6	广州广日股份有限公司	20,000.00	7.6628	有限合伙人
	7	广州产业投资控股集团有限公司	20,000.00	7.6628	有限合伙人
	8	广州环保投资集团有限公司	20,000.00	7.6628	有限合伙人
	9	广州地铁集团有限公司	20,000.00	7.6628	有限合伙人
	10	广州智能装备产业集团有限公司	20,000.00	7.6628	有限合伙人
	11	广州市建筑集团有限公司	20,000.00	7.6628	有限合伙人
	12	广州港集团有限公司	20,000.00	7.6628	有限合伙人
	13	广州市水务投资集团有限公司	20,000.00	7.6628	有限合伙人
	14	广州市广百股份有限公司	10,000.00	3.8314	有限合伙人
	15	广州珠江钢琴集团股份有限公司	9,800.00	3.7548	有限合伙人
	合计		**261,000.00**	**100.0000**	-
私募基金备案情况	已备案，基金编号：SS0251				

（7）越秀甬元

截至本招股说明书签署日，越秀甬元持有公司 1.3796%股份，其基本情况如下：

企业名称	宁波越秀甬元股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330203MAEEM4PF82
执行事务合伙人	广州越秀产业投资基金管理股份有限公司
出资总额	150,000 万元
企业类型	有限合伙企业

住所		浙江省宁波市海曙区鼓楼街道中宪巷 8 号八集创业园 7 楼 1856 工位			
设立日期		2025 年 3 月 26 日			
营业期限		2025 年 3 月 26 日至无固定期限			
经营范围		一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。			
合伙人认缴出资情况	**序号**	**合伙人名称**	**认缴出资额（万元）**	**出资比例（%）**	**合伙人类别**
	1	广州越秀产业投资基金管理股份有限公司	1,810.00	1.2067	普通合伙人
	2	广州越秀产业投资有限公司	75,000.00	50.0000	有限合伙人
	3	宁波市海曙神望壹号投资合伙企业（有限合伙）	20,000.00	13.3333	有限合伙人
	4	宁波市甬元投资基金有限公司	20,000.00	13.3333	有限合伙人
	5	江西省现代产业引导基金（有限合伙）	20,000.00	13.3333	有限合伙人
	6	浙江正泰新能源开发有限公司	5,000.00	3.3333	有限合伙人
	7	广汽资本有限公司	4,990.00	3.3267	有限合伙人
	8	津市嘉山实业有限公司	2,000.00	1.3333	有限合伙人
	9	津市嘉山产业发展投资有限公司	1,000.00	0.6667	有限合伙人
	10	广州市远见同行投资合伙企业（有限合伙）	200.00	0.1333	有限合伙人
	合计		**150,000.00**	**100.0000**	**-**
私募基金备案情况	已备案，基金编号：SAWP07				

（8）韦豪泰达

截至本招股说明书签署日，韦豪泰达持有公司 0.4599%股份，其基本情况如下：

企业名称	天津韦豪泰达海河股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91120118MA07DJKK7U
执行事务合伙人	上海韦豪创芯投资管理有限公司
出资总额	80,000 万元
企业类型	有限合伙企业
住所	天津自贸试验区（中心商务区）旷世国际大厦 2 栋-703（中塘商务秘书（天津）有限公司托管第 0365 号）
设立日期	2021 年 7 月 23 日

营业期限		2021 年 7 月 23 日至 2029 年 7 月 22 日			
经营范围		一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。			
合伙人认缴出资情况	**序号**	**合伙人名称**	**认缴出资额（万元）**	**出资比例（%）**	**合伙人类别**
	1	上海韦豪创芯投资管理有限公司	400.00	0.5000	普通合伙人
	2	天津泰达海河智能制造产业发展基金合伙企业（有限合伙）	60,000.00	75.0000	有限合伙人
	3	浙江韦尔股权投资有限公司	19,500.00	24.3750	有限合伙人
	4	韦豪泰达鎏芯管理咨询合伙企业（有限合伙）	100.00	0.1250	有限合伙人
	合计		**80,000.00**	**100.0000**	**-**
私募基金备案情况	已备案，基金编号：SSH190				

（9）韦豪镇鑫

截至本招股说明书签署日，韦豪镇鑫持有公司 0.4599%股份，其基本情况如下：

企业名称		宁波韦豪镇鑫一期创业投资合伙企业（有限合伙）			
统一社会信用代码		91330211MADNQLX78P			
执行事务合伙人		上海韦豪创芯投资管理有限公司			
出资总额		47,125 万元			
企业类型		有限合伙企业			
住所		浙江省宁波市镇海区庄市街道中官西路 777 号科创大厦 17 楼 216 室			
设立日期		2024 年 7 月 4 日			
营业期限		2024 年 7 月 4 日至 2031 年 7 月 3 日			
经营范围		一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。			
合伙人认缴出资情况	**序号**	**合伙人名称**	**认缴出资额（万元）**	**出资比例（%）**	**合伙人类别**
	1	上海韦豪创芯投资管理有限公司	125.00	0.2653	普通合伙人
	2	宁波甬欣韦豪三期半导体产业投资合伙企业（有限合伙）	25,000.00	53.0504	有限合伙人
	3	宁波市镇海威远镇芯	12,000.00	25.4642	有限合伙人

		一期半导体产业投资合伙企业（有限合伙）			
	4	衢州绿石新材料股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000.00	21.2202	有限合伙人
	合计		**47,125.00**	**100.0000**	**-**
私募基金备案情况	已备案，基金编号：SANA33				

（10）中广投资

截至本招股说明书签署日，中广投资持有公司 1.0655%股份，其基本情况如下：

企业名称	珠海德聚中广创业投资基金合伙企业（有限合伙）				
统一社会信用代码	91440003MAEWMCG30K				
执行事务合伙人	广东中广创业投资管理有限公司				
出资总额	2,440 万元				
企业类型	有限合伙企业				
住所	珠海市横琴汇通三路 108 号 1601 办公-5				
设立日期	2025 年 9 月 26 日				
营业期限	2025 年 9 月 26 日至无固定期限				
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）				
合伙人认缴出资情况	**序号**	**合伙人名称/姓名**	**认缴出资额（万元）**	**出资比例（%）**	**合伙人类别**
	1	广东中广创业投资管理有限公司	100.00	4.0984	普通合伙人
	2	郑强	422.00	17.2951	有限合伙人
	3	涂亮	330.00	13.5246	有限合伙人
	4	陈烨	300.00	12.2951	有限合伙人
	5	谢炜丹	300.00	12.2951	有限合伙人
	6	广东瀛富投资有限公司	300.00	12.2951	有限合伙人
	7	徐娅莉	200.00	8.1967	有限合伙人
	8	廖春晖	200.00	8.1967	有限合伙人
	9	胡海珍	100.00	4.0984	有限合伙人
	10	鲁小平	100.00	4.0984	有限合伙人
	11	谭波	88.00	3.6066	有限合伙人

	合计	**2,440.00**	**100.0000**	有限合伙人
私募基金备案情况	已备案，基金编号：SBJK11			

（11）海盐鋆昊

截至本招股说明书签署日，海盐鋆昊持有公司 2.7592%股份，其基本情况如下：

企业名称		海盐鋆昊臻选股权投资合伙企业（有限合伙）			
统一社会信用代码		91330424MA7D02C03D			
执行事务合伙人		珠海通沛股权投资管理合伙企业（有限合伙）			
出资总额		229,200.1 万元			
企业类型		有限合伙企业			
住所		浙江省嘉兴市海盐县望海街道长安北路 1628 号望海商贸中心 801-802 室			
设立日期		2021 年 11 月 15 日			
营业期限		2021 年 11 月 15 日至无固定期限			
经营范围		一般项目：股权投资；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。			
合伙人认缴出资情况	**序号**	**合伙人名称/姓名**	**认缴出资额（万元）**	**出资比例（%）**	**合伙人类别**
	1	珠海通沛股权投资管理合伙企业（有限合伙）	0.10	0.0000	普通合伙人
	2	海盐县国有资本投资有限公司	80,200.00	34.9913	有限合伙人
	3	珠海威迪投资有限公司	15,000.00	6.5445	有限合伙人
	4	张嘉慧	10,000.00	4.3630	有限合伙人
	5	海南泽昊股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000.00	4.3630	有限合伙人
	6	海南宸昊股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000.00	4.3630	有限合伙人
	7	深圳艾希一号投资合伙企业（有限合伙）	10,000.00	4.3630	有限合伙人
	8	深圳市嘉源启航创业投资企业（有限合伙）	10,000.00	4.3630	有限合伙人
	9	海南沃土股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000.00	4.3630	有限合伙人
	10	中国大地财产保险股份有限公司	7,000.00	3.0541	有限合伙人
	11	浙江开元股权投资有限公司	6,000.00	2.6178	有限合伙人

	12	华友控股集团有限公司	6,000.00	2.6178	有限合伙人
	13	李秀蓉	5,000.00	2.1815	有限合伙人
	14	中国财产再保险有限责任公司	5,000.00	2.1815	有限合伙人
	15	浙江正泰新能源投资有限公司	5,000.00	2.1815	有限合伙人
	16	清华大学教育基金会	5,000.00	2.1815	有限合伙人
	17	恒融投资集团有限公司	5,000.00	2.1815	有限合伙人
	18	杭州鋆泰股权投资合伙企业（有限合伙）	4,100.00	1.7888	有限合伙人
	19	南昌鑫旭企业管理合伙企业（有限合伙）	4,000.00	1.7452	有限合伙人
	20	珠海冠明投资有限公司	4,000.00	1.7452	有限合伙人
	21	张韬	3,000.00	1.3089	有限合伙人
	22	招商证券投资有限公司	3,000.00	1.3089	有限合伙人
	23	佛山市顺德区蚬华多媒体制品有限公司	3,000.00	1.3089	有限合伙人
	24	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	2,400.00	1.0471	有限合伙人
	25	珠海彧兴投资合伙企业（有限合伙）	2,000.00	0.8726	有限合伙人
	26	杭州星舰投资有限公司	2,000.00	0.8726	有限合伙人
	27	黄月娥	1,000.00	0.4363	有限合伙人
	28	上海正心瀚洋新材料有限公司	1,000.00	0.4363	有限合伙人
	29	北京懋源投资有限公司	500.00	0.2181	有限合伙人
	合计		**229,200.10**	**100.0000**	**-**
私募基金备案情况	已备案，基金编号：SVA142				

（12）五方九派

截至本招股说明书签署日，五方九派持有公司 0.6898%股份，其基本情况如下：

企业名称	湖北五方九派股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91420607MACWT2DC2L
执行事务合伙人	深圳市九派资本管理有限公司
出资总额	8,344 万元
企业类型	有限合伙企业
住所	湖北省襄阳高新技术开发区东风汽车大道 11 号湖北自贸区企业综合服务中心 15 楼-80417（住所申报）

设立日期		2023 年 9 月 19 日			
营业期限		2023 年 9 月 19 日至 2033 年 9 月 19 日			
经营范围		一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）,创业投资（限投资未上市企业）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）			
合伙人认缴出资情况	**序号**	**合伙人名称/姓名**	**认缴出资额（万元）**	**出资比例（%）**	**合伙人类别**
	1	深圳市九派资本管理有限公司	100.00	1.1985	普通合伙人
	2	湖北五方光电股份有限公司	5,000.00	59.9233	有限合伙人
	3	汉江控股发展集团有限公司	2,086.00	25.0000	有限合伙人
	4	赣州常青股权投资合伙企业（有限合伙）	690.00	8.2694	有限合伙人
	5	湖北省正煊商业服务有限公司	368.00	4.4104	有限合伙人
	6	苏州五方光电材料有限公司	100.00	1.1985	有限合伙人
	合计		**8,344.00**	**100.0000**	有限合伙人
私募基金备案情况	已备案，基金编号：SADM78				

（13）德森伯格

截至本招股说明书签署日，德森伯格持有公司 0.4268%股份，其基本情况参见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“四、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（五）其他持有发行人 5%以上股份的主要股东”之“3、赣州德熙、德森伯格”。

3、新增股东的入股原因

除德森伯格外，上述 12 名新增外部机构股东因看好公司未来发展前景，愿意以受让股份的方式持有公司股份，受让股份是各方真实意思表示；德森伯格是公司员工持股平台，因公司进行股权激励而以受让股份的方式持有公司股份。

4、新增股东入股的定价依据

东证常平、东莞科创接力、东莞科创知产等 12 名新增外部机构股东的入股价格均为 29.62 元/股，系公司、原股东及新增股东综合考虑公司所处行业发展前景、公司成长性、公司未来上市预期等因素，并参考公司上一轮增资价格 32.92 元/股的 90%协商确定。

德森伯格的入股价格（即本次员工股权激励授予价格）为 4.50 元/股，系参考前次股权激励授予价格并经协商确定。

5、新增股东与发行人其他股东、董事、监事会取消前监事、高级管理人员是否存在关联关系

截至本招股说明书签署日，新增股东与公司董事、监事会取消前监事、高级管理人员之间不存在关联关系，新增股东与公司其他股东之间的关联关系参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“五、发行人股本情况”之“（八）发行前各股东的关联关系及关联股东的各自持股比例”。

6、新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在关联关系

截至本招股说明书签署日，新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在关联关系。

7、新增股东是否存在股份代持情形

截至本招股说明书签署日，新增股东不存在股份代持情形。

（六）发行人机构股东涉及的私募投资基金备案情况

截至本招股说明书签署日，公司现有股东中涉及私募投资基金备案事项的股东情况如下：

序号	股东	基金编号	对应基金管理人	登记编号
1	全德学镂科芯创业投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）	SQN910	全德学尔私募基金管理（上海）有限公司	P1071902
2	全德学亨芯创业投资（平潭）合伙企业（有限合伙）	SSX584		
3	南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙）	SZL400		
4	杭州九州舜创股权投资合伙企业（有限合伙）	SQP215	宁波梅山保税港区舜翌投资管理有限公司	P1060581
5	青岛生润私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	SXQ719	青岛鲁创私募基金管理有限公司	P1001563
6	嘉兴鑫弘元通创业投资合伙企业（有限合伙）	SB2437	深圳市前海东方银石资产管理有限公司	P1016138
7	东莞勤合创业投资中心（有限合伙）	SVS349	清石资产管理（上海）有限公司	P1070825
8	深圳市勤道东创投资合伙企	SNC221	深圳市勤道资本管理有	P1022162

序号	股东	基金编号	对应基金管理人	登记编号
	业（有限合伙）		限公司	
9	天津高梧启明创业投资合伙企业（有限合伙）	SZU239	前海亚商粤科投资管理（深圳）有限公司	P1028017
10	广东省半导体及集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）	SNL096	广东粤财基金管理有限公司	P1032281
11	苏州邦信同盈创业投资合伙企业（有限合伙）	SGB408	苏州安洁私募基金管理合伙企业（有限合伙）	P1073343
12	深圳市立夏一号创业投资合伙企业（有限合伙）	S09575	深圳市德弘联信私募股权基金管理有限公司	P1028376
13	上海厚雪私募投资基金合伙企业（有限合伙）	SXS797	上海厚雪私募基金管理有限公司	P1074016
14	广州创盈健科投资合伙企业（有限合伙）	SCE438	广东粤财创业投资有限公司	P1027088
15	厦门汇桥科创二期股权投资合伙企业（有限合伙）	SB7507	深圳市前海汇桥投资管理有限公司	P1064706
16	广东立湾股权投资合伙企业（有限合伙）	SVJ442	广东立湾创业投资管理有限公司	P1069312
17	宁波立湾倍增五号创业投资基金合伙企业（有限合伙）	SAVM13		
18	宁波高易三期创业投资合伙企业（有限合伙）	SAFB24	江苏高易创业投资管理有限公司	P1072105
19	广东远智芯创业投资合伙企业（有限合伙）	SAUH57	广东远智先行股权投资基金管理有限公司	P1070716
20	东莞市东证常平新兴产业股权投资企业（有限合伙）	SZU961	东证锦信投资管理有限公司	GC2600030844
21	东莞科创智造专精与特新创业投资合伙企业（有限合伙）	SVQ521	东莞市科创资本投资管理有限公司	P1034696
22	东莞科创接力创业投资合伙企业（有限合伙）	SASC79		
23	东莞科创知识产权投资合伙企业（有限合伙）	SSL432		
24	江苏南通元禾璞华战新创业投资合伙企业（有限合伙）	SAYJ32	元禾璞华同芯（苏州）投资管理有限公司	P1071690
25	广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）	SS0251	广州越秀产业投资基金管理股份有限公司	P1000696
26	宁波越秀甬元股权投资合伙企业（有限合伙）	SAWP07		
27	天津韦豪泰达海河股权投资合伙企业（有限合伙）	SSH190	上海韦豪创芯投资管理有限公司	P1071402
28	宁波韦豪镇鑫一期创业投资合伙企业（有限合伙）	SANA33		
29	珠海德聚中广创业投资基金合伙企业（有限合伙）	SBJK11	广东中广创业投资管理有限公司	P1002009
30	海盐鋆昊臻选股权投资合伙企业（有限合伙）	SVA142	珠海通沛股权投资管理合伙企业（有限合伙）	P1060622
31	湖北五方九派股权投资合伙企业（有限合伙）	SADM78	深圳市九派资本管理有限公司	P1066518

（七）股东与公司及其相关方之间存在对赌等特殊协议或安排情况

1、股东特殊权利条款

公司历史上与股东签署的相关协议中，存在股份回购权等股东特殊权利条款约定，截至本招股说明书签署日，相关特殊权利条款安排均已解除并自始无效，具体如下：

序号	股东名称	相关协议中涉及的特殊权利条款	特殊权利条款解除情况
1	英特尔	董事会观察员、保护性权利、优先认购权、优先受让权、共同出售权、知情权、检查权、清算优先权、随惠权、反稀释保护、补偿和出售选择权等以公司和/或实际控制人黄成生为义务方的特殊权利	（1）2023 年 4 月 23 日，公司及全体股东共同签署《关于东莞市德聚胶接技术有限公司股东协议之补充协议》，约定各方于 2023 年 2 月 20 日签署的《股东协议》第 6.2 条“出售选择权”中以公司为义务方的条款均不可撤销地终止并自始无效，该等条款内容不再对公司具有法律约束力。 （2）2023 年 10 月 20 日，公司及全体股东共同签署《关于广东德聚技术股份有限公司股东协议之补充协议》，约定各方于 2023 年 6 月 12 日签署的《股东协议》中以实际控制人黄成生为义务方的出售选择权不可撤销并未附加任何条件地终止并自始无效，以公司和/或实际控制人黄成生为义务方的董事会观察员、保护性权利、优先认购权、优先受让权、共同出售权、知情权、检查权、清算优先权、最惠权、反稀释保护、一般性补偿等特殊权利条款均不可撤销并未附加任何条件地终止并自始无效；该等条款内容不再对各方具有法律约束力，任何一方不再享有该等约定的权利或有履行相关义务的责任。
2	全德学镂科芯	董事会观察员、保护性权利、优先认购权、优先受让权、共同出售权、知情权、检查权、清算优先权、随惠权、反稀释保护、补偿和出售选择权等以公司和/或实际控制人黄成生为义务方的特殊权利	
3	全德学亨芯	董事会观察员、保护性权利、优先认购权、优先受让权、共同出售权、知情权、检查权、清算优先权、随惠权、反稀释保护、补偿和出售选择权等以公司和/或实际控制人黄成生为义务方的特殊权利	
4	赣州御朗	共同出售权、股份回购权	2023 年 10 月 20 日，公司及实控人黄成生与赣州御朗共同签署《关于上海锐朗光电材料有限公司之股权交易协议及东莞市德聚胶接技术有限公司之增资协议之补充协议的终止协议》，约定各方于 2022 年 12 月 28 日签署的《关于上海锐朗光电材料有限公司之股权交易协议及东莞市德聚胶接技术有限公司之增资协议之补充协议》中有关共同出售权、股份回购等以实际控制人黄成生为义务方的特殊权利条款均不可撤销并未

序号	股东名称	相关协议中涉及的特殊权利条款	特殊权利条款解除情况
			附加任何条件地终止并自始无效，该等条款内容不再对各方具有法律约束力，任何一方不再享有该等约定的权利或有履行相关义务的责任，亦不得以任何理由向协议另一方提出权利要求或主张。
5	鹏鼎投资	董事会观察员、保护性权利、优先认购权、优先受让权、共同出售权、知情权、检查权、清算优先权、最惠权、反稀释保护、补偿和出售选择权等以公司和/或实际控制人黄成生为义务方的特殊权利	2023 年 10 月 20 日，公司及全体股东共同签署《关于广东德聚技术股份有限公司股东协议之补充协议》，约定各方于 2023 年 6 月 12 日签署的《股东协议》中以实际控制人黄成生为义务方的出售选择权不可撤销并未附加任何条件地终止并自始无效，以公司和/或实际控制人黄成生为义务方的董事会观察员、保护性权利、优先认购权、优先受让权、共同出售权、知情权、检查权、清算优先权、最惠权、反稀释保护、一般性补偿等特殊权利条款均不可撤销并未附加任何条件地终止并自始无效；该等条款内容不再对各方具有法律约束力，任何一方不再享有该等约定的权利或有履行相关义务的责任。
6	九州舜创、青岛生润、鑫弘元通、勤合投资、勤道投资、东莞科创、高梧启明、苏明、广东省半导体基金、邦信同盈、立夏一号、镂科芯二期、昆仑鼎天、厚雪投资、创盈健科	优先认购权、优先受让权、共同出售权、知情权、检查权、清算优先权、最惠权、反稀释保护、补偿和出售选择权等以公司和/或实际控制人黄成生为义务方的特殊权利	

综上，公司历史上曾与股东约定的特殊权利条款安排均未触发、均已解除并自始无效，且未设置任何其他替代性利益安排。截至本招股说明书签署日，公司不存在正在履行的股东特殊权利条款安排。

2、发行人与广东省半导体基金签署的其他条款

2023 年 6 月 12 日，公司及其原股东与包括广东省半导体基金在内的 16 名外部投资者共同签署了《增资及认缴协议》。与此同时，公司及其控股股东黄成生与广东省半导体基金签订了《关于广东德聚技术股份有限公司增资及认缴协议之补充协议》，约定广东省半导体基金实现收益并对合伙人进行分配时，将广东省人民政府财政出资部分对应超额收益（高于 6%／年（单利）的部分）的百分之六十（60%）在扣减广东省半导体基金或广东省政府财政出资部分因投资项目退出收到的全部收益大于因让利而实际所获收益而产生的多缴纳税费部分（如有）后，按照《广东省半导体及集成电路产业投资基金组建方案》和广东省发展改革

委、广东省财政厅等基金主管部门制定的关于让利的规定或要求（如有），以合理合法恰当的方式返还给公司。

广东省半导体基金与公司及黄成生签订收益返还条款系为了扶持半导体行业的发展，对符合条件的企业通过签订收益返还条款的方式予以激励，相关收益返还条款不属于《监管规则适用指引——发行类第 4 号》中规定的投资机构在投资时约定的估值调整机制（对赌协议）。

此外，公司系作为被投项目方签订协议，不涉及由公司回购股份或承担其他义务及责任的情形。该等收益返还系为了有效发挥财政资金的引导作用和政策效应，以及体现对项目的扶持力度，不属于 PE、VC 等投资机构对公司投资约定估值调整机制的情形，不涉及调整公司估值，不存在可能导致公司控制权变化、与市值挂钩、严重影响公司持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。

因此，上述协议符合《监管规则适用指引——发行类第 4 号》第 4-3 项的相关要求，不需要进行清理。

（八）发行前各股东的关联关系及关联股东的各自持股比例

公司现有股东中，黄成生直接持有公司 29.4863%的股份，通过担任赣州德熙、德森伯格的执行事务合伙人间接控制公司 9.2469%股份、0.4268%股份对应的表决权，合计控制公司 39.1600%股份对应的表决权。

国企创新、越秀甬元分别持有公司 1.3796%、1.3796%股份，两者的执行事务合伙人均为广州越秀产业投资基金管理股份有限公司，合计持股数量占公司本次发行前总股本的 2.7592%。

全德学镂科芯、全德学亨芯、镂科芯二期分别持有公司 3.1735%、0.5770%、0.2069%股份，全德学镂科芯的执行事务合伙人的执行事务合伙人、全德学亨芯的执行事务合伙人以及镂科芯二期的执行事务合伙人的执行事务合伙人均为全德学尔私募基金管理（上海）有限公司，前述三者合计持股数量占公司本次发行前总股本的 3.9574%。

广东省半导体基金、创盈健科分别持有公司 0.4967%、0.0493%股份，两者的执行事务合伙人的控股股东均为广东粤财投资控股有限公司，合计持股数量占公司本次发行前总股本的 0.5460%。

韦豪泰达、韦豪镇鑫分别持有公司 0.4599%、0.4599%股份，两者的执行事务合伙人均为上海韦豪创芯投资管理有限公司，合计持股数量占公司本次发行前总股本的 0.9198%。

广东立湾、宁波立湾分别持有公司 0.6898%、0.9657%股份，两者的执行事务合伙人均为广东立湾创业投资管理有限公司，合计持股数量占公司本次发行前总股本的 1.6555%。

东莞科创、东莞科创接力、东莞科创知产分别持有公司 0.6208%、0.6898%、0.4599%股份，三者的执行事务合伙人均为东莞市科创资本投资管理有限公司，合计持股数量占公司本次发行前总股本的 1.7705%。

除上述情形之外，公司其他股东之间不存在关联关系。

（九）发行人股东公开发售股份对发行人的影响

本次公开发行股份不涉及公司股东公开发售股份的情形。

六、董事、监事会取消前监事、高级管理人员及其他核心人员

（一）董事、监事会取消前监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况

1、董事会成员

公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名。公司的董事由股东（大）会选举产生。公司现任董事如下：

姓名	公司职务	提名人	本届任期
黄成生	董事长、总经理	黄成生	自 2026 年 1 月 23 日至 2029 年 1 月 22 日
马慷慨	董事	黄成生	自 2026 年 1 月 23 日至 2029 年 1 月 22 日
张芬	董事、副总经理	黄成生	自 2026 年 1 月 23 日至 2029 年 1 月 22 日
姚进	董事、董事会秘书、财务负责人	黄成生	自 2026 年 1 月 23 日至 2029 年 1 月 22 日
陈小云	职工代表董事	职工代表大会	自 2026 年 1 月 23 日至 2029 年 1 月 22 日
王天琳	董事	黄成生	自 2026 年 1 月 23 日至 2029 年 1 月 22 日
刘晓旸	独立董事	黄成生	自 2026 年 1 月 23 日至 2029 年 1 月 22 日
吴旭青	独立董事	黄成生	自 2026 年 1 月 23 日至 2029 年 1 月 22 日
刘宁悦	独立董事	黄成生	自 2026 年 1 月 23 日至 2029 年 1 月 22 日

各董事履历及主要任职情况如下：

黄成生履历请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人”。

马慷慨先生，男，1972 年 11 月出生，德国国籍，博士研究生学历。1997 年 7 月至 2000 年 4 月，任中国石油天然气集团公司管材研究所招待所工程师；2005 年 1 月至 2005 年 12 月，任德国伊瑟隆腐蚀防护与技术研究所助理研究员；2006 年 1 月至 2007 年 1 月，任德国弗劳恩霍夫生产技术和应用材料研究所（Fraunhofer IFAM）研究员；2007 年 1 月至 2011 年 1 月，任德国好乐股份有限公司研发工程师、上海代表处首席代表；2011 年 1 月至 2015 年 10 月，任好乐紫外技术贸易（上海）有限公司董事兼总经理；2015 年 11 月至 2018 年 3 月，从事自由职业；2021 年 1 月至 2021 年 6 月，任德涵新材料（太仓）有限公司执行董事兼总经理；2022 年 2 月至 2024 年 10 月，任德亿纬三维打印科技（太仓）有限公司监事；2018 年 4 月至今，任 Infinite Flex GmbH 董事；2019 年 3 月至今，任德怡科技（太仓）有限公司执行董事兼总经理；2021 年 3 月至今，任 International Graphene Product Certification Center GmbH 总经理；2022 年 2 月至今，任苏州德顿石墨烯新材料研究院有限公司执行董事兼总经理；2024 年 10 月至今，任公司董事；2024 年 11 月至今，任江苏德鼎能源科技有限公司执行董事兼总经理；2025 年 3 月至今，任德鼎健生物技术（太仓）有限公司执行董事兼总经理。马慷慨先生系持有公司 5%以上股份的股东余珩的配偶。

张芬女士，女，1982 年 1 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生学历。2010 年 1 月至 2011 年 5 月，任 Honda Research Institute USA, Inc. 研究员；2011 年 5 月至 2017 年 7 月，任 Prismark Partners LLC 战略顾问；2017 年 7 月至 2021 年 10 月任 CollTech Corporation, Inc.高级副总裁；2021 年 11 月至 2023 年 5 月，任德聚有限副总经理；2021 年 11 月至今，任北美德聚高级副总裁；2023 年 5 月至今，任公司董事、副总经理。

姚进先生，男，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015 年 6 月至 2016 年 8 月，任特变电工股份有限公司证券事务专员；2016 年 8 月至 2017 年 11 月，任广汇物流股份有限公司证券事务主管；2017 年 11 月至 2020 年 10 月，任澜起科技股份有限公司证券事务高级主管；2020 年 10

月至 2022 年 6 月，任浙江正泰电器股份有限公司证券事务高级经理；2021 年 10 月至 2022 年 6 月，任浙江正泰智慧低碳科技有限公司董事会秘书；2022 年 6 月至今，任公司董事会秘书；2024 年 10 月至今，任公司财务负责人；2026 年 1 月至今，任公司董事。

陈小云先生，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2004 年 12 月，任深圳市比克电池有限公司工程师；2005 年 1 月至 2005 年 8 月，任嘉兴市景瓷光化学科技有限公司工程师；2005 年 9 月至 2012 年 4 月，任东莞长安品质电子制造厂 PDE 经理；2012 年 5 月至 2014 年 10 月，任好乐紫外技术贸易（上海）有限公司技术服务经理；2014 年 11 月至今，任深圳市美科泰科技有限公司销售总监；2023 年 5 月至 2026 年 1 月，任公司监事；2026 年 1 月至今，任公司职工代表董事。

王天琳先生，男，1981 年出生，美国国籍，拥有中国永久居留权，硕士研究生学历。2005 年加入英特尔公司，曾领导英特尔在美国俄勒冈和以色列的迅驰无线产品研发和市场营销团队；2014 年至 2016 年，任英特尔终端计算部总监，负责中国区的商业拓展和风险管理；2016 年加入英特尔资本，现任董事总经理、中国区总经理，与团队专注于科技类创新公司的投资；2026 年 1 月至今，任公司董事。

刘晓旸先生，男，1964 年 2 月出生，加拿大国籍，拥有中国永久居留权，博士研究生学历。1993 年 7 月至 1995 年 6 月，历任吉林大学物理系讲师、副教授；1993 年 10 月至 1995 年 12 月，任日本大阪大学材料物理系访问学者；1996 年 1 月至 1999 年 1 月，任德国雷根斯堡大学无机化学研究所博士后；1999 年 2 月至 2000 年 2 月，任美国加利福尼亚大学洛杉矶分校化学与生物化学系博士后；2000 年 3 月至 2004 年 3 月，任加拿大西安大略大学地球科学系研究员；2002 年 7 月至今，任吉林大学化学学院教授；2023 年 5 月至今，任公司独立董事。

刘宁悦女士，女，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2013 年 5 月至 2018 年 7 月，任北京理工大学管理与经济学院讲师。2018 年 7 月至今，任北京理工大学管理学院副教授；2023 年 5 月至今，任公司独立董事。

吴旭青女士，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014 年 7 月至 2019 年 4 月，历任上海上正恒泰律师事务所（曾用名：上海市上正律师事务所）初级律师、高级律师；2019 年 4 月至 2019 年 9 月，任国浩律师（上海）事务所高级律师；2019 年 9 月至 2019 年 12 月，任毕马威企业咨询（中国）有限公司高级经理；2019 年 12 月至 2022 年 2 月，任上海睿威律师事务所高级律师；2022 年 2 月至 2024 年 6 月，任北京大成（上海）律师事务所授薪合伙人；2024 年 7 月至今，任北京己任（上海）律师事务所合伙人（合伙人备案手续办理中）；2026 年 1 月至今，任公司独立董事。

2、监事会取消前监事会成员

截至取消监事会前，公司监事会由 3 名监事王忠利、陈小云、郑微组成。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规规定，公司于 2026 年 1 月召开 2026 年第一次临时股东大会，决议调整公司内部监督机构，由董事会审计委员会承接原监事会的法定职权，不设监事会或者监事。截至本招股说明书签署日，公司审计委员会成员为刘宁悦、吴旭青、陈小云。

3、高级管理人员

公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，公司现任高级管理人员如下：

姓名	公司职务	本届任期
黄成生	董事长、总经理	自 2026 年 1 月 23 日至 2029 年 1 月 22 日
张芬	董事、副总经理	自 2026 年 1 月 23 日至 2029 年 1 月 22 日
姚进	董事、董事会秘书、财务负责人	自 2026 年 1 月 23 日至 2029 年 1 月 22 日
Junjun Wu（吴俊珺）	副总经理、首席技术官	自 2026 年 1 月 23 日至 2029 年 1 月 22 日

各位高级管理人员履历及主要任职情况如下：

黄成生先生、张芬女士、姚进先生履历及主要任职情况，参见本节“（一）董事、监事会取消前监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“1、董事会成员”。

Junjun Wu（吴俊珺）先生，男，1973 年 10 月出生，美国国籍，博士研究生

学历。2001 年 9 月至 2003 年 7 月，任 Lucent Technologies 技术员；2003 年 7 月至 2007 年 7 月，任 3M 公司研究员；2007 年 7 月至 2013 年 10 月，任 Shocking Technologies, Inc.研发总监；2013 年 10 月至 2020 年 6 月，任 Henkel Ablestik 产品开发经理；2022 年 7 月至 2023 年 5 月，任德聚有限首席技术官；2023 年 5 月至今，任公司首席技术官、副总经理。

4、其他核心人员

公司其他核心人员为核心技术人员，公司现有 3 名核心技术人员，具体如下：

姓名	公司职务
Junjun Wu（吴俊珺）	首席技术官、副总经理
韩火年	研发总监
张盈	青岛德聚研发总监

各位其他核心人员的简历及主要任职情况如下：

Junjun Wu（吴俊珺）先生履历及主要任职情况，参见本节“（一）董事、监事会取消前监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“3、高级管理人员”。

韩火年先生，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007 年 7 月至 2008 年 8 月，任路达（厦门）工业有限公司工程师；2008 年 9 月至 2011 年 7 月，于厦门大学攻读高分子化学与物理专业硕士学位；2011 年 7 月至 2013 年 9 月，任东莞优邦材料科技股份有限公司研发项目经理；2013 年 9 月至 2016 年 5 月，任伯乐通研发高级经理；2016 年 5 月至 2023 年 5 月，历任德聚有限研发经理、研发高级经理、研发总监；2023 年 5 月至今，任公司研发总监。

张盈女士，女，1981 年 6 月出生，中国国籍，拥有德国永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 1 月至 2019 年 3 月，任 Panacol-Elosol GmbH 研发人员；2019 年 5 月至今，任青岛德聚研发总监。

（二）董事、监事会取消前监事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系

公司现任董事、监事会取消前监事、高级管理人员及其他核心人员之间不存

在亲属关系。

（三）公司与董事、监事会取消前监事、高级管理人员及其他核心人员签署的协议

截至本招股说明书签署日，在公司任职并领取薪酬的董事、监事会取消前监事、高级管理人员及其他核心人员与本公司签署了聘任合同或劳动合同、保密和竞业限制协议，与独立董事签订了《独立董事聘任合同》，上述合同或协议均履行正常，不存在违约情况。

（四）公司董事、监事会取消前监事、高级管理人员及其他核心人员所持股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事会取消前监事、高级管理人员及其他核心人员所持股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。

（五）董事、监事会取消前监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况

截至本招股说明书签署日，除在公司及其控股子公司任职以及独立董事在高等院校或律师事务所任职外，本公司董事、监事会取消前监事、高级管理人员及其他核心人员的主要兼职情况如下：

序号	姓名	公司职务	兼职单位	兼任职务	与发行人的关联关系
1	黄成生	董事长、总经理	赣州德熙	执行事务合伙人	公司实际控制人控制的其他企业
			赣州德益	执行事务合伙人	
			德森伯格	执行事务合伙人	
2	马慷慨	董事	Infinite Flex GmbH	总经理	公司董事马慷慨担任董事/高级管理人员的企业
			International Graphene Product Certification Center GmbH	总经理	
			德怡科技（太仓）有限公司	执行董事兼总经理	
			苏州德顿石墨烯新材料研究院有限公司	执行董事兼总经理	
			江苏德鼎能源科技有限公司	执行董事兼总经理	
			德鼎健生物技术（太仓）有限公司	执行董事兼总经理	
3	王天琳	董事	英特尔（中国）有限公司北京分公司	董事总经理	其关联方英特尔亚太研发有限公司现持有公司

序号	姓名	公司职务	兼职单位	兼任职务	与发行人的关联关系
					4.7602%股份
			紫光展锐（上海）科技股份有限公司	董事	公司董事王天琳担任董事的企业
			宁波隔空智能科技有限公司	董事	
			浙江三时纪科技股份有限公司	董事	
			珠海亿智电子科技有限公司	董事	

（六）董事、监事会取消前监事、高级管理人员及其他核心人员的合法合规情况

报告期内，公司董事、监事会取消前监事、高级管理人员及其他核心人员不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

（七）董事、监事会取消前监事、高级管理人员及其他核心人员的投资情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事会取消前监事、高级管理人员及其他核心人员除直接或间接持有公司股权情况外，其他对外投资情况如下：

姓名	在本公司职务	被投资单位名称	注册资本	出资比例
马慷慨	董事	德怡科技（太仓）有限公司	55.5 万欧元	100.0000%
		苏州德顿石墨烯新材料研究院有限公司	600 万元	100.0000%
		深圳厚存京英企业管理合伙企业（有限合伙）	300 万元	1.6667%
		Infinite Flex GmbH	3 万欧元	80.0000%
		Sixonia Tech GmbH	16.66 万欧元	15.0060%
		江苏德鼎能源科技有限公司	1,159.48 万元	29.3235%
		德鼎健生物技术（太仓）有限公司	300 万元	江苏德鼎能源科技有限公司持股 36.0000%
陈小云	职工代表董事、监事会取消前监事	吴中区金庭华汇美贸易商行	3.00 万元	100.0000%

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事会取消前监事、高级管理人员及

其他核心人员的对外投资与公司不存在利益冲突。

（八）董事、监事会取消前监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况和原因

最近两年，公司董事、监事会取消前监事、高级管理人员及其他核心人员变动情况如下：

1、董事变动情况

期间	董事	变更情况	变更程序	变更原因
2024 年 1 月至 2024 年 10 月	黄成生、王延鲲、张芬、邱国明、刘晓旸、张文彬、刘宁悦	-	-	-
2024 年 10 月至 2026 年 1 月	黄成生、王延鲲、张芬、马慷慨、刘晓旸、张文彬、刘宁悦	1 名董事发生变更：原董事邱国明变更为马慷慨	2024 年 10 月 23 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，选举马慷慨为第一届董事会非独立董事。	原董事邱国明因个人原因离职，补选马慷慨为董事。
2026 年 1 月至今	黄成生、张芬、马慷慨、王天琳、陈小云、姚进、刘晓旸、刘宁悦、吴旭青	1、原独立董事张文彬变更为吴旭青；2、原董事王延鲲不再担任董事职务；3、新增三名董事：姚进、陈小云（职工代表董事）、王天琳	2026 年 1 月 23 日，公司召开 2026 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整董事会成员人数的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；公司召开职工代表大会，选举陈小云为职工代表董事。	董事会换届，一名原非独立董事任期届满离任，新增三名非独立董事，以及变更一名独立董事。其中，公司现有职工人数超过 300 人，根据新《公司法》规定，公司董事会中应当设立职工代表董事。为落实新《公司法》的内部监督机构调整，公司增设 1 名职工代表董事。

2、监事/审计委员会成员变动情况

2026 年 1 月 23 日，公司召开 2026 年第一次临时股东大会，决议取消了公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。本次调整后公司治理结构有效，不影响发行人内部控制的规范性。

2026 年 1 月 23 日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，审计委员会成员变更为刘宁悦（主任委员）、吴旭青、陈小云。

3、高级管理人员变动情况

期间	高级管理人员	变更情况	变更程序	变更原因
2024 年 1 月至 2024 年 10 月	黄成生（总经理）、张芬（副总经理）、Junjun Wu（吴俊珺）（副总经理）、邱国明（财务负责人）、姚进（董事会秘书）	-	-	-
2024 年 10 月至今	黄成生（总经理）、张芬（副总经理）、Junjun Wu（吴俊珺）（副总经理）、姚进（董事会秘书、财务负责人）	原财务负责人邱国明离职，聘任姚进为财务负责人。	2024 年 10 月 30 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，聘任董事会秘书姚进为公司财务负责人。	原财务负责人邱国明因个人原因离职，聘任姚进为财务负责人。

4、其他核心人员变动情况

期间	其他核心人员	变更情况	变更程序	变更原因
2024 年 1 月至 2025 年 12 月	韩火年、张盈、Junjun Wu（吴俊珺）、贾付云	-	-	-
2025 年 12 月至今	韩火年、张盈、Junjun Wu（吴俊珺）	原核心技术人员贾付云离职。	-	原核心技术人员贾付云因个人原因离职。

（九）董事、监事会取消前监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事会取消前监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属持有公司股份情况如下：

序号	姓名	与发行人关系	直接持股（%）	间接持股（%）	间接持股主体	合计持股（%）	股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况
1	黄成生	董事长、总经理	29.4863	2.3500	赣州德熙、赣州德益、德森伯格	31.8363	无
2	余珩	董事马慷慨配偶	14.4919	-	-	14.4919	无
3	王延鲲	原董事	9.7498	-	-	9.7498	无
4	邱国明	原董事	-	0.3653	赣州德熙	0.3653	无
5	张芬	董事、副总经理	-	0.3653	赣州德熙	0.3653	无
6	王忠利	监事会取消前监事会主席	-	0.3042	赣州德熙	0.3042	无
7	陈小云	董事、监事会取消前监事	-	0.3653	赣州德熙	0.3653	无
8	郑微	监事会取消前	-	0.3653	赣州德熙	0.3653	无

序号	姓名	与发行人关系	直接持股（%）	间接持股（%）	间接持股主体	合计持股（%）	股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况
		职工代表监事					
9	Junjun Wu（吴俊珺）	副总经理、核心技术人员	-	0.9429	赣州德益	0.9429	无
10	韩火年	核心技术人员	-	0.2432	赣州德熙	0.2432	无
11	张盈	核心技术人员	-	0.3653	赣州德熙	0.3653	无
12	黄钰喆	黄成生的女儿	-	0.0063	宁波高易	0.0063	无
13	姚进	董事、董事会秘书、财务负责人	-	0.3027	德森伯格	0.3027	无

注：黄钰喆系发行人股东宁波高易的有限合伙人。

（十）董事、监事会取消前监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况

1、薪酬组成

公司建立了完善的薪酬考核体系，公司董事（不含独立董事及未领取薪酬的董事）、监事会取消前监事、高级管理人员及其他核心人员从公司领取的薪酬主要由基本工资、绩效工资、津贴及年终奖金构成。

公司独立董事领取固定津贴，具体标准由公司参照市场水平确定。

2、薪酬确定依据及所履行的程序

公司董事（不含独立董事及未领取薪酬的董事）、监事会取消前监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由工资、津贴及奖金组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果（如需）等确定。公司董事会薪酬与考核委员会，按照薪酬计划及绩效考评结果，提出具体薪酬指标，报董事会批准后执行。

公司独立董事在公司所领取的津贴，参照资本市场中独立董事津贴的一般水平拟定，并经公司股东（大）会批准确定。

3、报告期内薪酬总额占各期利润总额的比重

报告期内，公司董事、监事会取消前监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬总额及其占各期公司利润总额的比重如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
薪酬总额	1,829.49	1,654.03	1,404.28

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利润总额	13,794.45	7,699.97	5,249.51
金额占比	13.39%	19.92%	25.62%

4、董事、监事会取消前监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年在公司及其关联企业领取薪酬情况

2025 年度，公司现任董事、监事会取消前监事、高级管理人员及其他核心人员在本公司领取薪酬的情况如下：

序号	姓名	职务	2025 年税前薪酬（万元）	是否在关联企业领薪
1	黄成生	董事长、总经理	143.86	否
2	王延鲲	原董事	239.38	否
3	马慷慨	董事	50.00	否
4	张芬	董事、副总经理	378.20	否
5	姚进	董事、董事会秘书、财务负责人	106.13	否
6	陈小云	职工代表董事、监事会取消前监事	383.53	否
7	王天琳	董事	-	否
8	刘晓旸	独立董事	12.00	否
9	张文彬	原独立董事	12.00	否
10	刘宁悦	独立董事	12.00	否
11	吴旭青	独立董事	-	否
12	王忠利	监事会取消前监事会主席	65.95	否
13	郑微	监事会取消前职工代表监事	85.62	否
14	Junjun Wu（吴俊珺）	副总经理、首席技术官	142.04	否
15	韩火年	核心技术人员	113.32	否
16	张盈	核心技术人员	85.45	否

注 1：姚进、王天琳、吴旭青自 2026 年 1 月起任公司董事/独立董事。
注 2：最近一年是否在关联企业领薪之关联企业指发行人实际控制人控制的其他企业。

七、发行人已制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排

截至本招股说明书签署日，公司通过员工持股平台对员工进行股权激励。

（一）申报前已实施的股权激励

公司在本次申报前已制定和实施的股权激励系通过员工持股平台增资入股

的方式进行，截至本招股说明书签署日，相关员工持股平台合计持有公司 11.3771%的股份。此外，公司子公司南通德聚半导体亦对其员工实施了股权激励。

1、员工持股平台基本情况

截至本招股说明书签署日，公司共有 4 个员工持股平台，即赣州德熙、赣州德益、赣州德悦、德森伯格。同时，发行人控股子公司南通德聚半导体设立了 1 个员工持股平台，即南通聚芯。

赣州德熙、赣州德益及德森伯格的基本信息及合伙人构成参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（五）其他持有发行人 5%以上股份的主要股东”之“3、赣州德熙、德森伯格”。

赣州德悦及南通聚芯的基本信息及合伙人构成如下：

（1）赣州德悦

截至本招股说明书签署日，赣州德悦的基本信息如下：

企业名称	赣州市德悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91441900MA55Q6DQ4W
成立时间	2020-12-21
出资额	560 万元
执行事务合伙人	李展红
住所	江西省赣州市赣州经济技术开发区数字金融产业园华昌科技园 Z1 办公楼 7 层 7005-50 室
经营范围	企业管理咨询服务；技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

赣州德悦的合伙人和出资比例情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	李展红	普通合伙人	19.9920	3.5700
2	李娅	有限合伙人	124.7680	22.2800
3	李文俊	有限合伙人	19.9920	3.5700
4	李春媛	有限合伙人	19.9920	3.5700
5	李霞	有限合伙人	19.9920	3.5700
6	李兆国	有限合伙人	19.9920	3.5700

序号	合伙人姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
7	吴鹏	有限合伙人	19.9920	3.5700
8	李彬彬	有限合伙人	19.9920	3.5700
9	聂淑英	有限合伙人	19.9920	3.5700
10	张晓亮	有限合伙人	19.9920	3.5700
11	石彪	有限合伙人	12.0240	2.1471
12	廖星原	有限合伙人	10.0240	1.7900
13	彭婧	有限合伙人	10.0240	1.7900
14	朱雪丽	有限合伙人	10.0240	1.7900
15	刘岚	有限合伙人	10.0240	1.7900
16	贺诗泉	有限合伙人	10.0240	1.7900
17	覃健	有限合伙人	10.0240	1.7900
18	张济明	有限合伙人	10.0240	1.7900
19	罗勇	有限合伙人	10.0240	1.7900
20	胡济楠	有限合伙人	10.0240	1.7900
21	胡乾穹	有限合伙人	10.0240	1.7900
22	唐鹏	有限合伙人	10.0240	1.7900
23	刘远琼	有限合伙人	10.0240	1.7900
24	利柳珍	有限合伙人	10.0240	1.7900
25	王蓉	有限合伙人	10.0240	1.7900
26	蔡伟	有限合伙人	10.0240	1.7900
27	成业	有限合伙人	5.9920	1.0700
28	薛君	有限合伙人	5.9920	1.0700
29	刘恩民	有限合伙人	5.9920	1.0700
30	陈雪玲	有限合伙人	5.9920	1.0700
31	吴春华	有限合伙人	5.9920	1.0700
32	张旭	有限合伙人	5.9920	1.0700
33	李锦桂	有限合伙人	5.9920	1.0700
34	沈铁如	有限合伙人	5.9920	1.0700
35	苏晓霞	有限合伙人	5.9920	1.0700
36	别华川	有限合伙人	4.9960	0.8921
37	陈小平	有限合伙人	4.9960	0.8921
38	程芳文	有限合伙人	4.9840	0.8900
39	丁辉	有限合伙人	4.0160	0.7171

序号	合伙人姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
40	何玉玲	有限合伙人	3.9760	0.7100
41	许海东	有限合伙人	3.0240	0.5400
42	张娟	有限合伙人	3.0000	0.5357
43	纪宁宁	有限合伙人	3.0000	0.5357
44	梁水清	有限合伙人	3.0000	0.5357
45	付平振	有限合伙人	4.0000	0.7143
合计			**560.0000**	**100.0000**

注：成业未在公司任职，其系原深圳美科泰员工何丽的配偶，何丽去世后，成业继承何丽在赣州德悦的财产份额。

（2）南通聚芯

截至本招股说明书签署日，南通聚芯的基本信息如下：

企业名称	南通聚芯半导体科技中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91320691MAC4RTC997
成立时间	2022-12-23
出资额	136.3116 万元
执行事务合伙人	KWON JEONGMIN
住所	江苏省南通市开发区新兴东路 1 号 9-2#
经营范围	一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；电子专用材料研发；科技推广和应用服务；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备销售；半导体照明器件销售；电子专用材料销售；电子专用设备销售；合成材料销售；电子产品销售；密封件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；增材制造装备销售；新型膜材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；技术进出口；进出口代理；货物进出口；工业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，南通聚芯的合伙人和出资比例情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	KWON JEONGMIN	普通合伙人	26.0084	19.0801
2	魏冲	有限合伙人	31.2444	22.9213
3	李银学	有限合伙人	19.9971	14.6701
4	籍欣	有限合伙人	11.2508	8.2537

序号	合伙人姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
5	许玲玲	有限合伙人	9.9968	7.3338
6	蔡雪锋	有限合伙人	9.9968	7.3338
7	朱大华	有限合伙人	20.0095	14.6792
8	陈星雨	有限合伙人	4.9962	3.6653
9	陈尔励	有限合伙人	2.8116	2.0626
合计			**136.3116**	**100.0000**

2、员工持股平台股份锁定承诺

赣州德熙、赣州德悦、德森伯格的锁定承诺参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件二：与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”之“（一）关于本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”。

（二）申报前制定、上市后实施的期权激励计划

截至本招股说明书签署日，公司不存在本次发行前制定、上市后实施的期权激励计划。

（三）对发行人经营状况、财务状况、控制权变化的影响

1、股权激励对经营状况的影响

公司针对董事、监事会取消前监事、高级管理人员和其他核心人员等实施股权激励，使员工可以分享公司发展经营成果，调动了员工的工作积极性，增强了员工对公司的认同感，提升了公司的凝聚力和人员稳定性，兼顾了公司长期和短期利益，有利于公司的持续稳定经营发展。

2、股权激励对财务状况的影响

由于实施股权激励，公司于报告期内确认的股份支付金额分别为 848.18 万元、369.64 万元和 649.78 万元，股份支付金额对公司净利润产生一定影响，但未对公司总体财务状况造成重大不利影响。

3、股权激励对公司控制权的影响

公司实施股权激励前后，控股股东、实际控制人未发生变化，未对公司控制权产生影响。

八、发行人员工情况

（一）员工构成情况

1、员工人数

报告期各期末，公司员工人数分别为 478 人、443 人和 461 人，整体保持稳定，公司员工人数与公司业务发展需求相匹配。

2、员工构成

（1）专业结构

截至 2025 年 12 月 31 日，公司员工专业结构情况如下：

专业岗位	人数（人）	占总人数的比例（%）
管理人员	92	19.96
销售人员	97	21.04
研发人员	120	26.03
生产人员	152	32.97
合计	**461**	**100.00**

（2）学历构成

截至 2025 年 12 月 31 日，公司员工学历结构情况如下：

受教育程度	人数（人）	占总人数的比例（%）
博士研究生	5	1.08
硕士研究生	43	9.33
本科	183	39.70
专科及以下	230	49.89
合计	**461**	**100.00**

（3）年龄结构

截至 2025 年 12 月 31 日，公司员工年龄结构情况如下：

年龄	人数（人）	占总人数的比例（%）
30 岁及以下	158	34.27
31 岁至 40 岁	193	41.87
41 岁至 50 岁	81	17.57
51 岁及以上	29	6.29

年龄	人数（人）	占总人数的比例（%）
合计	461	100.00

（二）社会保险和住房公积金缴纳情况

公司主要实行劳动合同制，员工根据与公司签订的劳动合同享受权利和承担义务。公司按照《中华人民共和国劳动法》及国家和地方政府有关规定参加了社会保障体系，实行养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险及生育保险等社会保险制度，定期向社会保险统筹部门缴纳上述各项保险，并按照国家有关政策建立了住房公积金制度。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司员工共 461 名，其中，公司及境内子公司合计 445 人（含境内工作的外籍员工 5 人），境外子公司 16 人。公司境内员工缴纳社会保险和住房公积金的情况如下：

项目	社会保险	住房公积金
总人数（A）	**461**	**461**
其中：		-
当月新入职员工（B）	4	4
退休返聘（C）	13	13
境外子公司员工（D）	16	16
境内外籍员工（E）	需缴纳且均已缴纳	5
应缴纳总人数（F=A-B-C-D-E）	**428**	**423**
应缴纳未缴纳人数（G=H+I）	**1**	**21**
其中：		-
主动放弃缴纳（H）	0	4
其他情形（I）（注）	1	17
应缴纳已缴纳人数（J=F-G）	**427**	**402**
缴纳比例（K=J/F）	**99.77%**	**95.04%**

注： 其他情形（I）中，未缴纳社保的其他 1 人系试用期员工；未缴纳公积金的其他 17 人中，16 人为试用期员工，1 人为即将退休的员工。

根据公司及境内子公司信用报告（无违法违规证明版），报告期内公司及境内子公司不存在因违反社保、住房公积金等相关法律法规而受到行政处罚的情形。

第五节 业务与技术

一、公司主营业务、主要产品或服务情况

（一）公司主营业务

公司是一家专注于电子专用高分子材料的研发、生产和销售的国家重点“小巨人”企业，主要产品为电子胶粘剂，并围绕客户具体用胶场景提供配套应用方案，已形成覆盖智能终端、新能源、半导体、通信等领域的产品布局。

电子产品需要在有限空间里实现高效协作，芯片、电子元器件、线路板、功能模组及结构件等构成了它的主体，电子胶粘剂则是贯穿其间的“无形纽带”，使不同材料、器件和结构在长期运行中保持稳定配合。电子胶粘剂在电子产品中承担可靠连接、功能防护和性能承载等职责，在微小空间内实现连接、防护、导热散热、导电绝缘、应力缓冲等功能，并由此直接影响着终端产品生产良率、运行可靠性和使用寿命。随着下游终端产品向轻薄化、小型化、高集成度、高功率密度和高可靠性方向发展，电子胶粘剂已成为保障关键电子材料的供应链安全的重要基础材料之一。

公司已在多个电子制造场景形成代表性产品成果，原创开发的柔性电路板（FPC）用元器件包封胶，通过光热双固化体系和低模量配方设计，实现快速定位、深层固化、高电绝缘、低应力及柔韧性的平衡，保障消费电子产品电性能的长期稳定，已在苹果等多个知名终端品牌商的智能终端产品中实现规模化应用；公司自主研发的磁芯粘接胶，适配磁芯材料与 PCB 之间的功能性粘接及 SMT 回流固化工艺，兼具高粘接强度、柔韧性和车规级高可靠性，成为特斯拉指定供应商。在此基础上，公司持续向芯片级封装等高附加值用胶场景拓展，是国内少数实现芯片级底部填充胶在倒装芯片（Flip Chip）封装等先进封装工艺中产业化应用的厂商，并具备芯片固晶胶膜（DAF）、各向异性导电胶膜（ACF）等高端半导体膜材开发能力，为公司进一步完善产品矩阵和后续产业化转化提供了充足的产品储备。

公司坚持自主研发和技术创新，围绕电子胶粘剂原材料开发与修饰、产品配方设计、生产工艺优化及产业化应用持续投入，已形成以丙烯酸酯、环氧树脂、

有机硅、聚氨酯、改性硅烷、杂化等为基础的六大化学体系产品平台。截至本招股说明书签署日，公司已获发明专利授权 65 项、实用新型专利授权 49 项。公司荣膺工业和信息化部的新一轮第一批国家重点“小巨人”企业及第三批专精特新“小巨人”企业，经广东省科学技术厅认定为“广东省新型高端电子胶粘剂（德聚）工程技术研究中心”，经广东省工业和信息化厅认定为“第 22 批省级企业技术中心”和“2024 年广东省省级制造业单项冠军企业-丙烯酸电子胶粘剂”。

凭借产品性能、质量稳定性、技术响应能力及持续供货能力，公司已进入多家下游知名客户的供应链体系，业务遍及亚洲、美洲及欧洲，并在部分应用场景与汉高、陶氏化学、3M、富乐、德路等国际厂商直接竞争。报告期内，公司主要向东山精密、鹏鼎控股、立讯精密、安费诺、旗胜电子、Sanmina、台郡科技、和硕、富士康等全球知名电子制造厂商直接供货，产品最终应用于苹果、特斯拉、OPPO、华为、阳光电源、比亚迪、vivo、小米、三星、宁德时代等知名终端品牌商或其产业链客户，形成了覆盖智能终端、新能源、半导体、通信等领域的规模化应用能力。此外，公司围绕芯片封装、光模块、AI 服务器等高附加值用胶场景推进产品导入和客户拓展，已陆续通过卓胜微、通富微电、舜宇光学、中际旭创、MPS、恒诺微等客户的产品验证测试。随着终端产品迭代、先进封装自主配套加速及新兴算力基础设施建设等需求提升，公司将持续拓宽产品矩阵和应用边界，推动技术积累向规模化收入转化。

公司产品覆盖的主要直接客户及终端品牌商图谱

（二）主要产品

公司主要产品为电子胶粘剂，属于典型的配方型、应用型功能材料，产品形态、性能指标和工艺要求通常与客户具体应用场景高度相关。因此，公司主要按

照下游应用领域及用胶场景对产品进行分类，已形成覆盖智能终端、新能源、半导体、通信等领域多个用胶场景的产品布局。

在各应用领域中，公司已形成以收入占比较高，或已导入客户体系具有代表性的产品为核心的产品矩阵：智能终端领域主要包括元器件包封胶、结构粘接密封胶、高可靠性环氧胶等；新能源领域主要包括磁芯粘接胶、包封补强胶、密封胶、三防漆等；半导体领域主要包括导热界面材料、底部填充胶、AA 制程胶、芯片塑封隔离膜、芯片固晶胶膜（DAF）、各向异性导电胶膜（ACF）等；通信领域主要包括电磁屏蔽胶、光模块密封胶、AI 电源模组导热粘接胶等。该等产品广泛应用于智能手机、可穿戴设备、新能源汽车、半导体功率器件、半导体芯片、5G 基站、高速光模块、AI 服务器等各类终端产品与核心设备。

公司主要产品实物图

电子胶粘剂作为电子制造中的关键功能性材料，在终端产品内部承担可靠连接、功能防护和性能承载等职责。从作用机理看，其通过与基材表面形成稳定、持久的物理与化学结合界面，将芯片等电子元器件、线路板、功能模组及结构件在微小空间内精准固定，并同步实现防护密封、导热散热、导电绝缘、应力缓冲等功能。从应用环境看，电子胶粘剂需要在终端产品长期使用过程中持续承受温度循环引发的热应力、机械振动与冲击、电流负载等工况影响，并抵御湿度渗透、化学腐蚀、紫外线老化等复杂环境的侵扰。因此，决定电子胶粘剂产品性能的并非是单一粘接强度指标，而是机械性能、工艺性能、电气性能和热管理性能的综合体现，具体包括初始粘接强度、长期耐久性、抗跌落冲击能力、工艺适应性，

以及介电强度、介电常数、导热系数、体积电阻率和长期电性能稳定性等指标。

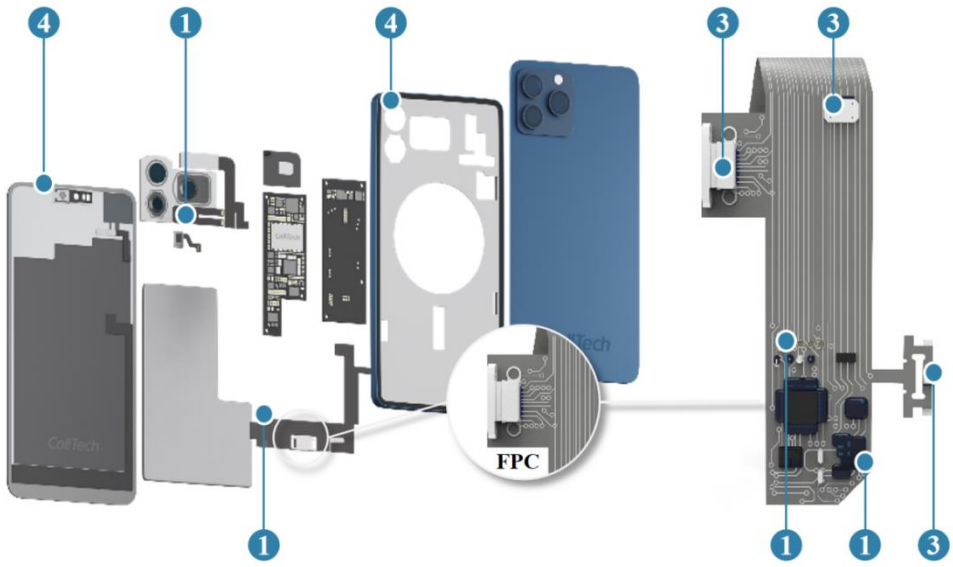
1、智能终端领域电子胶粘剂

（1）智能终端领域电子胶粘剂应用场景

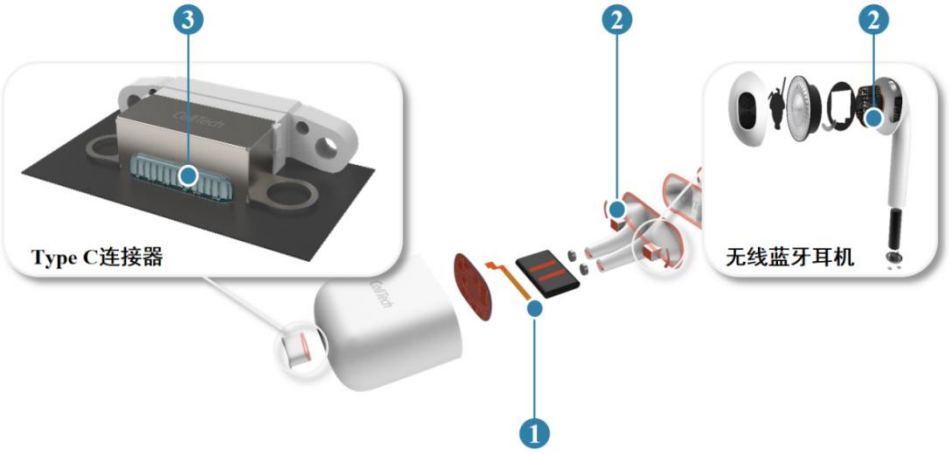
智能终端产品内部空间有限，电子元器件密度高，产品持续向轻薄化、小型化、柔性化和多功能化方向发展。智能手机、个人电脑、平板、TWS 耳机、智能手表、AR/VR 设备及无人机等各种电子产品及配件中的 FPC、PCBA、连接器、摄像头、结构件及整机外壳等均需使用电子胶粘剂。相较于螺丝、卡扣、焊接等机械连接方式，电子胶粘剂能够在不增加显性结构件的情况下，实现微小空间内的无损、低应力连接和多功能防护。

公司智能终端领域的主要产品包括元器件包封胶、结构粘接密封胶、高可靠性环氧胶等，能够适配核心元器件防护、整机结构密封、核心组件粘接等关键环节的用胶需求，覆盖超过 50 个产品用胶点，从元器件到整机层面为智能终端提供包封、粘接、导热、绝缘、抗腐蚀、密封与防护等全方位支撑，助力智能终端实现更轻薄的结构设计、更低损耗的 5G、蓝牙等高频信号传输，以及复杂使用场景下的长期运行可靠性，满足下游终端厂商对产品性能的高端化、多元化需求。以智能手机、TWS 耳机等为例，公司智能终端领域部分产品及用胶点示意如下：

智能手机部分用胶点示意图



TWS 耳机部分用胶点示意图



对应公司产品 ① 元器件包封胶 ② 结构粘接密封胶 ③ 高可靠性环氧胶 ④ 反应型聚氨酯热熔胶

注：公司产品具有多样化特点，上图仅为部分典型应用场景及产品类型的示意性列示，图示产品类型可能涵盖下文未逐项展开的其他产品或型号。

（2）公司智能终端领域电子胶粘剂主要产品情况

公司智能终端领域报告期内收入占比较高或具有代表性的电子胶粘剂的产品如下所示：

产品类型	产品用途及用胶场景	产品创新性及优势	应用场景
元器件包封胶	专为电子智能终端上元器件设计的包封保护材料，通过固化形成防护层实现物理隔离与环境防护	**痛点及创新：** 传统包封胶难以兼顾高电绝缘、强粘接、低应力、化学兼容性等互斥性能的平衡，调控包封精度不足，难以适配智能终端紧凑空间与高频信号传输需求。公司通过原材料修饰、配方优化和反复测试验证，以分子级调控实现多项功能参数精准调控，形成适用于智能终端元器件的专用包封保护材料 **产品优势：** 1）防护性能全面，可抵御湿气、腐蚀、振动、高温等严苛环境，为元器件构建多维度防护屏障； 2）性能协同性优异，兼顾高导热、电绝缘、强粘接与低应力，适配终端产品紧凑化、高集成化设计； 3）高频兼容性好，不干扰 5G、蓝牙等高频信号传输，保障元器件信号传输稳定； 4）可靠性突出，显著提升智能终端运行稳定性和全生命周期使用寿命	手机、平板、耳机、手表等
结构粘接密封胶	填充智能终端结构件缝隙的专用胶粘剂，固化后形成致密柔韧防护层，兼具粘接、密封	**痛点及创新：** 传统填缝胶难以平衡填充流动性与点胶定型性，产线连续使用时粘度稳定性差，难以满足高等级防水防尘、整机防护及抗冲击要求。公司通过原材料纯化、配方优化和工艺优化，平衡胶体流变特性，实现产线连续使用过程中粘度的高度稳定，形成适用于智能终端结构件的专用密封填缝材料	手机、平板、耳机、手表等

产品类型	产品用途及用胶场景	产品创新性及优势	应用场景
	双重功能	**产品优势：** 1）密封性能优异，可实现 IP68 级防水、防尘、防汗液，阻挡外界杂质侵入精密器件； 2）流变特性可控，兼顾微米级缝隙填充能力、点胶瞬时定型效果与无法流淌等问题； 3）结构增强效果突出，可提升整机刚性与抗扭强度，缓冲跌落冲击，适配复杂使用环境； 4）工艺适配性强，在产线连续使用过程中粘度稳定，显著提升终端组装良率和产品竞争力	
高可靠性环氧胶	适配智能终端组件组装的耐高温粘接胶，可耐受260℃无铅回流焊瞬时高温	**痛点及创新：** 传统粘接胶在无铅回流焊高温下易出现性能衰减，多基材浸润性差，难以适配 SMT 产线一体化生产工艺，组件定位精度与可靠性不足。公司通过原材料筛选、配方优化和工艺优化，实现高温下性能零衰减与多基材完美浸润，形成适用于智能终端组件组装的耐高温粘接材料 **产品优势：** 1）耐高温性能优异，可耐受 260℃无铅回流焊瞬时高温，核心性能无衰减； 2）粘接适配性强，可与 PA、金属等多种基材完美浸润，确保组件精准定位与粘接可靠性； 3）工艺兼容性好，适配 SMT 产线一体化生产，显著提升产品组装良率； 4）可靠性强，为组件提供长期应力缓冲与机械加固，提升终端整体运行稳定性	手机、平板、耳机、手表等

2、新能源领域电子胶粘剂

（1）新能源领域电子胶粘剂应用场景

在新能源领域，新能源汽车、储能系统及光伏等应用场景对电子胶粘剂的高可靠性、耐温湿老化、抗振动冲击、绝缘防护、导热散热和长期稳定性要求高。其中，新能源汽车是公司新能源领域电子胶粘剂的重要应用方向。随着新能源汽车产业向电气化、智能化持续升级，“三电系统”、高级驾驶辅助系统、智能座舱等汽车电子应用快速发展，电子胶粘剂在结构粘接、导热散热、电气连接、信号传输和元器件防护等环节的作用日益突出。

相较一般电子应用场景，汽车电子产品长期处于温湿度变化、化学腐蚀、机械振动、冷热冲击等复杂工况中，对材料的粘接强度、抗老化、耐腐蚀和长期耐久性提出更为严苛的车规级要求。公司依托自主研发的核心技术体系开发、生产车规级电子胶粘剂，可有效抵御温湿度波动、化学腐蚀、机械振动等复杂外部环境对汽车电子元器件的不利影响，保障元器件在额定工况下长期稳定运行，显著

提升其工作可靠性、使用寿命和信号传输稳定性，契合新能源汽车产业的核心发展需求。

以新能源汽车“三电系统”为例，其对复杂路况适应性、使用寿命、安全性、舒适性及轻量化均有较高要求，相应电池、电机、电控等部件需要具备结构稳定、高可靠、小体积、轻重量、持久耐用等特点，因此电子胶粘剂广泛应用于其中的结构粘接、导热散热、电气连接和信号传输等场景。

针对上述核心应用需求，公司自主研发形成了磁芯粘接胶、包封补强胶、密封胶、三防漆等车规级品类，适配新能源领域核心用胶场景。以新能源汽车为例，公司新能源领域部分产品及用胶点示意如下：

新能源汽车部分用胶点示意图

对应公司产品	① 磁芯粘接胶 ② 包封补强胶 ③ 三防漆 ④ 灌封胶 ⑤ 汽车电子导热界面材料 ⑥ 密封胶 ⑦ 结构粘接胶

注：公司产品具有多样化特点，上图仅为部分典型应用场景及产品类型的示意性列示，图示产品类型可能涵盖下文未逐项展开的其他产品或型号。

（2）公司新能源领域电子胶粘剂主要产品情况

公司新能源领域报告期内收入占比较高或具有代表性的电子胶粘剂的产品如下所示：

产品类型	产品用途及用胶场景	产品创新性及优势	应用场景
磁芯粘接胶	磁芯粘接胶是新能源高功率平面变压器、电感的核心粘接材料，通过化学	**痛点及创新：** 传统磁芯粘接胶难以兼顾高粘接强度与柔韧性，在高温高湿、冷热循环等严苛工况下长期性能衰减快，易出现磁芯位移脱落、高频噪音等问题，难以适配新能源设备 10~15 年使用寿命要求。公司通过原材料开发、填料复配、配方优化和合成工艺，实现高粘接强度与柔韧性的精准平衡，	新能源汽车电控系统、储能电控系统、

产品类型	产品用途及用胶场景	产品创新性及优势	应用场景
	键合与机械互锁双重加固，实现超高强度锁合，固定磁芯核心部件，保障设备在严苛工况下长期稳定安全运行	以及严苛工况下长效性能稳定，形成适用于新能源平面变压器、电感的专用粘接固定材料 **产品优势：** 1）粘接强度高，通过化学键合加机械互锁双重加固，防止磁芯位移与脱落并消除高频工作噪音； 2）耐候性优异，可通过 10~15 年长效老化测试，在-40℃~125℃宽温域工况下性能稳定； 3）适配性强，完美匹配新能源汽车、储能电控系统高功率、高负载的应用需求； 4）可靠性突出，稳定保障电磁元件能量转换效率，为动力系统长期安全运行提供核心支撑	光伏逆变器等
包封补强胶	应用于新能源汽车及储能系统 CCS 组件，用于 FPC 及敏感电子元器件的包封、防护和机械补强，提升系统抗振动、耐腐蚀、防潮及长期运行可靠性	**痛点及创新：** 新能源汽车 CCS 系统长期工作于高温、高湿、振动及电化学腐蚀等严苛环境，对 FPC 敏感元器件的防护可靠性提出高要求。传统补强胶在长期服役过程中易出现老化失效、离子析出及机械性能衰减等问题，难以满足新能源汽车 15 年以上使用寿命要求。公司通过高纯度树脂设计、填料复配及可靠性优化，形成适用于新能源汽车 CCS 系统的包封补强材料，为动力电池系统提供长期稳定防护 **产品优势：** 1）防护性能优异，有效抵御振动冲击、湿热侵蚀及化学腐蚀； 2）长效可靠性强，满足新能源汽车全生命周期使用要求； 3）电气性能稳定，保障电芯信号采集与传输精准可靠； 4）安全保障能力突出，显著提升动力电池系统长期运行稳定性	新能源汽车电池系统、储能电池系统等
密封胶	应用于新能源汽车组件的单元密封胶，在壳体、接口间隙形成致密防护屏障，专注新能源汽车组件 PCBA 和电气连接保护	**痛点及创新：** 新能源汽车的电子控制系统长期工作于高温、高湿、振动及电化学腐蚀等严苛环境，对新能源汽车的电子控制系统元器件的防护可靠性提出高要求。传统密封胶在长期服役过程中易出现老化失效、机械性能衰减和密封失效等问题，难以满足新能源汽车 15 年以上使用寿命要求。公司通过耐高温高纯度树脂选用、配方优化设计和可靠性提高，形成适用于新能源汽车电子系统的密封胶，为汽车电子系统提供长期稳定防护 **产品优势：** 1）密封性能优异，形成致密防护屏障，有效防止水汽、污染物侵入，保障汽车电子内部洁净； 2）压缩力小，组装时螺纹锁紧力小； 3）精密点胶工艺适配性强，可实现微米级密封点胶，完美适配精密流体控制、视觉定位产线工艺； 4）长期稳定性强，有效缓冲热应力，显著提升新能源汽车电子组件的长期运行稳定性	新能源汽车电子控制组件
三防漆	应用于新能源汽车控制器 PCBA 表面涂覆，在电路板及电子	**痛点及创新：** 新能源汽车域控制器、电池管理系统及电控系统中的 PCBA 长期处于温度循环、湿热侵蚀、粉尘污染及腐蚀性介质等复杂工况，对涂覆材料的成膜均匀性、基材附着力、绝缘稳定性和耐环境老化能力要求较高。传统三防漆在复	新能源汽车域控制器、电池管理

产品类型	产品用途及用胶场景	产品创新性及优势	应用场景
	元器件表面形成连续、致密的防护膜层，用于提升PCBA在湿热、粉尘、腐蚀介质及电气应力等复杂环境下的绝缘防护能力和长期运行可靠性。	杂板面结构中易出现边角覆盖不足、膜层开裂、附着力下降或绝缘性能衰减等问题，影响电子控制单元的长期稳定运行。公司通过聚氨酯与丙烯酸杂化体系设计、流变控制、固化体系优化及可靠性验证，形成适用于新能源汽车PCBA涂覆工艺的三防漆材料，为汽车电子控制系统提供薄膜化、连续性的环境防护 **产品优势：** 1）成膜性能优异，可在复杂PCBA表面形成连续、致密防护膜层，提升焊点、线路及敏感元器件的环境隔离能力； 2）耐环境性能良好，可抵御湿热、粉尘及腐蚀性介质侵蚀，适配新能源汽车复杂使用场景； 3）绝缘性能稳定，有助于降低漏电、短路及信号异常风险，保障PCBA长期可靠工作； 4）工艺适配性强，适用于新能源汽车控制器批量化涂覆工艺，提升产品防护一致性和量产稳定性	系统、电控系统等

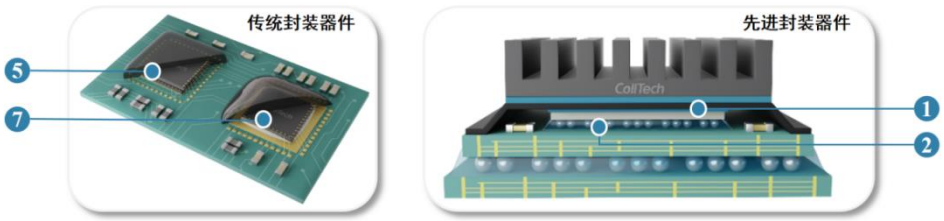
3、半导体领域电子胶粘剂

（1）半导体领域电子胶粘剂应用场景

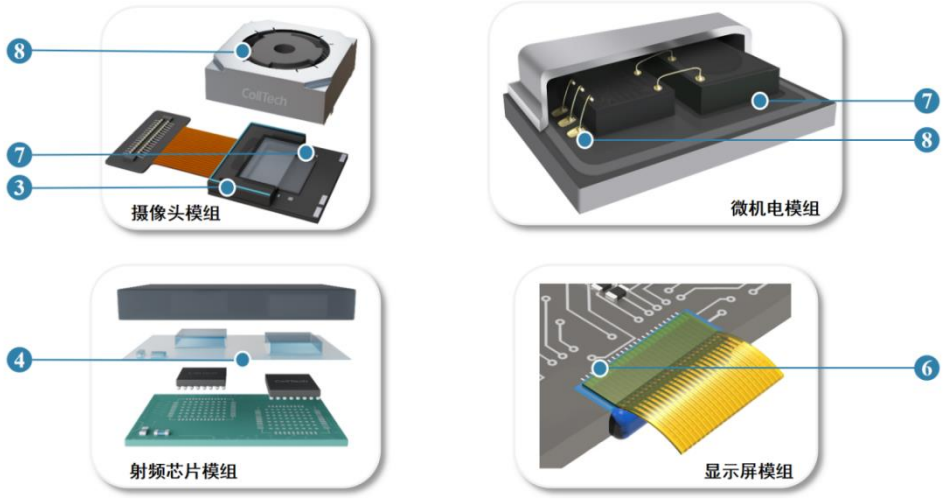
电子胶粘剂在半导体制造中的晶圆制造和封装环节均有运用，需要电子胶粘剂实现芯片粘接、防护、热量管理、应力缓和等功能，随着半导体器件向高功率、高密度、高可靠性和先进封装方向发展，对电子胶粘剂等材料的性能也相应提出更高要求。

公司半导体领域产品包括导热界面材料、底部填充胶、AA制程胶、芯片塑封隔离膜、芯片固晶胶膜（DAF）、各向异性导电胶膜（ACF）等，是公司培育未来增量业务、拓展高附加值应用场景的重要产品线，应用于先进封装、功率器件、射频芯片模组及光学芯片精密封装等场景。以半导体芯片封装、半导体模组封装为例，公司半导体领域部分产品及用胶点示意如下：

半导体芯片封装部分用胶点示意图



半导体模组封装部分用胶点示意图



对应公司产品	① 导热界面材料	② 底部填充胶	③ AA制程胶	④ 芯片塑封隔离膜
	⑤ 芯片固晶胶膜（DAF）	⑥ 各向异性导电胶膜（ACF）	⑦ 芯片固晶胶	⑧ 半导体模组封装结构胶

注：公司产品具有多样化特点，上图仅为部分典型应用场景及产品类型的示意性列示，图示产品类型可能涵盖下文未逐项展开的其他产品或型号。

（2）公司半导体领域电子胶粘剂主要产品情况

公司半导体领域报告期内收入占比较高或具有代表性的电子胶粘剂产品如下所示：

产品类型	产品用途及用胶场景	产品创新性及优势	应用场景
导热界面材料	填充芯片、功率器件与散热器间间隙的导热复合材料，构建高效导热通路，降低接触热阻	**痛点及创新：** 传统导热界面材料难以兼顾高导热性与可涂布性，高陶瓷粉体填充易导致可加工性下降，反复热循环下易出现“泵出”或永久变形等问题，难以解决高功率器件散热难题。公司通过填料复配、原材料纯化、配方优化和模拟验证，保障材料反复热循环下的结构稳定性，形成适用于芯片、功率器件的高效导热界面材料 **产品优势：** 1）导热性能优异，可构建高效导热通路，大幅降低芯片、功率器件结温，快速导出工作热量； 2）加工适配性强，兼顾高导热率与优异可涂布性，适配不同封装场景加工需求； 3）结构稳定性强，可在反复热循环下无“泵出”或永久压缩变形，长期保持低热阻状态； 4）热管理支撑能力突出，可为芯片高算力、微型化设计提供热管理解决方案，延长器件使用寿命	功率器件、芯片、电路板等
底部填充胶	填充 BGA、CSP 等芯片与 PCB 板间微米级间隙，将芯片与基板粘合为整体，分散焊点	**痛点及创新：** 传统底部填充胶难以在微米级间隙内实现无气泡均匀铺展，热膨胀系数与芯片、基板匹配度低，难以解决焊点疲劳开裂痛点并适配智能终端轻薄化升级需求。公司通过填料复配、配方优化和模拟验证，实现微米级间隙无气泡填充，优化分子结构实现热学参数与封装体系精准匹配，形成适用于 BGA 芯片的底部填充材料	芯片、电路板

产品类型	产品用途及用胶场景	产品创新性及优势	应用场景
	应力	**产品优势：** 1）填充性能优异，可在数微米间隙内快速、均匀铺展，无气泡和浸润不良问题； 2）应力缓冲效果突出，完美匹配芯片与基板热膨胀系数，从根源解决焊点疲劳开裂问题； 3）机械性能优异，大幅提升终端产品抗跌落、抗振动性能，支撑轻薄化、高集成化设计； 4）可靠性强，显著延长芯片及终端产品全生命周期使用寿命	
AA 制程胶	摄像头模组主动对位专用双固化粘接胶，在精准对位后快速锁定镜头与感光芯片相对位置	**痛点及创新：** 传统 AA 胶固化过程中体积收缩率高，易破坏微米级对位精度，小分子挥发物控制不足，易导致光学表面 “起雾”，无法保障高端影像系统成像精度。公司通过原材料开发、配方优化和模拟验证，配套高精度提纯工艺严控小分子挥发，形成适用于摄像头模组主动对位的双固化粘接材料 **产品优势：** 1）尺寸稳定性极致，固化近乎零体积收缩，实现微米级精准对位并长期锁定； 2）纯净度高，严控小分子挥发物，杜绝高温下光学表面 “起雾”，保障光学路径洁净； 3）环境适应性强，抵御极端温湿度环境，确保全生命周期内无跑焦、无画质衰减； 4）成像保障能力突出，保障高端影像系统的极致成像精度，提升终端影像体验	摄像头感光芯片模组
芯片塑封隔离膜	射频芯片封装专用隔离保护材料，在芯片与基板间形成封闭空腔，防止塑封料污染、入侵敏感结构	**痛点及创新：** 传统隔离膜难以同时满足高纯度、高热稳定性和高尺寸稳定性的严苛要求，杂质与低分子量物质去除不彻底，易污染射频芯片敏感结构并影响信号纯净度。公司通过原材料筛选与纯化，配方优化和模拟验证，实现挥发物＜0.01ppm 的超高纯度，优化分子结构的同时，实现耐高温与低收缩率，形成适用于射频芯片封装的专用隔离保护材料 **产品优势：** 1）纯度行业领先，挥发物＜0.01ppm，无杂质析出，不污染芯片敏感结构； 2）综合性能优异，耐受 260℃以上回流焊，热收缩率＜0.1%，兼具高热稳定性与高尺寸稳定性； 3）防护效果突出，为射频芯片微结构提供洁净防护空间，防止塑封料污染、入侵； 4）信号保障能力强，保障 5G 射频芯片高频高温环境下的信号纯净度与长期可靠性	射频滤波器芯片
芯片固晶胶膜（DAF）	半导体封装核心粘接材料，将芯片固定在基板/引线框架上，同时提供导热、	**痛点及创新：** 传统固晶胶难以平衡高粘接力、适配热膨胀系数、低模量、高耐热性等互斥性能指标，致小芯片贴装拾取良率、封装效率与良率不足，封装良率与可靠性不足。公司通过原材料修饰、配方优化和模拟验证，优化固晶胶膜模量和粘性，形成适用于半导体芯片固晶工艺的核心粘接	传统封装芯片、先进封装芯片

产品类型	产品用途及用胶场景	产品创新性及优势	应用场景
	电气连接功能	材料 **产品优势：** 1）综合性能均衡，兼顾高粘接力、精准热膨胀系数匹配、低模量和高耐热性，有效缓解芯片与基板的热应力； 2）工艺适配性强，可实现高速贴装时芯片拾取良率高，满足大规模量产高产出率的要求； 3）功能集成度高，同时提供牢固机械支撑、高效导热通道与可靠电气连接； 4）可靠性强，显著提升芯片封装良率与长期运行稳定性，支撑先进封装工艺发展	
各向异性导电胶膜（ACF）	应用于液晶显示器（LCD）、有机发光二极管（OLED）、触控模组、柔性电路板（FPC）及半导体封装等领域，用于芯片与基板、导电线路与显示面板之间的高密度互连，实现微小间距电子组件的Z向导电连接、牢固粘接及XY向绝缘保护	**痛点及创新：** ACF 是显示面板、触控模组、FPC 及半导体封装领域实现高密度互连的核心材料，长期以来市场主要由日本、韩国厂商主导，技术壁垒高、国产化难度大。ACF 需同时实现 Z 向稳定导电、XY 向高绝缘，并兼顾超细间距连接、高粘接可靠性及优异的耐热耐湿性能，对导电粒子分散、胶膜均匀性、界面结合力及量产工艺控制提出极高要求。公司通过自主开发的核心树脂体系、导电粒子分散技术及精密涂布工艺，突破 ACF 相关产品的开发，形成性能优异、供应安全可控的系列产品 **产品优势：** 1）互连性能优异，可实现微小间距、高密度电子组件稳定连接； 2）导电绝缘兼备，Z 向导电稳定、XY 向绝缘可靠； 3）制造工艺成熟，能够满足电子制造大规模量产需求	液晶显示器、柔性电路板、触控屏、芯片与基板、导电线路与显示面板

4、通信领域电子胶粘剂

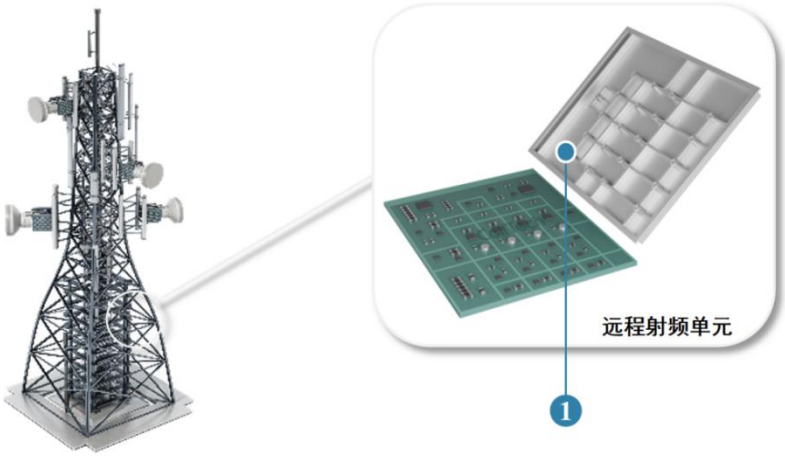
（1）通信领域电子胶粘剂应用场景

随着信息与通信技术快速发展，通信基站、数据中心等核心设施的集成度与信号传输密度持续提升，功耗与发热密度同步走高，设备对电磁屏蔽、系统散热及元器件保护需求明显增强，对相关材料的轻量化、高可靠性及信号传输稳定性提出了更高要求。电子胶粘剂可作为电磁屏蔽、导热及保护材料，用于解决通信设备电磁干扰、电磁泄漏、粘接补强、防护及散热等难题，提升设备屏蔽性能、散热性能和运行可靠性，并降低运行能耗。

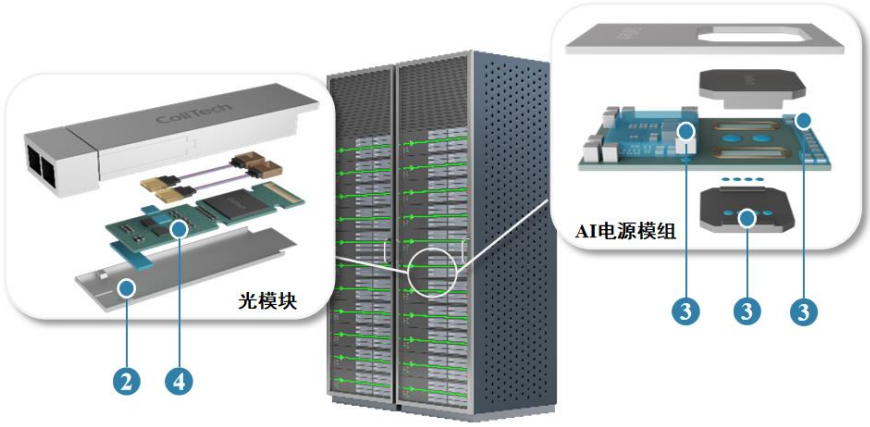
公司通信领域电子胶粘剂主要聚焦 5G 基站、高速光模块、AI 电源模块等核心应用场景，形成了电磁屏蔽胶、光模块密封胶、AI 电源模组导热粘接胶等产

品，广泛应用于通信基站、AI 服务器、数据中心服务器等通信核心设备。以通信基站、AI 服务器为例，公司通信领域部分产品及用胶点示意如下：

通信基站部分用胶点示意图



AI 服务器部分用胶点示意图



对应公司产品 1 电磁屏蔽材料 2 光模块密封胶 3 AI电源导热粘接胶 4 光模块包封胶

注：公司产品具有多样化特点，上图仅为部分典型应用场景及产品类型的示意性列示，图示产品类型可能涵盖下文未逐项展开的其他产品或型号。

（2）公司通信领域电子胶粘剂主要产品情况

公司通信领域报告期内收入占比较高或具有代表性的电子胶粘剂产品如下所示：

产品类型	产品用途及用胶场景	产品创新性及优势	应用场景
电磁屏蔽胶	通信设备专用功能胶，通过形成导电	**痛点及创新：** 传统电磁屏蔽胶难以实现超细线条稳定点胶，导电填料分散不均易堵针，严苛环境下长期使用屏蔽效能衰减快、易	5G 基站

产品类型	产品用途及用胶场景	产品创新性及优势	应用场景
	网络实现电磁屏蔽，同时兼具密封、防水、耐老化特性	回弹失效，难以保障通信设备信号稳定性。公司通过筛选不同粒径和形貌的导电填料，通过表面处理降低填料对工艺性能的影响，同时在配方中寻求不同粒径和形貌的最优比例的搭配，实现＜0.5mm 超细线条稳定点胶，优化配方保障严苛环境下屏蔽效能持久稳定，形成适用于通信设备的专用电磁屏蔽材料 **产品优势：** 1）屏蔽性能优异，高效吸收、反射高频电磁波，保障通信设备信号完整性与电磁兼容性； 2）精密点胶适配性强，可实现＜0.5mm 超细线条稳定点胶，不堵针、不流淌； 3）长期稳定性强，85℃/85%RH 高温高湿 1,000 小时、冷热冲击 1,000 次后，屏蔽效能仍保持 70dB 以上； 4）多功能集成，兼具密封、防水、耐老化特性，提升设备户外严苛环境下的运行稳定性	
光模块密封胶	高速光模块专用缝隙密封胶，封堵壳体、接口间隙，形成致密防护屏障，专注光学路径洁净保护	**痛点及创新：** 传统密封胶难以同时实现极致低释气与多基材强粘接力，难以适配微米级精密密封点胶工艺，易导致水汽、污染物侵入，影响光模块长期稳定性。公司通过对原料硅树脂的高温低真空薄膜蒸发纯化，提升原料纯度，同时在配方中选用适配体系的自研粘接助剂，突破实现低释气与强粘接的双重兼顾，优化流变特性适配微米级精密点胶，形成适用于高速光模块的专用缝隙密封材料 **产品优势：** 1）密封性能优异，形成致密防护屏障，有效防止水汽、污染物侵入，保障光模块内部洁净； 2）核心性能突破，可凝结挥发物 D3~D20＜50ppm，同时兼顾金属、陶瓷、LCP 多基材强粘接力； 3）精密工艺适配性强，可实现微米级密封点胶，完美适配精密流体控制、视觉定位产线工艺； 4）长效稳定性强，有效缓冲热应力，显著提升高集成度高速光模块的长期运行稳定性	光模块
AI 电源模组导热粘接胶	应用于 AI 服务器高功率电源模组，主要用于磁性器件、功率器件及散热结构之间的导热粘接、间隙填充和机械固定，实现高效散热、精准装配及长期可靠运行	**痛点及创新：** 随着 AI 服务器算力持续提升，电源模组功率密度、电流密度和发热量显著增加，对导热、粘接、绝缘及长期可靠性提出更高要求。传统导热粘接材料在高温回流、冷热冲击及长期高温高湿环境下，易出现性能衰减、界面失效及间隙控制不精准等问题。公司通过耐高温树脂设计、导热填料复配及流变特性优化，形成适用于 AI 服务器高功率电源模组的导热粘接材料，为高算力设备提供高可靠热管理解决方案 **产品优势：** 1）耐温性能突出，玻璃化转变温度高于 125℃； 2）可靠性优异，可通过三次无铅回流、85℃/85%RH 1,000 小时、高温老化及冷热冲击测试； 3）间隙控制精准，厚度控制精度可达±10%以内； 4）产品体系完善，可提供点涂、印刷、高导热及后固化等多样化解决方案	AI 服务器

5、配套设备与材料及其他

除电子胶粘剂外，公司根据客户具体应用需求，配套提供部分相关设备及辅助材料等，作为整体应用解决方案的补充。相关产品主要包括点胶机配件、固化设备及配件、解胶剂等，覆盖电子胶粘剂在点涂、固化等工艺环节的部分辅助需求，并可根据不同应用场景进行针对性选型与组合配置。

上述配套设备与材料及其他产品与公司电子胶粘剂产品在实际应用过程中具有协同关系。通过提供材料和工艺配套支持，公司能够更好地理解客户生产场景，提升客户产品导入、工艺适配及售后服务效率，从而增强公司电子胶粘剂产品的综合服务能力和客户粘性。

（三）主营业务收入构成及特征

1、主营业务收入构成

报告期内，公司主营业务收入按产品类型划分的构成情况如下：

单位：万元

项目	业务类型	应用领域	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
			金额	占比	金额	占比	金额	占比
电子胶粘剂	自产	智能终端	29,767.17	65.14%	24,908.11	64.80%	20,639.77	58.84%
		新能源	7,563.41	16.55%	6,142.09	15.98%	5,574.68	15.89%
		半导体	3,991.45	8.73%	3,410.48	8.87%	3,529.42	10.06%
		通信	2,439.89	5.34%	1,817.99	4.73%	2,083.11	5.94%
		其他领域	26.00	0.06%	29.53	0.08%	24.93	0.07%
		小计	**43,787.91**	**95.82%**	**36,308.20**	**94.46%**	**31,851.90**	**90.81%**
	贸易		663.45	1.45%	1,301.91	3.39%	2,628.87	7.49%
	电子胶粘剂小计		**44,451.36**	**97.28%**	**37,610.12**	**97.84%**	**34,480.77**	**98.30%**
配套设备与材料及其他	贸易		1,245.19	2.72%	828.62	2.16%	595.01	1.70%
合计			**45,696.55**	**100.00%**	**38,438.74**	**100.00%**	**35,075.78**	**100.00%**

注：“配套设备与材料及其他”包括材料销售，设备产品配件销售等。

2、主营业务收入特征

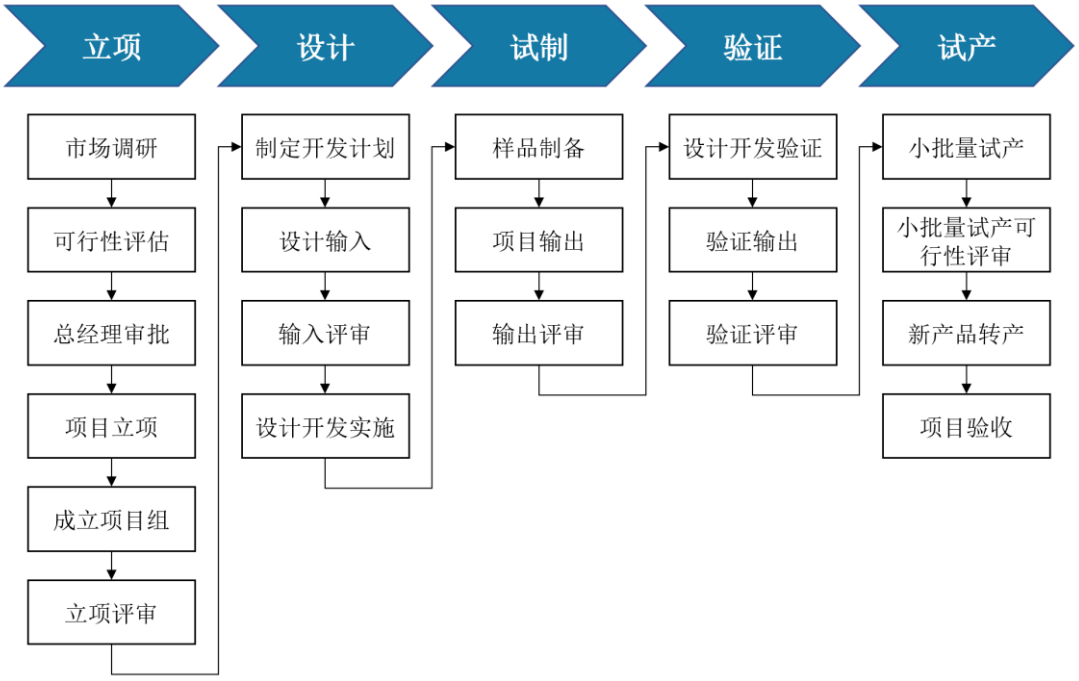
参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“（二）营业收入分析”。

（四）公司主要经营模式

1、研发模式

公司采取“交互式”研发和自发性研发相结合的研发模式。一方面，电子胶粘剂的应用领域具有终端品类众多、工艺复杂、产品更新速度较快等特点，为了满足各种客户不断迭代的需求，公司采取“交互式”的研发模式，贴近客户所在地，保持密切的技术交流，深度了解客户的工艺设计方案，挖掘其工艺需求和技术痛点，从而根据市场及客户需求开发相关产品或改进公司的产品设计；另一方面，公司基于自身对电子专用高分子材料技术的理解，对技术、产品、工艺、市场的发展趋势进行前瞻性研判并布局前沿技术的研发工作，增强技术实力、丰富技术储备。在注重自主研发的同时，公司也充分利用科研院所资源开展产学研合作，补充公司在树脂等原材料量产工艺方面的技术积累，与公司自主研发形成互补的作用。

制度方面，公司制定了《产品研发控制程序》指引公司研发活动高效、有序开展。公司产品研发流程具体如下：



2、采购模式

公司原材料的采购采用“以产定采”的采购模式，公司计划部结合生产计划、库存水平等因素进行原材料采购申请，采购部根据申请实施采购，如原材料的市

场价格存在大幅波动的预期，公司也会参考上游市场行情，进行适量备货。公司因电子胶粘剂贸易业务而进行的成品采购，一般遵循“以销定采”的采购原则，即结合销售订单及销售预测向供应商进行采购。

为确保公司采购活动的有序运行，且公司能适时、适质、适价、适量地采购生产经营活动所需要的物料，公司制定了《供应商控制程序》《采购控制程序》等相关制度。供应商管理方面，公司拥有完整的供应商开发、评审、考评的管理体系，采购部依照供应商控制程序开发供应商，组织相关部门对新供应商进行资质调查和综合评审，对评审合格的供应商纳入《合格供应商名录》，采购部和品质部定期对合作供应商的质量、交期、价格、综合服务等进行考评，根据考评结果确定供应商等级，采购时优先考虑等级高的供应商。采购流程方面，公司各部门根据需求填写采购申请表，采购部在公司的年度《合格供应商名录》中选择合格供应商进行询价、报价、比价、议价，并依照价格审批和合同审批流程签订采购合同，采购部负责合同履约管理。采购物料送至公司后，由采购部和品质部进行来料检验，检验合格的物料由仓库管理员办理入库。

3、生产模式

公司实行“以销定产、需求预测”相结合的生产模式。生产部根据销售订单及销售预测情况滚动制定生产月计划及周计划，并按生产计划进行领料和生产实施；品质部负责进行制程控制。

公司电子胶粘剂产品的主要工艺流程包含原料预处理、配料称量、混合搅拌、真空搅拌、取样检测、分装、离心脱泡、入库八个环节。公司主要产品的具体工艺流程参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“一、公司主营业务、主要产品或服务情况”之“（七）主要产品工艺流程图”。

4、销售模式

目前，公司采取直销为主、经销及贸易商销售为辅的销售模式。

直销模式下，公司与耗用公司产品的生产商客户直接进行交易。对于个别直销客户，根据其库存管理及响应要求，公司采用寄售的模式。经销及贸易商销售模式下，公司将产品销售给经销商或贸易商客户后再由其销售给直接耗用公司产品的终端厂商。经销及贸易商销售模式系对公司直销模式的补充，主要目的系进

一步拓宽销售渠道、扩大客户覆盖范围。经销商和贸易商的区别主要在于经销商与公司签订了经销协议，接受公司的经销管理。

公司的销售流程主要包括客户资源开发、售前服务、产品认证测试、产品交付、技术支持及售后服务。直销模式下，公司承担客户资源开发、售前服务、产品认证测试、产品交付、技术支持及售后服务的职能；经销及贸易商销售模式下，经销商及贸易商主要承担客户资源开发及产品交付的职能，产品认证测试、技术支持及售后服务仍主要由公司负责。

为了强化区域覆盖能力和服务效率，公司在东莞、深圳、苏州、上海、南通、美国、德国、韩国等地均设立了销售中心，形成点多面广、营运高效、服务优良的营销网络和售后服务体系，便于为客户提供高效、高质量的售前和售后服务。

5、采用目前经营模式的主要原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势

公司目前采用的经营模式是结合了公司所处行业发展政策、行业竞争格局、行业产业链上下游发展情况和主要产品情况等关键因素在长期发展中不断探索和完善的，符合自身经营发展需要和行业特点。随着公司业务的不断发展，公司将继续在目前经营模式的基础上，继续优化业务流程，不断提升公司竞争力，实现规模和效益的持续增长。

（五）公司设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况

自 2016 年设立以来，公司主营业务均为电子专用高分子材料的研发、生产及销售，持续深耕电子胶粘剂领域，不断拓展客户及产品应用领域。公司主营业务、主要产品及经营模式的发展主要可以分为三个阶段。

1、第一阶段（2016 年-2018 年）：厚积薄发，专注核心产品的研发和重要客户的导入

公司自 2016 年设立以来，凭借技术团队对产业技术趋势和市场需求的理解、对化学材料体系的理论储备及对材料应用分析的经验，专注于元器件包封胶、汽车电子补强胶、板级导热界面材料等核心产品的研发，并推动相关产品成功导入苹果、特斯拉、阳光电源等下游知名客户的供应链。

2、第二阶段（2019 年-2020 年）：重点突破，智能终端领域产品和客户快速拓展，收入实现快速放量

公司依托元器件包封胶产品性能优势，不断提升在苹果手机应用点的渗透率，且应用点从手机不断向个人电脑、平板、TWS 耳机、智能手表等各智能终端产品拓展，逐步成为苹果智能终端设备 FPC 元器件包封应用的平台型产品，实现对苹果供应链销售的快速放量。同时，凭借元器件包封胶的市场认可和技术优势，公司又为 OPPO、vivo、三星等更多国内外知名智能终端品牌企业开发了元器件包封胶产品，不断拓展产品市场。公司继而又开发了耐无铅回流环氧胶、结构粘接密封胶、反应型聚氨酯热熔胶等智能终端电子胶粘剂产品，丰富自身产品矩阵。

同时，在新能源领域，公司凭借在 FPC 领域的电子胶粘剂产品及应用经验，成功开发出动力电池 FPC 包封胶，解决了 FPC 元器件包封的车规级可靠性问题，成功进入宁德时代供应链；在半导体领域，公司开始着力研发板级底部填充胶、半导体模组封装用结构粘接胶、AA 制程胶等产品。相关产品和技术的积累，为公司新能源和半导体领域业务的发展奠定了基础。

3、第三阶段（2021 年至今）：多线扩张，智能终端领域渗透率进一步提升，新能源、半导体、通信领域收入快速增长，综合实力不断提升

在智能终端领域，公司凭借产品性能、质量稳定性、技术响应能力及持续供货能力，持续提升在下游主要客户中的产品渗透率，产品最终应用于苹果、OPPO、vivo、小米、三星等知名终端品牌商或其产业链客户；在新能源领域，公司自主研发的磁芯粘接胶适配磁芯材料与 PCB 之间的功能性粘接及 SMT 回流固化工艺，兼具高粘接强度、柔韧性和车规级高可靠性，成为特斯拉指定供应商，报告期内相关产品收入实现较快增长；在半导体、通信领域，公司围绕芯片封装、5G 基站、高速光模块、AI 服务器等高附加值用胶场景推进产品导入和客户拓展，底部填充胶、导热界面材料等产品销售快速增长，芯片固晶胶膜（DAF）、各向异性导电胶膜（ACF）、半导体模组封装用结构粘接胶、AA 制程胶、电磁屏蔽胶、光模块密封胶、AI 电源粘接导热胶等产品持续推进研发、验证和导入，部分产品已在卓胜微、通富微电、舜宇光学、中际旭创、MPS、恒诺微等客户处实现批量出货、小批量出货或通过产品验证测试。

（六）主要经营情况和核心技术产业化情况

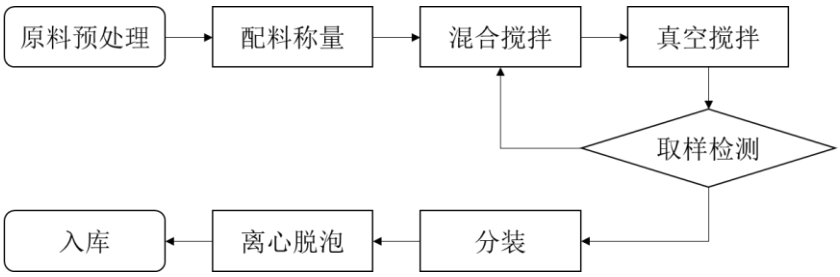
公司自成立以来，专注于电子专用高分子材料的研发、生产和销售，主要为客户提供电子胶粘剂产品及配套应用方案。电子胶粘剂属于典型的配方型、应用型功能材料，产品性能通常需要与客户具体用胶场景、生产工艺及可靠性要求高度匹配。公司以客户应用需求为牵引，围绕原材料开发与修饰、产品配方设计、生产工艺优化构建了“协同联动、交替迭代”的研发体系，并通过“交互式”研发和自发性研发相结合的研发模式，将下游客户的功能需求转化为产品开发方向和产业化成果。

报告期内，公司研发费用金额分别为 5,952.94 万元、6,936.12 万元和 6,799.27 万元；截至本招股说明书签署日，公司已获取 65 项发明专利授权，发明专利数量持续快速增长。依托先进的自有核心技术体系，公司持续完善以电子胶粘剂为主的电子专用高分子材料产品体系建设，产品广泛应用于智能终端、新能源、半导体、通信等战略性新兴产业。报告期内，公司基于多年研发和产业化经验的积累建立了产品配方和原材料数据库，持续在电子胶粘剂的原材料选择、配方设计和工艺优化等方面展开研发和技术提升，公司核心技术研发与产业化紧密联系，在长期生产制造过程中予以充分验证。

报告期内，依靠核心技术的开发和应用，公司主营业务收入、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润、核心技术产品收入等指标快速增长。报告期内，公司主营业务收入分别为 35,075.78 万元、38,438.74 万元、45,696.55 万元；公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 4,335.45 万元、7,724.90 万元、12,457.28 万元；公司核心技术产品收入分别为 31,851.90 万元、36,308.20 万元、43,787.91 万元，占营业收入的比例分别为 90.64%、94.33%、95.63%。

（七）主要产品工艺流程图

公司主要产品形态为电子胶粘剂，主要工艺流程包含原料预处理、配料称量、混合搅拌、真空搅拌、取样检测、分装、离心脱泡、入库八个主要步骤，主要工艺流程步骤的具体情况如下：



①原料预处理：根据不同产品的需求，对部分原材料进行烘烤、干燥、纯化、改性等预处理流程；

②配料称量：按照配方设定比例进行配料，原材料包括树脂、单体、填料、助剂等；

③混合搅拌：根据产品工艺需求分步投入树脂、单体、填料、助剂等原材料搅拌，并采用模温机和冷水机进行升温或降温以达到混合搅拌过程中的控温要求，搅拌过程均在密闭容器中进行；

④真空搅拌：混合搅拌后进行抽真空搅拌，去除电子胶粘剂内部的气泡；

⑤取样检测：对真空搅拌后的成品进行取样检测，检测合格后进入分装流程；若取样检测不合格则需要微调配方后继续搅拌，待检测合格后再分装；

⑥分装：通过压料机将合格成品分装成不同规格的产品；

⑦离心脱泡：利用离心脱泡机将胶粘剂在分装过程中产生的气泡去除，保证产品无气泡；

⑧入库：产品根据不同存储条件入库。

（八）公司具有代表性的业务指标情况

由于电子胶粘剂产品下游应用场景广泛，且不同应用场景的应用需求各异，行业内企业需要根据不同应用场景的性能指标要求进行定向开发、验证和迭代，才能推动产品导入并实现规模化销售，因而对公司的研发能力和研发投入要求较高，行业具有技术密集型的特性。公司坚持自主研发和技术创新，以市场需求为导向，不断实现核心技术的产业化转化。结合行业技术密集的特征，研发费用、研发费用占营业收入的比例、各期末已授权发明专利数量、主营业务收入、主营业务毛利率是能够体现公司研发和技术产业化的代表性业务指标。报告期内，公司主要业务指标变动情况如下：

业务指标	2025 年度/末	2024 年度/末	2023 年度/末
研发费用（万元）	6,799.27	6,936.12	5,952.94
研发费用占营业收入的比例	14.85%	18.02%	16.94%
期末发明专利授权数量（项）	62	59	49
主营业务收入（万元）	45,696.55	38,438.74	35,075.78
主营业务毛利率	77.06%	74.74%	77.29%

报告期内，公司研发费用分别为 5,952.94 万元、6,936.12 万元、6,799.27 万元，占营业收入的比例分别为 16.94%、18.02%、14.85%。围绕公司不断拓展的电子胶粘剂产品品类及应用领域，以及不断提高的电子胶粘剂产品性能指标，公司不断增加研发投入，持续推进产品配方和生产工艺优化并丰富产品体系。随着持续的研发投入，公司发明专利数量快速增长，截至报告期各期末，公司分别拥有 49 项、59 项、62 项发明专利授权。

报告期内，公司主营业务收入分别为 35,075.78 万元、38,438.74 万元、45,696.55 万元。公司以智能终端领域电子胶粘剂规模化应用为基础，依靠技术创新持续拓展新产品、新用胶点和新应用场景，并不断向新能源、半导体、通信等战略性新兴产业领域纵向延伸，在多个应用领域实现核心技术的产业化。现阶段，在新能源领域，公司通过自主研发的磁芯粘接胶，已成为特斯拉指定供应商，报告期内相关产品收入实现快速增长；在半导体、通信领域，公司围绕芯片封装、光模块、AI 服务器等高附加值用胶场景推进产品导入和客户拓展，部分产品已在卓胜微、通富微电、舜宇光学、中际旭创、MPS、恒诺微等客户处实现批量出货、小批量出货或通过产品验证测试，预计将成为公司未来主营业务收入的新增长点。

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 77.29%、74.74%、77.06%，保持在较高水平且整体较为稳定。

（九）符合产业政策和国家经济发展战略的情况

公司专注于电子专用高分子材料的研发、生产和销售，主要为客户提供电子胶粘剂产品及配套应用方案，属于新材料和新一代信息技术两大战略性新兴产业的交叉领域，符合国家产业政策和国家经济发展战略的要求，持续受益于国家重要产业发展规划和工程项目。

1、电子胶粘剂是支撑新一代信息技术、新能源、新材料等战略性新兴产业发展的关键专用材料，符合国家发展新质生产力和保障关键电子材料的供应链安全的战略方向

2026 年 3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》提出，“加快新一代信息技术、新能源、新材料、智能网联新能源汽车”等战略性新兴产业发展，推进电子信息、机械装备等全产业链创新，“加快突破关键零部件、元器件和专用材料”。电子胶粘剂作为电子信息制造产业中的关键专用材料之一，与上述政策方向高度契合。公司长期专注于电子专用高分子材料领域，持续推进电子胶粘剂新产品开发和产业化应用，并在部分应用场景与汉高、陶氏化学、3M、富乐、德路等国际厂商直接竞争，助力保障关键电子材料的供应链安全。

中国胶粘剂和胶粘带工业协会 2026 年 6 月发布的胶粘剂和胶粘带行业“十五五”发展规划相关信息显示，“十五五”期间行业将大力研发推广智能终端、半导体用高端电子胶粘剂，并重点发展绿色能源、新能源汽车、电子及通信、高技术制造业等领域用胶粘剂产品。公司产品已形成覆盖智能终端、新能源、半导体、通信等领域的应用布局，并围绕新能源汽车、光伏、芯片封装、5G 基站、高速光模块、AI 服务器等高附加值用胶场景推进产品导入和客户拓展，与行业重点发展的下游应用方向一致。

2、新型环保材料有助于推动我国电子胶粘剂产业结构优化调整，受国家产业政策鼓励支持

2023 年 12 月，国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，明确将低 VOCs 含量胶粘剂、功能性膜材料和先进封装材料等电子化学品及关键原料的开发与生产列入鼓励类产业。

2024 年 7 月，工业和信息化部等九部门印发《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027 年）》，在产业延链工程中提出重点发展高性能胶黏剂，在关键产品攻关中提出提升电子化学品、特种胶黏剂等领域关键产品供给能力，并在产品品质提升工程中提出加快发展水基（体）型等低 VOCs 胶粘剂，鼓励企业精耕细分领域，为不同领域客户提供系统化解决方案，增强国际竞争力。

公司主要产品为电子胶粘剂，产品均满足胶粘剂低挥发性有机物含量限值要求；同时，公司围绕环氧树脂、丙烯酸酯、有机硅树脂等化学体系持续开展产品开发和产业化应用，为客户提供电子胶粘剂产品及配套应用方案，符合精细化工产业高端化、绿色化发展方向和系统化解决方案方向发展的政策导向。

3、电子胶粘剂作为我国智能终端、新能源、半导体、通信等战略性新兴产业的关键材料，受国家产业政策重点支持和指导

2023 年 12 月，工信部印发《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》，将电子级环氧树脂、异方性导电胶膜、半导体芯片封装导热有机硅凝胶、半导体芯片封装自粘接导热硅橡胶、封装基板用高解析度感光干膜及配套 PET 膜、封装基板用高性能阻焊等列入重点新材料目录，并对相关材料的性能指标提出明确要求。公司已在芯片级底部填充胶、导热界面材料等产品实现产业化应用，并具备芯片固晶胶膜（DAF）、各向异性导电胶膜（ACF）等半导体膜材生产能力。公司相关产品和技术储备与国家重点支持的先进封装材料、电子化学品、功能性膜材料等方向高度匹配。

（十）公司的创新、创造、创意特征及与科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况

1、公司围绕原材料开发与修饰、产品配方设计、生产工艺优化构建了“协同联动、交替迭代”的研发体系

电子胶粘剂属于典型的配方型、应用型功能材料，其性能取决于从原材料开发与修饰到生产工艺的多环节协同。公司围绕原材料开发与修饰、产品配方设计、生产工艺优化构建了“协同联动、交替迭代”的研发体系，实现从底层材料到终端应用的系统性研发能力闭环。

在原材料开发与修饰方面，公司围绕下游客户对产品连接、防护、导热散热、导电绝缘、应力缓冲等性能要求，通过定制合成、分子结构设计、原材料修饰等方式提升基础材料性能，进而拓展通用材料在电子制造场景中的应用边界，为差异化产品开发构建底层原材料基础。

在产品配方设计方面，公司依托丙烯酸酯、环氧树脂、有机硅、聚氨酯、改性硅烷、杂化等六大化学体系积累，围绕客户具体用胶点，对树脂、填料、助剂

等多元材料进行高效复配与动态优化，在粘接强度、模量、热膨胀系数、导热性、绝缘性、耐湿热性、工艺适配性等多性能约束下实现平衡。公司的配方设计能力建立在对客户潜在需求、产品结构、可靠性要求与具体应用场景的深度理解之上，而这一能力离不开与核心客户长期稳定的合作关系。公司凭借长期的技术积累切入客户关键项目并持续获取应用反馈，在样品开发、可靠性验证、产线适配和量产验证的反复迭代过程中形成高频互动与正反馈机制，进而又反哺公司的技术积累、需求洞察、方案适配和产品迭代，构筑“技术突破—客户绑定—能力迭代”的良好体系。

在生产工艺优化方面，公司在流体力学和多相体系共混的理论基础上，围绕材料改性、体系兼容性转变、液-液混合、固-液混合、分散、脱除空气以及非必要小分子、精确分装、检测等关键环节进行工艺控制与持续优化，使材料体系和配方设计能够转化为符合客户量产要求的产品。同时，公司产品导入需经过样品开发、客户测试、可靠性验证、小批量试用及量产验证等环节，进一步体现电子胶粘剂产品较高的技术门槛与客户认证壁垒。

依托上述“协同联动、交替迭代”的研发体系，公司有能力与全球头部客户深度协同，能够将客户应用需求、底层材料开发、配方设计和生产工艺持续联动，为公司在智能终端、新能源、半导体及通信等领域持续推出高性能电子胶粘剂产品提供研发与创新能力支撑。

2、公司以产品创新推动电子制造关键环节升级，体现新旧产业融合特征

电子胶粘剂是实现电子元器件连接的关键功能性材料。随着下游智能终端、新能源、半导体及通信等领域终端产品的迭代发展，高性能电子胶粘剂在多个制造环节中发挥着替代传统工艺、提升产品可靠性和优化生产效率的重要作用。公司将高分子材料技术与制造工艺深度结合，相关产品嵌入下游客户产品设计、生产工艺等过程，助力电子制造向高精度、高可靠性和材料功能复合化方向升级，推动核心技术在电子制造环节实现产业化应用。

在智能终端领域，随着下游产品向轻薄化、柔性化、多功能化等方向发展，FPC、PCBA 及功能模组等核心器件对电子胶粘剂的性能、可靠性及工艺适配性提出更高要求。针对客户提出的“无丙烯酸致敏物”及“FPC 阴影区完全固化”

等严苛要求，公司在兼顾多项性能指标的前提下，通过自主研发的 UV-湿气双重固化技术，开发出兼具快速固化、高粘接强度与优异柔韧性的元器件包封胶产品，系统性提升了耐化学性、生物相容性与可靠性，已成为相关产业链中的核心材料。在核心组件粘接环节，公司开发的耐高温粘接材料有效解决了传统粘接胶在无铅回流焊高温制程中普遍存在性能衰减、多基材浸润性差等问题，支撑了下游产品的高精度组装需求。

在新能源领域，围绕新能源汽车对高可靠、轻量化的核心需求，公司通过产品创新推动客户传统工艺制程革新，以性能更优的材料方案替代传统工艺方案，提升客户生产效率与产品可靠性。例如，公司通过引入络合技术，对高分子链进行自主改性，实现环氧低温快速凝胶，以胶接工艺革新传统焊接方案，已成功导入国际领先电动汽车供应链并成为关键材料。

在半导体领域，为适配半导体产业向高功率、高热密度、高可靠性发展的技术需求，公司开发出高效导热的导热界面材料。该产品达到 UL94 V-0 级无卤阻燃的高标准，在相关应用场景中成功替代传统“导热凝胶+机械固定”的分体方案，有效降低热阻并提升器件运行可靠性。

在通信领域，针对 5G 基站、数据中心等通信设备的电磁屏蔽需求，公司研制出具有低硬度、高屏蔽效能的点胶成型屏蔽导电胶。该产品依托公司自主开发的低硬度点胶成型屏蔽导电胶核心技术，解决了传统电磁屏蔽材料装配压缩力过高和屏蔽性能衰减的痛点，满足轻质复杂结构器件的特殊装配要求，以及在极端环境下长期可靠屏蔽性的要求。

3、公司以技术成果实现产业化转化，创新成果形成规模化经营贡献

公司始终重视技术研发和技术成果产业化，截至 2025 年末拥有 120 人的研发团队，占员工总数比例为 26.03%。报告期内，公司研发费用分别为 5,952.94 万元、6,936.12 万元和 6,799.27 万元，占营业收入的比例分别为 16.94%、18.02%及 14.85%。截至本招股说明书签署日，公司已获发明专利授权 65 项、实用新型专利授权 49 项，公司荣膺工业和信息化部的新一轮第一批国家重点“小巨人”企业及第三批专精特新“小巨人”企业，经广东省科学技术厅认定为“广东省新型高端电子胶粘剂（德聚）工程技术研究中心”，经广东省工业和信息化厅认定

为“第 22 批省级企业技术中心”和“2024 年广东省省级制造业单项冠军企业-丙烯酸电子胶粘剂”。

公司创新成果已形成规模化经营贡献。报告期内，公司自产电子胶粘剂收入分别为 31,851.90 万元、36,308.20 万元和 43,787.91 万元，持续增长。公司经营成果主要来源于自主研发、自主生产的电子胶粘剂产品，已通过客户导入和规模化应用将核心技术转化为主营业务收入。

二、公司所处行业情况

（一）行业分类

公司专注于电子专用高分子材料的研发、生产和销售，主要为客户提供电子胶粘剂产品及配套应用方案，产品主要应用于智能终端、新能源、半导体、通信等领域。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”大类，属于“C398 电子元件及电子专用材料制造”中类，属于“C3985 电子专用材料制造”小类。

根据《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，公司产品所属的电子专用材料制造及相关电子级化学品和材料列入“3 新材料产业”之“3.3 先进石化化工新材料”之“3.3.6 专用化学品及材料制造”。

（二）行业管理体制及行业政策、法规

1、行业主管部门及监管体制

（1）行业主管部门

公司所处行业主管部门为工业和信息化部、科学技术部和国家发展和改革委员会。

工业和信息化部的主要职责包括拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划和产业政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级；监测分析工业、通信业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。

科学技术部的主要职责包括拟订国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施；统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；牵头建立统一的国家科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；拟订国家基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调国家重大基础研究和应用基础研究等。

国家发展和改革委员会的主要职责包括拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议等。

（2）行业自律组织

公司所处行业的行业自律组织主要为中国胶粘剂和胶粘带工业协会、中国电子材料行业协会等；涉及半导体封装材料等特定应用场景时，亦受到中国半导体行业协会等组织发布的行业信息和标准工作的影响。

中国胶粘剂和胶粘带工业协会是中国胶粘剂及密封剂行业的企业事业单位自愿联合组成的全国性专业性的行业组织，主要职责是负责收集、统计、分析和整理本行业的生产、经营、科研开发和进出口等各方面的运行数据和信息，定期向政府有关部门报告，并在全行业内发布；在本行业内开展调查研究，了解和掌握行业发展态势，对存在的问题提出的意见和建议，参与制定行业发展规划；推进行业诚信建设，规范企业行为，开展行业自律，维护市场秩序和公平竞争等。

中国电子材料行业协会是由从事电子材料行业相关的企事业单位和社会组织自愿结成的全国性、行业性社会团体，是非营利性社会组织，主要职责包括进行电子材料相关行业调查，掌握了解行业状况，积极向政府提出制（修）订行业发展规划、经济技术政策、经济立法等方面的咨询意见和建议，并参与有关活动；及时向有关部门和会员单位提供电子材料行业相关信息咨询等服务，包括行业情况、市场趋势、经济运行预测等信息，依照有关规定，建立信息网络，出版信息刊物，开展技术、经济、管理、市场等咨询与培训服务工作等。

中国半导体行业协会是由全国半导体界从事集成电路、半导体分立器件、

MEMS、半导体材料和设备的生产、设计、科研、开发、经营、应用、教学的单位、专家及其他相关企事业单位自愿结成的全国性、行业性社会团体，主要职责包括提供决策支撑服务；根据授权开展行业数据统计分析工作；广泛开展行业交流活动；开展国际交流与合作；为行业企业提供咨询等服务；促进行业质量与标准化工作等。

2、行业主要法律法规和政策

电子专用材料制造产业代表了智能终端、新能源、半导体、通信等下游行业的前沿研究领域。近年来，我国政府已颁布了一系列法律法规和产业政策支持行业以及上下游产业的快速发展，主要内容包括：

序号	政策名称	发布时间	发布部门	主要内容
1	《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方案》	2025 年 8 月	工业和信息化部、市场监督管理总局	提出围绕电子元器件、新型电子材料、电子专用设备等基础产业，制定知识产权质量评价指标体系，加快推动专利池布局，鼓励探索专利开源，以加强知识产权保护，促进产业可持续创新
2	《国家支持发展的重大技术装备和产品目录（2025 年版）》	2025 年 2 月	工业和信息化部、财政部、海关总署、国家税务总局、国家能源局	在“电子信息及生物医疗设备”类别中，纳入新型显示关键设备（如精细金属掩模版）、集成电路关键设备（如晶圆混合键合设备、碳化硅外延生长设备）、电子元器件生产设备（如片式多层陶瓷电容器相关设备），为相关装备和材料进口税收优惠提供依据
3	《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案（2025—2027 年）》	2024 年 12 月	工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家标准委	提出到 2027 年逐步推动完善新材料产业创新发展的标准技术体系，重点完善电子专用材料领域标准，提升电子专用材料产品质量和性能稳定性，支撑电子专用材料产业高质量发展
4	《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》	2024 年 9 月	工业和信息化部办公厅	针对电子元器件和电子材料行业，明确以生产检测设备的自动化、智能化、绿色化改造为重点，推动电子材料生产加工设备、先进检测设备等更新升级
5	《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027 年）》	2024 年 7 月	工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、农业农村部、应急管理部、中国科学院、中国工程院、国家能源局	将电子化学品列为重点发展领域，提升电子化学品等关键产品供给能力，加强精细化工用重要装备、高端仪器、控制软件等配套保障，推动电子专用材料领域关键技术攻关，促进电子化学品产业高端化、绿色化、智能化发展
6	《国家重点研发计划》	2024 年 7 月	工业和信息化部	将“新型显示与战略性电子材料”等列为重点专项方向，支持前沿技术、关键

序号	政策名称	发布时间	发布部门	主要内容
				核心技术和应用示范研究，推动战略性电子材料核心技术突破
7	《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	2023 年 12 月	国家发改委	将低 VOCs 含量胶粘剂、电子化学品及关键原料、封装材料、宽禁带半导体材料等相关方向纳入鼓励类产业目录，引导社会资源投向高端化、绿色化电子材料领域
8	《新产业标准化领航工程实施方案（2023—2035 年）》	2023 年 8 月	工业和信息化部、科技部、国家能源局、国家标准委	提出面向先进高分子材料、集成电路与电子元器件用化学品等方向研制关键标准，支撑新产业高质量发展
9	《关于印发电子信息制造业 2023—2024 年稳增长行动方案的通知》	2023 年 8 月	工业和信息化部、财政部	面向个人计算、新型显示、VR/AR、5G 通信、智能网联汽车等重点领域，推动电子材料、电子专用设备和电子测量仪器技术攻关
10	《制造业可靠性提升实施意见》	2023 年 6 月	工业和信息化部等五部门	重点提升电子整机装备用 SoC/MCU/GPU 等高端通用芯片、氮化镓/碳化硅等宽禁带半导体功率器件、精密光学元器件、光通信器件、新型敏感元件及传感器、高适应性传感器模组、北斗芯片与器件、片式阻容感元件、高速连接器、高端射频器件、高端机电元器件、LED 芯片等电子元器件的可靠性水平
11	《关于推动能源电子产业发展的指导意见》	2023 年 1 月	工业和信息化部等六部门	研究小型化、高性能、高效率、高可靠的功率半导体、传感类器件、光电子器件等基础电子元器件及专用设备、先进工艺

3、行业主要法律法规政策对发行人的影响

上述政策对公司的影响主要体现在三个层面：一是上游精细化工和先进高分子材料政策有助于提高电子级树脂、填料等关键原材料的国产供给和质量稳定性；二是电子专用材料标准提升和设备更新政策有助于推动电子胶粘剂企业提升配方开发、精密混合、自动化生产和检测能力；三是 AI 算力设备、汽车电子、新能源、光伏、通信设备等下游场景升级，持续提高导热、绝缘、阻燃、低挥发、耐湿热和精密点胶适配要求，为公司产品迭代和客户拓展提供政策与需求支撑。

（三）发行人所属行业概况

1、电子专用高分子材料行业

电子专用高分子材料是电子专用材料与高分子材料交叉形成的一类功能材

料，可从应用领域角度归属于材料行业的细分品类之一。除电子专用材料外，材料还可按应用领域划分为医用材料、建筑材料等类别，亦可按化学组成划分为金属材料、无机非金属材料、高分子材料和复合材料等类别。

电子专用材料指用于电子元器件、组件及系统制备的专用电子功能材料、互联与封装材料、工艺及辅助材料，包括半导体材料、光电子材料、磁性材料、锂电池材料、电子陶瓷材料、覆铜板及铜箔材料、电子化工材料等。电子专用材料是新一代信息技术产业发展的关键领域，是支撑经济社会发展的战略性、基础性、先导性的产业，具有产品种类多、技术门槛高、更新换代快、专业性强等特点，广泛应用于锂电池、新型显示、集成电路、太阳能光伏、电子电路板、电子元器件及整机、系统产品等领域，其质量和水平直接决定了元器件和整机产品的性能。

高分子材料也称聚合物材料，是以高分子化合物为基体，再配有其他助剂所构成的材料。按照高分子材料的应用特性可以分为塑料、橡胶、纤维、聚合物基复合材料、胶粘剂、涂料等。高分子材料通常具有质轻、耐腐蚀、绝缘性好、易于成型加工等特点，通过在高分子上修饰反应基团，高分子材料还可以具有导电性、导磁性、光敏性等功能，凭借优秀的理化性能和多种功能应用于各行各业，尤其在对材料性能和功能均要求较高的电子工业中，高分子材料在封装材料、导热材料、光刻胶、覆铜板材料、电子浆料等领域得到了广泛应用。

电子胶粘剂是电子专用高分子材料的重要产品形态之一，可作为封装材料、导热材料、电磁屏蔽材料、光刻胶等用途。

2、电子胶粘剂行业整体情况

（1）行业技术水平及特点

1）电子胶粘剂影响电子产品及元器件的性能提升与功能实现，是电子产业的关键材料

由于电子元器件及电子产品功能众多、生产工艺多样、工作环境复杂，因此通常对电子胶粘剂的电性能、化学性能、物理性能、光学性能、热性能、工艺性能等具有很高的要求。例如，部分电子胶粘剂直接与电子元器件接触，一般要求是绝缘材料，部分还有介电常数和介电损耗性能的要求；电子产品多由高精密电子元器件组成，基材热膨胀系数差异大，工作温度范围跨度大，对电子胶粘剂的

热膨胀系数和内应力也有较高要求，否则会影响电子产品的稳定性；基于安全规范的要求，电子胶粘剂还必须满足相关的阻燃等级要求，以防止电子产品短路或故障时出现严重火灾等。

电子胶粘剂性能类型	具体指标
电性能	绝缘性、介电性、导电性、耐电压性等
化学性能	耐腐蚀性、低吸湿性、阻燃性等
力学性能	粘接强度、断裂延伸率、本体强度等
光学性能	折光率、透光率、遮光率等
热性能	导热性、热稳定性、热膨胀系数等
工艺性能	固化条件、贮存稳定性、施胶工艺、可返修性等

2）电子胶粘剂技术水平持续提升，高性能电子胶粘剂亟待突破

随着电子行业技术迭代加快，下游客户对电子胶粘剂的要求已不止于粘接，而是延伸到密封防护、热管理、电气绝缘和制程适配等复合功能。AI 算力设备、AI 手机、AI PC 加速普及和高速光模块持续放量，终端设备和算力硬件的结构更紧凑、功率密度更高，对材料的低挥发、耐湿热、低应力、精密施胶、热管理及长期可靠性提出更高要求。全球主要电子材料企业持续投入相关研究和技术创新，推动电子胶粘剂行业技术水平不断提升。

电子胶粘剂的技术门槛主要体现为材料性能与具体工艺的匹配能力。以 AI 算力设备为例，服务器、交换机和高速光模块的高速运行带来更高的热管理和稳定性要求，胶粘剂需要在热管理、电气绝缘、低污染和可靠性之间取得平衡。智能终端轻薄化和多模组集成则要求材料兼顾点胶精度、固化效率、粘接强度和外观一致性。新能源汽车、储能和光伏场景则更强调材料长期耐受温湿度变化、振动冲击和户外环境的能力。下游应用升级使高性能电子胶粘剂的开发难度和产品附加值持续提高。

目前，国内企业在部分智能终端、新能源和通信应用中已具备与国际厂商竞争的能力，能够提供符合客户性能及制程要求、性价比较高的产品。但在部分高可靠、热管理和精密工艺要求较高的场景中，汉高、陶氏化学、3M、富乐、德路等国际厂商仍具有较强的技术积累、品牌影响力和客户认证优势，国内下游企业对部分关键材料仍存在一定进口依赖。近年来，在国家政策支持、供应链安全

需求提升以及国内企业持续研发投入的推动下，我国电子胶粘剂企业的配方开发、生产控制、应用验证和批量交付能力不断增强。以发行人为代表的部分行业领先企业正加快高性能电子胶粘剂研发和客户导入，推动产品向 AI 算力设备、智能终端、新能源和通信等关键应用场景拓展。

3）电子胶粘剂与下游技术和工艺发展相互依赖和促进，具有定制化程度高、迭代快的特点

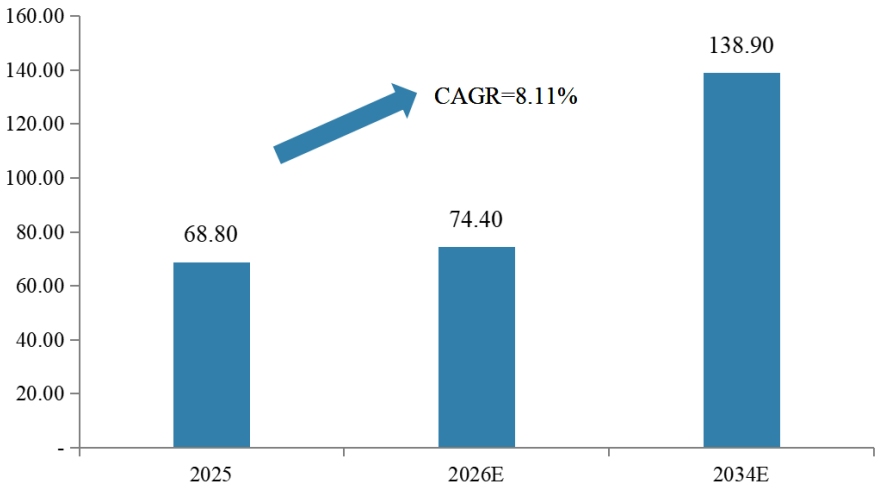
由于电子胶粘剂对于电子元器件及电子产品的性能提升与功能实现有着重要作用，直接影响了下游客户的产品功能、产品良率、生产成本、生产效率等，因此电子胶粘剂与电子产业的技术和工艺发展呈现相互依赖和相互促进的特点。一方面，电子胶粘剂的性能和特点与其应用场景有密切关系，不同电子产品有不同的应用需求，电子胶粘剂企业需要在充分理解下游需求的前提下，对电子胶粘剂产品的电性能、化学性能、物理性能、光学性能、热性能、工艺性能等各方面性能综合考虑，研发出满足客户需求的电子胶粘剂配方。另一方面，电子产品升级换代速度较快，相关技术和工艺也随之快速迭代，对电子胶粘剂的性能和功能也不断提出新的要求，因此电子胶粘剂也需要根据下游行业的技术和工艺发展不断迭代。

（2）市场发展情况

作为电子产业的上游功能性材料，电子胶粘剂市场与电子产品高端化、能源电子化和算力基础设施建设高度相关。近年来，智能终端轻薄化、新能源汽车和储能规模化、光伏装机增长、AI 算力设备和高速光模块放量等趋势，持续拓展电子胶粘剂在电子制造环节中的应用。

随着下游行业新兴技术发展趋势的不断推进，未来电子胶粘剂市场规模会保持增长。根据 Fortune Business Insights 数据，2025 年全球电子胶粘剂的市场规模达到了 68.80 亿美元，2026 年预计将达到 74.40 亿美元，未来 2034 年将增长至 138.90 亿美元，年复合增长率为 8.11%。

2025-2034 年全球电子胶粘剂市场规模（含预测，单位：亿美元）



数据来源：Fortune Business Insights

从区域分布看，亚太地区是全球电子胶粘剂的主要市场。根据 Fortune Business Insights 报告，亚太地区占全球电子胶粘剂市场规模的比重超过 40%。其中，中国作为全球主要电子信息产品生产国之一，也是电子胶粘剂的重要生产和消费市场。现阶段，全球电子胶粘剂市场仍主要由国际厂商占据较高份额，行业竞争格局相对稳定。汉高、陶氏化学、3M 等国际企业起步较早，在技术积累、品牌影响力和规模化供应能力方面具有一定先发优势，部分国际厂商也已在国内投资建厂，开展胶粘剂产品的生产和销售。近年来，随着智能终端、新能源汽车、半导体封装材料、AI 算力设备和高速光模块等下游应用加快发展，国内高性能电子胶粘剂企业持续推进技术突破和客户导入，本土化服务需求不断提升，我国高性能电子胶粘剂市场仍具有较大发展空间。

（3）行业发展趋势

1）国内企业快速崛起，高性能产品本土化配套进程有望加快

行业发展早期，国内市场主要由国外品牌主导，下游企业对进口产品的依赖性较强。近年来，国内企业通过不断加大研发投入，开发多类别原材料及产品配方并提升生产工艺和测试能力，产品性能持续提升，竞争力显著增强。在部分高性能产品细分市场上，国内企业产品性能指标已达到或超过国际头部企业同类产品水平，形成了较强的产品和技术积累。

2）新兴行业的快速发展创造了更多的应用需求

随着电子产业持续发展，电子胶粘剂应用领域不断拓展。智能终端、新能源、

半导体、通信等战略性新兴市场需求旺盛，新能源汽车、光伏发电系统、先进封装、AR/VR、5G/6G 等产品和技术发展带来新增用胶需求。高要求、高标准、高附加值的新兴市场促进行业内企业开展技术创新和产品结构优化，带动产品性能和质量提升，为电子胶粘剂进入更多高性能应用领域奠定基础。

3）全球对于环保的愈发重视促进环境友好型电子胶粘剂的发展

随着全球社会对环境保护和可持续发展的愈发重视，电子胶粘剂的环保特性也愈加重要。许多国家制定了限制有害物质（RoHS）和废弃电子设备和电子拆解（WEEE）等指令和标准，对电子胶粘剂的环保属性有着愈加严格的要求。目前，各大厂商针对水基型、热熔型、无溶剂型、紫外光固化型、高固含量型及生物降解型等环境友好型产品持续加大投入、积极生产，未来将逐步替代传统的、环境污染严重的溶剂型制品。环境友好型产品已成为电子胶粘剂行业技术发展方向的共识之一。

3、电子胶粘剂细分应用领域发展概况

（1）智能终端领域

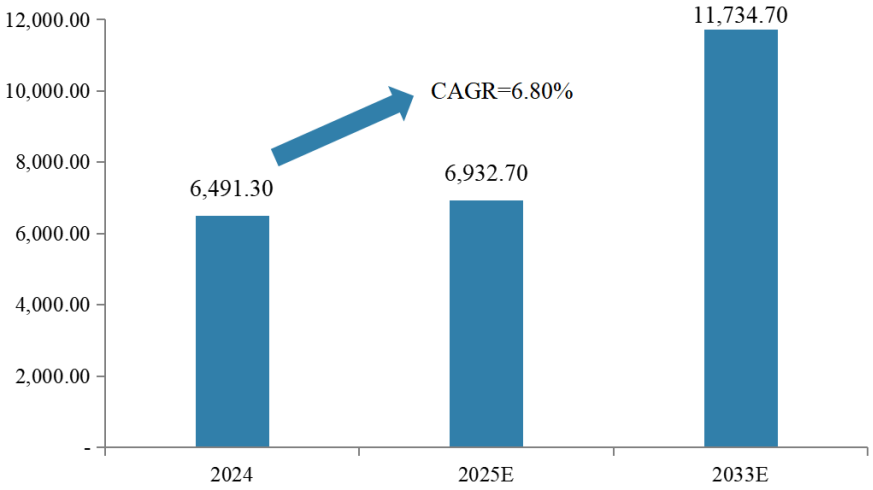
电子胶粘剂广泛用于智能手机、个人电脑、平板、TWS 耳机、智能手表、AR/VR 设备等智能终端产品。随着智能终端产品向轻薄化、美观化和多功能化方向发展，电子元器件集成度持续提升。相较于螺丝、卡扣、焊接等机械连接方式，电子胶粘剂更适用于微小缝隙连接、异质材料粘接和应力均匀分布，并可实现密封防护、热管理、电气绝缘等功能，在智能终端产品中的应用持续增加。同时，智能手机、个人电脑和平板等传统智能终端产品出货量整体保持稳定，TWS 耳机、智能手表、AR/VR 设备等新兴智能终端产品快速发展，为智能终端电子胶粘剂提供了稳定的市场空间和广阔的增长潜力。

1）智能手机和个人终端设备（PC）

国家发展改革委价格监测中心 2026 年 2 月指出，受 AI 服务器算力需求持续增长影响，全球存储芯片市场供需偏紧格局仍将延续，存储芯片价格上涨压力将逐步传导至智能手机、个人终端设备（PC）等消费电子产品。随着 AI 应用加速向终端侧渗透，智能手机和 PC 产业链对高性能芯片、存储器、散热结构及精密模组的需求进一步提升，消费电子行业也将加快向高端化和高性能化方向演进。

根据 GII 数据，2024 年全球智能手机市场规模为 6,491.30 亿美元，预计 2025 年将增长至 6,932.70 亿美元，2033 年市场规模将达到 11,734.70 亿美元，年复合增长率为 6.80%。

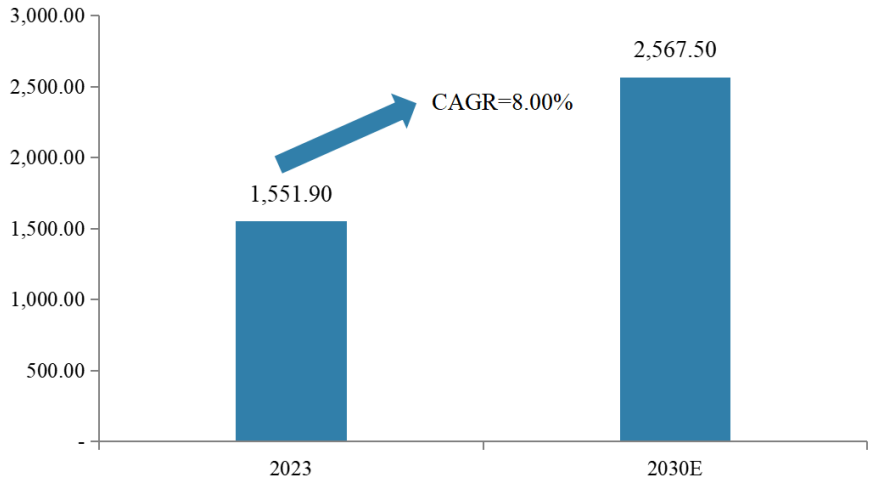
2024-2033 年全球智能手机市场规模（含预测，单位：亿美元）



数据来源：GII

个人终端设备（PC）方面，根据 Omdia 预测，PC 市场内部将进一步呈现结构性分化，入门级机型受成本上涨、供应短缺等因素影响较大，未来出货量可能承压；但在 AI PC 等新产品形态推动下，中高端 PC 需求有望持续增长。根据 Arma & Elma 数据，2024 年全球 PC 市场出货量为 2.63 亿台，预计 2025 年将达到 2.73 亿台；全球 PC 市场规模已于 2023 年突破 1,551.90 亿美元，预计 2030 年将达到 2,567.50 亿美元，年复合增长率约 8.00%。

2023-2030 年全球个人终端（PC）市场规模（含预测，单位：亿美元）



数据来源：Arma & Elma

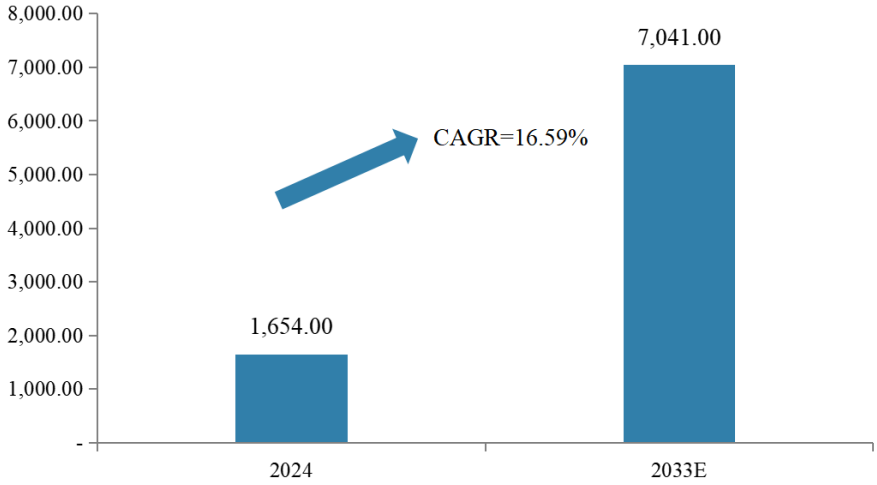
总体来看，在 AI 应用普及、产品性能升级和中高端机型占比提升的背景下，

智能手机和 PC 产业链将更加重视材料性能、制程精度和可靠性，带动上游配套产业链向尖端化、技术导向等发展。电子胶粘剂作为智能终端制造中的重要功能材料，可用于结构粘接、模组固定、导热散热、防水密封及电磁屏蔽等环节，预计将随终端产品升级持续受益。

2）可穿戴设备

近年来，以 TWS 耳机、智能手表为代表的可穿戴设备发展迅速，随着产品品类持续拓展，健康监测、运动检测、无线通信和智能交互等功能不断丰富，可穿戴设备市场需求预计将保持增长。根据 GII 数据，2024 年全球可穿戴设备市场规模为 1,654.00 亿美元，预计 2033 年将增长至 7,041.00 亿美元，年复合增长率为 16.59%。

2024-2033 年全球可穿戴设备市场规模（含预测，单位：亿美元）



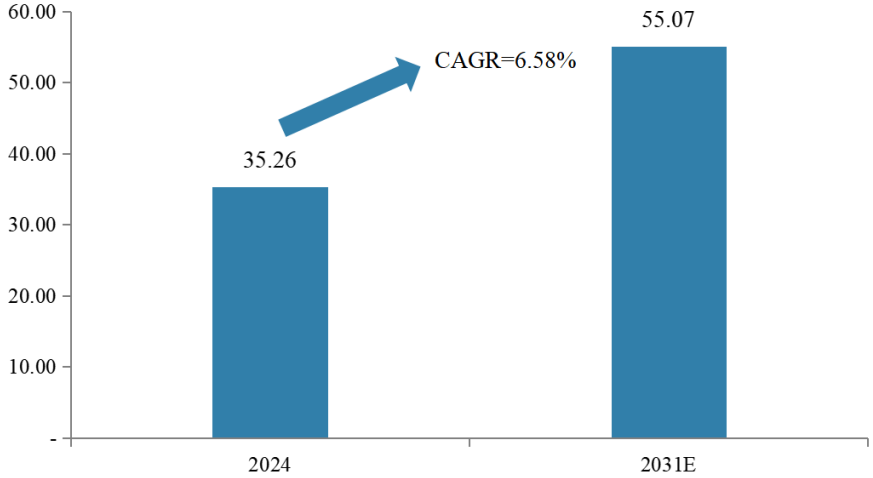
数据来源：GII

可穿戴设备具有体积小、结构紧凑、贴身使用和长期运行等特点，对内部元器件固定、柔性连接、防水密封、导热散热和电气可靠性提出较高要求。随着传感器、FPC、电池、天线等部件集成度提升，电子胶粘剂由基础粘接材料逐步向兼具导电、导热、防护等功能的材料方向发展。

3）AR/VR 头显

AR/VR 头显是智能终端行业的重要新兴方向。随着相关技术持续成熟，2023 年以来多家科技企业陆续发布相关产品，AR/VR 市场有望逐步进入放量阶段。根据 QY Research 数据，2024 年全球 AR/VR 头显设备市场规模约为 35.26 亿美元，预计 2031 年将达到 55.07 亿美元，年复合增长率为 6.58%。

2024-2031 年全球 AR/VR 头显设备市场规模（含预测，单位：亿美元）



数据来源：QY Research

（2）新能源领域

近年来，绿色可持续发展已逐渐成为国际社会的共识。目前，全球已有超过 120 个国家和地区提出“碳中和”目标，其中，美国、欧盟、英国、日本等经济体计划在 2050 年前实现“碳中和”，中国计划在 2060 年前实现“碳中和”。能源转型是实现“碳中和”的必要条件，加大新能源技术研发、调整能源结构是能源转型的重要路径。其中，新能源汽车因其环保性和生态可持续性，受到产业政策的大力支持，销量持续增长。光伏发电作为一种重要的清洁、可再生能源，能有效节约能源资源，随着技术发展，其经济效益也不断提升，装机规模逐年扩大。电子胶粘剂作为新能源汽车和光伏发电系统生产制造过程中的重要材料，也将受益于新能源行业的快速发展。

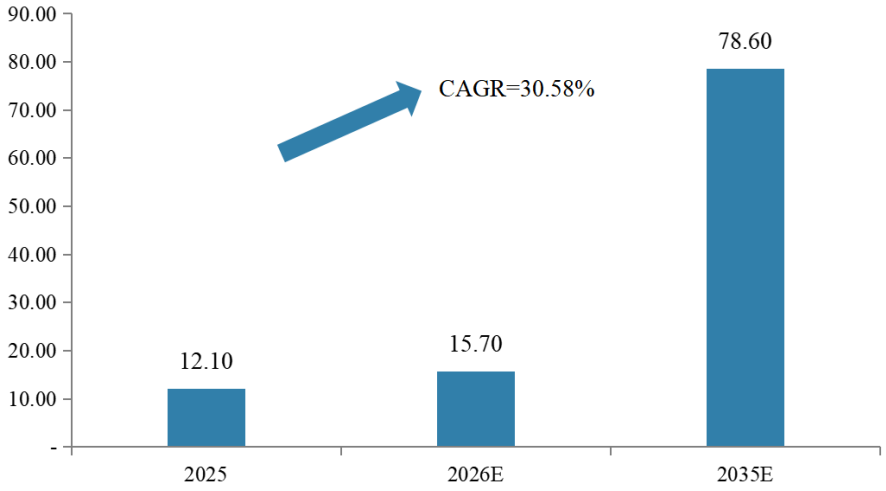
1）新能源汽车

随着绿色发展的要求和技术的进步，新能源汽车渗透率有望快速提升。根据国际能源署（IEA）数据，2025 年全球电动汽车销量超过 2,000 万辆，占全球新车销量约 25%；其中，中国电动汽车销量超过 1,300 万辆，继续保持全球最大电动汽车市场地位。未来，全球电动汽车市场呈现“中国主导、欧美跟进、新兴市场崛起”的多元化格局，IEA 预计，2026 年全球电动汽车销量将增至 2,300 万辆，占全球新车销量约 28%。

新能源汽车为电子胶粘剂市场提供了广阔的增量空间。在“三电系统”及整车电子系统中，电子胶粘剂可用于结构粘接、密封防护、导热散热和绝缘保护等。

随着动力电池向大模组化、无模组化方向发展，动力电池封装材料是取代传统结构件实现动力电池轻量化、高可靠性的关键材料之一，预计将带动新能源汽车用胶需求增长。根据 Research and Markets 预测，全球新能源汽车专用胶粘剂市场规模将从 2025 年的 12.10 亿美元增长至 2026 年的 15.70 亿美元，预计 2032 年将达到 78.60 亿美元。

2025-2032 年新能源汽车专用胶粘剂市场规模（含预测，单位：亿美元）



数据来源：Research and Market

此外，汽车智能化趋势也将拓展电子胶粘剂应用空间。智能驾驶和智能座舱的发展推动摄像头、毫米波雷达、激光雷达、车载显示等汽车电子部件渗透率提升。根据罗兰贝格发布的《汽车电子革命系列白皮书：四大核心技术趋势》测算，2019 年配备 L1 级辅助驾驶系统的传统燃油车单车汽车电子价值量为 3,145 美元。到 2030 年，受益于电动化、智能化以及网联化的发展趋势，配备 L3 级别自动驾驶系统的纯电动车中汽车电子的单车价值量有望增长至 7,030 美元。电子胶粘剂作为汽车电子产品制造过程中的重要粘接、密封、导热及保护材料，预计也将随着汽车电子的价值提升实现市场规模的增长。

2）光伏发电系统领域

全球能源结构向清洁化、低碳化方向转型已成必然趋势。可再生能源将在所有情景下成为增速最快的能源类型，其中太阳能光伏（PV）继续充当全球能源转型主力，在此背景下，各国政府对于发展光伏发电行业的政策支持和行业技术水平提升将推动全球光伏装机量的快速增长。根据 IEA-PVPS 数据，2024 年全球新增光伏装机容量约 553GW 至 601GW，全球累计光伏装机容量超过 2.2TW，

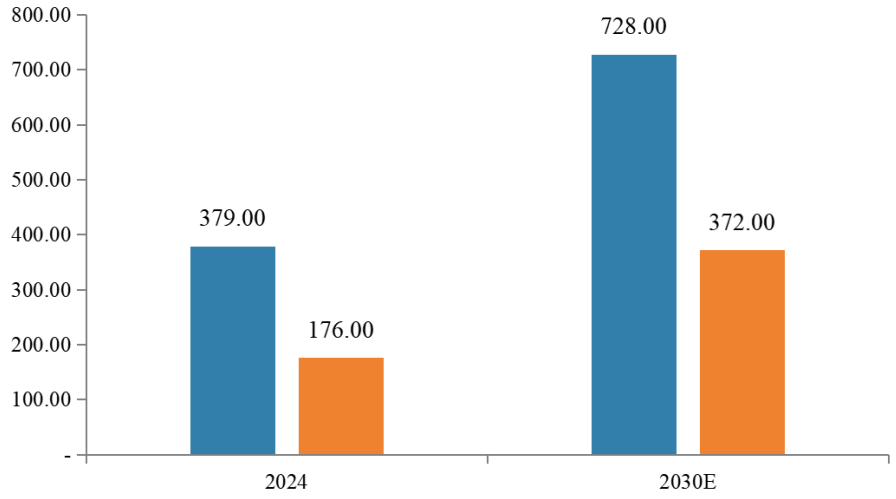
光伏发电已成为能源转型中的重要增长领域。电子胶粘剂可用于光伏发电系统中逆变器的导热和封装、光伏组件封装等应用点，是保证光伏发电系统持续稳定运行的关键材料，预计其未来市场规模将受益于净零排放政策的深入实施，成为有效实现全球净零排放目标的重要光伏部件之一。

（3）半导体领域

半导体是电子信息产业的核心基础，广泛支撑人工智能、物联网、云计算、工业互联网等领域发展。半导体产业链主要包括芯片设计、晶圆制造、封装和测试等环节，电子胶粘剂在晶圆制造和封装环节均有应用，其中在封装环节主要作为芯片粘接、底部填充、导热界面等功能性材料使用。

根据 GII 数据，2024 年全球半导体封装材料市场规模 379.00 亿美元，预计 2030 年将增长至 728.00 亿美元，年复合增长率为 11.50%。其中，中国是半导体封装材料仅次于北美地区的主要市场之一，市场规模预计将由 2024 年的约 176.00 亿美元增长至 2030 年的 372.00 亿美元，年复合增长率为 13.30%。

2024-2030 年全球和中国半导体封装材料市场规模（含预测，单位：亿美元）



数据来源：GII

近年来，我国集成电路产业持续发展，但关键封装材料仍处于本土化配套推进阶段。以电子胶粘剂为代表的封装材料具有配方体系复杂、工艺适配要求高、客户认证周期长等特点，部分应用仍由国际厂商垄断，国内企业长期依赖进口。随着国内供应链安全需求提升，以及国家对集成电路和关键材料产业的持续支持，国内半导体封装材料企业将加快研发和客户导入，本土化配套空间逐步打开。

随着先进封装技术发展，电子胶粘剂在半导体领域的应用场景进一步拓展。

先进封装可在不单纯依赖制程微缩的情况下提升芯片集成度、性能和功能多样性，并在一定程度上优化成本。根据 Yole 预测，2024 年全球先进封装市场规模约为 450 亿美元，预计 2030 年将达到 800 亿美元，2024 年至 2030 年年复合增长率为 9.4%，先进封装在整个封装行业中的市场占比有望在 2027 年超过 50%。倒装、晶圆级封装、2.5D/3D 先进封装形式带来更多粘接、导热和底部填充需求，为高性能电子胶粘剂提供了增长空间。

在半导体封装领域，电子胶粘剂主要可作为芯片粘接材料、导热界面材料、底部填充材料等使用：

1）芯片粘接材料

芯片粘接材料主要用于芯片与基板、引线框架或其他芯片之间的粘接固定，是封装环节的重要材料。在多芯片集成和芯片堆叠等先进封装工艺中，相关材料需具备较好的粘接强度、热膨胀匹配能力和导热性能。根据 Research and Market 数据，2025 年全球芯片粘接材料市场规模为 8.61 亿美元，预计 2026 年增长至 9.21 亿美元，2032 年增长至 13.50 亿美元，2025 年至 2032 年年复合增长率 6.67%。目前，全球芯片粘接材料市场仍主要由汉高、住友、昭和电工等海外企业占据主要市场份额。

2）导热界面材料

导热界面材料主要用于半导体封装热管理，通过填充界面空隙、降低接触热阻，提高器件散热效率。按照产品形态和应用方式不同，导热界面材料可分为导热膏、导热垫片、导热凝胶等，通常由高分子聚合物与氮化铝、氧化铝等导热填料组成。目前，全球主流供应商包括陶氏化学、信越化学、汉高、莱尔德、固美丽等。

3）底部填充材料

底部填充材料主要用于缓解芯片、焊点和基板之间因热膨胀系数不匹配产生的应力，提升热循环、跌落冲击等可靠性。底部填充胶通常以环氧树脂为主体，并添加球形硅微粉、固化剂等材料，需具备低热膨胀系数、良好流动性和长期可靠性。根据 Research And Markets 数据，2025 年全球底部填充材料市场规模约 11.00 亿美元，预计 2026 年增长至 11.90 亿美元，2032 年增长至 20.60 亿美元，

2025 年至 2032 年的年复合增长率为 9.32%。目前，全球主流供应商包括纳美仕、昭和电工、汉高等，高端应用国产化率几乎为零。

（4）通信领域

电子胶粘剂可应用于通信基站、数据中心、服务器、交换机和光模块中电子元器件的电磁屏蔽、导热、粘接、保护等，AI 大模型训练和推理推动加速服务器、数据中心和高速互联设备建设，IDC 预计 2028 年全球 AI 基础设施支出将达 2,230 亿美元。根据工信部《“十五五”规划纲要》，未来的通信领域发展中心将持续把握数字化、网络化、智能化发展大势，充分发挥中国数据资源丰富、产业体系完备、应用场景广阔优势，激活数据要素潜能，加快数智技术创新，深化拓展“人工智能+”，赋能经济社会发展和治理能力提升，促进生产方式深层次变革和生产力革命性跃迁。作为通信基站和数据中心的重要零部件，全球光模块处于市场快速发展的阶段，根据 Light Counting 数据，2025 年全球光模块及相关产品销售额为 268 亿美元，较 2024 年增长 74%；2026 年一季度光模块及 AOC 销售额约 100 亿美元，较 2025 年一季度增长超过 90%，未来市场将快速扩张。

4、进入行业的主要壁垒

（1）技术壁垒

电子胶粘剂广泛应用于智能终端、新能源、半导体、通信等领域。不同应用场景在用胶位置、功能需求、制程条件及可靠性要求方面存在差异，电子胶粘剂企业需具备定制化配方开发和工艺适配能力，以满足下游客户的差异化需求。同时，下游终端产品迭代较快，持续提高对电子胶粘剂性能、品质及交付效率的要求。电子胶粘剂研发依赖长期技术积累、跨学科材料理解和丰富应用经验，对新进入者形成较高技术壁垒。

（2）客户壁垒

电子胶粘剂直接影响终端产品的功能实现、质量稳定性和生产效率。下游客户通常对供应商的研发配合能力、生产工艺水平、质量控制能力、行业应用理解及经营稳定性提出较高要求，并需通过严格的认证测试后方可纳入供应链体系。供应商一旦通过认证并形成稳定合作关系，客户通常不会轻易更换，以避免重新认证、工艺磨合及供应稳定性风险，对新进入者形成较高客户壁垒。

（3）资金壁垒

电子胶粘剂研发及产业化具有投入大、周期长的特点。研发阶段需持续投入实验场地、研发设备和精密检测仪器；产业化阶段需投入生产车间、产线建设及质量控制体系。与此同时，行业认证周期较长，下游产品更新迭代较快，企业需保持持续研发和产线升级投入，以维持产品竞争力和交付能力，对新进入者形成较高资金壁垒。

（4）管理能力壁垒

电子胶粘剂业务涉及研发、销售、采购、生产和质量控制等多个环节，且产品定制化程度高、迭代速度快、配方保密要求高，对企业协同管理能力要求较高。企业需准确识别客户需求并快速转化为研发方案，同时在原料采购、生产排程、质量控制、成本管控和配方保密等方面建立有效机制，才能保障产品稳定交付和持续迭代，对新进入者形成较高管理壁垒。

5、行业面临的机遇与挑战

（1）行业面临的机遇

1）国家政策持续支持电子胶粘剂产业发展

电子胶粘剂产品属于国家重点鼓励发展的新材料产业。近年来，国家陆续出台多项政策，支持电子信息制造、新材料、精细化工及相关下游应用行业发展。《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方案》《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案（2025—2027 年）》等政策，将高性能胶粘剂、环保型胶粘剂、电子封装材料、功能性膜材料等相关方向纳入支持范围。在上游原材料方面，《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027 年）》《新产业标准化领航工程实施方案（2023—2035 年）》等政策支持先进高分子材料及关键化工材料发展；在下游应用方面，国家政策持续鼓励新能源、半导体、智能终端、通信及数字经济等战略性新兴产业发展。上述政策从原材料供给、产品标准、工艺升级和下游应用拓展等方面，为我国电子胶粘剂行业发展提供了良好的政策环境。

2）AI 算力设备、高速光模块等下游产业升级催生新需求

近年来，电子胶粘剂应用场景不断拓展，下游行业技术和工艺持续升级，带

动电子胶粘剂需求增长。在智能终端领域，手机、平板、电脑、可穿戴设备及AR/VR 等产品持续迭代，推动电子胶粘剂向精密点胶、轻薄化适配和多功能集成方向发展。下游应用场景的持续升级，为电子胶粘剂行业提供了新的增长空间；在新能源领域，新能源汽车、储能和光伏行业持续发展，带动结构粘接、灌封密封、热管理和可靠性防护等用胶需求增加；在半导体、通信领域，先进封装自主配套加速、光模块和 AI 服务器等新兴应用带来的功能性材料需求提升机遇，使相关设备功率密度提升，对导热、绝缘、低挥发、密封防护和光学固定等材料提出更高要求。

3）关键领域自主发展需求增强，推动国产品牌崛起

电子胶粘剂广泛应用于智能终端、新能源汽车及储能、光伏、半导体及先进封装、通信及 AI 算力设备等战略性新兴产业。近年来，受国际贸易环境变化及供应链安全需求提升影响，我国对关键材料自主发展的重视程度不断提高，自主配套需求持续增强。与此同时，国内电子胶粘剂企业在技术研发、生产工艺、应用验证和客户服务方面不断积累，部分产品已在下游高端应用中实现导入。随着国家政策支持、国内企业技术水平提升以及本土化快速响应优势逐步显现，国产电子胶粘剂在关键应用领域的替代空间有望进一步扩大。

电子胶粘剂产品广泛应用于智能终端、新能源、半导体、通信等战略性新兴产业。近年来，在西方国家对我国高科技行业施加技术和贸易限制的背景下，我国对关键材料自主发展的重视程度不断提高，自主配套需求持续增强。与此同时，国内电子胶粘剂企业在技术研发、生产工艺、应用验证和客户服务方面不断积累，已经接近或达到国际先进水平。随着国家政策支持、国内企业技术水平提升以及本土化快速响应优势逐步显现，国产电子胶粘剂在关键应用领域的替代空间有望进一步扩大。

（2）行业面临的挑战

目前国内高性能电子胶粘剂市场主要由汉高、陶氏化学、3M、富乐、德路等国际厂商主导。由于起步较早，国外企业具有品牌、技术、规模等方面的先发优势。由于电子胶粘剂对于终端产品的各项功能实现、可靠性、生产成本及效率均有关键性的影响，下游客户选择产品需要经过严苛的测试，因此倾向于与原有

供应商长期合作。如果国内电子胶粘剂企业无法提供有竞争力的产品及应用方案，则会在高端电子胶粘剂市场拓展的过程中受阻。

6、行业周期性特征

发行人所处行业的发展与下游行业的发展高度相关，报告期内发行人产品主要应用于智能终端、新能源、半导体、通信等领域。部分下游领域市场的需求受宏观经济景气度的变化呈现周期性波动的特征。

7、上述情况在报告期内的变化和未来可预见的变化趋势

报告期内，电子胶粘剂作为用于电子元器件、组件及系统制备的关键功能材料，受智能终端、新能源、半导体、通信的蓬勃发展而进入前所未有的业务扩张阶段。未来，电子胶粘剂在智能电子终端领域的发展将不再局限于单一的粘接功能，而是演变为一种集成了多重性能、精准适配多元场景的关键材料，其未来的发展趋势着重体现在功能集成化、工艺精密化、绿色环保化和新兴场景适配化四大方面。

（1）功能集成化

随着智能手机、可穿戴设备、新能源汽车、AI 服务器等产品向轻薄化、高性能化和高功率密度方向发展，电子胶粘剂正从单一粘接材料升级为兼具导热、导电、电磁屏蔽、防水密封等多重功能的“多能一体”解决方案。特别是在高算力芯片、功率器件、光模块及高速通信设备中，散热效率、信号稳定性和长期可靠性要求显著提高，推动电子胶粘剂向兼具传导性能、结构强度和环境耐受性的功能性材料升级。

（2）工艺精密化

为应对终端产品微型化、集成化和结构复杂化趋势，电子胶粘剂的配方设计与点胶工艺持续向高精度、高稳定性方向升级。在折叠屏、Mini/Micro LED、全面屏等应用中，材料需要兼顾柔韧性、低粘度、高韧性、快速固化及微间隙填充能力；在先进封装等场景中，材料洁净度、流动性、固化速度和可靠性要求进一步提高。上述变化推动电子胶粘剂企业持续提升配方开发能力，并与精密点胶、自动化控制等工艺深度协同。

（3）绿色环保化

在碳中和和循环经济理念推动下，电子胶粘剂行业将持续向绿色化方向发展，一方面通过开发无溶剂、低 VOC、无重金属、生物基或可回收材料降低环境负担；另一方面提升材料的可返工、可拆解和可维修性能，在保障使用期可靠性的同时，便利终端产品维修、回收和再利用。符合绿色制造和可持续发展要求的电子胶粘剂将成为行业重要发展方向。

（4）新兴场景适配化

AI 算力设备、高速光模块、智能汽车、AR/VR 等新兴应用快速发展，带来新的材料需求和验证要求。相关设备通常具有高功耗、高密度、高速传输和长期稳定运行等特点，对电子胶粘剂的热管理、低挥发、低应力、耐湿热、低污染和制程适配能力提出更高标准。未来，能否快速理解下游新场景并完成材料开发、工艺验证和批量导入，将成为电子胶粘剂企业竞争力的重要体现。

（四）行业竞争情况

1、发行人产品或服务的市场地位、技术水平及特点

（1）市场地位

公司是国内主要电子胶粘剂生产商之一。公司专注于电子专用高分子材料的研发、生产和销售，主要为客户提供电子胶粘剂产品及配套应用方案，是行业内少数拥有自主开发原材料及配方能力的国家级高新技术企业。公司凭借卓越的研发实力及多年的研发积累已进入了高端电子胶粘剂领域，打破了国际品牌在高端电子胶粘剂领域的垄断地位，是国内少数能与汉高、陶氏化学、3M、富乐、德路等世界级巨头展开直接竞争的企业。中国胶粘剂和胶粘带工业协会提供的资料显示，公司产品性能获得市场认可，声誉较高，已成为我国电子胶粘剂市场的领军企业。

（2）技术水平及特点

发行人技术水平及特点参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“七、公司研发及核心技术情况”。

2、行业内主要公司

（1）全球竞争格局

从全球市场竞争格局来看，国外发达国家企业在电子胶粘剂领域中起步较早，形成了一定的先发优势、品牌优势和规模优势，在全球电子胶粘剂市场中占有较大份额。根据 Mordor Intelligence，全球电子胶粘剂行业市场集中度较高，市场份额主要集中在部分主要企业，包括汉高、陶氏化学、3M 等。全球电子胶粘剂主要企业情况如下：

公司名称	简介
汉高	德国汉高公司（Henkel）成立于 1876 年，为全球胶粘剂龙头企业。汉高的工程胶粘剂、密封剂和表面处理方面的系列产品涵盖了锡膏、厌氧胶、环氧胶、硅胶、瞬干胶、UV 胶、PU 胶、MS 聚合物、清洗剂等八大系列，广泛应用于电子、工业、汽车、船舶、铁路等行业以及设备维修等多个领域
陶氏化学	美国陶氏化学（Dow）成立于 1897 年，为消费者护理、基础设施、包装等行业客户提供服务。陶氏化学聚焦乙烯、丙烯、有机硅三大材料领域，主要产品包括粘合剂、密封胶和导热材料，广泛应用于汽车制造、航空航天、太阳能、建筑、电子通信及成像设备制造等行业
3M	美国 3M 公司（Minnesota Mining and Manufacturing Corporation）成立于 1902 年，全球总部设在美国明尼苏达州的圣保罗市，是世界著名的产品多元化跨国企业。3M 于 1984 年进入中国开展业务，业务涉及胶粘材料、薄膜材料、电子材料等。3M 胶粘产品为消费电子、汽车、家电等行业的设备提供粘接方案，包含结构胶、热熔胶、密封胶等品类，在各类电子产品中广泛使用
富乐	美国富乐公司（H.B.Fuller）成立于 1887 年，是专业生产销售粘合剂、密封胶、涂料、油漆以及其他特殊化工品的跨国公司。富乐的胶粘剂产品主要包括厌氧胶、RTV 硅橡胶、瞬干胶、单组份聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、改性增强型氯丁胶类产品等七大类，应用于汽车制造和维修、电子电器等领域的密封、粘接、固定、灌封、包封、共形覆膜、底部填充、导电、导热、LCD 封装等
德路	德国德路（DELO）成立于 1961 年，是全球主要高科技胶粘剂及多功能材料制造商之一，并配套开发点胶和固化技术。德路产品包括光固化、热固化、双重固化、湿气固化、厌氧固化及双组分等胶粘剂体系，广泛应用于半导体、汽车、消费电子、医疗电子、光学与光子学、智能卡及工业解决方案等领域，应用场景包括半导体封装、摄像头、扬声器、电机、传感器等
好乐	德国好乐（Hönle）公司成立于 1976 年，是一家工业紫外技术供应商，主要产品包括紫外固化灯和固化设备以及紫外光固化胶粘剂，其旗下品牌 Panacol 主要经营胶粘剂相关产品，广泛应用于电子、医疗、光学、印刷、汽车、航空航天等领域
纳美仕	日本纳美仕（Namics）成立于 1947 年，主要开发、制造和销售电子材料。该公司的高科技产品服务于亚洲、美洲及欧洲处于世界领先地位的电子行业客户。该公司产品包括芯片涂层材料、芯片粘合剂、粘合膜等，广泛应用于半导体、家用电器、汽车和手机等领域

昭和电工	日本昭和电工（Resonac）成立于 1939 年，2020 年收购日立化成，并于 2023 年完成与昭和电工材料（原日立化成）的整合，主营半导体及电子材料、交通、创新材料、基础化工及其他五大业务板块，产品包括半导体前道材料、半导体后道材料、汽车材料、锂电池材料、创新材料、石油化工材料、石墨材料等，其半导体后道材料业务的主要产品包括芯片固晶胶膜（DAF）、芯片级底部填充材料、芯片级导热界面材料、各向异性导电胶膜等

（2）国内竞争格局

我国电子胶粘剂的国产化率较低，尤其智能终端、汽车电子等领域的高性能电子胶粘剂主要由汉高、富乐、陶氏化学等国外企业主导，国内电子胶粘剂企业产品应用领域主要集中在中低端的元器件灌封、密封。近年来随着国家政策的大力支持、国际产业转移以及国内企业持续的研发投入，以发行人为代表的部分国内企业在高端电子胶粘剂领域实现了技术积累及产品性能方面的突破，已在部分领域具备与国际一流企业竞争的实力。国内主要电子胶粘剂企业情况如下：

公司名称	简介
德邦科技（688035.SH）	德邦科技主要从事高端电子封装材料研发及产业化，主要产品包括集成电路封装材料、智能终端封装材料、新能源应用材料、高端装备应用材料四大类别，产品广泛应用于晶圆加工、芯片级封装、功率器件封装、板级封装、模组及系统集成封装等不同的封装工艺环节和应用场景
回天新材（300041.SZ）	回天新材主要从事胶粘剂和新材料研发及生产，在沪、粤、苏、鄂四地分别建有产业基地和研发中心，是中国规模较大的新能源、电子、汽车、工业、包装、环保、建筑、高铁等行业胶粘剂和新材料供应商
华海诚科（688535.SH）	华海诚科主要从事半导体封装材料的研发及产业化，主产品包括环氧塑封料与电子胶粘剂，广泛应用于半导体封装、板级组装等应用场景，其电子胶黏剂产品可应用于芯片粘结、芯片级塑封、板级组装等不同的封装环节，应用领域贯穿于一级封装、二级封装以及其他工业组装领域
松井股份（688157.SH）	松井股份主要为客户提供涂料、油墨、胶黏剂等新型功能涂层材料，已成功进入国际知名终端品牌供应体系并建立了相对稳定的业务合作关系，是一家可与国际巨头展开竞争的涂层材料生产企业
世华科技（688093.SH）	世华科技从事功能性材料研发、生产及销售，主要产品分为功能性电子材料和高性能光学材料，其中，功能性电子材料主要应用在消费电子、AI 智能硬件、汽车电子、医疗电子等，高性能光学材料主要应用于 OLED/LCD 等主流显示面板或其生产过程
韦尔通科技股份有限公司	韦尔通科技股份有限公司专注于高端胶粘剂、密封剂等功能性材料的开发与应用。韦尔通旗下创建了威尔邦品牌，主要为手机、平板、智能电子产品的触控屏组装、结构件固定、零件防水密封等应用，以及新能源领域的电池组组装等需求提供解决方案与服务
上海本诺电子材料有限公司	上海本诺电子材料有限公司是一家专注于电子级粘合剂产品和解决方案的生产商，主要产品有芯片粘贴胶、电子组装胶、硅胶系列、密封胶系列等，主要应用于集成电路、消费电子、物联网和汽车电子领域
长春永固科技有限公司	长春永固科技有限公司是一家主要研究开发、生产和销售电子胶粘剂的制造商，公司主要产品包括芯片固晶胶膜（DAF）、高性能导电胶、高绝缘性非导电胶，适用于半导体封装、LED、智能卡、摄像头模组、光伏等领域

3、发行人与同行业可比公司比较情况

（1）同行业可比公司选取的依据

公司的主营业务为电子专用高分子材料的研发、生产和销售，主要为客户提供电子胶粘剂产品及配套应用方案，产品广泛应用于智能终端、新能源、半导体、通信等战略性新兴产业。目前 A 股上市公司不存在与公司在产品结构、产品形态、下游应用领域、业务模式等方面完全一致的公司。公司综合考虑在产品结构、产品功能、生产制造工艺以及下游应用领域等方面与公司具有相似性的公司后，选取了德邦科技（688035.SH）、回天新材（300041.SZ）、华海诚科（688535.SH）、松井股份（688157.SH）及世华科技（688093.SH）作为同行业可比上市公司。

公司与同行业可比公司主营业务、主要产品、应用领域及收入结构的比较情况列示如下：

公司名称	主营业务	主营产品	应用领域	与公司可比性分析
德邦科技（688035.SH）	专业从事高端电子封装材料研发及产业化	电子级粘合剂和功能性薄膜材料	集成电路封装、智能终端封装和新能源应用等	国内电子复合材料同行业公司，与发行人电子胶粘剂产品主要类型和应用领域类似，系公司产品的主要对标企业
回天新材（300041.SZ）	专业从事胶粘剂等新材料研发、生产和销售	工程胶粘剂及太阳能电池背膜	可再生能源、电子电器、交通运输设备制造和维修等	国内有机硅胶粘剂、聚氨酯胶粘剂和新能源专用胶膜主要生产商，与发行人同领域下产品类似
华海诚科（688535.SH）	专注于半导体封装材料的研发及产业化	环氧塑封料和电子胶粘剂	半导体封装	产品主要应用于半导体封装，与发行人产品半导体用胶点应用领域存在重合
松井股份（688157.SH）	提供涂料、特种油墨等多类别系统化解决方案	涂料、特种油墨和胶粘剂	智能终端和乘用汽车	产品主要应用于智能终端和汽车粘接用胶点，与发行人产品应用领域存在重合
世华科技（688093.SH）	专业从事功能性材料的研发、生产和销售	精密制程应用材料、电子复合功能材料和光电显示模组材料	电子电器元器件、光电等	应用于电子元器件的电子复合功能材料，主要应用于智能终端领域，在产品功能性和应用领域方面较为类似
发行人	专注于电子专用高分子材料的研发、生产和销售，主要为客户提供电子胶	电子胶粘剂	智能终端、新能源、半导体、通信等	-

公司名称	主营业务	主营产品	应用领域	与公司可比性分析
	粘剂产品及配套应用方案			

注：根据同行业公司公告整理。

（2）经营情况比较

公司和同行业可比公司的主要经营情况如下：

1）营业收入

单位：万元

公司简称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
德邦科技	154,723.09	116,675.21	93,197.52
回天新材	443,557.15	398,855.15	390,151.92
华海诚科	45,805.59	33,163.49	28,290.22
松井股份	72,213.48	74,552.65	58,976.73
世华科技	108,673.25	79,468.34	51,149.97
德聚技术	**45,786.50**	**38,489.05**	**35,139.21**

2）净利润

单位：万元

公司简称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
德邦科技	10,926.01	9,752.63	10,031.59
回天新材	22,618.18	10,378.97	29,796.94
华海诚科	2,401.47	3,993.58	3,163.86
松井股份	1,824.39	8,767.44	7,826.44
世华科技	39,891.44	27,965.84	19,345.91
德聚技术	**12,307.74**	**6,745.44**	**4,212.79**

3）毛利率

单位：%

公司简称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
德邦科技	27.50	27.55	29.19
回天新材	23.61	18.46	22.82
华海诚科	26.66	25.63	26.88
松井股份	43.10	48.85	49.37
世华科技	58.11	56.21	58.88
德聚技术	**76.99**	**74.63**	**77.19**

公司与同行业可比公司关键财务数据比较分析情况参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”、“十一、资产质量分析”和“十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析”。

（3）市场地位比较

公司与同行业可比公司的市场地位对比情况如下：

公司名称	市场地位	主要终端品牌客户情况
德邦科技（688035.SH）	主要从事高端电子封装材料研发及产业化，与行业领先客户建立长期合作关系，已进入到众多知名品牌客户的供应链体系	宁德时代、苹果、通威股份、中航锂电、华天科技、阿特斯、华为等
回天新材（300041.SZ）	专注于胶粘剂等新材料的研发、生产，是我国工程胶粘剂行业中在规模、涵盖产品种类、应用领域等方面位于前列的内资企业	天合光能、晶澳科技、阿特斯、宁德时代、比亚迪、宇通客车、中通客车等
华海诚科（688535.SH）	专注于半导体封装材料的研发及产业化，已进入到众多知名客户的供应商体系，并已发展成为部分主要封装厂商的第一大环氧塑封料内资供应商	长电科技、华天科技、通富微电、富满微、扬杰科技、气派科技、银河微电等
松井股份（688157.SH）	专注于高端消费类电子和乘用汽车领域的新型功能涂层材料研究，为客户提供涂料、油墨、胶黏剂等多类别系统化解决方案。公司业务已覆盖手机、笔记本电脑、可穿戴设备、智能家居四大类细分市场，并形成涂料、油墨、胶黏剂等多类别一体化的产品体系结构	小米、华为、荣耀、罗技、北美消费电子大客户、Google、vivo、OPPO 等
世华科技（688093.SH）	专注于功能性材料的研发、生产和销售，以功能性电子材料和高性能光学材料为主营业务方向，在消费电子、AI 智能硬件、汽车电子、医疗电子、光学 LED/OLED 等方面均有布局	知名终端品牌及产业链客户（曾披露包括苹果、三星等）
发行人	专注于电子专用高分子材料的研发、生产和销售，主要为客户提供电子胶粘剂产品及配套应用方案，应用领域覆盖智能终端、新能源、半导体、通信等多个战略性新兴产业，是国内少有的与汉高、陶氏化学等国际领先企业展开直接竞争的电子胶粘剂生产企业	苹果、特斯拉、OPPO、华为、阳光电源、宁德时代等

可比公司情况参见本招股说明书之“第五节 业务与技术”之“二、公司所处行业情况”之“（四）行业竞争情况”之“2、行业内主要公司”。

（4）技术实力与核心竞争力指标对比

1）研发投入

报告期内，公司研发投入金额及其在营业收入中的占比与同行业可比公司的对比情况详见本招股说明书之“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、

经营成果分析”之“（五）期间费用及研发费用分析”之“3、研发费用”。

2）专利数量与研发人员情况

公司与同行业可比公司的技术实力对比情况如下：

相关指标	德邦科技	回天新材	华海诚科	松井股份	世华科技	发行人
设立日期	2003年1月	1998年9月	2010年12月	2009年3月	2010年4月	2016年5月
截至2025年12月31日专利数量情况						
发明专利（项）	356	172	63	149	90	62
实用新型专利（项）	81	50	157	85	64	49
截至2025年12月31日研发人员情况						
研发人员数量（人）	184	324	170	286	111	120
研发人员占比	18.78%	16.80%	17.51%	33.14%	21.02%	26.03%

（5）衡量核心竞争力的关键业务数据、指标

衡量公司核心竞争力的关键业务数据、指标比较情况参见本招股说明书之“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”。

（五）发行人竞争优势和劣势

1、公司的竞争优势

（1）体系化的产品开发及应用能力

自成立以来，公司专注于高端电子胶粘剂产品的研发及产业化，形成了从应用市场需求理解，到产品配方开发，再到产品分析测试的体系化研发优势。

在市场需求理解与把握方面，公司建立了与终端品牌深度绑定的“交互式”研发沟通机制，精准锚定电子胶粘剂下游多行业、多工艺的差异化应用需求。一方面，公司基于对行业技术发展动态的持续追踪，前瞻性研判科技发展趋势，将最新技术成果、工艺革新及材料应用方向分享给终端品牌商，引导下游应用创新；另一方面，通过与苹果、特斯拉、OPPO、华为、阳光电源、比亚迪、vivo、小米、三星、宁德时代等全球知名科技企业的长期深度合作，公司得以实时紧跟下游行业前沿发展脉络，深度洞悉电子胶粘剂在智能终端、新能源、半导体和通信等领域的前沿应用场景与性能升级需求，为产品研发创新提供精准导向。

在产品开发方面，公司拥有强大的研发团队、深厚的研发成果积累及高端产品研发基因。公司核心技术人员均具备优秀的专业背景以及十年以上的产品研发经验。截至 2025 年末，公司研发人员数量占比超过 25%。凭借对化学材料的深刻理解和应用经验，公司研发人员可以快速找到适应公司配方开发的原材料，并对其进行改良和修饰，从原材料层面即形成公司产品的技术壁垒。依靠多年的研发积累，公司形成了丙烯酸酯、环氧树脂、聚氨酯、有机硅、改性硅烷、杂化六大化学体系产品技术平台，能够根据客户需求快速对配方进行优化设计，定制化满足客户的应用需求。长期与苹果、特斯拉、宁德时代、阳光电源、通富微电、舜宇光学等行业领先的科技企业合作，为其解决工艺难点、提高产品可靠性，也塑造了公司高性能、高质量、高效率的高端产品研发基因。

在产品应用测试方面，公司拥有全方位模拟客户端应用场景的测试实验室，配备了化学分析、力学性能测试、电气性能测试、热性能测试、光学性能测试、可靠性测试、失效分析、材料表面处理、应用性能模拟等各种分析测试设备，能够全方位模拟客户产品使用场景，帮助客户确定合适的应用方案以解决生产环节痛点，保障研发产品与客户需求的一致性，提高产品研发的效率和成功率。

此外，公司充分利用业界和学术界资源展开产学研合作，与部分供应商保持密切的技术交流，共同推动电子胶粘剂的原材料创新。公司与广东粤港澳大湾区黄埔材料研究院、上海交通大学、中科院广州化学有限公司等高校及科研机构进行产学研合作，同时，公司与部分供应商建立了深入的合作关系，供应商会与公司及时同步上游最新原材料的信息并引入公司研发体系，或针对特定要求的原材料与公司进行定制化开发，为公司产品研发提供原材料方面的支持。

截至本招股说明书签署日，公司已获发明专利授权 65 项、实用新型专利授权 49 项。公司荣膺工业和信息化部的新一轮第一批国家重点“小巨人”企业及第三批专精特新“小巨人”企业，经广东省科学技术厅认定为“广东省新型高端电子胶粘剂（德聚）工程技术研究中心”，经广东省工业和信息化厅认定为“第 22 批省级企业技术中心”和“2024 年广东省省级制造业单项冠军企业-丙烯酸电子胶粘剂”。此外，公司获安费诺颁发的“2025 最佳质量奖”，于第十二届新能源汽车国际论坛获“2022 年度最佳动力电池材料奖”称号，参与了科技部 2022 年度国家重点研发计划“高端功能与智能材料”等重点专项项目。

（2）与知名客户建立长期稳定合作关系

电子胶粘剂广泛用于电子相关产品的电子元器件保护、电气连接、结构粘接和密封、热管理、电磁屏蔽等场景，其性能和质量直接决定了终端产品的各项功能实现、可靠性、生产成本及效率，是下游智能终端、新能源、半导体、通信等产业发展不可或缺的关键性支撑材料。为了保证产品可靠性及供应链稳定，下游客户在将电子胶粘剂厂商导入供应链体系前需进行严苛的认证测试，电子胶粘剂厂商一旦进入其供应商体系并实现规模化生产后更换供应商的成本较高，因此新进竞争者在不具备明显技术优势的情况下获取订单的难度较大。

经过多年发展和沉淀，公司凭借自身产品的优秀性能和稳定供应得到了下游知名客户的认可，与下游知名客户建立了长期、稳定的合作关系，具有较高的客户粘性，是国内少有的与汉高、陶氏化学、3M、富乐、德路等国际领先企业展开直接竞争的电子胶粘剂生产企业。公司主要向东山精密、鹏鼎控股、立讯精密、安费诺、旗胜电子、Sanmina、台郡科技、和硕、富士康等全球知名电子制造厂商直接供货；在智能终端领域，与苹果、OPPO、vivo、小米、三星等终端品牌商建立了稳定的合作关系；在新能源领域，公司与特斯拉、宁德时代、阳光电源、比亚迪、汇川技术等知名企业形成深度产业合作；在半导体领域，公司已陆续通过卓胜微、通富微电、舜宇光学、恒诺微等国内外多家知名半导体行业客户的产品验证测试；在通信领域，公司已进入华为、中际旭创、MPS 等知名客户的供应链体系。

与上述知名客户建立长期合作关系，一方面为公司提供了长期的经营业绩保证和增长潜力，另一方面也帮助公司不断接触各领域的前沿技术趋势，反哺公司的研发工作，形成良性循环。

（3）遍布全球、产研联动的市场拓展能力

作为一家业务遍布亚洲、美洲、欧洲的全球化企业，公司通过在国内的东莞、深圳、苏州、上海、南通等国内主要城市，以及美国、韩国、德国等主要下游市场国家布局销售中心，建立了横跨亚洲、北美、欧洲的销售网络体系，具有资深专业背景和丰富行业经验的技术应用工程师及销售人员分布全球各地，贴近客户，可以及时、高效地响应客户需求。

一方面，公司销售服务与技术应用相结合，能够快速、高效、准确地根据客户需求提供相应的产品和服务，以专业性和快速响应获得了多领域知名客户的认可；另一方面，公司技术应用工程师承担了解、收集、分析市场技术应用需求及产品开发方向，并向产品开发人员反馈的职能，公司设有多个研发中心，能够快速响应市场趋势和客户定制化需求，与客户形成了“交互式”的研发模式，为公司带来了极高的客户粘性及市场拓展成功率。

（4）完善的产品体系及配套应用方案

经过多年的技术积累和产品开发，公司形成了丙烯酸酯、环氧树脂、有机硅、聚氨酯、改性硅烷、杂化六大化学体系产品技术平台，掌握 20 项核心技术，可为客户提供元器件包封胶、磁芯粘接胶、结构粘接胶、底部填充胶、导热界面材料、电磁屏蔽材料、芯片固晶胶膜（DAF）、AA 制程胶、光学胶等各种产品品类及 UV 固化、热固化、湿气固化、双重固化等多种固化方式的产品，应用领域覆盖智能终端、新能源、半导体、通信等多个战略性新兴产业。除电子胶粘剂产品之外，公司还可以为客户提供与公司电子胶粘剂产品配套的设备及材料，能够为客户提供更加高效、高质量的工艺体验以及“一站式”的电子胶粘剂应用方案。

2、公司的竞争劣势

（1）融资渠道有限，资金实力不足

电子专用高分子材料行业具有技术密集型、人才密集型、资金密集型等特征，在产品开发、设备引进、核心人才引进及日常经营等方面均需要强有力的资金支持与可靠的融资能力保障，资金实力对公司发展的重要性日益凸显。目前公司融资渠道较为单一，在一定程度上限制了公司进一步发展的速度。

（2）整体规模与行业巨头尚有差距

公司通过不断探索创新，在电子胶粘剂领域积累了技术工艺及产品配方，但与汉高、陶氏化学、3M 等世界级巨头相比，公司涉足该领域时间较短，在收入规模、产能规模、资金实力、整体技术积累、产品丰富程度等方面仍存在一定差距，受宏观经济和下游行业波动影响相对较大，抗风险能力相对较弱。

三、公司销售情况和主要客户

（一）主要产品的产能、产量及销量

报告期内，公司产能、产量、销量、产能利用率及产销率情况如下表所示：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
产能（吨）（A）	1,218.87	1,027.67	564.71
产量（吨）（B）	583.72	1,038.44	545.73
自产产品销量（吨）（C）	546.71	959.74	491.86
产能利用率（=B/A）	47.89%	101.05%	96.64%
自产产品产销率（=C/B）	93.66%	92.42%	90.13%

2025 年，公司产能利用率为 47.89%，较前两年下降，主要系公司当年停止与部分用胶量较大的新能源领域客户合作，并同步停止生产相关客户胶粘剂产品，导致当期产量及产能利用率下降。

公司下游客户订单需求存在季节性波动，且产品具有品类多、定制化程度高、批量小等特点，不同化学体系产品难以混用生产设备，保留适当产能空间有利于公司兼顾产品质量控制、生产安全及客户订单响应。公司将结合客户导入进度、订单结构和新增产能释放节奏安排生产排期，保持对不同化学体系和多品类订单的响应能力。

报告期内，公司自产产品产销率分别为 90.13%、92.42%和 93.66%，持续保持较高水平，销售消化情况良好。

（二）主要销售及单价情况

报告期内，主要销售构成及产品单价情况参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“（二）营业收入分析”。

（三）主要客户情况

报告期内，公司向前五大客户销售金额及占各期营业收入的比例情况如下：

单位：万元

期间	排名	客户名称	主要应用领域	销售金额	占比
2025 年度	1	立讯精密	智能终端	6,237.45	13.62%
	2	东山精密	智能终端	6,222.93	13.59%

期间	排名	客户名称	主要应用领域	销售金额	占比
	3	鹏鼎控股	智能终端	5,546.15	12.11%
	4	Sanmina	新能源	3,847.11	8.40%
	5	安费诺	智能终端	3,457.11	7.55%
	前五大客户合计			**25,310.75**	**55.28%**
2024 年度	1	东山精密	智能终端	6,140.90	15.95%
	2	立讯精密	智能终端	4,349.23	11.30%
	3	鹏鼎控股	智能终端	4,076.37	10.59%
	4	安费诺	智能终端	3,062.51	7.96%
	5	深圳市米麒科技有限公司	智能终端	2,179.80	5.66%
	前五大客户合计			**19,808.81**	**51.47%**
2023 年度	1	东山精密	智能终端	5,635.38	16.04%
	2	鹏鼎控股	智能终端	4,243.36	12.08%
	3	旗胜电子	新能源	3,727.02	10.61%
	4	立讯精密	智能终端	2,473.69	7.04%
	5	安费诺	智能终端	2,137.88	6.08%
	前五大客户合计			**18,217.34**	**51.84%**

注：上表中客户名称均系包含受其同一实际控制人控制企业的合并计算口径数据，其中：
1、东山精密包含发行人向苏州维信电子有限公司、盐城维信电子有限公司、超维微电子（盐城）有限公司、珠海斗门超毅实业有限公司的销售，下同；
2、立讯精密包含发行人向江西立讯智造有限公司、昆山联滔电子有限公司、立芯精密智造（昆山）有限公司、立讯电子科技（昆山）有限公司、立讯精密有限公司、立讯精密组件（苏州）有限公司、立讯智造（浙江）有限公司、立讯智造电子服务（昆山）有限公司的销售，下同；
3、鹏鼎控股包含发行人向宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司、鹏鼎控股（深圳）股份有限公司、鹏鼎科技股份有限公司南科分公司、庆鼎精密电子（淮安）有限公司的销售，下同；
4、安费诺包含发行人向 Amphenol Intercon Systems, Inc.、安费诺永亿（海盐）通讯电子有限公司、上海安费诺永亿通讯电子有限公司的销售，下同；
5、旗胜电子包含发行人向 NIPPON MEKTRON LTD.、MEKTEC CORPORATION、苏州紫翔电子科技有限公司、珠海紫翔电子科技有限公司的销售，下同。

报告期内，公司向前五名客户的销售额占营业收入的比例分别为 51.84%、51.47%及 55.28%，公司不存在向单个客户的销售比例超过当期销售总额 50%的情形。公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事会取消前监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员与以上主要客户不存在关联关系。

四、公司采购情况和主要供应商

（一）主要采购及单价情况

1、主要采购情况

报告期内，公司采购物料主要包括电子胶粘剂生产所需原材料、辅助材料、电子胶粘剂成品、设备及零配件等，具体情况如下：

单位：万元

物料类型	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	5,082.28	45.83%	4,848.39	43.39%	4,698.66	40.67%
辅助材料	1,637.57	14.77%	1,499.85	13.42%	1,246.39	10.79%
电子胶粘剂成品	904.39	8.15%	1,705.47	15.26%	4,159.79	36.00%
设备及零部件	2,895.85	26.11%	2,524.71	22.59%	842.47	7.29%
其他物料	570.03	5.14%	596.2	5.34%	606.07	5.25%
合计	**11,090.12**	**100.00%**	**11,174.63**	**100.00%**	**11,553.38**	**100.00%**

注：上表为公司采购发生额口径，主要用于反映公司采购物料构成情况。其中，对于公司按照净额法确认收入的贸易业务而采购的物料（电子胶粘剂成品、设备及零部件等），相关采购金额不作为存货和营业成本列示。因此，上表采购发生额与财务报表营业成本口径存在差异。下表主要供应商的采购金额口径与此一致。

2、主要原材料采购情况

上表所列采购发生额中，原材料主要用于公司自产电子胶粘剂产品生产。报告期内，公司采购的主要原材料包括环氧树脂、镍包石墨粉、丙烯酸树脂、有机硅树脂、封装用球形二氧化硅、球形氧化铝、聚氨酯树脂等，具体情况如下：

单位：万元

原材料类型	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
环氧树脂	916.03	18.02%	760.85	15.69%	820.38	17.46%
镍包石墨粉	680.51	13.39%	551.98	11.38%	493.14	10.50%
丙烯酸树脂	569.83	11.21%	498.21	10.28%	396.73	8.44%
有机硅树脂	407.89	8.03%	706.18	14.57%	497.56	10.59%
封装用球形二氧化硅	359.18	7.07%	371.94	7.67%	676.79	14.40%
球形氧化铝	266.37	5.24%	269.17	5.55%	287.35	6.12%
聚氨酯树脂	258.30	5.08%	149.49	3.08%	141.53	3.01%
其他原材料	1,624.17	31.96%	1,540.58	31.78%	1,385.18	29.48%

原材料类型	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	5,082.28	100.00%	4,848.39	100.00%	4,698.66	100.00%

3、主要原材料单价及变动情况

报告期内，公司主要原材料单价及变动情况如下：

单位：元/KG

原材料类型	2025 年度	2024 年度	2023 年度
环氧树脂	286.03	239.76	213.62
丙烯酸树脂	198.88	194.69	192.85
镍包石墨粉	292.94	295.65	296.18
有机硅树脂	38.27	21.53	29.09
封装用球形二氧化硅	804.43	828.17	897.83
球形氧化铝	44.89	42.82	46.23
聚氨酯树脂	41.25	41.95	41.95

报告期内，公司采购丙烯酸树脂、镍包石墨粉、封装用球形二氧化硅、球形氧化铝、聚氨酯树脂等均价相对稳定，公司采购环氧树脂、有机硅树脂等产品均价波动主要系各期采购不同性能特性原材料的占比结构差异。报告期内，公司主要原材料单价不存在重大波动。

（二）主要能源采购情况

公司生产经营过程中使用的能源主要为电力。报告期内，公司电力采购情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
电费（万元）	708.94	769.46	453.73
用电量（万度）	937.34	889.22	482.75
电费均价（元/度）	0.76	0.87	0.94

报告期内，公司电费均价逐年下降，主要系公司报告期内持续优化生产工艺以及规模效应显现所致。整体而言，公司电力采购金额较小，公司经营业绩受电力价格变动影响较小。

（三）主要供应商情况

报告期内，公司向前五大物料供应商的采购额及占当期物料采购总额的比例

情况如下：

单位：万元

期间	排名	供应商名称	主要采购内容	采购金额	占比
2025年度	1	埃赛力达	设备及零配件	1,343.11	11.87%
	2	苏州华旭自动化设备有限公司	设备及零配件	946.02	8.36%
	3	广州亿菲迪电子科技有限公司	辅助材料	880.97	7.79%
	4	洛德	电子胶粘剂	796.06	7.04%
	5	重庆新福佰科技有限公司	镍包石墨粉	640.82	5.66%
	前五大供应商合计			**4,606.98**	**40.72%**
2024年度	1	洛德	电子胶粘剂	1,654.47	14.25%
	2	埃赛力达	设备及零配件	1,291.73	11.13%
	3	广州亿菲迪电子科技有限公司	辅助材料	808.14	6.96%
	4	昆山鸿仕达智能科技股份有限公司	设备及零配件	651.09	5.61%
	5	重庆新福佰科技有限公司	镍包石墨粉	509.92	4.39%
	前五大供应商合计			**4,915.35**	**42.34%**
2023年度	1	洛德	电子胶粘剂	2,686.96	22.77%
	2	蓝浦新材料科技（南通）有限公司	电子胶粘剂	1,198.16	10.15%
	3	广州亿菲迪电子科技有限公司	辅助材料	661.98	5.61%
	4	埃赛力达	设备及零配件	518.14	4.39%
	5	北京福思深德贸易有限公司	封装用球形二氧化硅	513.99	4.36%
	前五大供应商合计			**5,579.23**	**47.28%**

注：上表中供应商名称均系包含受其同一实际控制人控制企业的合并计算口径数据，其中：
1、北京福思深德贸易有限公司包含发行人向北京福德天勤商贸有限公司、北京福思深德贸易有限公司的采购，下同；
2、洛德包含发行人向洛德国际贸易（上海）有限公司、Lord Corporation 的采购，下同；
3、埃赛力达包含发行人向贺利氏（沈阳）特种光源有限公司、埃赛力达（沈阳）特种光源有限公司的采购。

报告期内，公司向前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例为 47.28%、42.34%及 40.72%，报告期内前五大供应商集中度呈持续下降趋势，主要系公司业务规模不断扩大和业务类型逐渐丰富。报告期内，公司不存在单一供应商采购占比超过 50%或严重依赖于少数供应商的情况，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事会取消前监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员与以上主要供应商不存在关联关系。

五、公司主要固定资产、无形资产及经营性资产情况

（一）主要固定资产

公司主要固定资产为房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他等。截至 2025 年 12 月 31 日，公司固定资产的具体情况如下：

单位：万元

固定资产	账面原值	累计折旧	账面价值	成新率
房屋及建筑物	27,365.26	2,294.57	25,070.69	91.62%
机器设备	13,207.40	4,543.53	8,663.87	65.60%
运输设备	355.99	255.07	100.92	28.35%
电子设备及其他	1,736.09	1,027.67	708.41	40.81%
合计	**42,664.74**	**8,120.84**	**34,543.90**	**80.97%**

1、主要机器设备

截至 2025 年 12 月 31 日，公司主要机器设备及成新情况如下：

单位：台/套、万元

设备类型	数量	资产原值	资产净值	成新率
异方性导电胶膜涂布机	6	1,899.21	1,703.75	89.71%
涂布复合机	1	823.01	757.85	92.08%
三辊研磨机	4	690.27	575.51	83.38%
高速分散搅拌机	6	484.73	346.58	71.50%
New Ross Power Mix Model PDDM-4	3	471.95	412.29	87.36%
28000m³/h 风量蓄热氧化 RTO 设备	2	465.49	428.63	92.08%
异方性导电胶膜切割机	2	440.54	402.18	91.29%
材料试验机	3	411.50	229.07	55.67%
双行星搅拌机	6	399.78	285.84	71.50%
单锥干燥机	6	371.68	265.76	71.50%
动态热机械分析仪	6	350.44	237.45	67.76%
十工位自动轮转模切机	2	336.28	320.31	95.25%
Model 9440 Vertical Impact System	2	299.44	260.91	87.13%
ROSS MODEL PDDM-10 MIXER	1	261.59	255.37	97.63%
真空捏合机	4	258.23	217.33	84.16%
徕卡三离子束研磨仪	3	257.52	228.98	88.92%

设备类型	数量	资产原值	资产净值	成新率
ACF 邦定机	3	247.46	223.95	90.50%
热熔胶机	3	238.94	170.84	71.50%
奥林巴斯 3D 激光测量显微镜	3	229.16	200.13	87.33%
气相色谱质谱联用仪	3	224.60	110.80	49.33%
耐压测试设备	3	220.62	136.78	62.00%
热动态机械分析仪	3	212.39	131.68	62.00%
行星高速搅拌机	3	211.86	168.25	79.42%
微焦点 X 射线检查装置	3	209.73	120.08	57.25%
三辊研磨机	3	204.42	84.67	41.42%
压力脱泡机	3	204.42	107.32	52.50%
高级旋转流变仪	3	171.24	149.55	87.33%
旋转流变仪	3	171.24	84.47	49.33%
双行星搅拌器	3	171.03	110.10	64.38%
200L 反应釜	3	167.26	98.41	58.84%
岛津红外显微镜	3	166.99	148.48	88.92%
流变仪	3	163.28	127.09	77.83%
视觉点胶机 SJ441CCD	3	152.26	108.90	71.52%
热常数分析仪	3	151.33	99.82	65.96%
柴油发电机组	2	151.01	119.93	79.42%
Discovery 动态热机械分析仪	2	146.90	116.66	79.42%
水蒸气透过率测试仪	2	127.43	105.24	82.58%
薄膜高速检测设备	2	120.35	114.64	95.25%
多阀点胶机（Multi-valve dispensing machine）	2	115.41	107.25	92.93%
100L 双行星分散机	2	110.44	105.20	95.25%
总计	**123**	**12,511.45**	**9,978.05**	**79.75%**

2、房屋建筑物

截至本招股说明书签署日，公司拥有的房屋建筑物情况如下：

（1）自有房屋

序号	权利人	坐落	不动产权证号	建筑面积（㎡）	用途	土地终止日期
1	德聚技术	东莞市石排镇向沙路石排段 14 号（东	粤（2023）东莞不动产权第 0173800	6,829.95	工业	2055.4.1

序号	权利人	坐落	不动产权证号	建筑面积（㎡）	用途	土地终止日期
		莞市德聚胶接技术有限公司厂房 A）	号			
2	深圳美科泰	福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）A 座 906	粤（2021）深圳市不动产权第 0191673 号	349.81	办公	2052.9.4
3	韩国德聚	京畿道光明市所下洞 1344 号光明 G TOWER，13 楼第 A1315 号	1349-2022-001376	56.61	办公	永久
4	韩国德聚	京畿道光明市所下洞 1344 号光明 G TOWER，13 楼第 A1316 号	1349-2022-001377	56.61	办公	永久
5	上海锐朗	松江区三浜路 261_3 号	沪（2026）松字不动产权第 000574 号	2,731.17	工业	2064.3.2
6	南通德聚半导体	新兴东路 1 号久钰金谷产业园 9 幢 101 室	苏（2023）南通开发区不动产权第 0020238 号	2,431.31	工业	2071.5.10
7	南通德聚半导体	新兴东路 1 号久钰金谷产业园 9 幢 102 室	苏（2023）南通开发区不动产权第 0020239 号	2,509.88	工业	2071.5.10
8	德聚技术	东莞市石排镇向沙路石排段 14 号德聚二期工程增资扩产项目 2 号厂房	粤（2024）东莞不动产权第 0234578 号	18,479.19	工业	2055.4.1
9	德聚技术	东莞市石排镇向沙路石排段 14 号德聚二期工程增资扩产项目 3 号厂房	粤（2024）东莞不动产权第 0230364 号	11,554.27	工业	2055.4.1
10	德聚技术	东莞市石排镇向沙路石排段 14 号德聚二期工程增资扩产项目 4 号宿舍	粤（2024）东莞不动产权第 0230492 号	6,709.91	集体宿舍	2055.4.1
11	德聚技术	东莞市石排镇向沙路石排段 14 号德聚二期工程增资扩产项目 5 号地下室	粤（2024）东莞不动产权第 0232721 号	6,499.94	车库/车位	2055.4.1

注 1：上述第 1 项、第 8-11 项房产被抵押给中国建设银行股份有限公司东莞市分行，抵押方式为最高额抵押，抵押担保责任的最高限额为 16,848.1728 万元，抵押担保对应的借款期限为 2023 年 7 月 18 日至 2034 年 12 月 31 日。

注 2：上述第 5 项房产，系按份共有，其中，上海锐朗持有 92.92%份额、上海国际中小企业城发展有限公司持有 7.08%份额。

（2）租赁房屋

序号	承租方	出租方	房屋地址	面积（㎡）	承租期限

序号	承租方	出租方	房屋地址	面积（㎡）	承租期限
1	德聚技术	青岛锦汇蓝波湾实业有限公司	青岛高新区锦汇路 1 号蓝湾创业园项目 A5 号楼	6,626.90	2022.7.1-2028.3.31
2	深圳美科泰	深圳市宝安华丰实业有限公司	深圳市宝安区西乡街道劳动社区西乡大道 300 号华丰金源商务大厦 A 座二楼 210、211 号	216.00	2025.8.1-2026.7.31
3	深圳美科泰	深圳市宝安华丰实业有限公司	深圳市宝安区西乡街道劳动社区西乡大道 300 号华丰金源商务大厦 A 座一楼 109 号	106.65	2025.8.1-2026.7.31
4	深圳美科泰	王延鲲	江苏省苏州市吴江区松陵镇开平路 3333 号德博商务大厦 A#1604、1605	410.19	2024.6.1-2027.5.31
5	苏州美科泰	苏州高铁新城车联网技术有限公司	苏州市相城区高铁新城西公田路 69 号的 AI＋交通产业园 5 幢一层	3,459.96	2025.9.1-2028.8.31
6	青岛德聚	青岛锦汇蓝波湾实业有限公司	青岛高新区蓝湾创业园 D2（103、203、303、403）、D3 号楼（103、203、303、403）	6,974.78	2023.8.22-2028.3.31
7	青岛德聚	青岛四季春不动产有限公司	青岛高新区锦汇路以北 D5-707 号楼	58.87	2026.1.1-2026.12.31
8	青岛德聚	青岛四季春不动产有限公司	青岛高新区锦汇路以北 F5-1-301 号楼	148.59	2026.1.1-2026.12.31
9	青岛德聚	青岛四季春不动产有限公司	青岛高新区锦汇路以北 D5-501 号楼	50.16	2026.1.1-2026.12.31
10	青岛德聚	程帅鹏	高新区和源路 206 号 615 户	63.48	2026.1.1-2026.12.31
11	青岛德聚	青岛四季春不动产有限公司	青岛高新区锦汇路以北，华东路以东，和源路以西，锦荣路以南 D5-1009 号楼	64.09	2026.1.1-2026.12.31
12	青岛德聚	青岛四季春不动产有限公司	青岛高新区锦汇路 1 号 F3-1-301 号楼	141.00	2025.7.1-2026.6.30
13	南通德聚半导体	南通经济技术开发区控股集团有限公司	四海家园人才公寓 31 号楼 3 层 302 室	80.00	2025.8.15-2026.8.14
14	南通德聚半导体	南通经济技术开发区控股集团有限公司	四海家园职工宿舍 9 号楼 6 层 602 室	40.00	2025.8.16-2026.8.15
15	南通德聚半导体	南通经济技术开发区控股集团有限公司	四海家园职工宿舍 5 号楼 1 层 116 室	40.00	2025.12.16-2026.12.15
16	南通德聚半导体	南通经济技术开发区控股集团有限公司	四海家园职工宿舍 19 号楼 6 层 615 室、617 室	80.00	2026.1.15-2027.1.14

序号	承租方	出租方	房屋地址	面积（㎡）	承租期限
17	上海锐朗	上海国际中小企业发展有限公司	松江区三浜路 261 号 3 幢	2,436.38	2023.12.15-2026.12.14
18	如东德聚	如东鼎洋建设投资有限公司	如东沿海经济开发区节能环保产业孵化器 5#厂房	3,090.42	2023.7.1-2032.12.31
19	如东德聚	平阳万睿商业管理有限公司	南通（如东）万洋众创城 A 地块 7 幢 403，A 地块 7 幢 405，A 地块 7 幢 407，A 地块 7 幢 430，A 地块 7 幢 428	149.96	2026.4.1-2027.3.31
20	如东德聚	平阳万睿商业管理有限公司	南通（如东）万洋众创城 A 地块 7 幢 707	28.37	2026.1.1-2027.1.31
21	欧洲德聚	Johannes Staudt	Im Eichwald 1 in 65599 Dornburg-Frickhofen	约 472 ㎡	2022.7.1-2027.6.30
22	北美德聚	ICON OWNER POOL 1 SF BUSINESS PARKS, LLC	3066 Scott Boulevard, Santa Clara, California 95054	约 1,780 平方英尺	2022.9.1-2027.10.31
23	北美德聚	ICON OWNER POOL 1 SF BUSINESS PARKS, LLC	3056-A Scott Boulevard, Santa Clara, CA 95054	约 898 平方英尺	2023.11.15-2027.10.31
24	北美德聚	BRE Jupiter C2 West CA Owner,LP	3058 Scott Blvd., Suite D, Santa Clara, CA 95054	约 820 平方英尺	2024.12.16-2027.10.31
25	北美德聚	Wei Hu	3001 Kaiser Dr. Unit A, Santa Clara, CA 95051	92	2025.9.1-2026.9.1
26	美科泰贸易	99COMMONS MANAGEMENT SERVICES LIMITED	99 Pui To Road, Tuen Mun, New Territories, Hong Kong	54	2025.4.25-2027.4.24
27	美科泰贸易	Công ty TNHH TMDV Thảo Nguyên Xanh	北宁省北宁市京北坊李太祖路 33 号北宁电信大楼 8 层 8.4 室	51	2026.5.6-2027.5.5
28	马来西亚德聚	KOO TIEK REALTY SDN. BHD.	25 & 27 LORONG SELATAN 1, KAWASAN PERINDUSTRIAN VALDOR, SUNGAI BAKAP, 14200 PULAU PINANG	1,401	2025.11.1-2028.10.31

注：备注：上述第 3、4 项房产系深圳市农村城市化过程中的历史遗留违法建筑，因而未能办理产权证书。上述第 5 项租赁房屋系产权证书尚在办理中的新建园区房产，因产权证书暂无办理完成从而未能办理租赁备案手续。上述第 1、6 项房产系工业用房，当地暂无法办理租赁备案手续。上述第 18 项房产出租方暂未协助办理租赁备案手续。上述第 8-10、12、14-17、19-20 项房产系发行人子公司员工宿舍，出租方未向发行人提供相关产权证书或协助办理租赁备案手续。

（二）主要无形资产

1、土地使用权

截至本招股说明书签署日，公司拥有的土地使用权情况如下：

权利人	坐落	不动产权证号	使用权面积（㎡）	用途	土地终止日期
德聚技术	东莞市石排镇向沙路石排段 14 号	粤（2023）东莞不动产权第 0173800 号、粤(2024)东莞不动产权第 0230364 号、粤(2024)东莞不动产权第 0234578 号、粤(2024)东莞不动产权第 0232721 号、粤(2024)东莞不动产权第 0230492 号	12,441.32	工业用地	2055.4.1
德聚技术	东莞市石排镇水贝村	粤（2023）东莞不动产权第 0137590 号	14,578.97	工业用地	2073.5.17
江苏德聚	如东沿海经济开发区洋兴路东侧、向海大道南侧地块	苏（2024）如东县不动产权第 0007802 号	69,196.00	工业用地	2054.5.26

注 1：上述坐落于东莞市石排镇向沙路石排段 14 号的土地使用权随其地上房屋建筑物一同抵押给中国建设银行股份有限公司东莞市分行，具体参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“五、公司主要固定资产、无形资产及经营性资产情况”之“（一）主要固定资产”之“2、房屋建筑物”。

注 2：上述坐落于东莞市石排镇水贝村的土地使用权存在抵押情形，抵押权人为中国建设银行股份有限公司东莞市分行、中信银行股份有限公司东莞分行，抵押方式为最高额抵押，抵押担保责任的最高限额为 1,895.2661 万元，抵押担保对应的借款期限为 2024 年 11 月 15 日至 2035 年 11 月 24 日。

2、注册商标

截至本招股说明书签署日，公司共拥有注册商标 28 项，其中境内注册商标 24 项，境外注册商标 4 项，该等注册商标的权属清晰，不存在质押或许可使用情况。公司已取得的注册商标如下表所示：

序号	商标名称	注册号	注册地	国际分类	有效期限	取得方式	他项权利	商标权人
1	CollTech	19662263	中国	35	2017.6.7-2027.6.6	继受取得	无	德聚技术
2	CollTech	19662246	中国	16	2017.6.7-2027.6.6	继受取得	无	德聚技术
3	CollTech	19661987	中国	7	2017.6.7-2027.6.6	继受取得	无	德聚技术
4	CollTech	19662344	中国	19	2017.8.28-2027.8.27	继受取得	无	德聚技术
5	CollTech	19661945	中国	5	2017.8.28-2027.8	继受	无	德聚

序号	商标名称	注册号	注册地	国际分类	有效期限	取得方式	他项权利	商标权人
					.27	取得		技术
6	CollTech	19661860	中国	3	2017.8.28-2027.8.27	继受取得	无	德聚技术
7	CollTech	19661634	中国	1	2017.8.28-2027.8.27	继受取得	无	德聚技术
8	CollTech	77088612	中国	17	2025.10.7-2035.10.6	原始取得	无	德聚技术
9	CollTech	302020100223	德国	1、2、16	2020.1.8-2030.1.7	原始取得	无	德聚技术
10	CollTech	6106976	美国	1	2020.7.21-2030.7.20	原始取得	无	德聚技术
11	CollTech	40-1691424	韩国	1	2021.2.8-2031.2.8	原始取得	无	德聚技术
12	CollTech	02073743	中国台湾	1	2020.8.1-2030.7.31	原始取得	无	德聚技术
13	德聚	43885815	中国	16	2021.4.28-2031.4.27	原始取得	无	德聚技术
14	德聚	61980348	中国	1	2022.7.28-2032.7.27	原始取得	无	德聚技术
15	德聚技术	77081275	中国	16	2024.8.14-2034.8.13	原始取得	无	德聚技术
16	德聚技术	77083354	中国	17	2024.10.21-2034.10.20	原始取得	无	德聚技术
17	德聚技术	77081237	中国	3	2024.10.21-2034.10.20	原始取得	无	德聚技术
18	德聚技术	77085510	中国	7	2024.10.28-2034.10.27	原始取得	无	德聚技术
19	德聚技术	77095434	中国	1	2024.10.28-2034.10.27	原始取得	无	德聚技术
20	RELAN	10310108	中国	17	2023.2.21-2033.2.20	原始取得	无	上海锐朗
21	RELAN	10310036	中国	1	2023.2.21-2033.2.20	原始取得	无	上海锐朗
22	诺贝诺	13226947	中国	1	2025.1.21-2035.1.20	继受取得	无	德聚技术
23	NOBELPLA	13226867	中国	1	2025.1.7-2035.1.6	继受取得	无	德聚技术
24	MCOTI	81694403	中国	1	2025.5.28-2035.5.27	原始取得	无	深圳美科泰
25	美科泰	78468620	中国	7	2024.10.28-2034.10.27	原始取得	无	深圳美科泰

序号	商标名称	注册号	注册地	国际分类	有效期限	取得方式	他项权利	商标权人
26	MCOTI	78461018	中国	7	2025.3.28-2035.3.27	原始取得	无	深圳美科泰
27	美科泰	78473264	中国	1	2024.10.28-2034.10.27	原始取得	无	深圳美科泰
28	MCOTI	78455666	中国	1	2025.11.28-2035.11.27	原始取得	无	深圳美科泰

注：上述第 1-7、22、23 项商标均系从伯乐通无偿受让。

3、专利权

截至本招股说明书签署日，公司已取得境内授权专利 114 项，其中，发明专利 65 项，实用新型专利 49 项，该等专利权的权属清晰，不存在权属纠纷和法律风险，不存在抵押、质押等权利瑕疵或限制的情形。公司已取得的专利权如下表所示：

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类型	申请日	授权公告日	取得方式
1	一种耐高温柔性单组份环氧密封胶黏剂及其制备方法	ZL202010003070.8	德聚技术	发明	2020.1.2	2020.10.27	原始取得
2	一种紫外光和湿气双重固化聚氨酯热熔胶及其制备方法	ZL201911420848.9	德聚技术	发明	2019.12.31	2020.12.1	原始取得
3	一种光/热双固化低介电性能胶黏剂及其制备方法	ZL202010097655.0	德聚技术、青岛德聚	发明	2020.2.17	2021.1.19	原始取得
4	一种丙烯酸树脂组合物	ZL201911420221.3	德聚技术	发明	2019.12.31	2021.4.16	原始取得
5	一种改性端硅烷聚醚密封胶及其制备方法	ZL202110156574.8	德聚技术	发明	2021.2.4	2021.9.24	原始取得
6	一种改性丙烯酸酯低聚物及一种 UV、湿气双重固化压敏胶	ZL202110157365.5	德聚技术	发明	2021.2.4	2021.10.12	原始取得
7	一种非锡催化硅烷改性聚醚密封胶及其制备方法	ZL202110157539.8	德聚技术	发明	2021.2.4	2021.11.23	原始取得
8	一种聚氨酯胶黏剂用附着力促进剂及聚氨酯胶黏剂	ZL202110156572.9	德聚技术	发明	2021.2.4	2021.11.23	原始取得
9	一种湿气固化型聚氨酯热熔胶	ZL202110157562.7	德聚技术	发明	2021.2.4	2021.11.23	原始取得

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类型	申请日	授权公告日	取得方式
10	一种本征阻燃型丙烯酸酯类低聚物以及丙烯酸酯结构胶	ZL202110166475.8	德聚技术	发明	2021.2.4	2021.11.23	原始取得
11	一种耐高温电磁屏蔽涂料及其应用	ZL202110269248.8	德聚技术	发明	2021.3.12	2021.11.23	原始取得
12	一种低吸水率的双组份热固环氧胶及其制备方法和用途	ZL202110284057.9	德聚技术	发明	2021.3.17	2021.11.23	原始取得
13	一种热固环氧胶及其制备方法	ZL202110284297.9	德聚技术	发明	2021.3.17	2021.11.23	原始取得
14	一种环氧电磁屏蔽涂料及其制备方法	ZL202110267675.2	德聚技术	发明	2021.3.12	2022.2.15	原始取得
15	一种耐湿热环氧导电胶、制备方法及其应用	ZL202210746332.9	德聚技术	发明	2022.6.29	2023.1.10	原始取得
16	一种低温快速固化耐湿热环氧粘结剂及其制备方法和应用	ZL202210746391.6	德聚技术	发明	2022.6.29	2023.4.25	原始取得
17	一种用于晶圆级芯片尺寸封装的底部填充胶组合物及其制备方法	ZL202210746333.3	德聚技术	发明	2022.6.29	2023.4.25	原始取得
18	一种耐冷热冲击阻燃型双组分聚氨酯结构胶及其制备方法	ZL202211069063.3	德聚技术	发明	2022.8.31	2023.4.25	原始取得
19	一种耐高低温单组分半导体用导电胶及其制备方法	ZL202210935121.X	德聚技术	发明	2022.8.5	2023.5.2	原始取得
20	一种用于电子元器件的 UV 湿气双重固化的胶粘剂	ZL202211242943.6	德聚技术	发明	2022.10.11	2023.5.9	原始取得
21	一种适用于电池封装的双组分环氧结构胶及其制备方法	ZL202211051551.1	德聚技术	发明	2022.8.31	2023.5.12	原始取得
22	一种耐高低温导热硅脂、制备方法及其应用	ZL202211061259.8	德聚技术	发明	2022.8.31	2023.5.19	原始取得
23	一种低吸水率的丙烯酸胶黏剂及其制备方法	ZL202211242278.0	德聚技术	发明	2022.10.11	2023.5.19	原始取得
24	一种抗冲击 UV 固化围堰胶及其制备方法	ZL202211242271.9	德聚技术	发明	2022.10.11	2023.5.19	原始取得
25	一种 UV 固化围堰胶及其制备方法	ZL202211242300.1	德聚技术	发明	2022.10.11	2023.7.4	原始取得
26	一种耐油酸 UV-湿气双重固化胶粘剂	ZL202211336181.6	德聚技术	发明	2022.10.28	2023.7.4	原始取得
27	一种抗迁移环氧导电银胶及其制备方法	ZL202211337428.6	德聚技术	发明	2022.10.28	2023.8.15	原始取得

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类型	申请日	授权公告日	取得方式
28	一种低水汽透过率湿气固化型聚氨酯热熔胶	ZL202310204493.X	德聚技术	发明	2023.3.6	2023.10.13	原始取得
29	一种密封防水的单组份硅胶及其制备方法	ZL202310170601.6	德聚技术	发明	2023.2.27	2023.10.27	原始取得
30	一种适用于摄像头模组的 UV 粘结剂及其制备方法	ZL202310235120.9	德聚技术	发明	2023.3.13	2023.11.17	原始取得
31	一种多粘接功能的硅烷改性聚醚密封胶及其制备方法	ZL202310170687.2	德聚技术	发明	2023.2.27	2023.12.1	原始取得
32	一种高流淌性低热膨胀系数的底填胶水及其制备方法	ZL202211575925.X	德聚技术	发明	2022.12.9	2023.12.5	原始取得
33	一种低密度阻燃型导热聚氨酯结构胶及其制备方法	ZL202211575966.9	德聚技术	发明	2022.12.9	2023.12.5	原始取得
34	一种高导热、低粘度环氧灌封胶及其制备方法	ZL202311310413.5	德聚技术	发明	2023.10.11	2025.8.15	原始取得
35	一种超支化环氧树脂的制备方法以及含该超支化环氧树脂的灌封胶	ZL202311194158.2	德聚技术	发明	2023.9.15	2025.5.6	原始取得
36	一种用于电子精密器件的光热双重固化胶粘剂及其制备方法	ZL202311394994.5	德聚技术	发明	2023.10.26	2024.12.3	原始取得
37	一种耐湿热聚氨酯导热结构胶及其制备方法	ZL202310563912.9	德聚技术	发明	2023.5.18	2024.11.15	原始取得
38	一种用于摄像头模组的光热双重固化胶粘剂及其制备方法	ZL202311194066.4	德聚技术	发明	2023.9.15	2024.10.18	原始取得
39	一种适用于智能汽车的底填胶及其制备方法	ZL202211621219.4	德聚技术	发明	2022.12.16	2024.1.23	原始取得
40	一种热油加热滚喷设备	ZL202010506219.4	深圳美科泰	发明	2020.6.5	2021.3.23	原始取得
41	一种半固化环氧胶膜及其制备方法	ZL202010632433.4	青岛德聚	发明	2020.7.2	2022.4.8	原始取得
42	一种不可逆热敏变色胶黏剂及其制备方法	ZL202111317258.0	青岛德聚	发明	2021.11.9	2022.6.3	原始取得
43	一种耐高温-阻燃型环氧粘合剂、制备方法及应用	ZL202210542710.1	青岛德聚	发明	2022.5.18	2023.1.10	原始取得
44	一种柔性环氧灌封胶及其制备方法和应用	ZL202210542644.8	青岛德聚	发明	2022.5.18	2023.3.3	原始取得

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类型	申请日	授权公告日	取得方式
45	一种抗震、抗跌落微型扬声器用环氧粘结剂及其制备方法和应用	ZL202210543081.4	青岛德聚	发明	2022.5.18	2023.4.28	原始取得
46	一种高透光率、耐黄变的环氧胶膜及其制备方法	ZL202411659253.X	青岛德聚	发明	2024.11.20	2025.11.11	原始取得
47	一种可逆热敏变色微胶囊及其制备方法	ZL202111317260.8	青岛德聚	发明	2021.11.9	2024.11.22	原始取得
48	一种用于柔性印制电路板粘结的光固化胶黏剂及其制备方法	ZL202410165002.X	青岛德聚	发明	2024.2.5	2024.10.11	原始取得
49	一种耐高温、抗变形芯片环氧胶膜及其制备方法	ZL202311007128.6	青岛德聚	发明	2023.8.11	2024.9.24	原始取得
50	一种低硬度点胶成型屏蔽导电胶及其制备方法和应用	ZL201110383570.X	上海锐朗	发明	2011.11.25	2013.12.4	原始取得
51	一种 PVDF-PAM 聚合物锂电池隔膜的制备方法	ZL201510171124.0	上海锐朗	发明	2015.4.10	2017.7.7	原始取得
52	一种线缆接头密封防水护套	ZL201410419485.8	上海锐朗	发明	2014.8.22	2017.10.10	继受取得
53	一种用于芯片封装材料的银粉填充体筛选方法	ZL202111068664.8	上海锐朗	发明	2021.9.13	2023.5.26	继受取得
54	一种 UV 光和热双重固化高气密性聚异丁烯胶及其制备方法	ZL202110441244.3	上海锐朗	发明	2021.4.23	2022.5.27	原始取得
55	一种适用于不同属性芯片封装材料的原料预处理工艺	ZL202111069101.0	上海锐朗	发明	2021.9.13	2023.6.6	继受取得
56	一种应用于大尺寸芯片粘接的导电胶及其制备方法	ZL202110980035.6	上海锐朗	发明	2021.8.25	2023.6.30	继受取得
57	一种易混合高舒适度硅橡胶口腔印模材料及制备方法	ZL202011013361.1	上海锐朗	发明	2020.9.24	2023.8.8	原始取得
58	一种低温半烧结导电导热胶及其制备方法	ZL202111411475.6	上海锐朗	发明	2021.11.25	2024.1.2	原始取得
59	一种可喷雾高粘接室温固化液体硅橡胶及其制备方法和应用	ZL202211680344.2	上海锐朗	发明	2022.12.26	2026.4.3	原始取得
60	一种耐高温环氧胶黏剂及其制备方法	ZL202110284056.4	南通德聚半导体	发明	2021.3.17	2021.10.12	继受取得
61	一种单组分半导体用导电胶及其制备方法	ZL202210746384.6	南通德聚半导体	发明	2022.6.29	2023.6.23	继受取得

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类型	申请日	授权公告日	取得方式
62	涂布机涂布导电球排列	ZL202410231838.5	南通德聚半导体	发明	2024.3.1	2024.4.30	原始取得
63	异向导电胶及使用该胶的异向导电胶薄膜连接件	ZL202410760824.2	南通德聚半导体	发明	2024.6.13	2024.10.29	原始取得
64	一种异方性导电胶膜粒子分布检测设备	ZL202511378154.9	南通德聚半导体	发明	2025.9.25	2026.5.19	原始取得
65	一种用于隔离PCB板的环氧胶膜及其制备方法	ZL202510865355.5	如东德聚	发明	2025.6.26	2026.3.17	原始取得
66	一种测量FPC与FPC粘接力的工装夹具	ZL201720041244.3	德聚技术	实用新型	2017.1.13	2017.7.21	原始取得
67	一种压料机过滤系统	ZL201720041245.8	德聚技术	实用新型	2017.1.13	2017.8.1	原始取得
68	一种防粉料扬尘分散设备	ZL201720041136.6	德聚技术	实用新型	2017.1.13	2017.8.4	原始取得
69	一种动力混合机搅拌装置	ZL201720041349.9	德聚技术	实用新型	2017.1.13	2017.8.11	原始取得
70	一种快速检测胶粘剂中微量水分的简易装置	ZL201720101197.7	德聚技术	实用新型	2017.1.24	2017.8.15	原始取得
71	一种活塞改进型点胶针筒	ZL201720820392.5	德聚技术	实用新型	2017.7.7	2018.3.2	原始取得
72	一种测量FPC与FPC粘接力的工装夹具	ZL202022428314.5	青岛德聚	实用新型	2020.10.28	2021.6.11	原始取得
73	一种测量FPC和FPC粘接力的工装夹具	ZL202022428792.6	青岛德聚	实用新型	2020.10.28	2021.6.11	原始取得
74	一种用于压料机的过滤装置	ZL202022431998.4	青岛德聚	实用新型	2020.10.28	2021.6.25	原始取得
75	搅拌充分的动力混合机	ZL202022431997.X	青岛德聚	实用新型	2020.10.28	2021.6.25	原始取得
76	粉料分散设备	ZL202022431996.5	青岛德聚	实用新型	2020.10.28	2021.6.25	原始取得
77	一种压料机使用的过滤装置	ZL202022428864.7	青岛德聚	实用新型	2020.10.28	2021.7.9	原始取得
78	一种粉料分散设备	ZL202022431999.9	青岛德聚	实用新型	2020.10.28	2021.7.9	原始取得
79	一种动力混合机	ZL202022428435.X	青岛德聚	实用新型	2020.10.28	2021.7.9	原始取得
80	一种点胶针筒	ZL202022429062.8	青岛德聚	实用新型	2020.10.28	2021.7.13	原始取得
81	点胶针筒	ZL202022428183.0	青岛德聚	实用新型	2020.10.28	2021.7.13	原始取得
82	一种注射式导电胶包装	ZL201721889539.2	上海锐朗	实用新型	2017.12.29	2018.9.18	原始取得
83	一种芯片导电胶固化烤箱排气设备	ZL201721888809.8	上海锐朗	实用新型	2017.12.29	2018.9.18	原始取得

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类型	申请日	授权公告日	取得方式
84	一种用于制作导电胶标准样条的模具	ZL201820319745.8	上海锐朗	实用新型	2018.3.8	2019.1.8	原始取得
85	垃圾袋与垃圾桶装套固定结构	ZL202021616172.9	上海锐朗	实用新型	2020.8.6	2021.4.23	原始取得
86	聚四氟乙烯搅拌桨固定组件	ZL202021615529.1	上海锐朗	实用新型	2020.8.6	2021.6.29	原始取得
87	一种导电硅橡胶加工检测用拉伸装置	ZL202022700128.2	上海锐朗	实用新型	2020.11.20	2021.6.29	原始取得
88	一种用于测试导电填料体积电阻率的装置	ZL202022452762.9	上海锐朗	实用新型	2020.10.29	2021.7.6	原始取得
89	一种导电硅橡胶样品原料储存装置	ZL202022706661.X	上海锐朗	实用新型	2020.11.20	2021.7.6	原始取得
90	一种导电硅橡胶制备用上料装置	ZL202022706659.2	上海锐朗	实用新型	2020.11.20	2021.7.16	原始取得
91	一种导电硅橡胶制备用原料干燥装置	ZL202022700201.6	上海锐朗	实用新型	2020.11.20	2021.8.13	原始取得
92	一种导电橡胶生产用原料搅拌设备	ZL202022706671.3	上海锐朗	实用新型	2020.11.20	2021.9.14	原始取得
93	一种用于芯片封装材料的导电导热性能检测设备	ZL202122206493.2	上海锐朗	实用新型	2021.9.13	2022.3.22	继受取得
94	一种芯片封装材料生产用三辊研磨设备	ZL202122212289.1	上海锐朗	实用新型	2021.9.14	2022.3.22	继受取得
95	一种芯片封装材料生产用均质搅拌设备	ZL202122212287.2	上海锐朗	实用新型	2021.9.14	2022.3.22	继受取得
96	一种用于存储点胶用液体硅橡胶的胶管	ZL202123165427.1	上海锐朗	实用新型	2021.12.16	2022.5.27	原始取得
97	一种覆有内外涂层的导电胶粒的测量工装	ZL202123182093.9	上海锐朗	实用新型	2021.12.17	2022.5.27	原始取得
98	一种阵列物料托盘的整体式翻转、传输机构	ZL202223130663.4	上海锐朗	实用新型	2022.11.24	2023.4.7	原始取得
99	一种实验室用的针筒灌装辅助工装	ZL202421906259.8	上海锐朗	实用新型	2024.8.8	2025.7.4	原始取得
100	一种用于安装胶管软塞的可更换式工装	ZL202420175284.7	上海锐朗	实用新型	2024.1.24	2025.2.7	原始取得
101	一种用于制备哑铃型和新月形试样的模具	ZL202323381020.1	上海锐朗	实用新型	2023.12.12	2024.11.1	原始取得
102	一种用于有机硅凝胶体积电阻率测试的治具	ZL202323381015.0	上海锐朗	实用新型	2023.12.12	2024.9.17	原始取得
103	一种用于超声喷涂涂层快速干燥的红外加热装置	ZL202423189137.4	苏州美科泰	实用新型	2024.12.23	2025.12.26	原始取得
104	一种具有热风加热装置的超声喷涂设备	ZL202423032918.2	苏州美科泰	实用新型	2024.12.9	2025.12.5	原始取得
105	一种快速成膜的超声喷涂设备	ZL202323101060.6	苏州美科泰	实用新型	2023.11.16	2024.7.23	原始取得

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类型	申请日	授权公告日	取得方式
106	一种曲面超声喷涂设备	ZL202323100918.7	苏州美科泰	实用新型	2023.11.16	2024.7.23	原始取得
107	卷盘	ZL202323067040.1	南通德聚半导体	实用新型	2023.11.14	2024.6.21	原始取得
108	胶带卷盘	ZL202322954821.6	南通德聚半导体	实用新型	2023.11.1	2024.7.2	原始取得
109	一种胶膜涂布厚度监控	ZL202323390601.1	南通德聚半导体	实用新型	2023.12.13	2024.7.23	原始取得
110	电池隔膜切割装置	ZL202323574465.1	南通德聚半导体	实用新型	2023.12.26	2024.8.6	原始取得
111	膜体分条切割器	ZL202323636684.8	南通德聚半导体	实用新型	2023.12.28	2024.10.29	原始取得
112	易断料带缓冲机构和收料装置	ZL202420945518.1	南通德聚半导体	实用新型	2024.4.30	2024.12.6	原始取得
113	胶膜涂布异物和排列监控	ZL202421279501.3	南通德聚半导体	实用新型	2024.6.6	2025.1.10	原始取得
114	多工位收卷装置的卷力同步检测机构	ZL202421724840.8	南通德聚半导体	实用新型	2024.7.22	2025.7.22	原始取得

注：上述第 52 项为上海锐朗自陈玲处继受取得；上述第 53、55、56、93、94、95 项专利为上海锐朗从其关联方苏州锐朗新材料有限公司继受取得，苏州锐朗新材料有限公司已于 2022 年 8 月注销；上述第 60、61 项专利为南通德聚半导体从德聚技术继受取得。

（三）主要生产经营资质

截至本招股说明书签署日，公司取得的业务经营资质证书如下：

1、高新技术企业证书

序号	持有人	证书名称	证书编号	有效期
1	德聚技术	高新技术企业证书	GR202444010004	2024 年 12 月至 2027 年 12 月
2	上海锐朗	高新技术企业证书	GR202431002149	2024 年 12 月至 2027 年 12 月
3	南通德聚半导体	高新技术企业证书	GR202432013749	2024 年 12 月至 2027 年 12 月

2、管理体系认证证书

序号	持有人	证书名称	技术标准	有效期	发证机关
1	德聚技术	职业健康安全管理体系认证证书	ISO 45001:2018	2025.9.23-2028.9.22	SGS United Kingdom Ltd
2	德聚技术	环境管理体系认证证书	ISO 14001:2015	2025.9.24-2028.9.23	SGS United Kingdom Ltd
3	德聚技术	知识产权管理体系认证证书	GB/T29490-2013	2023.8.4-2026.8.3	中审（深圳）认证有限公司
4	德聚技术	质量管理体系认证证书	ISO 9001:2015	2023.9.23-2026.9.22	SGS United Kingdom Ltd

序号	持有人	证书名称	技术标准	有效期	发证机关
5	德聚技术	有害物质过程控制管理体系认证证书	IECQ QC080000: 2017	2023.10.14-2026.10.13	SGS-CSTC Standards Technical Services Co. Ltd.
6	德聚技术	汽车行业质量管理体系认证证书	IATF16949:2016	2023.9.23-2026.9.22	SGS United Kingdom Ltd
7	德聚技术	实验室认可证书	ISO/IEC17025:2017	2025.5.26-2031.5.25	中国合格评定国家认可委员会
8	德聚技术	信息安全管理体系认证证书	IS0/IEC27001:2022	2024.12.18-2027.12.17	中正国际认证（深圳）有限公司
9	上海锐朗	汽车行业质量管理体系认证证书	IATF16949:2016	2025.11.10-2028.11.9	AENOR CONFIA S.A.U.
10	上海锐朗	质量管理体系认证证书	ISO 9001:2015	2025.11.10-2028.11.10	AENOR CONFIA S.A.U.
11	上海锐朗	环境管理体系认证证书	GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015	2023.11.09-2026.11.08	赛瑞认证有限公司
12	上海锐朗	职业健康安全管理体系认证证书	GB/T45001-2020 /ISO45001:2018	2023.11.09-2026.11.08	赛瑞认证有限公司
13	北美德聚	质量管理体系认证证书	ISO 9001:2015	2023.10.30-2026.10.29	PERRY JOHNSON REGISTRARS,INC.
14	南通德聚半导体	质量管理体系认证证书	ISO 9001:2015	2024.7.22-2027.7.21	SGS United Kingdom Ltd
15	南通德聚半导体	环境管理体系认证证书	ISO14001:2015	2024.7.22-2027.7.21	SGS United Kingdom Ltd
16	南通德聚半导体	职业健康安全管理体系认证证书	ISO45001:2018	2024.7.22-2027.7.21	SGS United Kingdom Ltd
17	青岛德聚	质量管理体系认证证书	ISO 9001:2015	2024.12.27-2027.12.26	SGS United Kingdom Ltd
18	青岛德聚	环境管理体系认证证书	ISO14001:2015	2024.12.27-2027.12.26	SGS United Kingdom Ltd
19	青岛德聚	职业健康安全管理体系认证证书	ISO45001:2018	2024.12.27-2027.12.26	SGS United Kingdom Ltd
20	如东德聚	质量管理体系认证证书	ISO 9001:2015	2025.5.16-2028.5.15	北京中鼎乾元认证有限公司
21	如东德聚	环境管理体系认证证书	ISO14001:2015	2025.5.16-2028.5.15	北京中鼎乾元认证有限公司
22	如东德聚	职业健康安全管理体系认证证书	ISO45001:2018	2025.5.16-2028.5.15	北京中鼎乾元认证有限公司
23	北美德聚	汽车行业质量管理体系认证证书	IATF16949:2016	2024.10.29-2027.10.28	PERRY JOHNSON REGISTRARS,INC.

3、对外贸易经营者备案登记表

序号	持有人	证书名称	证书编号	备案日期
1	德聚技术	对外贸易经营者备案登记表	04802480	2022 年 4 月 1 日
2	深圳美科泰	对外贸易经营者备案登记表	03073967	2016 年 11 月 8 日

序号	持有人	证书名称	证书编号	备案日期
3	苏州美科泰	对外贸易经营者备案登记表	04107164	2022 年 5 月 24 日
4	江苏德聚	对外贸易经营者备案登记表	04198832	2022 年 11 月 18 日
5	上海锐朗	对外贸易经营者备案登记表	04077133	2021 年 1 月 19 日
6	南通德聚半导体	对外贸易经营者备案登记表	04198571	2022 年 9 月 14 日

4、排污许可证/固定污染源排污登记回执

序号	持有人	证书名称	有效期	发证机关
1	德聚技术	城镇污水排入排水管网许可证	2023.11.7-2028.11.6	东莞市生态环境局
2	德聚技术	固定污染源排污登记回执	2023.11.18-2028.11.17	全国排污许可证管理信息平台
3	上海锐朗	固定污染源排污登记回执	2024.11.22-2029.11.21	全国排污许可证管理信息平台
4	青岛德聚	固定污染源排污登记回执	2023.06.21-2028.06.20	全国排污许可证管理信息平台
5	南通德聚半导体	固定污染源排污登记回执	2023.09.05-2028.09.04	全国排污许可证管理信息平台
6	德聚技术	排污许可证	2025.12.29-2030.12.28	东莞市生态环境局
7	上海锐朗	城镇污水排入排水管网许可证	2024.4.12-2029.4.11	上海市松江区水务局
8	上海锐朗	固定污染源排污登记回执	2024.7.25-2029.7.24	全国排污许可证管理信息平台
9	如东德聚	固定污染源排污登记回执	2024.4.25-2029.4.24	全国排污许可证管理信息平台

（四）各要素与所提供产品或服务的内在联系

发行人目前所拥有或租赁的固定资产、无形资产等主要资源要素中，租赁的房屋主要系公司生产经营场所；拥有的机器设备、运输工具、电子及其他设备用于公司生产经营；商标、专利等无形资产对公司的产品研发和生产经营具有支撑作用，是公司技术成果、品牌实力等软实力的体现。上述固定资产、无形资产等主要资源要素不存在重大权属纠纷，不存在重大偿债风险，不存在重大诉讼、仲裁等或有事项，对公司持续经营不存在重大不利影响。

六、公司拥有的特许经营权情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在特许经营权情况。

七、公司研发及核心技术情况

（一）公司的核心技术情况

1、核心技术概况

经过多年自主研发，公司形成共计 20 项核心技术，覆盖丙烯酸酯、环氧树脂、有机硅、聚氨酯、改性硅烷、杂化六大化学材料体系和智能终端、新能源、半导体、通信四大战略性新兴产业。

公司核心技术已建立完善的保护体系，除部分因技术保密原因或尚处于送样阶段未申请专利，其余核心技术均已形成或正在申请对应的专利，具体情况如下：

序号	核心技术名称	专利名称	专利号
1	UV 湿气双重固化丙烯酸酯预聚物合成技术	一种用于电子元器件的 UV 湿气双重固化的胶粘剂	ZL202211242943.6
		一种改性丙烯酸酯低聚物及一种 UV、湿气双重固化压敏胶	ZL202110157365.5
		一种耐油酸 UV-湿气双重固化胶粘剂	ZL202211336181.6
2	高性能反应型聚氨酯产品制备技术	一种湿气固化型聚氨酯热熔胶	ZL202110157562.7
		一种紫外光和湿气双重固化聚氨酯热熔胶及其制备方法	ZL201911420848.9
		一种低水汽透过率湿气固化型聚氨酯热熔胶	ZL202310204493.X
3	半导体胶膜核心树脂合成技术	一种耐高温、抗变形芯片环氧胶膜及其制备方法	ZL202311007128.6
4	UV 延迟固化环氧树脂材料制备技术	非专利技术	
5	光热双固化高性能元器件包封胶配方开发技术	一种光/热双固化低介电性能胶黏剂及其制备方法	ZL202010097655.0
		一种低吸水率的丙烯酸胶黏剂及其制备方法	ZL202211242278.0
6	耐高温高湿环氧胶黏剂复配技术	一种用于晶圆级芯片尺寸封装的底部填充胶组合物及其制备方法	ZL202210746333.3
		一种耐高温环氧胶黏剂及其制备方法	ZL202110284056.4
7	硅烷改性聚醚密封胶制备技术	一种改性端硅烷聚醚密封胶及其制备方法	ZL202110156574.8
		一种多粘接功能的硅烷改性聚醚密封胶及其制备方法	ZL202310170687.2
8	低温快速固化单组份胶黏剂配方开发技术	一种低温快速固化耐湿热环氧粘结剂及其制备方法和应用	ZL202210746391.6
9	球形填料复配及倒装芯片封装底部填充胶组合物制备技	一种用于晶圆级芯片尺寸封装的底部填充胶组合物及其制备方法	ZL202210746333.3
		一种耐高温环氧胶黏剂及其制备方法	ZL202110284056.4

序号	核心技术名称	专利名称	专利号
	术	一种适用于智能汽车的底填胶及其制备方法	ZL202211621219.4
		一种高流淌性低热膨胀系数的底填胶水及其制备方法	ZL202211575925.X
10	高 Tg 低 CTE 树脂开发和改性填料互配技术	一种抗冲击 UV 固化围堰胶及其制备方法	ZL202211242271.9
11	高性能导热界面材料配方优化技术	一种耐湿热聚氨酯导热结构胶及其制备方法	ZL202310563912.9
		一种低密度阻燃型导热聚氨酯结构胶及其制备方法	ZL202211575966.9
12	低硬度镍碳系列导电屏蔽胶制备技术	一种低硬度点胶成型屏蔽导电胶及其制备方法和应用	ZL201110383570.X
13	低沉降耐高温环氧电磁屏蔽涂料的制备技术	一种环氧电磁屏蔽涂料及其制备方法	ZL202110267675.2
		一种耐高温电磁屏蔽涂料及其应用	ZL202110269248.8
14	高性能芯片级导电胶粘剂优化设计与开发技术	一种耐高低温单组分半导体用导电胶及其制备方法	ZL202210935121.X
		一种耐湿热环氧导电胶、制备方法及其应用	ZL202210746332.9
		一种低温半烧结导电导热胶及其制备方法	ZL202111411475.6
		一种用于芯片封装材料的银粉填充体筛选方法	ZL202111068664.8
		一种应用于大尺寸芯片粘接的导电胶及其制备方法	ZL202110980035.6
		一种适用于不同属性芯片封装材料的原料预处理工艺	ZL202111069101.0
15	半导体封装保护固晶胶膜的配方开发技术	一种耐高温、抗变形芯片环氧胶膜及其制备方法	ZL202311007128.6
16	模组封装 AA 制程胶光热双重固化胶粘剂制备技术	一种用于摄像头模组的光热双重固化胶粘剂及其制备方法	ZL202311194066.4
17	加成型有机硅增粘剂结构设计及双组份加成固化有机硅的制备技术	非专利技术	
18	各向异性导电胶膜及其原材料制备技术	膜体材料及应用该材料的导电性粘贴膜	ZL2024107608242
19	水性可喷涂高绝缘导热涂层技术	非专利技术	
20	基于导电硅胶的高可靠晶振胶技术	一种应用于晶体振荡器的有机硅热固化纯银导电胶及制备方法	专利申请中

2、发行人核心技术的先进性表征

电子胶粘剂行业的技术难度主要体现在多种性能要求及量产工艺约束之间

实现平衡。电子胶粘剂除了需要包括传统胶粘剂的粘接、密封、灌封和涂覆作用，即粘接强度、硬度、密封性、韧性、抗跌落失效等性能，还需具备导热、介电、绝缘、电磁屏蔽、耐电压、耐腐蚀、吸水或疏水、阻燃、尺寸稳定、光学性能、耐冷热冲击等特殊性能。该部分性能指标的单一优化通常较为容易，但多种指标之间往往并不兼容，例如物体很难同时兼备硬度和柔韧性。因此，如何通过原材料开发与修饰、产品配方设计和生产工艺优化，在多性能约束下形成平衡、稳定、可量产的解决方案，满足下游应用点的特殊需求，同时兼顾客户应用电子胶粘剂时的生产效率、点胶成本和固化条件等，即为电子胶粘剂设计开发的技术难度。

公司主营产品电子胶粘剂的核心技术包括原材料开发与修饰、产品配方设计、生产工艺优化等方面。

原材料是电子胶粘剂性能突破的关键技术门槛，开发难度较大，尤其是核心成分的分子结构设计及合成制备技术是电子专用高分子材料领域的底层技术，需要完善的高分子聚合物理论支撑及大量的实验测试才能完成。公司拥有配方核心成分的分子结构设计及合成制备技术，已建立丰富的核心成分分子结构储备，对各类成分的性能指标可实现精准把控，并在此基础上通过对各组分进行配方复配，满足不同下游领域对电子胶粘剂不同的综合性能需求。

配方的细微变化对产品综合性能的实现有着重要影响。电子胶粘剂主体成分包含树脂、填料、交联剂、增韧剂、固化剂、催化剂、抑制剂、增粘剂、触变剂等多种主剂及助剂成分，各成分在产品配方中所扮演的角色亦有所不同。公司经大量实验测试，验证不同成分组合的复配工艺所形成的产品性能特征，并持续优化产品配方及生产工艺，筛选确定适配的原材料组合及配比关系，以实现产品多项性能之间的平衡及精确调整，实现针对性、定制化的配方及工艺开发。

经过多年自主研发，公司形成共计 20 项核心技术，核心技术先进性的具体情况如下表所示：

序号	核心技术名称	技术研发背景	技术独特性和突破点	应用领域及产品	技术水平情况	技术来源	技术成熟度
1	UV 湿气双重固化丙烯酸酯预聚物合成技术	智能终端等精密电子组装中，大量不透明基材、窄缝异形结构需兼顾 UV 快速定位与盲区湿气固化，常规双重固化产品普遍存在韧性不足、易跌落失效、耐化学性差等痛点，无法满足高可靠性组装要求，亟需开发综合性能均衡的相关技术	该项技术解决固化盲区问题；突破固化效率与韧性不可兼得的行业痛点，兼顾高粘接强度、优异柔韧性与抗冲击性，同时优化耐化学性与生物相容性	智能终端-手机、手表；新能源汽车-CCS 系统	公司该系列产品性能指标已达到国际同行同等水平	自主研发	批量
2	高性能反应型聚氨酯产品制备技术	电子制造自动化产线对效率要求持续提升，传统胶粘剂无法兼顾快速定位与高强度粘接，常规 PUR 产品存在初粘力不足、开放时间不可控的缺陷，大幅制约产线流转效率，亟需开发适配高端自动化产线的高性能PUR制备技术	该项技术合成互穿聚合物网络结构预聚物，实现开放时间宽范围可控；压合 5 分钟即可形成 0.6-2.2MPa 高强度粘接，无需夹具即可产线连续流转，显著提升生产效率，兼具多基材适配性与高可靠性	智能终端-手机、手表盖板粘接密封	公司该系列产品性能指标已达到国际同行同等水平	自主研发	批量
3	半导体胶膜核心树脂合成技术	半导体先进封装向晶圆级、3D 堆叠方向快速演进，传统液态固晶胶无法适配超薄芯片均匀粘接需求，DAF 核心树脂技术长期被海外厂商垄断，国产化率较低，亟需开发能够实现自主保障的半导体胶膜核心树脂合成技术	该项技术突破高分子量与低 Tg 不可兼得的技术难题，胶膜常温贴装柔韧性优异、高温下尺寸稳定性强；实现 Tg、模量、CTE 精准调控，固化后增韧效果与可靠性突出	半导体芯片粘接固定	公司应用该核心技术的产品性能指标已接近行业领先水平	自主研发	小批量
4	UV 延迟固化环氧树脂材料制备技术	高精密组装工序对微米级对位精度要求严苛，传统 UV 胶无对位调整窗口，易造成产品报废，常规双重固化体系成本高、工艺复杂，核心技术长期被海外巨头垄断，亟需开发 UV 延迟固化技术	该项技术构建分步固化体系，UV光照后可提供1-3分钟可控对位窗口，解决固化速度与精密对位不可兼得的行业痛点；完全固化后剪切强度达7.9MPa，冷热循环后仍保持高粘接性能	智能终端结构粘接和密封	UV 延迟固化技术目前全球仅汉高、德路、日本积水化学等海外巨头厂商掌握相关核心技术，公司已在该领域实现前沿技术开发	自主研发	送样

序号	核心技术名称	技术研发背景	技术独特性和突破点	应用领域及产品	技术水平情况	技术来源	技术成熟度
5	光热双固化高性能元器件包封胶配方开发技术	柔性电子产业快速发展，FPC 元器件包封需同时满足低硬度高柔韧、高绝缘低透水、强粘接耐湿热的多重要求，常规包封胶普遍存在性能失衡问题，无法适配柔性电子长期可靠性要求	该项技术构建光热双固化体系，兼顾快速定位与深层固化；突破柔韧性与绝缘性不可兼得的行业痛点，低硬度适配 FPC 弯折场景，双 85 环境下稳定工作 1,000 小时，绝缘阻抗稳定在 $1.0\times10^{9}\Omega$ 以上，核心指标处于行业领先水平，已批量规模化应用。通过使用低敏感单体降低丙烯酸体系的刺激性，满足终端的一类环保管控，产品低模量进一步降低固化应力，提高温冲的可靠性，同时绝缘性能也进一步升级	智能终端-手机、手表；新能源汽车-CCS 系统	公司应用该技术设计的元器件包封胶，已成为公司主力产品，关键性能指标处于行业领先水平	自主研发	批量
6	耐高温高湿环氧胶粘剂复配技术	新能源汽车电子快速发展，车载BMS、电芯模组用 FPC 对胶粘剂提出车规级高可靠性要求，消费电子级胶粘剂耐湿热性能不足，传统环氧胶高温回流焊后性能衰减、良率低，无法适配车载场景严苛要求	该项技术构建填料-固化剂协同体系，显著提升树脂耐湿热与高温稳定性；引入特种增韧材料，兼顾高 Tg 与较低的高温模量，解决高温回流焊后性能衰减的行业痛点，双 85 测试后对 PI 基材粘接强度仍超 5MPa	新能源汽车-CCS 系统	公司该系列产品性能指标处于行业领先水平	自主研发	批量
7	低温快速固化单组份胶粘剂配方开发技术	半导体、医疗电子等领域大量热敏性元器件与非透明基材，无法适配高温固化与 UV 光固化工艺，常规低温固化胶存在固化慢、储存稳定性差、粘接强度不足的缺陷，无法兼顾低温固化与高可靠性需求	该项技术构建潜伏性固化体系，低温下可快速固化，常温下储存稳定性优异，解决热敏性元器件固化适配难题；通过树脂与填料协同复配，兼顾高粘接强度、低模量与耐湿热性能，抗跌落性能突出	智能终端结构粘接	公司该款产品粘接强度等指标已达到国际同行同等水平	自主研发	批量
8	硅烷改性聚醚密封胶制备技术	新能源、智能终端等领域工程塑料结构件的粘接密封，对密封胶提出高本	该项技术优化硅烷封端聚醚分子结构，固化后形成高密度交	智能终端和新能源	公司该系列产品性能指标已	自主研发	批量

序号	核心技术名称	技术研发背景	技术独特性和突破点	应用领域及产品	技术水平情况	技术来源	技术成熟度
		体强度、多基材适配、高耐候性的综合要求，传统硅橡胶密封胶对PA/PC/ABS等塑料粘接性差、强度低，易出现密封失效问题	联网络，本体强度与拉伸性能显著提升；主链引入丙烯酸酯结构增强韧性，通过偶联剂复配实现多基材广谱粘接，固化后粘接与拉伸强度均达 3MPa以上，断裂延伸率达100%以上	汽车结构粘接密封	达到国际同行同等水平		
9	高Tg低CTE树脂开发和改性填料互配技术	BGA封装芯片边角绑定工序，对材料提出高粘接、低应力、高尺寸稳定性的要求，常规丙烯酸UV胶对PCB阻焊层粘接性差，易脱落失效，传统材料热膨胀系数高，易挤压损伤芯片焊点，亟需适配的高性能绑定材料技术。	该项技术开发高Tg低CTE特种树脂体系，固化后Tg达120℃以上，CTE小于30ppm/K，高温尺寸稳定性优异，解决热应力损伤焊点的行业痛点；通过改性填料复配，兼顾高固化深度、优异柔韧性与强粘接性能，抗振动跌落效果突出	芯片底部填充	公司该系列产品性能指标已达到国际同行同等水平	自主研发	批量
10	球形填料复配及倒装芯片封装底部填充胶组合物制备技术	倒装芯片封装成为高端芯片主流技术路径，底部填充胶需适配微米级间隙快速填充，同时满足低CTE、高Tg、高耐候性的严苛要求，高端产品核心技术长期被海外厂商垄断，亟需能够实现自主保障的相关技术	该项技术构建微纳米球形硅微粉梯度复配体系，显著提升胶体流动性与微米级间隙无孔洞填充能力；通过特种环氧树脂改性，固化后Tg达155℃，CTE低至25ppm/K，剪切强度达40MPa，耐冷热循环性能优异	芯片底部填充	公司应用该核心技术的产品性能指标已接近行业领先水平	自主研发	小批量
11	高性能导热界面材料配方优化技术	高功率芯片热管理需求持续升级，传统导热界面材料存在热阻高、长期易老化出油、工艺适配性差的痛点，高端芯片级TIM材料长期被海外厂商垄断，亟需开发兼顾高导热、高可靠性、优工艺性的高性能TIM技术	该项技术构建多粒径梯度导热网络，产品导热系数达4.5W/m·K，热阻低至0.1℃·cm²/W，接近行业领先水平；优化耐老化体系，大幅降低析油性，保障长期散热稳定；挤出速率达60g/min，适配自动化高速点胶工艺	芯片和电路板散热	公司应用该核心技术的产品性能指标已接近行业领先水平	自主研发	批量

序号	核心技术名称	技术研发背景	技术独特性和突破点	应用领域及产品	技术水平情况	技术来源	技术成熟度
12	低硬度镍碳系列导电屏蔽胶制备技术	电子设备高集成化、高频化发展，电磁干扰问题日益突出，传统屏蔽材料无法适配紧凑异形空间，常规屏蔽胶硬度高、易磨损设备、高低温循环后屏蔽性能衰减，核心技术长期被海外厂商垄断，亟需能够实现自主保障的低硬度高性能屏蔽胶技术	自主研发核心制备技术，构建镍碳复合导电体系，老化前后屏蔽隔离度均大于 70dB；通过柔性树脂体系设计实现低硬度特性，减少设备磨损，同时适配异形弯折场景；可通过-40℃~125℃的 1,000 次高低温循环测试，性能稳定	电磁屏蔽	该款产品早期被诺兰特（Nolato）垄断，目前公司已掌握该领域核心技术，成为国内主要厂商之一	自主研发	批量
13	低沉降耐高温环氧电磁屏蔽涂料的制备技术	半导体元器件微型化发展，传统硬质屏蔽材料无法适配 0.1mm 级微型元器件精细化屏蔽需求，常规屏蔽涂料存在填料易沉降、耐高温性差、喷涂工艺性不佳的痛点，易出现屏蔽失效、涂层脱落等问题	该项技术通过导电填料表面改性解决沉降难题，储存稳定性优异，触变指数小于 1.5，适配微米级精密喷涂工艺；耐高温性能突出，可承受 3 次以上高温回流焊无粘接失效，体积电阻率小于 0.1Ω·cm，双 85 环境下 1,000 小时老化后性能稳定，已完成小批量试制	电磁屏蔽	公司该系列产品性能指标已接近国际同行同等水平	自主研发	小批量
14	高性能芯片级导电胶粘剂优化设计与开发技术	半导体封装微型化发展，芯片级导电胶需适配 50 微米级间隙粘接，同时满足低电阻率、高耐湿热、优流动性的严苛要求，常规产品存在湿热环境下导电性能衰减、工艺适配性差的痛点，高端产品长期被海外厂商垄断	该项技术通过导电粉体纳米改性，提升与树脂相容性，在高填充下仍保持优异流动性，适配微米级精密封装；构建稳定三维导电网络，双 85 环境 1,000 小时测试后，仍保持 1.0×10^{-5}Ω·cm 量级极低电阻率，同时兼具高粘接强度与耐候性	半导体芯片粘接	公司该系列产品性能指标已达到国际同行同等水平	自主研发	批量
15	半导体封装保护固晶胶膜的配方开发技术	3D 堆叠、Chiplet 等先进封装快速发展，DAF 作为芯片立体堆叠的核心材料，需实现 Tg、模量、CTE 三大核心参数精准平衡，核心配方与制备技术长期被海外厂商垄断，国产化率较低，	该项技术实现 Tg、模量、CTE 三大参数精准协同调控，热压贴装可实现微米级均匀涂覆与高精度贴装，高温下尺寸稳定性优异，有效抑制芯片翘曲分	半导体芯片粘接	公司该系列产品性能指标已接近行业领先水平	自主研发	小批量

序号	核心技术名称	技术研发背景	技术独特性和突破点	应用领域及产品	技术水平情况	技术来源	技术成熟度
		亟需能够实现自主保障的 DAF 配方开发技术	层；固化后剥离强度达 300g/25mm，剪切强度超 8MPa，耐候性与可靠性突出				
16	模组封装 AA 制程胶光热双重固化胶粘剂制备技术	光学模组向高像素、高精度升级，AA 制程需胶粘剂实现“先临时精准定位、后永久高强度锁固”，传统单一固化胶无法适配工艺需求，核心技术长期被海外厂商垄断，国产化率较低，亟需开发 AA 制程专用胶粘剂技术	该项技术构建光热双分步固化体系，UV 光照 1-5 秒即可快速初步定位，保证部件无位移，同时保留微米级调校窗口；80~85℃低温加热即可完成完全固化，形成高稳定粘接强度，耐候性与抗冲击的优异性能	摄像头模组结构粘接	公司该系列产品性能指标已达到国际同行同等水平	自主研发	批量
17	加成型有机硅增粘剂结构设计及双组份加成固化有机硅的制备技术	Mini/Micro LED 产业爆发式增长，传统缩合型有机硅固化释放副产物易腐蚀微电极，常规加成型有机硅存在固化深度不足、易黄变、透光率衰减的痛点，无法满足新型显示面板长期可靠性要求	该项技术设计合成新型加成型有机硅增粘剂，提升多基材粘接性能，大幅优化固化深度与固化效率；通过树脂改性提升折射率与出光效率，优化抗黄变体系，长期老化后透光率仍保持 92%以上，有效抑制光衰，适配 Mini/Micro LED 光学保护需求	Mini LED 的保护	公司该系列产品性能指标已达到国际同行同等水平	自主研发	批量
18	各向异性导电胶膜及其原材料制备技术	新型显示产业高密度互连需求持续升级，ACF 是显示面板与驱动芯片绑定的核心关键材料，全链条核心技术长期被日本厂商垄断，亟需开发能够实现自主保障的 ACF 全链条技术	该项技术自主构建 ACF 从原材料合成、配方设计到精密涂布的全链条自主研发体系；实现胶膜“垂直导通、水平绝缘”的精准各向异性导电特性，解决高密度互连短路风险；掌握微米级超薄胶层均匀涂布核心工艺	显示屏驱动芯片与电路板连接固定	公司该系列产品性能指标已达到国际同行同等水平	自主研发	批量
19	水性可喷涂高绝缘导热涂层技术	新能源汽车产业快速发展，车内电控系统电子元件高度集成，热量累积易影响系统稳定性与安全性，传统绝缘	该项技术以水为溶剂制备环保型涂层，乳化环氧树脂搭配导热填料，实现超声喷涂下涂层	新能源汽车电控系统	公司该系列产品性能指标处于行业领先水	自主研发	批量

序号	核心技术名称	技术研发背景	技术独特性和突破点	应用领域及产品	技术水平情况	技术来源	技术成熟度
		胶膜散热能力不足，无法适配车载电控系统高绝缘、高导热的双重严苛要求，亟需开发新型散热绝缘材料技术	均匀致密；导热系数达 2W/（m·K），兼具高附着力与高绝缘性，可通过 125℃/2,000h 耐高温、双 85、耐盐雾及 4.3KV 耐击穿电压等车规级严苛可靠性测试，环保性与综合性能兼具		平		
20	基于导电硅胶的高可靠晶振胶技术	晶振行业用导电银胶核心技术长期被海外厂商垄断，国产化率极低；有机硅本体极性低，对金、银基材粘接性差，且导电填料添加量易造成“导电性提升则粘接性、模量失衡”的行业痛点，亟需开发兼顾高导电、低模量、高粘接力与低 VOC 的晶振专用导电胶技术	该项技术通过低真空高温薄膜蒸发降低原料 VOC 含量，保障晶振 ppm 级精度长期工作；优化基础树脂流变性与力学性能，复配适配银粉及有机硅体系特种助剂，实现对镀金基材的高粘接；精准平衡高导电性、低模量特性，规避胶层脱落风险，跌落特性测试寿命高于同类型国内外产品	半导体晶体振荡器件的导电粘接	公司该系列产品性能指标已达到国际同行同等水平	自主研发	批量

注：上表中所列示的粘接强度数据均为基于客户要求的基材进行测试的数据。

（二）核心技术产生的收入占营业收入比例

公司核心技术已广泛应用于电子胶粘剂主要产品，并形成规模化收入。报告期内，公司核心技术产品产生的收入占营业收入比例情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	销售额	占比	销售额	占比	销售额	占比
核心技术收入	43,787.91	95.63%	36,308.20	94.33%	31,851.90	90.64%
非核心技术收入	1,998.59	4.37%	2,180.84	5.67%	3,287.31	9.36%
合计	**45,786.50**	**100.00%**	**38,489.05**	**100.00%**	**35,139.21**	**100.00%**

报告期内，公司核心技术产品收入分别为 31,851.90 万元、36,308.20 万元、43,787.91 万元，占营业收入的比例分别为 90.64%、94.33%、95.63%，占比持续保持在较高水平并逐年提升。公司主要生产经营以核心技术产业化应用为基础，核心技术产业化成效明显。发行人非核心技术产品主要包括贸易业务及其他业务收入。

（三）公司在研项目情况

截至本招股说明书签署日，公司正在开展的主要在研项目及进展情况如下：

序号	项目名称	拟达到目的/主要研究内容	当前状态	同行业对比/技术水平先进性	应用领域
1	模组（摄像头，声学，光学等）类胶粘剂的研发	开发模组（摄像头、声学、光学等）组装用丙烯酸、环氧及杂化体系胶粘剂，实现低温下快速固化；针对高温高湿、冷热冲击等老化条件下粘接力下降、模组稳定性变差等技术需求，满足电子模组高精度组装的可靠性要求	实施阶段	模组组装用胶粘剂需同时满足高粘接强度、低温快速固化及抗老化性能要求，该类高端胶粘剂市场长期被国外企业垄断；本项目产品通过材料体系创新，在综合性能上达到国际先进水平，降低国内模组企业的采购成本	模组组装
2	高性能环氧底填胶的研发	开发高玻璃化转变温度（Tg）、高流动性、高可靠性且易返修的胺类固化环氧底部填充胶，符合晶圆级封装（Wafer Level Chip Scale Packaging）、车载芯片及 GPU 等大尺寸芯片的封装保护技术标准，解决传统产品可靠性与可维修性难	实施阶段	当前行业内同类产品难以实现高可靠性与易返修性的兼顾，且普遍含有甲基六氢苯酐等致敏物质；本项目产品通过创新配方设计，在保持高可靠性的同时实现易返修特性，且不含致敏成分，在产品性能和安全性上均具有明显竞争优势	车载芯片、GPU 等

序号	项目名称	拟达到目的/主要研究内容	当前状态	同行业对比/技术水平先进性	应用领域
		以兼顾的行业难题			
3	高性能灌封材料的研发	开发高流动性、高填充率、高玻璃化转变温度（Tg180℃）的高性能灌封材料，长期耐温可达 200℃，导热系数 2W/（m·K），可显著提升电机散热效率，降低电机运行温度，提高电机设计功率，延长使用寿命	实施阶段	市场主流灌封材料导热系数普遍为 0.8-1.5W/（m·K），玻璃化转变温度（Tg）低于 120℃，长期耐温低于 150℃；而市场上导热系数 2W/（m·K）的产品普遍粘度较高，耐温性能与工艺适应性难以平衡。本项目产品在导热性、耐温性及工艺性能上实现协同提升	新能源轮毂电机，油泵电机，大型特种设备如螺旋 CT 扫描仪
4	多用途高导热材料的研发	联合开发单组分非硅导热凝胶，不含硅类低分子物质，具备优异的耐高低温冲击性能，低应力且不固化，可应用于精密电子元件的散热需求，满足汽车电子及消费电子产品的高可靠性要求	实施阶段	当前行业内同类导热材料使用温度范围普遍为-40~125℃，耐湿热性能有待提升；本项目通过材料结构创新，将使用温度上限提升至 150℃，同时改善耐湿热性能，满足汽车电子等高温严苛环境的应用需求	汽车电子、精密消费电子
5	半导体芯片粘接胶粘剂的研发	开发应用于 IC、钽电容、晶振、LED 等器件封装的导电及非导电固晶胶与胶膜，以及半导体制程用胶膜，符合高可靠性、高导热性及大芯片低应力封装的技术标准	实施阶段	大芯片封装对低应力、高导热的技术需求日益提升，而该类固晶胶市场长期被国外企业垄断；本项目产品通过自主研发，在低应力控制和高导热性能上达到国际先进水平，打破国外技术垄断格局	半导体，汽车电子
6	MiniLED 有机硅光学胶的研发	MiniLED 用胶需要同时满足高折射率，高固化深度，耐黄变，透光率稳定，无腐蚀微电极副产物，以达到新型显示面板长期可靠性要求	实施阶段	本项目通过设计合成新型加成型有机硅增粘剂，提升多基材粘接性能，大幅优化固化深度与固化效率；通过树脂改性提升折射率与出光效率，优化抗黄变体系，长期老化后透光率仍保持 92%以上，有效抑制光衰，适配 MiniLED 光学保护需求	显示模组组装
7	手持设备用结构胶粘剂的研发	开发手持及可穿戴设备组装用胶粘剂，同时满足高粘接强度、耐热蠕变、耐皮脂、耐汗液浸泡及抗冲击等技术	实施阶段	当前行业内手机盖板玻璃粘接、手表壳体粘接及可穿戴设备结构粘接用聚氨酯类材料，在难粘塑料、金属基材的粘	手持可穿戴设备结构粘接

序号	项目名称	拟达到目的/主要研究内容	当前状态	同行业对比/技术水平先进性	应用领域
		性能要求，符合消费电子产品轻量化、小型化的发展趋势，提升产品使用可靠性		接性能及耐候性上有待提升；本项目通过树脂结构优化，显著提升对难粘基材的粘接强度和耐候性能，满足消费电子产品长期使用需求	
8	高强度发泡材料的研发	开发锂电池包用阻燃灌封材料，以及储能、新能源汽车等领域用 CIPG/FIPG 防水密封胶条，解决传统发泡材料延伸率低、老化后失效风险高的问题，满足新能源汽车电子设备的高安全性和可靠性要求	实施阶段	当前行业内锂电池包发泡灌封胶延伸率普遍低于 10%，导致振动实验和冷热冲击等老化后失效风险较高；国内同行的 CIPG/FIPG 产品普遍存在热压缩回弹率低、长期密封性有待提升的问题；本项目产品在延伸率、回弹率及密封性上均实现技术突破，性能优于国内同类产品	汽车电子
9	用于 TFT-LCD 显示器偏光片的压敏胶粘剂的研发	开发 TFT-LCD 显示器偏光片用压敏胶粘剂，通过优化树脂分子结构，提升偏光片在高温老化等严苛测试条件下的可靠性，符合不同尺寸显示器的组装技术标准，满足显示产业高质量发展需求	实施阶段	当前行业内偏光片用压敏胶粘剂在高温老化条件下的可靠性有待提升；本项目通过优化 PSA 树脂分子结构组成，显著提升产品在高温老化等严苛条件下的可靠性，可满足高端显示产品需求	显示模组组装
10	高性能丙烯酸环氧杂化体系胶黏剂的研发	联合开发高玻璃化转变温度（Tg）、低热膨胀系数（CTE）、高可靠性的环氧丙烯酸杂化体系低介电底部填充胶，兼具环氧体系高强度、高可靠性与丙烯酸体系柔韧性、低粘度、低介电特性，可应用于大尺寸芯片保护，同时降低信号传输损耗，满足高端芯片封装需求	实施阶段	市场上常用单一体系底部填充胶介电常数普遍大于 3，且粘度较高；杂化体系底部填充胶则存在玻璃化转变温度（Tg）低、可靠性差的问题；本项目产品通过创新杂化体系设计，在介电性能、粘度控制及可靠性上均实现突破，技术指标优于同类产品	车载芯片、GPU 等
11	高性能制程保护胶黏剂的研发	联合开发高伸长率、低附着力、高韧性且可返修的 UV 丙烯酸胶粘剂，实现对半导体制程中元器件的临时保护功能，解决传统保护胶在回流温度下出现硬度提高、本体强度降	实施阶段	当前行业内制程保护胶在回流温度下普遍出现硬度提高、本体强度降低、附着力上升等问题，导致剥离后残胶风险较高；本项目产品通过配方优化，有效解决上述问题，显著提升制程保	半导体、消费电子

序号	项目名称	拟达到目的/主要研究内容	当前状态	同行业对比/技术水平先进性	应用领域
		低、附着力上升导致的剥离残胶风险，满足半导体精密制造需求		护的可靠性和便利性，满足半导体精密制造需求	
12	低模量高粘接高耐候胶黏剂的研发	开发低模量高粘接高耐候胶黏剂，低模量高粘接丙烯酸酯体系胶粘剂。具有优秀的粘接强度。良好的柔韧性和较低的内应力，不易脱胶开裂。在高温高湿、冷热冲击等老化实验中表现良好，满足相关领域的技术标准和应用需求	实施阶段	当前行业内同类产品平衡了粘接力和模量之间的固有矛盾。在具有优秀粘接力的同时，降低材料的模量，在热胀冷缩情况下内应力小，可耐受-40~125℃冷热循环 2000 次；本项目产品通过技术创新，在相关性能指标上实现突破，具有明显的技术优势和市场竞争力	汽车电子

（四）研发费用占营业收入的比例

报告期内，公司研发费用及占营业收入的比例情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
研发费用	6,799.27	6,936.12	5,952.94
营业收入	45,786.50	38,489.05	35,139.21
占比	14.85%	18.02%	16.94%

报告期内，公司研发费用分别为 5,952.94 万元、6,936.12 万元和 6,799.27 万元，占营业收入的比例分别为 16.94%、18.02%及 14.85%。

（五）合作研发情况

报告期内，公司开展的合作研发情况如下：

序号	合作方	合作项目	签订时间	研究内容及采取的保密措施	知识产权归属
1	中国科学院长春应用化学研究所、广东粤港澳大湾区黄埔材料研究院	PSPI 树脂及其光刻胶的量产关键技术和中试工艺	2022 年 11 月	研究内容：负责 1000L 规模光敏聚酰亚胺树脂及其光刻胶的量产工艺优化 保密措施：合同约定双方承担保密义务	各方单独完成的项目成果归该方单独享有； 对于共同完成的，各方共同享有，申请专利时需征得各方同意
2	深圳先进电子材料国际创新研究院、南通通	倒装芯片封装用底部填充材料的研发	2023 年 11 月	研究内容：负责项目原材料研究、制备工艺研究、建立内部评测方法；负	1、各方负责领域的专利申请权及专利权知识产权所有权归各方各自所有；

序号	合作方	合作项目	签订时间	研究内容及采取的保密措施	知识产权归属
	富微电子有限公司、浙江三时纪新材科技有限公司			责项目样品试制、测试与应用评估等保密措施：合同约定双方承担保密义务	2、各方有权自主、单独实施（包括但不限于以制造、销售、使用的方式实施）本协议项下各方负责领域内产生的知识产权或以普通许可的方式许可其全资子公司、控股子公司实施本协议项下知识产权，而无需取得其他三方的同意，其他三方也不享有收益分配权

（六）核心技术人员及研发人员情况

1、研发人员情况

公司坚持自主研发和技术创新，不断加强研发团队建设与培养，已经组建了一支具有扎实高分子材料理论基础与丰富研发经验积累的研发团队。截至 2025 年末，公司拥有 120 名研发人员，研发人员占总员工人数比例为 26.03%。

2、核心技术人员情况

公司核心技术人员的认定标准为：（1）过往在公司核心技术领域有匹配的教育背景和行业经验，在产品的开发中承担重要角色；（2）在研发部门担任重要岗位且未来具有较强稳定性；（3）对公司的技术发展和产品研发具有重要贡献。

根据上述标准，公司共有 3 名核心技术人员，分别为 Junjun Wu（吴俊珺）、韩火年、张盈。公司核心技术人员的基本情况如下：

序号	姓名	职务	学历背景	研发工作履历及成果	对公司研发的贡献
1	Junjun Wu（吴俊珺）	首席技术官、副总经理	加利福尼亚大学洛杉矶分校化学专业博士	1、曾于 3M 公司、汉高公司从事研发工作，拥有二十年以上电子胶粘剂相关研发工作经验； 2、作为发明人参与公司一种耐高低温单组份半导体用导电胶及其制备方法的发明专利开发工作； 3、作为课题负责人参与科技部“高端功能与智能材料”专项“面向晶圆级封装的光敏聚酰亚胺材料关键技术研发及应用”项目中“PSPI 树脂及其光刻胶的量产关键技术和中试工艺”的课题研究	1、统筹全公司的研发资源及新产品研发方向； 2、完善公司研发管理体系和流程及测试分析能力； 3、帮助公司成功建立起半导体和新能源技术平台，深化和拓展智能终端技术平台； 4、统筹和外部的技

序号	姓名	职务	学历背景	研发工作履历及成果	对公司研发的贡献
					术合作开发项目
2	韩火年	德聚技术研发总监	厦门大学高分子化学与物理专业硕士	1、自公司成立起即在公司从事研发工作，拥有十余年电子胶粘剂相关研发工作经验； 2、作为发明人参与公司一种用于晶圆级芯片尺寸封装的底部填充胶组合物及其制备方法、一种低温快速固化耐湿热环氧粘结剂及其制备方法和应用、一种耐高温环氧胶黏剂及其制备方法等 4 项发明专利的开发工作； 3、参与科技部“高端功能与智能材料”专项“面向晶圆级封装的光敏聚酰亚胺材料关键技术研发及应用”项目中“PSPI 树脂及其光刻胶的量产关键技术和中试工艺”的课题研究	1、统筹公司总部的各项研发工作，落实研发工作计划； 2、在公司成立初期统筹研发部门各项工作，包括研发部门及研发流程的建立、国家标准导入等； 3、主导环氧和丙烯酸体系胶粘剂重点项目研发，成功研发出多款高性能产品并实现大规模量产销售
3	张盈	青岛德聚研发总监	德国卡尔斯鲁厄理工学院化工专业硕士	1、曾于 Panacol 公司从事研发工作，拥有十余年电子胶粘剂相关研发工作经验； 2、作为发明人参与公司一种测量 FPC 与 FPC 粘接力的工装夹具、一种用于压料机的过滤装置、一种粉料分散设备等 5 项专利的开发工作； 3、参与科技部“高端功能与智能材料”专项“面向晶圆级封装的光敏聚酰亚胺材料关键技术研发及应用”项目中“PSPI 树脂及其光刻胶的量产关键技术和中试工艺”的课题研究	1、规划青岛德聚的发展与研发方向； 2、主导原料自主合成工作，成功研发出多款性能独特的原材料并使用到公司电子胶粘剂产品； 3、进行环氧和丙烯酸体系胶粘剂重点项目研发，成功研发出多款高性能产品并实现大规模量产销售

上述核心技术人员简历及变动情况参见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“六、董事、监事会取消前监事、高级管理人员及其他核心人员”。

（七）保持技术持续创新的机制、技术储备及创新安排

电子专用高分子材料行业具有技术密集、应用场景复杂、产品迭代较快等特点，行业内企业需要保持高水平的研发投入和研发管理，进而保持市场竞争地位。为实现持续发展，公司建立健全了一系列可行且高效的技术创新促进机制：

1、完善的研发组织体系及管理制度

目前，公司研发中心下设研发部、材料分析实验室、应用工程部，三大部门相互配合保证研发工作的高效实施，其主要职能分工如下：

研发部门	主要职能
研发部	1、负责产品开发、配方设计、样品初步测试、设计开发阶段的评审组织工作；

研发部门	主要职能
	2、负责开发输出文件的编制，专利申请资料的编制； 3、负责小批量样品制备，跟踪新产品试产过程中技术优化和产品方案更新等问题
材料分析实验室	1、负责新开发产品、原材料等性能测试及可靠性测试； 2、负责新开发产品测试标准/方法的制定，以及产品测试标准/方法的改进
应用工程部	1、在新产品开发初期了解客户端的技术需求，设计产品技术方案； 2、负责新产品在客户端试用的技术支持和问题解决，及时向研发部反馈技术问题； 3、负责产品的委外检测及认证工作，产品设计变更的测试、确认和更改； 4、负责新产品规格书（TDS）、产品手册等文件编制

经过多年发展，公司建立了完善的研发管理制度，规范了公司研发工作开展过程中的各个环节，保障研发活动规范、高效开展，也为研发人员的工作考核和成果管理提供了明确的依据。公司高度重视知识产权的保护，按照公司层面统一管理、加强保护与运营的原则制定了完善的知识产权管理制度，对拥有的知识产权的有关方面均作出了明确严格的规范，为公司持续技术创新和技术储备提供制度保障。

2、完善的团队建设与激励措施

研发团队建设是公司发展的重要基础，公司坚持人才引进与内部培养相结合，使得团队中既有行业经验丰富的团队骨干，也有具有丰富理论知识、创新意识与研发活力的年轻力量，具备卓越的前瞻性和行动力。同时，公司根据电子胶粘剂产品开发对多学科协同的需求，充分考量研发人员专业结构，为公司实现研发目标提供了坚实的人才支撑。

公司注重研发人员在知识积累、技能改善、思维开拓、团队协作和专业成长等方面的全方位发展，不断优化研发人才培养路径和方式，使其在不断探索和实践中提高自身的专业素养和综合能力，从而为公司长期发展提供有力的支撑。通过科学、完善和有序的研发团队建设机制，公司研发团队不断发展壮大，截至2025年末，公司已拥有研发人员120人，占员工总人数的26.03%。

公司重视人才激励机制的建设，不断创新激励模式，为研发人员的技术创新提供了良好的环境和条件。通过设置系统化、科学化的激励机制和绩效考核体系，公司鼓励研发人员积极推动技术革新和产业升级，培养优秀团队和人才，提高团队协作水平和专业竞争力。公司不断落实激励措施，将实现创新成果和开发项目、提升研发能力等作为研发和技术人才绩效评价的重要指标和考核标准，充分调动

员工的热情和积极性，推动技术创新和发展，为公司的持续发展提供坚实的技术保障。

3、创新的产学研合作研发模式

在坚持自主研发的基础上，公司积极开展产学研合作，与广东粤港澳大湾区黄埔材料研究院、上海交通大学、中科院广州化学有限公司等高校及科研机构开展研究合作，整合实验室优质研发资源与公司技术创新需求，共同推动高精尖领域的技术进步与储备和研发成果产业化。

4、持续的研发投入

报告期内，公司研发费用分别为 5,952.94 万元、6,936.12 万元和 6,799.27 万元，研发费用占营业收入的比例分别为 16.94%、18.02%及 14.85%，报告期内累计研发投入达到 19,688.33 万元。同时，本次发行上市部分募集资金将用于技术研发与研发中心建设，进一步提升公司研发测试条件、研发协同效率和新产品开发能力，为公司持续进行新技术、新产品开发提供资金和平台支持。

八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力

根据《企业环境信用评价办法（试行）》（环发[2013]150 号）第三条的规定，重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业 16 类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为电子专用材料制造（C3985）。根据《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，公司产品所属的电子专用材料制造及相关电子级化学品和材料列入“3 新材料产业”之“3.3 先进石化化工新材料”之“3.3.6 专用化学品及材料制造”。

报告期内，公司不存在高危险、重污染的情况。公司生产过程中排放的污染物较少，主要为少量废气、废水、固体废弃物和噪声。公司生产过程中涉及的污染物及处置情况如下：

污染物	主要来源	采取的主要防护措施
废水	生活污水和零星工业废水	生活污水经隔油隔渣池、三级化粪池处理后，通过厂区污水总排口接管至市政污水管网，排入城市污水处理厂进行处理；零散工业废水交由工业废水处理站处

污染物	主要来源	采取的主要防护措施
		理
废气	实验、生产过程中产生的废气及颗粒物、食堂油烟	生产区域处于相对密封状态，生产废气和颗粒物经集气罩、通风柜、由活性炭吸附后进行有组织的高空排放；食堂油烟经油烟净化器处理后经烟道排放
固体废弃物	废渣、废过滤网、废胶、边角废料以及生产过程中产生的一般废弃物等	一般固废根据固体废弃物的性质进行处理：化学原料包装等交由专业公司处理，原料桶罐交物资公司回收利用，其他生活垃圾集中后定期由环卫部门清理运走；危险固废交由有资质的单位处置
噪声	生产车间内的空压机、加工机械、通风机等设备	合理布局、隔声、吸声、减震、墙体隔声；安装吸声隔音屏、距离衰减等

报告期内，公司严格遵守国家相关的污染排放标准，对生产经营过程中涉及的污染物进行有效管控，没有发生环境污染事故，不存在环保方面的重大违法违规行为。

九、公司境外经营情况

截至本招股说明书签署日，公司拥有的境外经营主体为美科泰贸易、北美德聚、欧洲德聚、韩国德聚、新加坡德聚、马来西亚德聚和越南美科泰，主要为发行人提供境外销售支持等工作，其中北美德聚还存在小规模生产。境外经营主体具体情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、发行人股权结构及控股子公司、分公司、参股公司情况”之“（二）发行人控股子公司、分公司、参股公司情况”。公司境外主要资产情况参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“五、公司主要固定资产、无形资产及经营性资产情况”的相关内容。

第六节 财务会计信息与管理层分析

本节所列财务数据，非经特别说明，均引自经中兴华会计师审计的公司财务报告，或根据其中相关数据计算得出。公司提醒投资者关注和阅读本招股说明书所附财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务会计信息。非经特别说明，本节所列财务数据均为合并口径。若各分项数字之和（或差）与合计数字存在微小差异（如 0.01），系四舍五入原因导致。

一、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	71,182,894.88	48,979,971.94	276,226,366.72
交易性金融资产	214,468,841.01	56,532,615.88	7,132,614.03
应收票据	3,305,971.14	2,869,183.33	5,102,061.77
应收账款	154,102,189.02	145,138,819.53	147,507,995.29
应收款项融资	6,455,475.27	4,788,964.81	26,915,245.68
预付款项	4,788,026.85	10,746,723.57	2,537,461.53
其他应收款	1,726,135.61	1,304,810.79	2,714,650.23
存货	32,841,133.04	30,030,036.96	26,193,580.21
合同资产	2,592,341.00	561,047.75	428,070.00
一年内到期的非流动资产	43,916,699.42	-	-
其他流动资产	92,026,329.43	217,813,400.81	56,973,238.55
流动资产合计	**627,406,036.67**	**518,765,575.37**	**551,731,284.01**
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
投资性房地产	14,310,005.65	14,815,438.09	15,320,870.53
固定资产	345,438,960.64	281,871,361.90	137,569,512.35
在建工程	117,513,659.40	95,416,455.31	130,441,726.85
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	55,840,607.73	61,336,500.62	84,496,020.47
无形资产	54,040,947.87	55,782,406.48	29,802,698.73
开发支出	-	-	-
商誉	6,489,476.11	6,489,476.11	6,489,476.11
长期待摊费用	47,647,635.71	46,173,955.80	27,814,665.03
递延所得税资产	25,452,906.73	15,005,120.71	9,092,823.89
其他非流动资产	15,179,262.19	59,041,352.91	18,050,094.37
非流动资产合计	**681,913,462.03**	**635,932,067.93**	**459,077,888.33**
资产总计	**1,309,319,498.70**	**1,154,697,643.30**	**1,010,809,172.34**
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	1,698,597.67	1,896,779.89
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	10,000,000.00	-
应付账款	42,298,901.49	56,304,160.25	49,023,481.00
预收款项	-	-	-
合同负债	670,051.14	4,914,477.24	500,214.96
应付职工薪酬	43,407,012.37	39,714,532.09	33,730,123.09
应交税费	19,381,850.50	11,129,093.92	7,965,562.21
其他应付款	2,454,526.32	1,792,355.49	2,260,451.34
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	18,136,211.18	68,764,218.27	5,717,636.46
其他流动负债	3,988,793.94	3,897,235.41	1,842,790.39
流动负债合计	**130,337,346.94**	**198,214,670.34**	**102,937,039.34**
非流动负债：	**-**	**-**	**-**
长期借款	123,850,000.00	87,120,000.00	35,960,000.00

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	61,140,304.31	9,382,596.20	83,553,500.63
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	4,405,425.71	229,763.60	337,952.72
递延所得税负债	4,155,332.16	4,038,073.21	3,688,691.51
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	**193,551,062.18**	**100,770,433.01**	**123,540,144.86**
负债合计	**323,888,409.12**	**298,985,103.35**	**226,477,184.20**
股东权益：	**-**	**-**	**-**
股本	73,407,000.00	73,407,000.00	73,407,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	661,552,485.95	655,054,731.37	651,358,356.15
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	1,243,715.64	2,340,328.84	2,110,508.13
专项储备	-	-	-
盈余公积	29,148,405.16	16,454,219.25	6,661,395.27
未分配利润	230,751,514.82	115,605,957.87	53,749,187.51
归属于母公司股东权益合计	996,103,121.57	862,862,237.33	787,286,447.06
少数股东权益	-10,672,031.99	-7,149,697.38	-2,954,458.92
股东权益合计	**985,431,089.58**	**855,712,539.95**	**784,331,988.14**
负债和股东权益总计	**1,309,319,498.70**	**1,154,697,643.30**	**1,010,809,172.34**

（二）合并利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	**457,865,019.59**	**384,890,472.45**	**351,392,148.66**
其中：营业收入	457,865,019.59	384,890,472.45	351,392,148.66

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
二、营业总成本	**317,638,283.46**	**308,864,608.96**	**265,723,190.29**
其中：营业成本	105,369,256.84	97,662,029.20	80,139,181.35
税金及附加	6,175,236.69	3,807,609.27	2,817,985.35
销售费用	74,971,294.80	72,075,384.60	69,236,702.31
管理费用	62,532,100.27	64,810,434.54	56,547,986.24
研发费用	67,992,700.93	69,361,197.08	59,529,414.46
财务费用	597,693.93	1,147,954.27	-2,548,079.42
其中：利息费用	3,276,871.95	5,729,998.28	2,892,604.42
利息收入	4,097,941.35	4,596,400.23	4,469,674.94
加：其他收益	3,028,892.86	4,323,726.89	2,284,217.52
投资收益（损失以“－”号填列）	205,687.90	1,285,626.07	185,020.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,545,016.91	407,466.57	132,614.03
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-626,738.64	14,366.61	-607,605.45
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-6,607,659.30	-4,542,412.97	-34,964,278.33
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-102,008.32	86,244.16	114,000.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	**138,669,927.54**	**77,600,880.82**	**52,812,927.60**
加：营业外收入	271,142.27	194.05	22,304.79
减：营业外支出	996,574.87	601,328.64	340,155.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	**137,944,494.94**	**76,999,746.23**	**52,495,076.47**
减：所得税费用	14,867,102.69	9,545,390.35	10,367,144.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	**123,077,392.25**	**67,454,355.88**	**42,127,932.09**
（一）按经营持续性分类	-	-	-
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	123,077,392.25	67,454,355.88	42,127,932.09
2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-	-
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	127,839,742.86	71,649,594.34	44,664,994.83
2、少数股东损益（净亏损以“－”号	-4,762,350.61	-4,195,238.46	-2,537,062.74

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
填列）			
六、其他综合收益的税后净额	**-1,096,613.19**	**229,820.71**	**284,120.79**
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-1,096,613.19	229,820.71	284,120.79
1、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
（5）其他	-	-	-
2、将重分类进损益的其他综合收益	-1,096,613.19	229,820.71	284,120.79
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-	-
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-
（6）外币财务报表折算差额	-1,096,613.19	229,820.71	284,120.79
（7）其他	-	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	**121,980,779.06**	**67,684,176.59**	**42,412,052.88**
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	126,743,129.67	71,879,415.05	44,949,115.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,762,350.61	-4,195,238.46	-2,537,062.74
八、每股收益：	**-**	**-**	**-**
（一）基本每股收益（元/股）	1.74	0.98	0.64
（二）稀释每股收益（元/股）	1.74	0.98	0.64

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	497,654,049.75	449,629,591.41	424,736,241.73

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
收到的税费返还	3,443,592.29	562,311.88	1,928,371.57
收到其他与经营活动有关的现金	11,340,737.11	9,321,628.94	11,115,732.29
经营活动现金流入小计	512,438,379.15	459,513,532.23	437,780,345.59
购买商品、接受劳务支付的现金	121,630,043.91	127,085,180.16	142,761,518.41
支付给职工以及为职工支付的现金	145,307,689.76	142,328,117.00	123,338,109.91
支付的各项税费	57,326,555.61	37,795,085.19	53,124,289.34
支付其他与经营活动有关的现金	43,514,563.58	44,322,610.81	51,920,129.39
经营活动现金流出小计	367,778,852.86	351,530,993.16	371,144,047.05
经营活动产生的现金流量净额	144,659,526.29	107,982,539.07	66,636,298.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	84,324,191.29	485,126,747.28	31,618,417.35
取得投资收益收到的现金	525,940.39	1,460,315.10	207,174.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	265,387.00	-	196,858.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	213,686,833.00	60,969,315.00	17,493,600.00
投资活动现金流入小计	**298,802,351.68**	**547,556,377.38**	**49,516,049.66**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,948,346.64	144,792,704.15	183,254,716.70
投资支付的现金	254,002,200.92	524,119,282.56	30,618,417.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			5,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	86,960,189.00	251,830,187.78	39,891,255.00
投资活动现金流出小计	**462,910,736.56**	**920,742,174.49**	**258,864,389.05**
投资活动产生的现金流量净额	**-164,108,384.88**	**-373,185,797.11**	**-209,348,339.39**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	1,240,016.00	-	216,190,630.58
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,240,016.00	-	-
取得借款收到的现金	51,730,000.00	61,160,000.00	65,320,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	**62,970,016.00**	**61,160,000.00**	**281,510,630.58**
偿还债务支付的现金	11,698,597.67	198,182.22	52,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,945,271.01	3,187,821.59	80,656,263.49

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	3,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,283,265.95	20,367,726.29	19,462,544.82
筹资活动现金流出小计	**20,927,134.63**	**23,753,730.10**	**152,278,808.31**
筹资活动产生的现金流量净额	**42,042,881.37**	**37,406,269.90**	**129,231,822.27**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-391,099.84**	**550,593.36**	**1,092,729.75**
五、现金及现金等价物净增加额	**22,202,922.94**	**-227,246,394.78**	**-12,387,488.83**
加：期初现金及现金等价物余额	48,979,971.94	276,226,366.72	288,613,855.55
六、期末现金及现金等价物余额	**71,182,894.88**	**48,979,971.94**	**276,226,366.72**

二、审计意见和关键审计事项

（一）审计意见

中兴华会计师审计了发行人报告期内的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度、2024 年度、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

中兴华认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了发行人 2025 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2025 年度、2024 年度、2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

（二）关键审计事项

关键审计事项是中兴华会计师根据职业判断，认为对报告期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，中兴华会计师不对这些事项单独发表意见。中兴华会计师确定 2025 年度、2024 年度、2023 年度的下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1、存货的期末价值

（1）事项描述

关键审计事项适用的会计期间：2025 年度、2024 年度和 2023 年度。

公司与存货相关的会计政策请参阅本招股说明书之“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（十二）存货”。

公司 2025 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日存货余额分别为 3,802.17 万元、3,275.99 万元、2,887.13 万元，计提的存货跌价准备分别为人民币 518.06 万元、272.99 万元、267.77 万元，由于存货金额重大，并且存货跌价准备的测算涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将存货的期末价值确定为关键审计事项。

（2）审计应对

在 2025 年度、2024 年度和 2023 年度财务报表审计中，中兴华会计师针对存货的期末价值实施的重要审计程序包括：

①了解、评估了管理层对公司生产与仓储流程的内部控制的设计，并对关键控制点运行的有效性实施了控制测试；

②执行分析性复核程序，结合公司所处行业发展、产品市场需求及存货周转率等情况，分析存货金额较大的合理性及是否存在减值迹象；

③选取适当样本检查与存货采购真实性及准确性相关的支持性文件，包括但不限于采购合同、采购订单、采购入库单、采购发票、付款凭证等；

④对报告期内的存货采购选取适当样本执行了函证程序及走访、访谈程序，检查存货采购的真实性及完整性；

⑤对期末的存货盘点实施了监盘程序，检查存货的数量并观察存货的状态，分析期末存货是否真实存在，是否存在减值迹象；

⑥对报告各期存货的发出进行计价测试，检查发出结转金额和结存金额是否准确；

⑦获取报告期各期末的存货库龄明细表、存货跌价准备计算表，复核存货库龄及存货可变现净值的准确性，评估各期末存货跌价准备的计提是否充分。

2、营业收入的确认

（1）事项描述

关键审计事项适用的会计期间：2025 年度、2024 年度及 2023 年度。

公司与营业收入确认相关的会计政策请参阅本招股说明书之“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（二十七）收入确认的原则和计量方法”。

公司主要从事电子胶粘剂的研发、生产和销售，公司 2025 年度、2024 年度和 2023 年度的营业收入分别为 45,786.50 万元、38,489.05 万元、35,139.21 万元。由于收入金额重大且为关键业绩指标，所以可能存在收入被确认于不恰当的期间或被操控以达到预期目标的风险，因此，我们把收入确认确定为关键审计事项。

（2）审计应对

在 2025 年度、2024 年度和 2023 年度财务报表审计中，中兴华会计师针对营业收入确认实施的重要审计程序包括：

①了解和测试与销售和收款相关的关键内部控制设计和运行的有效性，复核相关的会计政策是否正确且一贯地运用；

②结合产品类型及客户类别对收入和毛利率执行实质性分析程序，评价销售业务的规模及变化趋势是否合理；

③对销售和发货记录抽样执行细节测试，检查公司销售合同（订单）、出库单、客户签收单、对账单、发票、出口报关单、货运提单、银行回款单据、会计凭证等文件，评价相关收入确认是否真实准确、符合公司收入确认的会计政策；

④向主要客户发函确认销售金额以及应收账款余额，并对主要客户现场走访，核实收入确认的真实性、准确性、完整性；

⑤对营业收入执行截止性测试，评价收入是否记录在恰当的会计期间。

三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），

以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的规定编制。

（二）合并财务报表范围及变化情况

1、截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表范围内存续的子公司如下：

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
1	青岛德聚胶接技术有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
2	苏州美科泰制程电子科技有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
3	CollTech North America	全资子公司	一级	100%	100%
4	CollTech South Asia PTE	全资子公司	二级	100%	100%
5	CollTech Malaysia SDN. BHD	全资子公司	三级	100%	100%
6	CollTech Europe GmbH.	全资子公司	一级	100%	100%
7	CollTech Technology Co.,Ltd	全资子公司	一级	100%	100%
8	深圳市美科泰科技有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
9	美科泰贸易有限公司	全资子公司	二级	100%	100%
10	上海濠茂科技有限公司	全资子公司	二级	100%	100%
11	上海锐朗光电材料有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
12	南通德聚半导体材料有限公司	控股子公司	一级	61.33%	61.33%
13	南通德聚精密膜材料有限公司	控股子公司	一级	100%	100%
14	江苏德聚新材料科技有限公司	全资子公司	一级	100%	100%
15	如东德聚胶粘技术有限公司	全资子公司	一级	100%	100%

2、报告期内，纳入合并财务报表范围的主体增加 4 户，减少 2 户，具体如下：

（1）报告期内新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
如东德聚胶粘技术有限公司	设立
德聚化学材料（深圳）有限公司	设立
CollTech South Asia PTE.LTD	设立
CollTech Malaysia SDN.BHD	设立

如东德聚胶粘技术有限公司于 2023 年 5 月 5 日新设成立，自成立之日起至报告期末，由发行人持股 100%，自成立之日起纳入合并范围；德聚化学材料（深圳）有限公司于 2023 年 7 月 31 日新设成立，江苏德聚持股 100.00%，自成立之

日起纳入合并范围；CollTech South Asia PTE.LTD 于 2025 年 9 月 15 日成立，CollTech North America 持股 100.00%，自成立之日起纳入合并范围；CollTech Malaysia SDN.BHD 于 2025 年 9 月 19 日成立，CollTech South Asia PTE.LTD 持股 100.00%，自成立之日起纳入合并范围。

（2）报告期内不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
广州德聚埔材半导体技术有限公司	注销
德聚化学材料（深圳）有限公司	注销

广州德聚埔材半导体技术有限公司于 2024 年 11 月 11 日完成工商注销，自注销之日起不再纳入合并范围，德聚化学材料（深圳）有限公司于 2024 年 12 月 24 日完成工商注销，自注销之日起不再纳入合并范围。

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

本公司的重要会计政策及会计估计如下：

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2025 年度、2024 年度、2023 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度，本报告期为 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（三）营业周期

公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采

用的货币为人民币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的

合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

（六）控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1、控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。通常包括母公司拥有其半数以上的表决权的被投资单位和公司虽拥有其半数以下的表决权但通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营决策；有权任免被投资单位的董事会的多数成员；在被投资单位董事会占多数表决权。

2、合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以

“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

（八）现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（九）外币业务和外币报表折算

1、外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2、对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性

项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

3、外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期加权平均汇率折算。上年年末未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置

当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（十）金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（1）以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或

利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2、金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身

信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是

否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

4、金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（十一）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1、减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

2、信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

（1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

（2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

（3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

（4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

（5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

3、以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等，在组合的基础上评估信用风险。

4、金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

5、各类金融资产信用损失的确定方法

（1）应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项　目	确定组合的依据
银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强
商业承兑汇票组合	出票人未经权威性的信用评级，或出票人历史上发生过票据违约，存在一定信用损失风险，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力存在不确定性

（2）应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项　目	确定组合的依据
组合一：合并范围内关联方	合并范围内关联方往来款项
组合二：账龄分析法组合	包括除上述组合之外的应收款项

①本公司应收款项账龄从发生日开始计算。

组合中，采用账龄组合计提预期信用损失的组合计提方法：

账龄	应收票据计提比例（%）	应收账款计提比例（%）	合同资产计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	5.00	5.00	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00	20.00	20.00
3-4 年	30.00	30.00	30.00	30.00
4-5 年	50.00	50.00	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00	100.00

②按照单项认定单项计提的坏账准备的判断标准：

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

1）发行方或债务人发生重大财务困难；

2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；

5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合一：银行承兑汇票组合	承兑人为信用等级较高的银行
组合二：商业承兑汇票组合	除银行承兑汇票之外的应收票据
组合三：账龄分析法组合	包括除上述组合之外的应收款项

（4）其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项　目	确定组合的依据
组合一：合并范围内关联方	合并范围内关联方往来款项
组合二：账龄分析法组合	包括除上述组合之外的其他应收款项

（十二）存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的半成品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。存货主要包括

原材料、半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资、合同履约成本等。

2、发出的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

3、存货的盘存制度为永续盘存制。

4、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

5、存货跌价准备的确认标准和计提方法

存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（十三）持有待售和终止经营

1、持有待售的非流动资产和处置组

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组

是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

2、终止经营的认定标准和列报方法

终止经营是指满足下列条件之一、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个独立的主营经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个

单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（十四）长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

1、投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之

前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2、后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放

的现金股利或利润确认。

（2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本节“（六）控制的判断标准和合并财务报表的编制方法”之“2、合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

（十五）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节之“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（二十）长期资产减值”。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

（十六）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	直线法	3-10	5	9.50-31.67
运输设备	直线法	4	5	23.75
电子及其他设备	直线法	3-5	5	19-31.67

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

3、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节之“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（二十）长期资产减值”。

4、其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价

值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

（十七）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节之“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（二十）长期资产减值”。

（十八）借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得

的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（十九）无形资产

1、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

有限使用寿命的无形资产项目的使用寿命、确定依据及摊销方法如下：

项　目	使用寿命	使用寿命的确定依据	摊销方法
土地使用权	土地使用权证有效期限	按土地权证有限期估计	直线法分期平均摊销
专利权	3-10	预计受益期限	直线法分期平均摊销
非专有技术	3-20	预计受益期限	直线法分期平均摊销
软件	3-10	合同约定年限或预计受益期限	直线法分期平均摊销
商标	8	预计受益期限	直线法分期平均摊销

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

2、研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

本公司研发支出归集范围包括研发领用的材料、人工及劳务成本、研发设备摊销、在开发过程中使用的其他无形资产及固定资产的摊销、水电等费用。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段；开发阶段为在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司开发阶段支出资本化在同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

内部研究开发支出的资本化时点：开发项目立项完成且预计能形成产生经济利益的研发技术产品时。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

3、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节之“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（二十）长期资产减值”。

（二十）长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（二十一）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费及软件服务费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

（二十二）合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，

不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

（二十三）职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。

其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

（二十四）预计负债

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十五）租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

（1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；

（3）在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；

（4）在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；

（5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

（二十六）股份支付

1、股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩

条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，

本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（二十七）收入确认原则和计量方法

1、收入的确认一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2、收入确认的具体方法

公司主要销售电子胶粘剂等电子专用高分子材料，公司收入确认的具体方法为：

（1）内销部分

①电子胶粘剂等电子专用高分子材料及配套材料销售

按签收确认收入：根据合同（订单）约定，在与客户约定的交货地点将货物

交付客户，在取得客户签收确认的签收单据时确认销售收入；

按对账确认收入：根据合同（订单）约定，在与客户约定的交货地点将货物交付客户，在与客户约定的对账日，将上一对账日至本期对账日期间客户验收的货物进行核对，在取得客户对账确认的对账单据时确认销售收入。其中，对于寄售的客户，按客户要求送至指定仓库，在客户实际领用并取得客户对账确认的对账单据时确认销售收入。

②电子胶粘剂配套设备销售

在设备交付客户并经客户安装验收后，取得客户确认的设备验收单据时确认销售收入。

③电子胶粘剂配套设备租赁

公司根据双方约定的租赁期间，按租赁期分期确认销售收入。

（2）外销部分

对于外销的产品：公司采用 FOB 或 CIF 方式出口的，公司将货物运至出口港并报关装船后，公司以取得货运提单或海关核准的报关单据时确认销售收入；对于指定收货地点的外销客户，公司将货物运至客户指定地点，取得客户或客户指定承运人收货确认的签收单据或承运人出具的货运提单时确认销售收入。

（二十八）合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认

为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（二十九）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付

是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

（三十）递延所得税资产、递延所得税负债

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或者事

项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

（三十一）租赁

1、本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房屋。

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

（1）使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供

的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2、本公司作为出租人

（1）经营租赁

本公司采用直线法或其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（三十二）重要性标准确定方法和选择依据

涉及重要性判断标准的披露事项	重要性标准确定方法和选择依据
重要的单项计提坏账	公司将单项应收账款金额超过资产总额 5%的应收账款认定为重要

涉及重要性判断标准的披露事项	重要性标准确定方法和选择依据
准备的应收账款	应收账款
重要的应收账款坏账准备收回或转回	公司将单项应收账款金额超过资产总额 5%的应收账款认定为重要应收账款
重要的核销应收账款	公司将单项应收账款金额超过资产总额 5%的应收账款认定为重要应收账款
重要的其他应收款坏账准备收回或转回	公司将单项其他应收款金额超过资产总额 5%的其他应收款认定为重要其他应收款
重要的核销其他应收款	公司将单项其他应收款金额超过资产总额 5%的其他应收款认定为重要其他应收款
重要的在建工程项目	公司将单项在建工程金额超过资产总额 2%的在建工程认定为重要在建工程
重要的子公司、非全资子公司	公司将资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的 5%的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司

五、重要的会计政策、会计估计变更

（一）重要会计政策变更

1、会计政策变更

单位：万元

序号	会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
1	公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”	无	递延所得税资产、递延所得税负债	572.97
2	公司自 2023 年 10 月 25 日起执行财政部 2023 年发布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回的会计处理”	无	无	无
3	公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 18 号的规定“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”	无	无	无

（1）执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》〔财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司在 2021 年度提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关

股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2023 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2023 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。

根据解释 16 号的相关规定，本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日原列报金额	累积影响金额	2023 年 1 月 1 日调整后列报金额
递延所得税资产	1,139.60	-572.97	566.63
递延所得税负债	876.63	-572.97	303.66

②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

执行解释 16 号关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理的规定对本报告期内财务报表无重大影响。

③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

执行解释 16 号关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理对本报告期内财务报表无重大影响。

（2）执行企业会计准则解释第 17 号对本公司的影响

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释 17 号”），本公司自 2023 年 10 月 25 日起施行“关于售后租回交易的会计处理”。

执行“关于售后租回交易的会计处理”对本报告期内财务报表无重大影响。

（3）执行企业会计准则解释第 18 号对本公司的影响

2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号，以下简称“解释 18 号”），解释 18 号“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 18 号的规定。

执行“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”对本报告期内财务报表无重大影响。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

六、非经常性损益

根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定，公司编制了申报期内的非经常性损益明细表，并由中兴华出具了中兴华核字（2026）第 00003238 号《广东德聚技术股份有限公司非经常性损益审核报告书》。报告期内，公司非经常性损益的具体情况如下：

单位：万元

非经常性损益项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	-100.27	5.59	2.45
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外；	195.8	269.08	142.81
3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益；	275.07	169.31	31.76
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出。	17.53	-57.08	-22.84
5、其他符合非经常性损益定义的损益项目	18.54	-1,007.18	6.08
扣除所得税前非经常性损益合计	406.67	-620.28	160.27
减：所得税影响金额	76.48	-65.79	25.86
扣除所得税后非经常性损益合计	330.19	-554.49	134.41
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）	3.49	5.46	3.36

非经常性损益项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
归属于母公司所有者的非经常性损益净利润额	**326.69**	**-559.94**	**131.05**

报告期内，公司非经常性损益对当期经营成果的影响如下：

单位：万元

非经常性损益明细	2025 年度	2024 年度	2023 年度
归属于发行人股东的非经常性损益	326.69	-559.94	131.05
归属于发行人股东的净利润	12,783.97	7,164.96	4,466.50
归属于发行人股东的非经常性损益占归属于发行人股东的净利润的比例	2.56%	-7.81%	2.93%
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润	**12,457.28**	**7,724.90**	**4,335.45**

报告期内，公司非经常性损益金额主要为政府补助及持有交易性金融资产等投资取得的投资收益。

报告期内，公司归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为 131.05 万元、-559.94 万元和 326.69 万元，占归属于发行人股东的净利润比例较低，分别为 2.93%、-7.81%和 2.56%。

七、主要税项及税收优惠

（一）公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	以境内销售，提供加工、修理修配劳务的销售额	13%
	以有形动产租赁服务	13%
	以不动产租赁服务	9%
	应税销售服务销售额	6%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
房产税	房产原值的 70%或租金收入	12%或 1.2%

除下述主体外，合并范围内其他主体均按照 25%税率缴纳企业所得税：

纳税主体名称	所得税税率
发行人、青岛德聚、上海锐朗、南通德聚半导体	15%
北美德聚、欧洲德聚、韩国德聚、新加坡德聚、	境外注册的公司按境外所得税法执行

纳税主体名称	所得税税率
马来西亚德聚	
美科泰贸易	不超过200万港币的应评税利润按8.25%，应评税利润中超过200万港币的部分按16.5%
苏州美科泰	按照小型微利企业优惠税率执行
德聚埔材（已注销）	

（二）税收优惠

1、公司2021年12月20日取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR202144005735，有效期三年），2023年享受15%的企业所得税优惠税率。本公司2024年12月11日取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR202444010004，有效期三年），2024年至2025年享受15%的企业所得税优惠税率。

2、公司之子公司青岛德聚胶接技术有限公司2022年12月14日取得了青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR202237102158，有效期三年），2023年至2024年享受15%的企业所得税优惠税率。

3、公司之子公司上海锐朗光电材料有限公司于2021年11月18日收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR202131001357，有效期三年），2023年享受15%的企业所得税优惠税率。本公司之子公司上海锐朗光电材料有限公司于2024年12月4日收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR202431002149，有效期三年），2024年至2025年享受15%的企业所得税优惠税率。

4、公司之子公司南通德聚半导体材料有限公司2024年12月16日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR202432013749，有效期三年），2024年至2025年享受15%的企业所得税优惠税率。

5、根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》

（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）文件有关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司苏州美科泰制程电子科技有限公司 2025 年享受小型微利企业税收优惠、广州德聚埔材半导体技术有限公司 2023 年至 2024 年享受小型微利企业税收优惠。

6、根据香港特别行政区《2018 年税务（修订）（第 3 号）条例》的规定，美科泰贸易有限公司自报告期开始的课税年度采用两级制税率，不超过 200 万港币的应评税利润按 8.25%的利得税率，应评税利润中超过 200 万港币的部分按 16.5%的利得税率。

7、根据 2023 年 9 月 3 日《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号）的相关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。公司自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日可享受上述税收优惠政策。

八、主要财务指标

（一）基本财务指标

主要财务指标	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	4.81	2.62	5.36
速动比率（倍）	4.56	2.47	5.11
资产负债率（母公司）（%）	19.74	19.68	14.59
资产负债率（合并）（%）	24.74	25.89	22.41
利息保障倍数（倍）	43.10	14.44	19.15
主要财务指标	**2025 年度**	**2024 年度**	**2023 年度**
应收账款周转率（次）	3.06	2.63	2.49
存货周转率（次）	3.35	3.47	3.05
息税折旧摊销前利润（万元）	18,636.11	12,607.82	8,087.84
归属于母公司股东净利润（万元）	12,783.97	7,164.96	4,466.50
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润（万元）	12,457.28	7,724.90	4,335.45
研发投入占营业收入的比例（%）	14.85	18.02	16.94

每股经营活动产生的现金流量（元）	1.97	1.47	0.91
每股净现金流量（元）	0.30	-3.10	-0.17
每股净资产（元）	13.57	11.75	10.72

注：上述财务指标的计算方法如下：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=负债总额/资产总额
利息保障倍数=（净利润+所得税费用+利息支出）/利息支出
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值
存货周转率=营业成本/存货平均账面价值
息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息支出＋折旧摊销
研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入
每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本
每股净资产=归属于母公司股东净资产/期末总股本

（二）净资产收益率及每股收益

按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算的公司净资产收益率和每股收益如下表所示：

报告期利润		加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2025 年度	净利润	13.75	1.74	1.74
	扣除非经常性损益后的净利润	13.40	1.70	1.70
2024 年度	净利润	8.68	0.98	0.98
	扣除非经常性损益后的净利润	9.36	1.05	1.05
2023 年度	净利润	6.78	0.64	0.64
	扣除非经常性损益后的净利润	6.58	0.62	0.62

九、盈利预测及报告

公司未编制盈利预测报告。

十、经营成果分析

（一）经营情况概述

报告期内，公司主要经营情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	45,786.50	38,489.05	35,139.21
营业成本	10,536.93	9,766.20	8,013.92
毛利	35,249.58	28,722.84	27,125.30
毛利率	76.99%	74.63%	77.19%
营业利润	13,866.99	7,760.09	5,281.29
利润总额	13,794.45	7,699.97	5,249.51
净利润	12,307.74	6,745.44	4,212.79
归属于母公司股东的净利润	12,783.97	7,164.96	4,466.50
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	12,457.28	7,724.90	4,335.45

公司坚持技术驱动的发展路线，持续进行产品创新迭代并拓展应用场景及客户资源，报告期内不断巩固和扩大产品与技术优势。凭借优秀的研发实力及多年的研发积累，与苹果、特斯拉、OPPO、华为、阳光电源、比亚迪、vivo、小米、三星、宁德时代等全球知名科技企业的长期深度合作。

报告期内，公司的营业收入分别为35,139.21万元、38,489.05万元和45,786.50万元，公司归属于母公司股东的净利润分别为 4,466.50 万元、7,164.96 万元和 12,783.97 万元，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 4,335.45 万元、7,724.90 万元及 12,457.28 万元。

（二）营业收入分析

1、营业收入总体情况分析

报告期内，公司营业收入总体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	45,696.55	99.80%	38,438.74	99.87%	35,075.78	99.82%
其他业务收入	89.95	0.20%	50.31	0.13%	63.44	0.18%
合计	**45,786.50**	**100.00%**	**38,489.05**	**100.00%**	**35,139.21**	**100.00%**

公司主营业务为电子专用高分子材料的研发、生产和销售，并为客户提供电子胶粘剂产品及配套应用方案。报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入分别为 35,075.78 万元、38,438.74 万元和 45,696.55 万元，2025 年较 2024 年增长

18.88%，2024 年较 2023 年增长 9.59%。主营业务收入变动的主要原因如下：

（1）胶粘剂行业快速发展，各应用领域需求提升

随着行业发展，电子胶粘剂的应用领域范围不断扩大，诸如智能终端、新能源汽车、可再生能源、半导体、通信等战略性新兴市场对电子胶粘剂的需求日益强劲，具体表现在如智能终端产品出货量快速增长，汽车电子化、半导体先进封装等方面带来的用胶量增加。

（2）本土化配套进程加快，为公司提供发展机遇

近年来，国家对以半导体行业为代表的战略性新兴产业供应链的自主发展愈发重视，本土化配套意愿显著提高，为国内企业替代国外厂商创造了有利的窗口条件。与此同时，国内的电子胶粘剂企业在技术研发和生产能力方面不断发展，在部分领域已经接近或达到国际先进水平。电子胶粘剂行业的本土化发展进程正逐步加快，为公司提供了难得的发展机遇。

（3）持续的研发投入及卓越的研发实力，成为公司持续发展的有力保障

自成立以来，公司专注于高端电子胶粘剂产品的研发及产业化，形成了从应用市场需求理解，到产品配方开发，再到产品分析测试的体系化研发优势。截至招股说明书签署日，公司已获发明专利授权 65 项、实用新型专利授权 49 项；2024 年 12 月，获工业和信息化部认定为新一轮第一批支持的重点“小巨人”企业及工业和信息化部通过复核的第三批专精特新“小巨人”企业，经广东省科学技术厅认定为“广东省新型高端电子胶粘剂（德聚）工程技术研究中心”，经广东省工业和信息化厅认定为“第 22 批省级企业技术中心”等荣誉或称号。同时，凭借对于电子专用高分子材料技术的深厚积累，公司产品品类持续增加，实现了从智能终端领域向新能源、半导体领域的持续扩展。公司长期的研发投入及出色的研发实力成为保障长期持续发展的重要基础。

（4）持续积累并拓展客户，与终端品牌商建立长期稳定合作关系

经过多年发展和沉淀，公司成功进入苹果、特斯拉、OPPO、华为、阳光电源、比亚迪、vivo、小米、三星、宁德时代等全球知名科技企业的供应体系，并且公司在美国、德国、韩国等地均设立子公司，深度服务终端品牌商，给予客户高效、及时的服务响应，以保持客户粘性。公司凭借自身优秀的研发体系、过硬

的产品质量以及快速高效的服务能力，与终端品牌商建立了长期稳定的合作关系。

2、主营业务收入按产品类型分析

报告期内，公司的主要产品包括电子胶粘剂及配套的设备和材料，主营业务收入按产品类型划分情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
电子胶粘剂	44,451.36	97.28%	37,610.12	97.84%	34,480.77	98.30%
配套设备与材料及其他	1,245.19	2.72%	828.62	2.16%	595.01	1.70%
合计	**45,696.55**	**100.00%**	**38,438.74**	**100.00%**	**35,075.78**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务收入中电子胶粘剂产品的金额分别为 34,480.77 万元、37,610.12 万元、44,451.36 万元，占主营业务收入的比例分别为 98.30%、97.84%、97.28%。

配套设备与材料及其他产品类型的金额分别为 595.01 万元、828.62 万元、1,245.19 万元，占主营业务收入的比例分别为 1.70%、2.16%、2.72%，该业务收入主要系销售的胶粘剂固化设备及配件等，报告期内，相关增长主要得益于公司为强化客户服务能力，积极推动电子胶粘剂与配套设备的协同销售。

3、主营业务收入按产品应用领域分析

报告期内，公司主营业务收入按产品类别划分的构成情况如下：

单位：万元

项目	业务类型	应用领域	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
			金额	占比	金额	占比	金额	占比
电子胶粘剂	自产	智能终端	29,767.17	65.14%	24,908.11	64.80%	20,639.77	58.84%
		新能源	7,563.41	16.55%	6,142.09	15.98%	5,574.68	15.89%
		半导体	3,991.45	8.73%	3,410.48	8.87%	3,529.42	10.06%
		通信	2,439.89	5.34%	1,817.99	4.73%	2,083.11	5.94%
		其他领域	26.00	0.06%	29.53	0.08%	24.93	0.07%
		小计	**43,787.91**	**95.82%**	**36,308.20**	**94.46%**	**31,851.90**	**90.81%**
	贸易		663.45	1.45%	1,301.91	3.39%	2,628.87	7.49%
	电子胶粘剂小计		**44,451.36**	**97.28%**	**37,610.12**	**97.84%**	**34,480.77**	**98.30%**

项目	业务类型	应用领域	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
			金额	占比	金额	占比	金额	占比
配套设备与材料及其他	贸易		1,245.19	2.72%	828.62	2.16%	595.01	1.70%
合计			**45,696.55**	**100.00%**	**38,438.74**	**100.00%**	**35,075.78**	**100.00%**

注：“配套设备与材料及其他”包括材料销售，设备产品配件销售等。

报告期内，公司主营业务收入主要来源于电子胶粘剂和配套设备与材料，其中主要为电子胶粘剂的生产和销售。

电子胶粘剂按业务类型可进一步区分为自产和贸易，其中以自产为主。自产业务类型的收入金额分别为 31,851.90 万元、36,308.20 万元和 43,787.91 万元，占主营业务收入比例分别为 90.81%、94.46%和 95.82%。

公司自产电子胶粘剂按下游应用领域可进一步细分为智能终端、新能源、半导体、通信和其他领域，应用于智能终端的电子胶粘剂产品销售金额分别为 20,639.77 万元、24,908.11 万元和 29,767.17 万元，占主营业务收入的比例分别为 58.84%、64.80%和 65.14%；应用于新能源的电子胶粘剂产品销售金额分别为 5,574.68 万元、6,142.09 万元和 7,563.41 万元，占主营业务收入的比例分别为 15.89%、15.98%和 16.55%；报告期内，智能终端和新能源两个领域的收入合计占公司主营业务收入的比例均超过 70%，为主营业务收入的主要来源，其他领域的收入贡献相对较小。

（1）智能终端领域

报告期内，公司自产智能终端的电子胶粘剂产品销售金额分别为 20,639.77 万元、24,908.11 万元和 29,767.17 万元，销售金额持续增长，2025 年较 2024 年增长 19.51%，2024 年较 2023 年增长 20.68%，主要受益于公司下游终端品牌商智能终端产品的需求量的快速增长，消费者对手机、电脑、耳机等智能终端的需求量持续升高，从而带动上游智能终端电子胶粘剂的销量。

报告期内，公司智能终端收入构成中 80%以上为元器件包封胶产品，具体如下表所示：

单位：万元

智能终端产品	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
元器件包封胶	27,004.82	90.72%	22,160.21	88.97%	18,916.91	91.65%
其他自产产品	2,762.34	9.28%	2,747.90	11.03%	1,722.86	8.35%
合计	**29,767.17**	**100.00%**	**24,908.11**	**100.00%**	**20,639.77**	**100.00%**

报告期内，公司智能终端领域区分产品类别的销售数量和销售价格情况如下：

单位：千克、元/千克

智能终端产品	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	销售数量	平均单价	销售数量	平均单价	销售数量	平均单价
元器件包封胶	41,059.52	6,576.99	33,328.80	6,648.97	27,978.75	6,761.17
其他自产产品	105,379.79	262.13	76,507.85	359.17	40,314.22	427.36
合计	**146,439.31**	**2,032.73**	**109,836.65**	**2,267.74**	**68,292.96**	**3,022.24**

1）元器件包封胶

报告期内，公司智能终端领域元器件包封胶收入分别为 18,916.91 万元、22,160.21 万元和 27,004.82 万元，占智能终端产品销售金额比例分别为 91.65%、88.97%和 90.72%，系公司智能终端领域的主力产品。该产品主要用于 FPC（柔性线路板）上元器件的包封和保护。元器件包封胶的应用点以手机、电脑、平板、TWS 耳机、智能手表等终端产品为主，客户包括苹果、OPPO 等国内外智能终端知名企业。

报告期内，公司自产的元器件包封胶销量因下游终端品牌商产品需求增长而不断提升，销量的增长对产品销售收入变化影响较大。元器件包封胶产品的单价随着销量的提升和客户采购量的提升略有降低。

2）其他自产产品

报告期内，公司智能终端领域其他型号自产产品，包括反应型聚氨酯热熔胶、耐无铅回流环氧胶等，报告期内收入分别为 1,722.86 万元、2,747.90 万元和 2,762.34 万元，占智能终端领域产品销售金额比例相对较低。公司其他自产产品种类较多，随着产品销售结构性变动的影响，公司其他自产产品的平均销售单价也随之变动。

（2）新能源领域

报告期内，公司自产新能源领域电子胶粘剂产品销售金额分别为 5,574.68 万元、6,142.09 万元和 7,563.41 万元，销售金额持续增长。2025 年公司新能源领域电子胶粘剂产品销售金额较 2024 年增长 23.14%，主要系公司研发了新能源汽车动力电池、电控等核心部件的电子胶粘剂产品和解决方案，并逐步通过客户的测试验证从而实现量产导入，相关收入快速提升。

报告期内，公司新能源领域收入构成的产品主要包括磁芯粘接胶、包封补强胶、密封胶等。随着各产品在下游客户的测试验证及量产进度不同，报告期各期各主要产品占该领域的收入比例有所波动，具体如下表所示：

单位：万元

新能源产品	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
磁芯粘接胶	4,599.51	60.81%	1,703.25	27.73%	761.76	13.66%
包封补强胶	835.23	11.04%	1,690.21	27.52%	3,695.31	66.29%
密封胶	441.04	5.83%	1,546.06	25.17%	548.71	9.84%
其他自产产品	1,687.62	22.31%	1,202.57	19.58%	568.90	10.21%
合计	**7,563.41**	**100.00%**	**6,142.09**	**100.00%**	**5,574.68**	**100.00%**

报告期内，公司新能源领域区分产品类别的销售数量和销售价格情况如下：

单位：千克、元/千克

新能源产品	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	销售数量	平均单价	销售数量	平均单价	销售数量	平均单价
磁芯粘接胶	3,699.96	12,431.25	1,375.91	12,379.07	363.93	20,931.44
包封补强胶	3,740.15	2,233.15	10,302.43	1,640.59	20,579.72	1,795.61
密封胶	22,651.76	194.71	475,493.62	32.51	229,684.05	23.89
其他自产产品	285,523.20	59.11	301,667.98	39.86	98,470.59	57.77
合计	**315,615.07**	**239.64**	**788,839.94**	**77.86**	**349,098.29**	**159.69**

1）磁芯粘接胶

报告期内，公司新能源领域磁芯粘接胶收入分别为 761.76 万元、1,703.25 万元和 4,599.51 万元，占新能源产品销售金额比例分别为 13.66%、27.73%和 60.81%，系公司新能源领域主要产品之一，是新能源汽车电控系统中平面变压器和电感的核心粘接材料。随着该产品在终端品牌商的顺利导入，报告期内该产品销量呈现

快速增长，产品的平均单价在 2024 年和 2025 年大批量销售后也保持相对稳定。

2）包封补强胶

报告期内，公司新能源领域包封补强胶收入分别为 3,695.31 万元、1,690.21 万元和 835.23 万元，占新能源产品销售金额比例分别为 66.29%、27.52%和 11.04%，该产品主要用于汽车电子连接器补强、汽车电子 PCB 元器件固定补强、动力电池集成母排（CCS）FPC 元器件包封，报告期内该产品销售金额下降明显，主要系公司终端品牌商需求下降所致。

3）密封胶

报告期内，公司新能源领域密封胶合计收入分别为 548.71 万元、1,546.06 万元和 441.04 万元，占新能源产品销售金额比例分别为 9.84%、25.17%和 5.83%。报告期内，公司密封胶收入呈现波动，主要受 2024 年度公司向特定客户销售有机硅密封胶，前述产品单价较低、出货量较大，公司主动终止了该产品的销售，导致 2025 年该产品的销售同比下降较多。

4）其他自产产品

报告期内，公司新能源领域其他自产产品合计收入分别为 568.90 万元、1,202.57 万元和 1,687.62 万元。报告期内，产品销量逐年递增，销量的增长对产品销售收入变化影响较大。公司其他系列自产产品种类较多，且每年存在新产品销售的情况，因此单价存在一定波动。

（3）半导体领域

报告期内，公司自产半导体胶粘剂产品销售金额分别为 3,529.42 万元、3,410.48 万元和 3,991.45 万元，占主营业务收入的比例分别为 10.06%、8.87%和 8.73%。公司半导体胶粘剂产品主要为导热界面材料、底部填充胶等。另外，公司正在持续研发芯片塑封隔离膜、芯片固晶胶膜（DAF）及 AA 制程胶等新产品，相关产品已在多家客户进行认证测试，未来随着多家客户完成认证测试，产品逐渐实现批量出货，公司在半导体领域的收入将实现进一步突破。

报告期内，公司半导体领域收入的构成产品较为多样，主要为导热界面材料和底部填充胶等产品。具体如下表所示：

单位：万元

半导体产品	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
导热界面材料	1,628.45	40.80%	1,191.36	34.93%	2,143.34	60.73%
底部填充胶	1,422.26	35.63%	1,616.53	47.40%	890.74	25.24%
其他自产产品	940.73	23.57%	602.59	17.67%	495.33	14.03%
合计	**3,991.45**	**100.00%**	**3,410.48**	**100.00%**	**3,529.42**	**100.00%**

报告期内，公司半导体领域分产品类别的销售数量和销售价格情况如下：

单位：千克、元/千克

半导体产品	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	销售数量	平均单价	销售数量	平均单价	销售数量	平均单价
导热界面材料	33,662.60	483.76	21,326.95	558.62	39,469.03	543.04
底部填充胶	4,275.09	3,326.87	4,235.67	3,816.46	2,753.93	3,234.42
其他自产产品	4,458.73	2,109.86	2,732.69	2,205.12	1,393.23	3,555.30
合计	**42,396.41**	**941.46**	**28,295.32**	**1,205.32**	**43,616.19**	**809.20**

1）导热界面材料

报告期内，公司半导体领域导热界面材料收入分别为 2,143.34 万元、1,191.36 万元和 1,628.45 万元，占半导体产品销售金额比例分别为 60.73%、34.93%和 40.80%，系公司半导体领域主要产品之一，产品主要用于半导体功率器件、芯片封装等领域。报告期内，公司导热界面材料因处于产品更新换代的导入爬坡期，销售金额与销售量出现一定波动，产品单价基本保持平稳。

2）底部填充胶

报告期内，公司半导体领域底部填充胶收入分别为 890.74 万元、1,616.53 万元和 1,422.26 万元，占半导体产品销售金额比例分别为 25.24%、47.40%和 35.63%，系公司半导体领域主要产品之一，产品主要用于电脑主板芯片边角绑定、芯片板级底部填充等。该产品技术附加值高，客户对性能指标要求严格，报告期内，随着客户导入逐步成熟，2024 年该产品销售金额与销售量相比上年增长较多，2025 年相对平稳，整体单价相对处于较高水平。

3）其他自产产品

报告期内，公司半导体领域其他自产产品包括固晶胶、AA 制程胶、半导体

模组封装结构胶、芯片塑封隔离膜等，合计收入分别为 495.33 万元、602.59 万元和 940.73 万元，占半导体产品销售金额比例分别为 14.03%、17.67%和 23.57%。报告期内，产品销量逐年递增，销量的增长对产品销售收入变化影响较大。公司其他系列自产产品种类较多，单价存在一定波动。

（4）通信领域

报告期内，公司自产通信领域电子胶粘剂产品销售金额分别为 2,083.11 万元、1,817.99 万元和 2,439.89 万元，占主营业务收入的比例分别为 5.94%、4.73%和 5.34%。公司通信领域电子胶粘剂产品主要为电磁屏蔽材料，主要用于 5G 基站、数据中心服务器等高频高速通信领域的电磁屏蔽。

报告期内，公司通信领域收入构成中主要为电磁屏蔽胶产品。具体如下表所示：

单位：万元

通信产品	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
电磁屏蔽胶	2,423.76	99.34%	1,799.81	99.00%	2,063.10	99.04%
其他自产产品	16.12	0.66%	18.17	1.00%	20.01	0.96%
合计	**2,439.89**	**100.00%**	**1,817.99**	**100.00%**	**2,083.11**	**100.00%**

报告期内，公司通信领域区分产品类别的销售数量和销售价格情况如下：

单位：千克、元/千克

通信产品	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	销售数量	平均单价	销售数量	平均单价	销售数量	平均单价
电磁屏蔽胶	41,237.04	587.76	32,189.31	559.13	30,493.43	676.57
其他自产产品	978.26	164.80	493.27	368.44	318.03	629.22
合计	**42,215.30**	**577.96**	**32,682.58**	**556.26**	**30,811.46**	**676.08**

1）电磁屏蔽胶

公司通信领域胶粘剂产品主要为电磁屏蔽材料，系子公司上海锐朗的主要产品。报告期内，公司通信领域电磁屏蔽胶合计收入分别为 2,063.10 万元、1,799.81 万元和 2,423.76 万元，占通信产品销售金额比例分别为 99.04%、99.00%和 99.34%。报告期内，该产品的销售数量稳步增长，平均销售价格和销售金额基本稳定。

2）其他自产产品

报告期内，公司通信领域其他自产产品合计收入分别为 20.01 万元、18.17 万元和 16.12 万元，占通信产品销售金额比例分别为 0.96%、1.00%和 0.66%，占比较低。公司其他系列自产产品种类较多，且每年存在新产品销售的情况，因此单价存在一定波动。

（5）其他领域

报告期内，公司自产的其他领域电子胶粘剂产品销售金额分别为 24.93 万元、29.53 万元和 26.00 万元，公司其他领域产品种类较多，收入金额较小。其他领域主要包括机械装备、医疗设备等领域。

4、主营业务收入按业务模式分析

报告期内，公司的销售模式可分为直销、经销及贸易商销售两种，主营业务收入按销售模式划分的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销	37,348.67	81.73%	31,352.75	81.57%	29,953.46	85.40%
经销及贸易商	8,347.88	18.27%	7,085.98	18.43%	5,122.32	14.60%
合计	**45,696.55**	**100.00%**	**38,438.74**	**100.00%**	**35,075.78**	**100.00%**

报告期内，公司直销的销售模式收入占比较高。同时，根据下游应用领域如智能终端、新能源、半导体等较为广泛，客户多、分布广的特点，为提高运营效率，借助经销及贸易商区位和渠道优势，扩大对客户的覆盖广度，提升响应速度和服务能力，助力公司品牌和产品的属地化推广，公司辅之以经销及贸易商的模式。

报告期内，公司直销客户的收入分别为 29,953.46 万元、31,352.75 万元和 37,348.67 万元，收入占比分别为 85.40%、81.57%和 81.73%；经销及贸易商的收入分别为 5,122.32 万元、7,085.98 万元和 8,347.88 万元，占比分别为 14.60%、18.43%及 18.27%。

5、主营业务收入按地区分析

报告期内，公司主营业务收入按区域划分情况如下：

单位：万元

地区		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	华东区	22,995.24	50.32%	21,073.63	54.82%	20,663.86	58.91%
	华南区	13,240.54	28.97%	11,393.88	29.64%	9,895.23	28.21%
	华北区	1,607.70	3.52%	991.10	2.58%	254.79	0.73%
	西南区	614.24	1.34%	522.18	1.36%	264.84	0.76%
	华中区	352.62	0.77%	290.15	0.75%	118.46	0.34%
	西北区	24.92	0.05%	0.12	0.00%	4.43	0.01%
	东北区	0.20	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	小计	38,835.47	84.99%	34,271.06	89.16%	31,201.61	88.95%
境外		6,861.07	15.01%	4,167.68	10.84%	3,874.17	11.05%
合计		**45,696.55**	**100.00%**	**38,438.74**	**100.00%**	**35,075.78**	**100.00%**

报告期内，公司境内销售金额占主营业务收入的比例分别为 88.95%、89.16%、84.99%；境外销售金额占主营业务收入的比例分别为 11.05%、10.84%、15.01%。

报告期内，公司产品以境内销售为主，其中主要为向华东、华南地区的销售，与下游智能终端产业链企业、新能源产业链企业、半导体产业链的生产企业等重点客户的区域分布相匹配。

6、主营业务收入按季节分析

报告期内，公司主营业务收入按季度划分情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	9,115.55	19.95%	7,163.84	18.64%	7,279.58	20.75%
第二季度	10,104.38	22.11%	8,868.50	23.07%	7,292.51	20.79%
第三季度	13,374.91	29.27%	11,116.35	28.92%	9,055.35	25.82%
第四季度	13,101.70	28.67%	11,290.04	29.37%	11,448.34	32.64%
合计	**45,696.55**	**100.00%**	**38,438.74**	**100.00%**	**35,075.78**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务收入呈现一定的季节性特征，第三季度、第四季度的收入占比较高，公司第三季度与第四季度的主营业务收入合计占全年主营业务收入的比重分别为 58.46%、58.29%和 57.94%，主要是由于公司电子胶粘剂产品在智能终端领域的销售占比较高，智能终端产品通常在第三、四季度的需求更为

旺盛，进而导致公司产品销售存在一定的季节性，符合行业特点和公司业务实际情况，具备合理性。

（三）营业成本分析

1、营业成本情况分析

报告期内，公司营业成本总体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	10,481.60	99.47%	9,709.84	99.42%	7,967.30	99.42%
其他业务成本	55.32	0.53%	56.36	0.58%	46.62	0.58%
合计	**10,536.93**	**100.00%**	**9,766.20**	**100.00%**	**8,013.92**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务成本分别为 7,967.30 万元、9,709.84 万元和 10,481.60 万元，占公司营业成本比重分别为 99.42%、99.42%和 99.47%，与主营业务收入的结构相匹配。

2、主营业务成本按产品应用领域分析

报告期内，公司主营业务成本按产品应用领域分类情况如下：

单位：万元

项目	业务类型	应用领域	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
			金额	占比	金额	占比	金额	占比
电子胶粘剂	自产	智能终端	3,810.00	36.35%	3,438.38	35.41%	2,702.89	33.92%
		新能源	2,823.20	26.93%	3,711.60	38.23%	2,970.62	37.29%
		半导体	2,079.15	19.84%	1,306.38	13.45%	909.64	11.42%
		通信	1,195.88	11.41%	948.58	9.77%	881.17	11.06%
		其他领域	21.36	0.20%	14.02	0.14%	7.41	0.09%
		小计	**9,929.59**	**94.73%**	**9,418.96**	**97.00%**	**7,471.73**	**93.78%**
	贸易		25.44	0.24%	167.08	1.72%	422.21	5.30%
	电子胶粘剂小计		**9,955.03**	**94.98%**	**9,586.04**	**98.73%**	**7,893.94**	**99.08%**
配套设备与材料及其他	贸易		526.57	5.02%	123.80	1.27%	73.36	0.92%
合计			**10,481.60**	**100.00%**	**9,709.84**	**100.00%**	**7,967.30**	**100.00%**

报告期内，公司成本主要来源于电子胶粘剂产品的自产业务。电子胶粘剂自产业务的成本分别为 7,471.73 万元、9,418.96 万元和 9,929.59 万元，占当期主营业务成本比例分别为 93.78%、97.00%和 94.73%。报告期内，公司主营业务成本随业务规模扩大逐年上升，变动与主营业务收入变动基本一致。主营业务成本按应用领域分类的占比较主营业务收入占比略有差异，主要系不同应用领域的毛利率不同所致。例如，智能终端领域电子胶粘剂产品的毛利率相对较高，而成本相对较低，导致其成本占比低于收入占比。

3、主营业务成本按构成明细分析

公司自产电子胶粘剂成本构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	5,700.75	57.41%	5,803.97	61.62%	4,887.78	65.42%
直接人工	781.90	7.87%	664.30	7.05%	422.55	5.66%
制造费用	2,919.57	29.40%	2,622.66	27.84%	1,836.91	24.58%
其他	527.37	5.31%	328.03	3.48%	324.48	4.34%
合计	**9,929.59**	**100.00%**	**9,418.96**	**100.00%**	**7,471.73**	**100.00%**

报告期内，公司自产电子胶粘剂成本包括直接材料、直接人工、制造费用和运输费等。直接材料为公司主营业务成本的主要构成部分。具体如下：

（1）直接材料

公司生产所需的主要原材料包括环氧树脂、镍包石墨粉、丙烯酸树脂、各类单体、助剂等原材料以及针筒等包装物。

报告期内，公司自产电子胶粘剂成本中直接材料分别为 4,887.78 万元、5,803.97 万元和 5,700.75 万元，占自产电子胶粘剂成本的比例分别为 65.42%、61.62%和 57.41%。报告期内，公司各期直接材料占比波动较小。

（2）直接人工

报告期内，公司主营业务成本中直接人工金额较小，占比较低，分别为 422.55 万元、664.30 万元和 781.90 万元，占自产电子胶粘剂成本的比例分别为 5.66%、7.05%和 7.87%。报告期内，公司直接人工占比持续提升，主要系公司报告期内

自产产品销售比例持续提高及生产人员数量变动所致。

（3）制造费用

报告期内，公司自产电子胶粘剂成本中制造费用分别为 1,836.91 万元、2,622.66 万元和 2,919.57 万元，占自产电子胶粘剂成本的比例分别为 24.58%、27.84%和 29.40%。公司的制造费用主要为组织和管理生产所发生的各项间接费用，包括车间间接费用、折旧及能源消耗等。公司制造费用总体呈增长趋势，主要系公司持续加大对生产设施设备投入，新建厂房投资支出，以及新增部分子公司生产基地所致。

（4）其他

公司自产电子胶粘剂成本中的其他主要包括运费等，报告期内，其他项目的金额分别为 324.48 万元、328.03 万元和 527.37 万元，占比分别为 4.34%、3.48%和 5.31%，占比相对较低。

（四）毛利和毛利率分析

1、公司综合毛利情况

报告期内，公司综合毛利情况具体如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利	毛利占比	毛利	毛利占比	毛利	毛利占比
主营业务	35,214.94	99.90%	28,728.90	100.02%	27,108.48	99.94%
其他业务	34.63	0.10%	-6.05	-0.02%	16.82	0.06%
合计	**35,249.58**	**100.00%**	**28,722.84**	**100.00%**	**27,125.30**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务毛利分别为 27,108.48 万元、28,728.90 万元和 35,214.94 万元，整体呈上升趋势，报告期主营业务毛利占比均超过 99%，毛利构成稳定。

报告期内，公司其他业务毛利总体较小。2024 年度，公司其他业务毛利为负，主要系深圳美科泰对外出租的房产因租户提前解约，对之前免租期确认的收入予以冲回所致。

2、公司综合毛利率情况

报告期内，公司综合毛利率的变动情况如下：

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
主营业务	77.06%	99.80%	74.74%	99.87%	77.29%	99.82%
其他业务	38.50%	0.20%	-12.03%	0.13%	26.51%	0.18%
合计	**76.99%**	**100.00%**	**74.63%**	**100.00%**	**77.19%**	**100.00%**

报告期内，公司综合毛利率分别为 77.19%、74.63%和 76.99%，主要受主营业务毛利率波动影响。

3、主营业务毛利按产品应用领域的分析

报告期内，公司主营业务毛利构成及占比情况如下：

单位：万元

项目	业务类型	应用领域	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
			金额	占比	金额	占比	金额	占比
电子胶粘剂	自产	智能终端	25,957.16	73.71%	21,469.74	74.73%	17,936.87	66.17%
		新能源	4,740.21	13.46%	2,430.50	8.46%	2,604.06	9.61%
		半导体	1,912.29	5.43%	2,104.10	7.32%	2,619.78	9.66%
		通信	1,244.01	3.53%	869.41	3.03%	1,201.94	4.43%
		其他领域	4.64	0.01%	15.51	0.05%	17.52	0.06%
		小计	**33,858.32**	**96.15%**	**26,889.24**	**93.60%**	**24,380.18**	**89.94%**
	贸易		638.01	1.81%	1,134.83	3.95%	2,206.65	8.14%
	电子胶粘剂小计		**34,496.33**	**97.96%**	**28,024.08**	**97.55%**	**26,586.83**	**98.08%**
配套设备与材料及其他	贸易		718.61	2.04%	704.82	2.45%	521.65	1.92%
合计			**35,214.94**	**100.00%**	**28,728.90**	**100.00%**	**27,108.48**	**100.00%**

报告期内，公司毛利主要来源于电子胶粘剂自产产品，电子胶粘剂自产产品的毛利分别为 24,380.18 万元、26,889.24 万元和 33,858.32 万元，呈增长的趋势，公司自产电子胶粘剂产品的毛利占当期主营业务毛利的比例分别为 89.94%、93.60%和 96.15%。公司配套设备与材料销售毛利占比分别为 1.92%、2.45%和 2.04%，占比相对较小。

自产电子胶粘剂的应用领域方面，智能终端领域是公司毛利的主要来源，报告期内其毛利占比分别为 66.17%、74.73%和 73.71%。新能源领域是公司毛利的第二大来源，报告期内新能源领域毛利占比分别为 9.61%、8.46%和 13.46%，半导体领域毛利占比分别为 9.66%、7.32%和 5.43%。智能终端、新能源和半导体三个领域合计毛利占当期主营业务毛利比例分别为 85.44%、90.52%和 92.60%，其余领域的毛利占比相对较低。

4、主营业务毛利率按产品应用领域分析

报告期内，公司自产产品主营业务毛利率及分应用领域的毛利率变动情况如下：

应用领域	2025 年度			2024 年度			2023 年度	
	收入占比	毛利率	毛利率变动	收入占比	毛利率	毛利率变动	收入占比	毛利率
智能终端	67.98%	87.20%	1.17%	68.60%	86.20%	-0.82%	64.80%	86.90%
新能源	17.27%	62.67%	58.38%	16.92%	39.57%	-15.29%	17.50%	46.71%
半导体	9.12%	47.91%	-22.34%	9.39%	61.70%	-16.88%	11.08%	74.23%
通信	5.57%	50.99%	6.62%	5.01%	47.82%	-17.12%	6.54%	57.70%
其他领域	0.06%	17.86%	-65.99%	0.08%	52.52%	-25.29%	0.08%	70.29%
合计	**100.00%**	**77.32%**	**4.41%**	**100.00%**	**74.06%**	**-3.25%**	**100.00%**	**76.54%**

报告期内，公司自产产品毛利率分别为 76.54%、74.06%和 77.32%，整体较为稳定。

（1）智能终端

报告期内，公司智能终端领域的毛利率分别为 86.90%、86.20%和 87.20%，其毛利率水平高于其他应用领域，主要系公司在智能终端领域的客户主要为全球知名电子制造厂商，客户对产品的技术参数指标和产品性能表现有较高要求，因而单位产品售价较高，毛利率较高。具体如下：

单位：元/千克

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度
	金额	变动	金额	变动	金额
单价	2,032.73	-10.36%	2,267.74	-24.96%	3,022.24
单位成本	260.18	-16.89%	313.04	-20.90%	395.78
毛利率	87.20%	1.17%	86.20%	-0.82%	86.90%

报告期内，公司智能终端领域产品毛利率分别为86.90%、86.20%和87.20%，得益于公司产品生产工艺的持续精进，在单位成本与销售价格同步下降的情况下，毛利率水平保持稳定。

（2）新能源

报告期内，公司新能源领域的毛利率分别为46.71%、39.57%和62.67%，新能源应用领域的客户通常对电子胶粘剂需求量高，采购量大，因此毛利率相对智能终端领域偏低。具体如下：

单位：元/千克

项目	2025年度		2024年度		2023年度
	金额	变动	金额	变动	金额
单价	239.64	207.77%	77.86	-51.24%	159.69
单位成本	89.45	90.11%	47.05	-44.71%	85.09
毛利率	62.67%	58.38%	39.57%	-15.29%	46.71%

报告期内，公司新能源领域产品毛利率分别为46.71%、39.57%和62.67%，2024年同比2023年下降较多，主要系公司于2024年销售了较多的售价较低但出货量大的新能源产品，该部分产品对新能源领域整体毛利率影响较大。2025年毛利率回升较多，主要得益于高附加值的磁芯粘接胶产品逐步放量以及减少了部分低毛利业务，故其毛利率维持在较高水平。

（3）半导体

报告期内，公司半导体领域的毛利率分别为74.23%、61.70%和47.91%，具体如下：

单位：元/千克

项目	2025年度		2024年度		2023年度
	金额	变动	金额	变动	金额
单价	941.46	-21.89%	1,205.32	48.95%	809.2
单位成本	490.41	6.22%	461.7	121.38%	208.56
毛利率	47.91%	-22.34%	61.70%	-16.88%	74.23%

报告期内，公司半导体领域的毛利率有所下降，主要系公司大力开展芯片固晶胶膜（DAF）等产品的研发生产，相关新产线投入运行初期，相应的固定成本及折旧摊销增加，对短期毛利率水平产生了一定影响，同时半导体应用领域销售

单价有所下降，导致毛利率有所降低。

（4）通信领域

报告期内，公司通信领域的毛利率分别为 57.70%、47.82%和 50.99%，呈现一定的波动。

公司通信领域的产品的毛利率具体如下：

单位：千克、元/千克

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度
	金额	变动	金额	变动	金额
单价	577.96	3.90%	556.26	-17.72%	676.08
单位成本	283.28	-2.40%	290.24	1.49%	285.99
毛利率	50.99%	6.62%	47.82%	-17.12%	57.70%

报告期内，公司自产产品通信应用领域的毛利率分别为 57.70%、47.82%和 50.99%，呈现先下降后略回升的趋势。主要系公司向终端品牌商销售因受市场供求影响，2024 年平均单价下调，导致 2024 年收入有所下滑，相应毛利率下降所致；随着 2025 年毛利较高的新产品销量提升，2025 年毛利率有所回升。

（5）其他领域

报告期内，公司其他领域毛利率分别为 70.29%、52.52%和 17.86%，毛利分别 17.52 万元、15.51 万元和 4.64 万元，其他领域的毛利润的占比较低。公司其他领域的电子胶粘剂产品种类较多，且每年存在新产品销售的情况，各期主要销售的品类不尽相同，因而毛利率存在一定波动，可比性较低。

5、毛利率与同行业上市公司比较情况

报告期内，公司与同行业可比上市公司综合毛利率对比情况如下：

证券代码	公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
688035.SH	德邦科技	27.50%	27.55%	29.19%
300041.SZ	回天新材	23.61%	18.46%	22.82%
688157.SH	松井股份	43.10%	48.85%	49.37%
688535.SH	华海诚科	26.66%	25.63%	26.88%
688093.SH	世华科技	58.11%	56.21%	58.88%
行业平均		**35.80%**	**35.34%**	**37.43%**

证券代码	公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
公司		76.99%	74.63%	77.19%

报告期内，公司综合毛利率高于同行业可比公司，主要系公司与同行业可比公司在下游客户、用胶点及下游应用领域均存在一定差异。

一方面，公司专注于高性能电子胶粘剂产品的研发及产业化，公司在各应用领域主要导入开发难度较大的应用点产品，除了注重物理性能和长期可靠性，还要兼顾较高的电气性能等直接影响终端产品的良品率、电/热性能、可靠性等关键指标的要求，使得与同行业可比公司相同应用领域的产品相比，公司更加聚焦高性能、高毛利的应用点，使得公司产品相较上述可比公司同类产品的整体毛利率水平较高。

另一方面，从产品下游应用领域来看，智能终端等应用领域的产品由于其定制化程度较高，具有小批量特点，客户通常对技术参数指标要求较高，毛利率相对较高，而新能源等应用领域的产品则因为需求量大、采购量大，毛利率相对较低。相比同行业可比公司，公司智能终端应用领域产品占比相对较高，新能源等应用领域产品占比相对较低，而同行业可比公司的智能终端应用领域占比较小，新能源应用领域、建筑领域产品的占比较大，产品结构差异导致公司毛利率水平相对较高。

（五）期间费用分析

报告期内，公司期间费用金额以及占营业收入比例情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比
销售费用	7,497.13	16.37%	7,207.54	18.73%	6,923.67	19.70%
管理费用	6,253.21	13.66%	6,481.04	16.84%	5,654.80	16.09%
研发费用	6,799.27	14.85%	6,936.12	18.02%	5,952.94	16.94%
财务费用	59.77	0.13%	114.80	0.30%	-254.81	-0.73%
合计	**20,609.38**	**45.01%**	**20,739.50**	**53.88%**	**18,276.60**	**52.01%**

报告期内，公司期间费用分别为 18,276.60 万元、20,739.50 万元和 20,609.38 万元，公司期间费用率分别为 52.01%、53.88%和 45.01%，期间费用率整体较为

稳定，2025 年期间费用率下降，主要系收入提升所致。

1、销售费用

（1）销售费用变动分析

报告期内，公司销售费用明细情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	5,653.88	75.41%	5,444.18	75.53%	4,993.58	72.12%
差旅费	541.88	7.23%	606.72	8.42%	595.15	8.60%
业务招待费	340.16	4.54%	302.75	4.20%	310.61	4.49%
折旧及摊销费	291.15	3.88%	246.86	3.43%	230.42	3.33%
办公费	157.66	2.10%	155.98	2.16%	183.98	2.66%
检测费	126.73	1.69%	54.34	0.75%	74.48	1.08%
服务费	131.64	1.76%	153.35	2.13%	159.96	2.31%
广告宣传费	69.17	0.92%	110.29	1.53%	56.47	0.82%
租赁及物业费	34.03	0.45%	25.47	0.35%	46.55	0.67%
其他	150.82	2.01%	107.59	1.49%	272.47	3.94%
合计	**7,497.13**	**100.00%**	**7,207.54**	**100.00%**	**6,923.67**	**100.00%**

报告期内，公司销售费用分别为 6,923.67 万元、7,207.54 万元和 7,497.13 万元，占同期营业收入的比例分别为 19.70%、18.73%和 16.37%。随着公司业务增长，公司销售费用占营业收入的比例逐年下降。公司销售费用主要由职工薪酬、差旅费、业务招待费和折旧及摊销构成，上述四项费用占销售费用比重分别为 88.53%、91.58%和 91.06%，占比较高。

1）职工薪酬

报告期内，计入销售费用的职工薪酬分别为 4,993.58 万元、5,444.18 万元和 5,653.88 万元。薪酬总额变动主要系公司结合年度业务拓展等情况对销售人员进行了适当调整。公司主要采用底薪加绩效奖金的薪酬制度，给予了销售人员较高的薪酬。

2）差旅费及业务招待费

报告期内，公司差旅费金额分别为 595.15 万元、606.72 万元和 541.88 万元；

业务招待费金额分别为 310.61 万元、302.75 万元和 340.16 万元。两项费用随着公司业务的拓展存在一定的波动。

3）折旧及摊销费

报告期内，公司销售费用中的折旧与摊销金额分别为 230.42 万元、246.86 万元和 291.15 万元，主要为销售部门使用的固定资产折旧、使用权资产折旧及长期待摊费用摊销。报告期内，该项目整体金额较小，2025 年较 2024 年增长 44.29 万元，增幅为 17.94%，增幅较大主要系新增德聚二期办公楼及宿舍楼折旧所致；2024 年较 2023 年增长 16.44 万元，增幅为 7.13%，增幅较小，主要系销售部门资产配置的变动所致。

（2）与同行业对比分析

报告期内，发行人的销售费用率与同行业可比公司比较情况如下：

证券代码	公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
688035.SH	德邦科技	6.22%	6.29%	5.66%
300041.SZ	回天新材	5.46%	4.56%	4.76%
688157.SH	松井股份	12.33%	11.25%	9.58%
688535.SH	华海诚科	5.40%	5.04%	4.76%
688093.SH	世华科技	3.74%	4.81%	5.70%
行业平均		**6.63%**	**6.39%**	**6.09%**
公司		**16.37%**	**18.73%**	**19.70%**

报告期内，公司销售费用率总体呈下降趋势，整体上高于同行业平均水平，主要系公司给予销售人员的薪酬激励高于同行业水平，具体原因包括：1）公司处于快速增长期，为激励团队、开拓市场，提供了具有竞争力的薪酬待遇。薪酬结构采用底薪加绩效奖金模式；2）公司美国、欧洲等境外子公司的销售人员整体薪酬水平较高，提高了整体平均值。

2、管理费用

（1）管理费用变动分析

报告期内，公司管理费用明细情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	3,265.68	52.22%	3,241.33	50.01%	2,768.24	48.95%
折旧及摊销费	1,070.76	17.12%	1,257.82	19.41%	470.72	8.32%
股权激励	649.78	10.39%	369.64	5.70%	848.18	15.00%
中介服务费	488.07	7.81%	922.94	14.24%	738.12	13.05%
业务招待费	153.09	2.45%	109.37	1.69%	105.37	1.86%
差旅费	149.90	2.40%	188.26	2.90%	292.19	5.17%
办公费	150.42	2.41%	169.95	2.62%	174.77	3.09%
租赁及物业费	107.49	1.72%	54.62	0.84%	55.98	0.99%
其他	218.02	3.49%	167.11	2.58%	201.23	3.56%
合计	**6,253.21**	**100.00%**	**6,481.04**	**100.00%**	**5,654.80**	**100.00%**

报告期内，公司管理费用分别为 5,654.80 万元、6,481.04 万元和 6,253.21 万元，占同期营业收入的比例分别为 16.09%、16.84%和 13.66%。2023 年和 2024 年公司管理费用总体较为平稳，2025 年随着公司业务增长，公司管理费用占营业收入的比例出现下降。报告期内，公司管理费用主要由职工薪酬、中介服务费、折旧及摊销和股权激励费用构成，上述四项费用报告期内占管理费用比重合计分别为 85.33%、89.36%和 87.54%。

1）职工薪酬

职工薪酬主要包括公司职能部门员工的薪酬。报告期内分别为 2,768.24 万元、3,241.33 万元和 3,265.68 万元。报告期内，公司持续完善管理架构，健全管理体系，随着公司业务规模的扩展，子公司的增多，管理人员相应增加，从而导致职工薪酬总额的增长。

2）中介服务费

报告期内公司的管理费用中介服务费分别为 738.12 万元、922.94 万元和 488.07 万元。2023 年中介服务费较高，主要系支付前次申报上市中介机构的费用所致；2024 年中介服务费较 2023 年增长 184.82 万元，主要系公司支付评估、审计、律师等中介机构费用较多，同时当年厂区搬迁等发生设备调试、搬运吊装等偶发性费用增加所致。2025 年公司中介服务费相对稳定。

3）折旧及摊销

折旧及摊销主要为公司购置的办公用资产的折旧以及费用摊销。报告期内，公司管理费用中的折旧及摊销费分别为 470.72 万元、1,257.82 万元和 1,070.76 万元，占管理费用的比例分别为 8.32%、19.41%和 17.12%。2024 年较 2023 年大幅增长，主要系折旧费及长期待摊费用摊销增加所致：折旧费增加主要系德聚技术确认使用权资产折旧，以及青岛德聚新增固定资产折旧；长期待摊费用摊销增加主要系德聚技术本部厂区搬迁导致原厂区装修费一次性摊销，以及如东德聚厂房装修工程完工转入摊销。2025 年较 2024 年有所回落，主要系前述厂区搬迁等偶发性因素消除，折旧及摊销费回归至正常水平。报告期内，公司管理费用中折旧及摊销费的波动具有合理性。

4）股权激励

报告期内公司计入管理费用的股权激励分别为 848.18 万元、369.64 万元和 649.78 万元。主要系公司对骨干员工实施股权激励，并将股权激励费用在服务期内进行分摊所致。公司历次股权激励的公允价格主要参考最近外部投资者的入股价，符合《监管规则适用指引——发行类第 5 号》规定。

有关股权激励的方案，详见“第四节 发行人基本情况”之“七、发行人已制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排”。

（2）与同行业对比分析

报告期内，发行人的管理费用率与同行业可比公司比较情况如下：

证券代码	公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
688035.SH	德邦科技	8.29%	8.30%	7.66%
300041.SZ	回天新材	5.66%	4.98%	5.14%
688157.SH	松井股份	11.03%	10.36%	10.06%
688535.SH	华海诚科	10.60%	7.65%	7.40%
688093.SH	世华科技	5.08%	6.74%	7.10%
行业平均		**8.13%**	**7.60%**	**7.47%**
公司		**13.66%**	**16.84%**	**16.09%**
公司（剔除股权支付后）		**12.24%**	**15.88%**	**13.68%**

报告期内，公司管理费用率（剔除股份支付后）呈先上涨后下降的趋势，整

体略高于同行业平均水平，主要由于公司营收规模相比于可比公司较小，处于业务持续拓展期，给予管理人员的薪酬整体较高，发行人管理费用率高于同行业可比公司具有合理性。

3、研发费用

（1）研发费用基本情况

报告期内，研发费用的具体构成及占比如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接人工	3,859.20	56.76%	4,071.98	58.71%	3,376.93	56.73%
折旧及摊销	1,525.78	22.44%	1,440.15	20.76%	1,135.86	19.08%
直接材料	781.33	11.49%	584.00	8.42%	596.90	10.03%
差旅费	210.92	3.10%	231.21	3.33%	239.34	4.02%
水电费	162.38	2.39%	164.08	2.37%	129.37	2.17%
检测费	106.97	1.57%	181.00	2.61%	284.99	4.79%
劳务及顾问费	45.55	0.67%	61.40	0.89%	31.95	0.54%
租赁及物业费	32.67	0.48%	39.14	0.56%	31.91	0.54%
委托开发费	-	0.00%	40.00	0.58%	34.00	0.57%
其他费用	74.46	1.10%	123.16	1.78%	91.69	1.54%
合计	**6,799.27**	**100.00%**	**6,936.12**	**100.00%**	**5,952.94**	**100.00%**

报告期内，公司研发费用分别为 5,952.94 万元、6,936.12 万元和 6,799.27 万元，占营业收入的比例分别为 16.94%、18.02%和 14.85%。研发费用主要由直接人工、折旧与摊销费和直接材料构成，三者合计占研发费用总额比例分别为 85.83%、87.89%和 90.69%，占比较高。

1）直接人工

研发费用中的直接人工主要包括公司研发部门员工的薪酬。报告期内分别为 3,376.93 万元、4,071.98 万元和 3,859.20 万元，2024 年较 2023 年增加较多，主要系公司持续加大研发投入，为开拓新能源、半导体等新业务增长点扩充了研发团队规模，同时优化薪酬结构。2025 年度较 2024 年度有所减少主要系研发人员结构调整所致。报告期内，公司持续加大研发投入，创新激励机制等提高研发人

员薪资待遇。

2）折旧摊销

研发费用中的折旧摊销主要由公司研发部门研发用设备及软件使用费的折旧摊销、研发场地及实验室改造装修费用的折旧摊销等构成。报告期内，研发费用中折旧及摊销分别为 1,135.86 万元、1,440.15 万元、1,525.78 万元，主要为用于研发活动的机器设备折旧和长期资产摊销。

3）直接材料

研发费用中的直接材料费用主要系公司研发项目所耗用的直接材料投入。报告期内，研发材料费用分别为 596.90 万元、584.00 万元和 781.33 万元。公司为开拓新的业务增长点，针对不同应用场景的应用点进行研发试验及测试，研发试验及测试需耗用直接材料。

（2）研发项目构成情况

报告期内，研发费用对应的主要研发项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	预算	研发投入			合计	项目进度
			2025 年度	2024 年度	2023 年度		
1	高性能环氧底填胶的研发	2,650.00	786.57	1,082.60	754.10	2,623.27	在研
2	手持设备用结构胶粘剂的研发	2,160.00	485.21	654.09	562.24	1,701.54	在研
3	新能源汽车部件胶粘剂的研发	1,672.00	491.39	505.38	674.59	1,671.36	在研
4	半导体芯片粘接胶粘剂的研发	1,470.00	437.91	520.20	627.80	1,585.92	在研
5	UV 及多固化体系胶粘剂的研发	1,500.00	503.90	504.07	521.58	1,529.55	结项
6	多用途高导热材料的研发	1,245.00	418.38	476.18	428.75	1,323.30	在研
7	高可靠性环氧胶粘剂的研发	1,210.00	346.02	400.30	426.54	1,172.86	结项
8	高性能导电胶的研发	915.00	295.65	390.79	255.46	941.90	在研
9	FOG 异方性导电胶膜(ACF)的研发	2,500.00	441.31	342.77	125.45	909.54	在研
10	高性能包封胶的研发	1,100.00	256.74	293.66	329.20	879.60	结项

序号	项目名称	预算	研发投入			合计	项目进度
			2025年度	2024年度	2023年度		
11	高性能灌封材料的研发	655.00	260.49	280.51	189.75	730.75	在研
12	PCB 异方性导电胶膜(ACF)的研发	2,000.00	293.97	277.26	137.86	709.09	在研
13	高强度发泡材料的研发	772.00	82.49	288.44	286.63	657.56	在研
14	高耐湿热性能三防涂层的研发	478.00	98.34	160.79	146.74	405.88	在研
15	高性能丙烯酸酯胶粘剂的研发	400.00	153.67	149.91	94.69	398.28	结项
16	半导体粘接固定用热固性胶膜的研发	1,750.00	282.22	108.02	-	390.25	在研
17	高耐老化 UV 胶的研发	550.00	232.84	154.20	-	387.05	结项
18	高性能多固化体系胶粘剂的研发	550.00	225.83	108.00	-	333.84	结项
19	MiniLED 有机硅光学胶的研发	517.00	74.84	109.35	121.87	306.07	在研
20	半导体芯片底部填充胶的研发	300.00	192.36	-	-	192.36	在研
21	芯片粘接用耐高温环氧胶膜的研发	250.00	112.18	-	-	112.18	在研
22	低模量高粘接高耐候胶黏剂的研发	800.00	80.94	-	-	80.94	在研
23	耐回流焊 UV 丙烯酸胶黏剂的研究	300.00	70.39	-	-	70.39	在研
24	高可靠性双组分环氧胶的研发	250.00	65.70	-	-	65.70	在研
25	高性能制程保护胶黏剂的研发	800.00	62.97	-	-	62.97	在研
26	高性能底填胶的研发	650.00	-	-	47.89	47.89	结项
27	高性能丙烯酸环氧杂化体系胶黏剂的研发	700.00	46.96	-	-	46.96	在研
28	生物基 UV 固化丙烯酸酯压敏胶的研发	40.00	-	40.22	-	40.22	结项
29	柔性印制电路板粘结光固化胶粘剂的研发	40.00	-	39.10	-	39.10	结项

序号	项目名称	预算	研发投入			合计	项目进度
			2025年度	2024年度	2023年度		
30	应用于新能源电池行业的胶粘剂产品的研发	600.00	-	-	37.58	37.58	结项
31	高可靠高绝缘包封环氧胶粘剂的研发	430.00	-	-	34.72	34.72	结项
32	消费电子用高导热硅凝胶	97.00	-	-	32.90	32.90	终止
33	高可靠超低温快速固化环氧胶粘剂的研发	310.00	-	-	31.23	31.23	结项
34	芯片粘接导电胶粘剂的研发	400.00	-	-	26.47	26.47	结项
35	耐高温抗变形芯片环氧胶膜的研发	25.00	-	26.05	-	26.05	结项
36	室温快速固化双组份环氧胶的研发	25.00	-	24.22	-	24.22	结项
37	半导体应用有机硅密封粘接胶	40.50	-	-	20.52	20.52	终止
38	长期老化高隔离度镍碳导电胶	54.50	-	-	12.23	12.23	终止
39	中温低模量导电胶	104.00	-	-	10.49	10.49	终止
40	有机硅光学应用胶	68.00	-	-	9.38	9.38	终止
41	半导体应用有机硅纯银导电胶	26.00	-	-	4.48	4.48	终止
42	单组份室温超软镍碳导电胶	15.50	-	-	1.20	1.20	终止
43	单组份室温纯银导电胶	51.00	-	-	0.55	0.55	终止
44	单组份室温存储热固化密封胶	33.50	-	-	0.03	0.03	终止
合计		**30,504.00**	**6,799.27**	**6,936.12**	**5,952.94**	**19,688.37**	

注：上表中的终止项目，均为上海锐朗被收购后终止的原研发项目，需重新按照德聚技术整体市场定位、研发规划和技术方向创建新研发项目所致。

（3）与同行业对比分析

报告期内，发行人的研发费用率与同行业可比公司比较情况如下：

证券代码	公司名称	2025年度	2024年度	2023年度
688035.SH	德邦科技	4.70%	5.73%	6.65%

证券代码	公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
300041.SZ	回天新材	4.81%	4.93%	4.61%
688157.SH	松井股份	15.58%	14.14%	15.31%
688535.SH	华海诚科	10.93%	7.96%	8.71%
688093.SH	世华科技	5.57%	6.32%	7.19%
行业平均		**8.32%**	**7.82%**	**8.49%**
公司		**14.85%**	**18.02%**	**16.94%**

公司研发费用率整体高于同行业可比公司的平均水平，主要系公司处于业务成长期，为大力开拓新业务，公司报告期内持续加大研发投入，开发新产品，同时公司营业收入规模与同行业可比公司相比较低，因此研发费用占营业收入比例较高。此外，同行业可比公司中，回天新材主要经营工程胶粘剂且营业收入规模较大，研发费用占营业收入比例较低，拉低了同行业可比公司平均值。

4、财务费用

（1）财务费用变动分析

报告期内，公司财务费用具体明细构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利息支出	327.69	573.00	289.26
其中：未确认融资费用	80.35	386.97	240.28
减：利息收入	409.79	459.64	446.97
汇兑损益	126.10	-15.60	-118.67
银行手续费	15.78	17.04	21.57
合计	**59.77**	**114.80**	**-254.81**

报告期内，公司财务费用分别为-254.81 万元、114.80 万元和 59.77 万元，占各期营业收入的比例分别为-0.73%、0.30%和 0.13%。公司财务费用主要由利息支出和汇兑损益构成，报告期内公司银行借款增加，利息支出整体增加。未确认融资费用主要系公司租赁房屋所致。

（2）财务费用率与同行业可比公司比较情况

证券代码	公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
688035.SH	德邦科技	-0.06%	-0.74%	-1.68%

证券代码	公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
300041.SZ	回天新材	1.48%	1.22%	0.76%
688157.SH	松井股份	0.44%	0.11%	-0.69%
688535.SH	华海诚科	1.57%	0.56%	0.04%
688093.SH	世华科技	0.23%	-0.60%	-0.59%
行业平均		**0.73%**	**0.11%**	**-0.43%**
公司		**0.13%**	**0.30%**	**-0.73%**

报告期内，公司与同行业可比公司的财务费用率均处于较低水平，不存在重大差异。

（六）利润表其他项目分析

报告期内，公司利润表其他重要项目情况具体如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
其他收益	302.89	432.37	228.42
投资收益	20.57	128.56	18.5
公允价值变动收益	254.5	40.75	13.26
信用减值损失	-62.67	1.44	-60.76
资产减值损失	-660.77	-454.24	-3,496.43
资产处置收益	-10.2	8.62	11.4
营业外收入	27.11	0.02	2.23
营业外支出	99.66	60.13	34.02

1、其他收益

报告期内，公司其他收益的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
政府补助	195.80	255.31	136.53
增值税加计抵减	88.55	135.39	84.72
个税手续费返还	18.54	41.67	7.18
合计	**302.89**	**432.37**	**228.42**

报告期内，公司其他收益分别为 228.42 万元、432.37 万元和 302.89 万元，主要为政府补助。计入其他收益的政府补助明细如下：

单位：万元

补助项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度	与资产相关/与收益相关
“专精特新”企业技改项目	10.82	10.82	2.70	与资产相关
上海市松江区国有资产监督管理委员会企业扶持资金	-	-	42.00	与收益相关
南通市经济技术开发区财政局科创项目补贴款	-	-	15.00	与收益相关
高新技术企业政府补助	3.00	-	20.00	与收益相关
东莞市科学技术局 2023 年创新型企业研发投入补助	-	-	39.18	与收益相关
东莞市财政局石排分局创新人才研发人才和引进培养费	-	-	0.20	与收益相关
石排财政局支持企业稳产提质专项补助	-	-	16.54	与收益相关
东莞市工业和信息化局 2023 年东莞市“倍增计划”鼓励和支持企业兼并重组项目费	-	20.05	-	与收益相关
2022 年国家重点研发项目（广州黄埔）	-	50.00	-	与收益相关
东莞市商务局促进开放型经济高质量发展专项资金（境内专业展项目 2024）	-	2.40	-	与收益相关
社保局 2024 年稳岗返还款	-	4.31	-	与收益相关
2023 年国家、省知识产权示范（优势）企业奖金	-	20.00	-	与收益相关
东莞市科学技术局 2023 年东莞市工程技术研究中心绩效评估项目款	-	50.00	-	与收益相关
科技发展专项奖金	-	14.89	-	与收益相关
2024 年度青岛科技计划、重点人才工程、产业领军人才补助	-	27.22	-	与收益相关
上海市松江区经济委员会企业专项专精特新	-	20.00	-	与收益相关
引进外国人才补助	-	1.00	-	与收益相关
22-23 年人才公寓租金补贴	-	17.08	-	与收益相关
如东县人民政府鼓励企业转型升级补助	-	2.00	-	与收益相关
收到石排镇关于支持企业稳产提质专项补助	2.00	-	-	与收益相关
2023 年人才引进补贴	1.20	-	-	与收益相关
2024 年东莞市技能大师工作室（市）补助	10.00	-	-	与收益相关
2024 年高新技术企业认定奖励	1.00	-	-	与收益相关
2024 年广东省省级制造业单项冠军	10.00	-	-	与收益相关

补助项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度	与资产相关/与收益相关
重点“小巨人”实施期补助资金	26.61	-	-	与收益相关
2024 年度松江区高新技术企业认定专项补贴	2.50	-	-	与收益相关
2023 年相城区产学研合作奖补	0.27	-	-	与收益相关
南通市 2024 年度第二批省三星级上云企业补贴	3.00	-	-	与收益相关
南通市经济技术开发区财政局科创项目补贴款	5.00	-	-	与收益相关
南通市经济发展局 2025 年第一批科技资助及奖励资金	1.00	-	-	与收益相关
如东政府奖励—2023 年厂房租金补助	110.60	-	-	与收益相关
其他补助	8.80	15.55	0.90	与收益相关
合计	**195.80**	**255.31**	**136.53**	

报告期内，公司与科研项目相关的主要政府补助明细如下：

单位：万元

科研项目课题名称	政府补助名称	项目预算	财政预算	报告期内进当期损益金额	是否计入非经常性损益
PSPI 树脂及其光刻胶的量产关键技术和中试工艺	2022 年国家重点研发项目（广州黄埔）	1,100.00	300.00	50.00	是
倒装芯片封装用底部填充材料的研发	2024 年市重点领域研发项目补助一关键技术攻关项目中期评估资助资金	2,000.00	400.00	-	是

注：高性能环氧底填胶研发项目尚未完成验收，相关政府补助未满足计入当期损益的确认条件，故暂未计入当期损益。

2、投资收益

报告期内，公司投资收益分别为 18.50 万元、128.56 万元和 20.57 万元，均系公司当年购买及赎回银行理财产品产生的投资收益。

3、公允价值变动收益

报告期内，公司公允价值变动收益分别为 13.26 万元、40.75 万元和 254.50 万元，公司公允价值变动收益均源于当期交易性金融资产（结构性存款及理财产品）的变动收益。

4、信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
坏账损失	-62.67	1.44	-60.76
合计	**-62.67**	**1.44**	**-60.76**

注：损失以负数列示。

报告期内，公司信用减值损失分别为-60.76 万元、1.44 万元和-62.67 万元，公司信用减值损失均系坏账损失。坏账损失变动原因详见本节“十一、资产质量分析” 之“（二）流动资产构成及变化分析”之“4、应收账款”。

5、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
存货跌价损失	-606.30	-382.25	-473.09
其他流动资产损失	-44.01	-71.06	-8.21
合同资产减值损失	-10.45	-0.94	-0.45
商誉减值损失	-	-	-3,014.68
合计	**-660.77**	**-454.24**	**-3,496.43**

注：损失以负数列示。

报告期内，公司资产减值损失分别为-3,496.43 万元、-454.24 万元和-660.77 万元，主要为公司存货跌价损失和商誉减值损失。存货跌价损失变动原因详见本节“十一、资产质量分析” 之“（二）流动资产构成及变化分析”之“7、存货”；商誉减值损失变动原因详见本节“十一、资产质量分析” 之“（三）非流动资产构成及变化分析”之“6、商誉”。

6、资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益分别为 11.40 万元、8.62 万元和-10.20 万元，公司资产处置收益或损失主要由固定资产处置利得或损失和使用权资产处置利得或损失构成。相关金额较小，对公司经营业绩影响较小。

7、营业外收入

报告期内，公司营业外收入分别为 2.23 万元、0.02 万元和 27.11 万元，主要为合同违约赔偿收入及其他收入。相关金额较小，对公司经营业绩影响较小。

8、营业外支出

报告期内，公司营业外支出的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动资产毁损报废损失	90.07	3.03	8.95
对外捐赠	-	45.00	3.63
滞纳金	1.51	2.10	16.76
其他	8.08	10.00	4.67
合计	**99.66**	**60.13**	**34.02**

报告期内，公司营业外支出分别为 34.02 万元、60.13 万元和 99.66 万元，主要为非流动资产毁损报废损失、对外捐赠等。相关款项金额较小，占各期营业收入的比例较低，对公司经营业绩影响较小。

（七）非经常性损益

报告期内，公司非经常性损益情况具体如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	-100.27	5.59	2.45
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外；	195.8	269.08	142.81
3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益；	275.07	169.31	31.76
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出。	17.53	-57.08	-22.84
5、其他符合非经常性损益定义的损益项目	18.54	-1,007.18	6.08
扣除所得税前非经常性损益合计	406.67	-620.28	160.27
减：所得税影响金额	76.48	-65.79	25.86
扣除所得税后非经常性损益合计	330.19	-554.49	134.41

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）	3.49	5.46	3.36
归属于母公司所有者的非经常性损益净利润额	326.69	-559.94	131.05

报告期内，公司归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为 131.05 万元、-559.94 万元和 326.69 万元，主要由计入当期损益的政府补助及首次筹备上市时的中介机构费用增加等与主营业务不直接相关的费用变动所致。总体来看，公司未对非经常性损益产生重大依赖。

（八）纳税情况及分析

报告期内，公司企业所得税、增值税等主要税种缴纳情况如下：

1、企业所得税

单位：万元

期间	期初未交	本期应交	本期已交	期末未交
2025 年度	926.12	2,547.89	2,036.29	1,437.72
2024 年度	503.69	1,473.90	1,051.47	926.12
2023 年度	1,398.37	1,366.85	2,261.53	503.69

2、增值税

单位：万元

期间	期初未交	本期应交	本期已交	期末未交
2025 年度	86.02	3,082.33	2,808.72	359.64
2024 年度	200.47	1,988.39	2,102.84	86.02
2023 年度	1,015.16	1,876.83	2,691.53	200.47

报告期内，公司税收政策不存在重大变化。

十一、资产质量分析

（一）资产结构总体概况及变动分析

报告期各期末，公司的资产结构如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	62,740.60	47.92%	51,876.56	44.93%	55,173.13	54.58%

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
非流动资产	68,191.35	52.08%	63,593.21	55.07%	45,907.79	45.42%
资产总计	**130,931.95**	**100.00%**	**115,469.76**	**100.00%**	**101,080.92**	**100.00%**

报告期各期末，公司资产总额分别为 101,080.92 万元、115,469.76 万元和 130,931.95 万元，整体呈稳步增长态势。总资产规模的扩大主要得益于公司生产经营规模的持续扩张以及 2023 年完成的外部股权融资。

报告期各期末，资产结构总体保持稳定，公司流动资产占总资产的比例分别为 54.58%、44.93%和 47.92%。2024 年末流动资产占比有所下降，非流动资产占比相应上升，主要系随着公司业务规模扩大及产能扩张需求增加，公司购置了生产设备、厂房等长期资产，导致固定资产余额增长较快。

（二）流动资产构成及变化分析

报告期各期末，公司流动资产具体构成情况如下：

单位：万元

流动资产	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	7,118.29	11.35%	4,898.00	9.44%	27,622.64	50.07%
交易性金融资产	21,446.88	34.18%	5,653.26	10.90%	713.26	1.29%
应收票据	330.60	0.53%	286.92	0.55%	510.21	0.92%
应收账款	15,410.22	24.56%	14,513.88	27.98%	14,750.80	26.74%
应收款项融资	645.55	1.03%	478.90	0.92%	2,691.52	4.88%
预付款项	478.80	0.76%	1,074.67	2.07%	253.75	0.46%
其他应收款	172.61	0.28%	130.48	0.25%	271.47	0.49%
存货	3,284.11	5.23%	3,003.00	5.79%	2,619.36	4.75%
合同资产	259.23	0.41%	56.10	0.11%	42.81	0.08%
一年内到期的非流动资产	4,391.67	7.00%	-	-	-	-
其他流动资产	9,202.63	14.67%	21,781.34	41.99%	5,697.32	10.33%
合计	**62,740.60**	**100.00%**	**51,876.56**	**100.00%**	**55,173.13**	**100.00%**

公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货及其他流动资产构成。报告期各期末，上述五类流动资产合计占流动资产总额的比重分别

为 93.18%、96.10%和 89.99%。

1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金具体情况如下：

单位：万元

货币资金	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
库存现金	4.82	0.07%	4.53	0.09%	2.37	0.01%
银行存款	7,113.47	99.93%	4,893.47	99.91%	27,620.27	99.99%
合计	**7,118.29**	**100.00%**	**4,898.00**	**100.00%**	**27,622.64**	**100.00%**

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 27,622.64 万元、4,898.00 万元和 7,118.29 万元，占各期末流动资产的比例分别为 50.07%、9.44%和 11.35%。公司货币资金主要由银行存款构成，报告期内各期末占比均超过 99%。

2023 年末货币资金余额较高，主要系当年公司引入多家外部投资者投资，股权融资款到位所致。

2024 年末及 2025 年末，货币资金余额较 2023 年末显著下降，主要系：一方面，公司为提高闲置资金的使用效率，购买了流动性较好、安全性较高的大额存单、结构性存款及理财产品，该等款项在资产负债表中列示于“交易性金融资产”或“其他流动资产/其他非流动资产”项目；另一方面，为满足业务扩张需求，公司持续推进新厂房建设及设备购置等资本性支出，资金投入增加，以支持公司长期发展战略的有效实施。

2、交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产具体情况如下：

单位：万元

交易性金融资产	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
结构性存款及理财产品	21,446.88	100.00%	5,653.26	100.00%	713.26	100.00%
合计	**21,446.88**	**100.00%**	**5,653.26**	**100.00%**	**713.26**	**100.00%**

报告期各期末，公司交易性金融资产均系公司为提高临时闲置资金使用效率而购买的结构性存款及理财产品。

报告期各期末，公司交易性金融资产金额分别为 713.26 万元、5,653.26 万元和 21,446.88 万元，占各期末流动资产比例分别为 1.29%、10.90%和 34.18%。2024 年末及 2025 年末，公司交易性金融资产规模显著增长，主要系公司在确保日常经营资金需求的前提下，加强现金管理，适度增加了低风险理财产品的配置所致。2025 年末交易性金融资产较 2024 年末增加 15,793.62 万元，增幅较大，主要系原计入“其他流动资产”的定期存款于 2025 年到期后，公司基于资金灵活性的综合考量，选择将其重新配置为流动性更强的结构性存款及理财产品，相应在“交易性金融资产”项目核算。

3、应收票据及应收款项融资

报告期各期末，公司应收票据的账面价值分别 510.21 万元、286.92 万元和 330.60 万元，包括银行承兑汇票及商业承兑汇票，占各期末流动资产的比例分别为 0.92%、0.55%和 0.53%；公司应收款项融资的账面价值分别为 2,691.52 万元、478.90 万元和 645.55 万元，占各期末流动资产的比例分别为 4.88%、0.92%和 1.03%。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，银行承兑汇票信用等级较高，公司未对承兑人为银行的银行承兑汇票计提减值；公司对承兑人为财务公司的银行承兑汇票和商业承兑汇票根据账龄组合计提减值，因该两类承兑汇票均在一年以内，坏账准备计提比例为 5%。报告期各期末，应收票据和应收款项融资具体明细如下表所示：

单位：万元

分类	项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收票据	银行承兑汇票（含财务公司）	309.00	277.46	487.13
	商业承兑汇票	25.83	14.03	24.29
	小计	**334.83**	**291.49**	**511.42**
	坏账准备	4.23	4.57	1.21
	合计	**330.60**	**286.92**	**510.21**
应收款项融资	银行承兑汇票	645.55	478.90	2,691.52
	合计	**645.55**	**478.90**	**2,691.52**

根据新金融工具准则要求，同时遵照谨慎性原则，公司对承兑人的信用等级进行了划分，其中银行承兑汇票划分为信用级别较高的银行（指 6 家大型商业银行：中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银

行、交通银行，9 家全国性上市股份制商业银行：招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行，简称“6+9 银行”）以及其他信用级别的商业银行及财务公司（简称“非 6+9 银行”）。公司将由“6+9 银行”银行承兑的汇票计入应收款项融资科目列示，并在其背书转让或贴现时终止确认，由“非 6+9 银行”承兑的银行汇票以及商业承兑汇票计入应收票据列示，并在背书转让或贴现时继续确认为应收票据，待到期兑付后终止确认。报告期各期末，公司应收票据及应收款项融资中已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的情况如下表所示：

单位：万元

项目	终止确认金额		
	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	886.49	1,440.92	44.73
小计	**886.49**	**1,440.92**	**44.73**
项目	**未终止确认金额**		
	2025 年 12 月 31 日	**2024 年 12 月 31 日**	**2023 年 12 月 31 日**
银行承兑汇票	168.48	206.16	38.22
商业承兑汇票	-	-	12.49
小计	**168.48**	**206.16**	**50.71**

报告期内，公司应收票据期后兑付情况良好，未发生兑付方不予兑付、持票人向公司追索的情形。

4、应收账款

报告期各期末，公司应收账款具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款期末余额	16,244.59	15,306.29	15,552.54
减：坏账准备	834.37	792.41	801.74
应收账款账面价值	15,410.22	14,513.88	14,750.80
营业收入	45,786.50	38,489.05	35,139.21
应收款项余额占营业收入比例	35.48%	39.77%	44.26%

报告期各期末，公司应收账款的账面价值分别为 14,750.80 万元、14,513.88 万元和 15,410.22 万元，占各期末流动资产的比例为 26.74%、27.98%和 24.56%，

整体保持稳定，其中 2025 年末应收账款余额略有上升，主要系销售规模扩大所致。各期末应收账款余额占当期营业收入的比例分别为 44.26%、39.77%和 35.48%，呈现逐年下降趋势，表明公司销售回款效率持续提升。

2024 年末应收账款余额占营业收入比例较 2023 年末下降 4.49 个百分点，2025 年末进一步下降 4.29 个百分点，主要系随着公司业务规模扩大及市场地位增强，公司加强了对客户的信用管理和应收账款的催收力度使得整体回款周期缩短。此外，公司营业收入保持较快增长，收入规模的扩大亦在分母端降低了占比。

（1）应收账款账龄及坏账准备计提情况

单位：万元

坏账准备	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按单项计提坏账准备	2.56	100.00%	10.02	100.00%	10.02	100.00%
按组合计提坏账准备	831.81	5.12%	782.39	5.11%	791.72	5.09%
其中：账龄分析法	831.81	5.12%	782.39	5.11%	791.72	5.09%
合计	**834.37**	**5.14%**	**792.41**	**5.18%**	**801.74**	**5.16%**

1）采用账龄分析法计提坏账准备的情况

报告期各期末，公司采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款如下：

单位：万元

账龄	2025 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	16,204.46	810.22	5.00%
1-2 年	16.39	1.64	10.00%
2-3 年	-	-	-
3-4 年	1.68	0.50	30.00%
4-5 年	0.12	0.06	50.00%
5 年以上	19.39	19.39	100.00%
合计	**16,242.03**	**831.81**	**5.12%**
账龄	**2024 年 12 月 31 日**		
	账面余额	**坏账准备**	**计提比例**
1 年以内	15,245.52	762.28	5.00%
1-2 年	29.57	2.96	10.00%
2-3 年	1.68	0.34	20.00%

3-4 年	0.12	0.04	30.00%
4-5 年	5.21	2.60	50.00%
5 年以上	14.18	14.18	100.00%
合计	**15,296.27**	**782.39**	**5.11%**
账龄	**2023 年 12 月 31 日**		
	账面余额	**坏账准备**	**计提比例**
1 年以内	15,504.62	775.23	5.00%
1-2 年	5.48	0.55	10.00%
2-3 年	5.52	1.10	20.00%
3-4 年	5.21	1.56	30.00%
4-5 年	16.84	8.42	50.00%
5 年以上	4.85	4.85	100.00%
合计	**15,542.52**	**791.72**	**5.09%**

报告期各期末，公司应收账款主要为账龄一年以内的应收账款，发生坏账的风险较小。

公司与同行业可比上市公司应收账款坏账准备计提政策对比情况如下：

证券代码	公司名称	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 至 4 年	4 至 5 年	5 年以上
688035.SH	德邦科技	5.00%	10.00%	20.00%	30.00%	50.00%	100.00%
688157.SH	松井股份	预期信用损失率平均值			100.00%	100.00%	100.00%
300041.SZ	回天新材	5.00%	10.00%	20.00%	30.00%	50.00%	100.00%
688535.SH	华海诚科	预期信用损失率平均值			100.00%	100.00%	100.00%
688093.SH	世华科技	6 个月内（含）2.00%，6-12 月 5.00%	20.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%
本公司		**5.00%**	**10.00%**	**20.00%**	**30.00%**	**50.00%**	**100.00%**

注：以上数据取自各上市公司公开披露文件，其中，松井股份和华海诚科采用的坏账准备计提比例为各账龄区间实际执行的预期信用损失率的平均值。

公司坏账准备计提政策与同行业可比上市公司相比不存在重大差异。

2）采用单项计提坏账准备的情况

报告期内，公司单项计提坏账准备的情况如下表所示：

单位：万元

单位名称	2025 年 12 月 31 日					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
安徽国晶微电子有限公司	2.56	100.00%	2.56	100.00%	-	-
合计	**2.56**	**100.00%**	**2.56**	**100.00%**	**-**	**-**
单位名称	**2024 年 12 月 31 日**					
	账面余额		**坏账准备**		**账面价值**	
	金额	**比例**	**金额**	**比例**	**金额**	**比例**
通威太阳能（合肥）有限公司	2.50	24.95%	2.50	24.95%	-	-
深圳市垦鑫达科技有限公司	2.04	20.36%	2.04	20.36%	-	-
安徽国晶微电子有限公司	2.56	25.55%	2.56	25.55%	-	-
沃特维（义乌）实验室有限公司	1.52	15.17%	1.52	15.17%	-	-
东莞绿境通讯技术有限公司	1.40	13.97%	1.40	13.97%	-	-
合计	**10.02**	**100.00%**	**10.02**	**100.00%**	**-**	**-**
单位名称	**2023 年 12 月 31 日**					
	账面余额		**坏账准备**		**账面价值**	
	金额	**比例**	**金额**	**比例**	**金额**	**比例**
通威太阳能（合肥）有限公司	2.50	24.95%	2.50	24.95%	-	-
深圳市垦鑫达科技有限公司	2.04	20.36%	2.04	20.36%	-	-
安徽国晶微电子有限公司	2.56	25.55%	2.56	25.55%	-	-
沃特维（义乌）实验室有限公司	1.52	15.17%	1.52	15.17%	-	-
东莞绿境通讯技术有限公司	1.40	13.97%	1.40	13.97%	-	-
合计	**10.02**	**100.00%**	**10.02**	**100.00%**	**-**	**-**

上述款项均预计无法收回，故均全额计提坏账准备。

（2）发行人与同行业可比公司应收账款坏账准备实际计提的比例对比

证券代码	证券简称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
688035.SH	德邦科技	5.23%	5.12%	5.09%
300041.SZ	回天新材	7.51%	7.79%	8.52%
688157.SH	松井股份	8.25%	5.93%	5.93%
688535.SH	华海诚科	7.04%	8.63%	9.23%
688093.SH	世华科技	2.00%	2.00%	2.00%
同行业平均		**6.01%**	**5.89%**	**6.15%**

证券代码	证券简称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
本公司		5.14%	5.18%	5.16%

公司应收账款坏账准备实际计提比例与同行业可比公司并无重大差异，其略低于同行业可比公司平均值主要系公司主要应收款客户为境内外知名上市公司及其子公司，回款情况良好，坏账风险较低。

（3）应收账款前五名客户情况

报告期各期末，公司应收账款前五名客户具体如下：

单位：万元

客户名称	应收账款和合同资产账面余额	占应收账款和合同资产余额比例	是否关联方
2025 年 12 月 31 日			
立讯精密	3,346.46	20.26%	否
东山精密	3,072.62	18.60%	否
安费诺（东亚）有限公司	1,734.72	10.50%	否
鹏鼎控股	1,171.30	7.09%	否
富士康	908.29	5.50%	否
合计	**10,233.39**	**61.95%**	
2024 年 12 月 31 日			
东山精密	3,625.53	23.60%	否
立讯精密	2,572.34	16.74%	否
安费诺（东亚）有限公司	1,900.35	12.37%	否
和硕	902.18	5.87%	否
鹏鼎控股	842.86	5.49%	否
合计	**9,843.26**	**64.06%**	
2023 年 12 月 31 日			
东山精密	4,237.92	27.17%	否
鹏鼎控股	2,046.87	13.12%	否
立讯精密	1,374.75	8.81%	否
旗胜电子	990.55	6.35%	否
安费诺（东亚）有限公司	952.90	6.11%	否
合计	**9,602.99**	**61.56%**	

注：上述客户名称均系包含受其同一实际控制人控制企业的合并计算口径数据。

报告期各期末，公司应收账款前五名客户均为智能终端、新能源领域的知名厂商，信用情况良好，且应收账款账龄主要在一年以内，坏账风险相对较小。

（4）公司信用政策情况

公司综合考虑客户的经营情况、企业规模、信用状况、合作历史、付款条件等因素后制定对应信用政策，平均而言，公司一般给予生产商客户 90-120 天的信用账期；一般给予经销及贸易商客户 60-90 天的信用账期。报告期内，公司对主要客户的信用政策稳定，未发生重大变化。

5、预付账款

报告期各期末，预付账款账龄主要在一年以内，预付账款按账龄分析的具体情况如下表所示。

单位：万元

账龄	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	476.73	99.57%	1,049.42	97.65%	247.90	97.69%
1-2 年	1.87	0.39%	25.25	2.35%	5.85	2.31%
2-3 年	0.20	0.04%	-	-	-	-
合计	**478.80**	**100.00%**	**1,074.67**	**100.00%**	**253.75**	**100.00%**

公司的预付账款主要系原材料采购款及服务采购款等，报告期各期末，公司预付款项分别为 253.75 万元、1,074.67 万元和 478.80 万元，占各期末流动资产的比例分别为 0.46%、2.07%和 0.76%，占比较小。公司预付账款账龄主要在 1 年以内，预付款项不能兑现的风险较小。

2024 年末，预付账款同比 2023 年末增加 820.92 万元，主要系 GTC 储能项目传热模块组装线预付供应商设备款 714.50 万元所致。

6、其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款按性质划分情况如下：

单位：万元

其他应收款	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
保证金、押金	138.27	68.55%	86.33	58.43%	166.11	56.69%

其他应收款	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
备用金	-	-	2.00	1.35%	-	-
往来款项	-	-	-	-	42.60	14.54%
代垫社保、公积金	56.36	27.94%	52.62	35.61%	53.95	18.41%
其他	7.07	3.51%	6.80	4.60%	30.37	10.36%
账面余额合计	**201.70**	**100.00%**	**147.75**	**100.00%**	**293.03**	**100.00%**
减：坏账准备	29.09	14.42%	17.27	11.69%	21.56	7.36%
账面价值	**172.61**	**85.58%**	**130.48**	**88.31%**	**271.47**	**92.64%**

报告期各期末，其他应收款账面价值分别为 271.47 万元、130.48 万元和 172.61 万元，占各期末流动资产的比例为 0.49%、0.25%及 0.28%，占比较小，主要由保证金及押金、往来款项、代垫社保和公积金等构成。

7、存货

报告期内，公司存货主要包括原材料、库存商品和发出商品。报告期各期末，公司各类存货账面余额具体情况如下：

单位：万元

存货	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	1,427.92	37.56%	1,281.81	39.13%	1,416.29	49.06%
半产品	364.99	9.60%	257.82	7.87%	125.01	4.33%
库存商品	1,279.55	33.65%	1,197.74	36.56%	774.92	26.84%
周转材料及低值易耗品	53.68	1.41%	45.70	1.39%	25.67	0.89%
发出商品	658.76	17.33%	475.90	14.53%	532.12	18.43%
合同履约成本	17.28	0.45%	17.02	0.52%	13.12	0.45%
账面余额合计	**3,802.17**	**100.00%**	**3,275.99**	**100.00%**	**2,887.13**	**100.00%**
减：存货跌价准备	518.06	13.63%	272.99	8.33%	267.77	9.27%
账面价值	**3,284.11**	**86.37%**	**3,003.00**	**91.67%**	**2,619.36**	**90.73%**

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 2,619.36 万元、3,003.00 万元和 3,284.11 万元，占各期末流动资产比重分别为 4.75%、5.79%和 5.23%。报告期各期末公司存货账面价值随着公司业务规模扩大呈上升趋势。

报告期各期末，公司存货跌价准备计提情况具体如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	1,427.92	166.78	1,281.81	123.41	1,416.29	87.4
半成品	364.99	16.67	257.82	11.92	125.01	17.32
库存商品	1,279.55	298.21	1,197.74	112.02	774.92	115.46
周转材料及低值易耗品	53.68	-	45.70	-	25.67	-
发出商品	658.76	36.40	475.90	25.63	532.12	47.58
合同履约成本	17.28	-	17.02	-	13.12	-
合计	**3,802.17**	**518.06**	**3,275.99**	**272.99**	**2,887.13**	**267.77**

报告期各期末，公司结合存货库龄以及预计销售需求状况，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。

8、合同资产

合同资产为公司向客户提供电子胶粘剂配套设备业务的应收质保金。报告期各期末，公司合同资产账面价值分别为 42.81 万元、56.10 万元和 259.23 万元，占各期末流动资产的比例分别为 0.08%、0.11%和 0.41%，公司各期末应收质保金账龄基本在 1 年以内。2025 年末，合同资产同比 2024 年末增加 203.13 万元，主要系客户在 2025 年完成 GTC 储能项目传热模块组装线的验收，公司据此增加质保金所致。

9、一年内到期的非流动资产

报告期各期末，公司一年内到期的非流动资产分别为 0 万元、0 万元和 4,391.67 万元。2025 年末，公司一年内到期的非流动资产系购买的一年内到期的长期协定存款及应计利息。

10、其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产按性质划分情况如下：

单位：万元

其他流动资产	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一年内到期的定期、定息存款及利息	5,927.59	64.41%	18,271.67	83.89%	3,339.02	58.61%

其他流动资产	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
净额法确认收入的贸易产品	1,730.51	18.80%	2,167.27	9.95%	1,067.41	18.74%
留抵及待抵扣税额	-	0.00%	-	0.00%	873.06	15.32%
待摊费用	34.66	0.38%	52.69	0.24%	58.90	1.03%
预缴税费及其他	43.20	0.47%	11.73	0.05%	48.27	0.85%
IPO 发行费	-	0.00%	-	0.00%	310.66	5.45%
合计	**9,202.63**	**100.00%**	**21,781.34**	**100.00%**	**5,697.32**	**100.00%**

公司其他流动资产主要系留抵及待抵扣税额、尚未销售的以净额法确认收入的贸易产品和一年内到期的定期、定息存款及利息。报告期各期末，公司其他流动资产余额分别为 5,697.32 万元、21,781.34 万元和 9,202.63 万元，占各期末流动资产的比例分别为 10.33%、41.99%和 14.67%。

公司将部分闲置的现金用于购买银行机构的定期、定息存款。其中，期限在 1 年以内的列报于“其他流动资产”，期限在 1 年以上的列报于“其他非流动资产”。

（三）非流动资产构成及变化分析

报告期各期末，公司非流动资产具体构成情况如下：

单位：万元

非流动资产	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
投资性房地产	1,431.00	2.10%	1,481.54	2.33%	1,532.09	3.34%
固定资产	34,543.90	50.66%	28,187.14	44.32%	13,756.95	29.97%
在建工程	11,751.37	17.23%	9,541.65	15.00%	13,044.17	28.41%
使用权资产	5,584.06	8.19%	6,133.65	9.65%	8,449.60	18.41%
无形资产	5,404.09	7.92%	5,578.24	8.77%	2,980.27	6.49%
商誉	648.95	0.95%	648.95	1.02%	648.95	1.41%
长期待摊费用	4,764.76	6.99%	4,617.40	7.26%	2,781.47	6.06%
递延所得税资产	2,545.29	3.73%	1,500.51	2.36%	909.28	1.98%
其他非流动资产	1,517.93	2.23%	5,904.14	9.28%	1,805.01	3.93%
合计	**68,191.35**	**100.00%**	**63,593.21**	**100.00%**	**45,907.79**	**100.00%**

公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、长期

待摊费用构成。报告期各期末，上述五类非流动资产合计占非流动资产总额的比重分别为 89.34%、85.00%和 90.99%。

1、投资性房地产

报告期各期末，公司投资性房地产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产原值	1,884.91	1,884.91	1,884.91
累计折旧	453.91	403.36	352.82
账面价值	**1,431.00**	**1,481.54**	**1,532.09**

报告期各期末，公司投资性房地产为深圳美科泰持有的对外出租办公楼。

2、固定资产

报告期各期末，公司固定资产构成情况如下：

单位：万元

固定资产	账面原值	累计折旧	账面价值
2025 年 12 月 31 日			
房屋及建筑物	27,365.26	2,294.57	25,070.69
机器设备	13,207.40	4,543.53	8,663.87
运输设备	355.99	255.07	100.92
电子设备及其他	1,736.09	1,027.67	708.41
合计	**42,664.74**	**8,120.84**	**34,543.90**
2024 年 12 月 31 日			
房屋及建筑物	21,011.69	1,299.99	19,711.70
机器设备	10,964.15	3,012.79	7,951.36
运输设备	446.28	303.53	142.75
电子设备及其他	1,209.82	828.49	381.33
合计	**33,631.93**	**5,444.79**	**28,187.14**
2023 年 12 月 31 日			
房屋及建筑物	7,390.70	682.35	6,708.35
机器设备	8,163.39	1,725.04	6,438.35
运输设备	421.32	257.43	163.88
电子设备及其他	1,096.26	649.90	446.37
合计	**17,071.67**	**3,314.72**	**13,756.95**

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 13,756.95 万元、28,187.14 万元和 34,543.90 万元，占各期末非流动资产比例分别为 29.97%、44.32%和 50.66%，公司的固定资产主要由房屋及建筑物、机器设备构成。报告期各期末，公司固定资产持续增长主要由于为扩充产能和改善工作环境而购建新厂区的房屋、车间以及生产设备，同时为满足研发项目增多和技术难度提升的需求，相应增加了研发设备的投入。

截至 2025 年末，账面价值为 13,650.72 万元的固定资产作为抵押物用于本公司银行借款。

公司各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率及与同行业可比公司对比情况如下：

发行人固定资产折旧年限与同行业可比公司相比并无明显差异。

类别	公司名称	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	德邦科技	年限平均法	10-30	5.00%	3.17%-9.50%
	松井股份	年限平均法	30	5.00%	3.17%
	回天新材	年限平均法	15-35	3%/5%	2.71%-6.47%
	华海诚科	年限平均法	20-30	5.00%	3.17%-4.75%
	世华科技	年限平均法	20/30	5.00%-10.00%	3.00%-4.75%
	发行人	**年限平均法**	**20-30**	**5.00%**	**3.17%-4.75%**
机器设备	德邦科技	年限平均法	5-10	5.00%	9.50%-19.00%
	松井股份	年限平均法	10	5.00%	9.50%
	回天新材	年限平均法	3-10	3%/5%	9.5%-32.33%
	华海诚科	年限平均法	10	5.00%	9.50%
	世华科技	年限平均法	5/10	5.00%-10.00%	9.00%-19.00%
	发行人	**年限平均法**	**3-10**	**5.00%**	**9.50%-31.67%**
运输工具	德邦科技	年限平均法	5	5.00%	19.00%
	松井股份	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%
	回天新材	年限平均法	4-6	3%/5%	15.83%-24.25%
	华海诚科	年限平均法	4	5.00%	23.75%
	世华科技	年限平均法	4	0.00%-10.00%	22.50%-25.00%
	发行人	**年限平均法**	**4**	**5.00%**	**23.75%**
电子设备	德邦科技	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%

类别	公司名称	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
（办公设备）	松井股份	年限平均法	5	5.00%	19.00%
	回天新材	年限平均法	3-8	3%/5%	11.88%-32.33%
	华海诚科	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%
	世华科技	年限平均法	3/5	0.00%-10.00%	18.00%-33.33%
	发行人	**年限平均法**	**3-5**	**5.00%**	**19.00%-31.67%**

3、在建工程

报告期各期末，公司在建工程账面价值情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
德聚二期工程增资扩产项目-装修	-	3,813.54	-
德聚二期工程增资扩产项目-基建	-	109.69	10,982.30
德聚高端复合功能材料生产项目	11,751.37	5,618.41	481.74
德聚高端半导体胶粘剂和胶膜项目	-	-	42.74
德聚北方总部产研一体化项目（二期）	-	-	921.67
德聚如东研发中心项目	-	-	615.73
合计	**11,751.37**	**9,541.65**	**13,044.17**

报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为 13,044.17 万元、9,541.65 万元和 11,751.37 万元，占各期末非流动资产比例分别为 28.41%、15.00%和 17.23%。

报告期各期末，公司主要在建工程为德聚二期和德聚高端复合功能材料生产项目，其中德聚二期基建工程已于 2024 年完成竣工验收，德聚二期装修工程已于 2025 年完成验收，德聚高端复合功能材料生产项目目前正在办理相关验收手续，预计 2026 年三季度转固。公司自行建造的在建工程按实际成本计价，各期末均不计提减值准备，建设进度与建设支出相匹配，在建工程不存在减值迹象。

4、使用权资产

报告期各期末，公司使用权资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
账面原值	7,094.09	7,279.53	9,611.13
累计折旧	1,510.03	1,145.88	1,161.53

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
账面价值	**5,584.06**	**6,133.65**	**8,449.60**

报告期各期末，公司使用权资产的账面价值分别为 8,449.60 万元、6,133.65 万元和 5,584.06 万元，呈现逐年下降趋势。与 2023 年末相比，2024 年末使用权资产减少了 2,315.95 万元，主要为配合德聚二期新厂房的建成投用，发行人于 2024 年末主动提前终止了下沙工业园区厂房的租赁合同；以及子公司如东德聚为优化资源配置、实现降本增效，同步退租了位于如东沿海经济开发区节能环保孵化器的 6#厂房。与 2024 年末相比，2025 年末使用权资产减少 549.59 万元，主要系使用权资产折旧计提所致。

5、无形资产

报告期各期末，公司无形资产按性质构成情况如下：

单位：万元

无形资产	账面原值	累计摊销	账面价值
2025 年 12 月 31 日			
土地使用权	4,784.64	356.49	4,428.15
专利权	130.00	53.05	76.95
非专利技术	864.91	99.68	765.23
软件	251.13	118.35	132.78
商标	1.26	0.28	0.98
合计	**6,031.93**	**627.84**	**5,404.09**
2024 年 12 月 31 日			
土地使用权	4,784.64	225.18	4,559.46
专利权	130.00	36.72	93.28
非专利技术	864.91	54.69	810.22
软件	198.63	84.41	114.22
商标	1.26	0.20	1.06
合计	**5,979.43**	**401.19**	**5,578.24**
2023 年 12 月 31 日			
土地使用权	2,860.30	115.25	2,745.04
专利权	130.00	20.39	109.61
非专利技术	34.91	20.07	14.83
软件	161.37	51.73	109.64

无形资产	账面原值	累计摊销	账面价值
商标	1.26	0.12	1.14
合计	**3,187.84**	**207.57**	**2,980.27**

公司无形资产系土地使用权、非专有技术及软件。报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 2,980.27 万元、5,578.24 万元和 5,404.09 万元，占非流动资产的比例分别为 6.49%、8.77%和 7.92%。与 2023 年末相比，2024 年末无形资产增加 2,597.97 万元，主要系子公司江苏德聚购买土地使用权所致，与 2024 年末相比，无形资产减少了 174.15 万元，主要系无形资产摊销所致。

截至 2025 年末，账面价值为 899.65 万元的发行人土地使用权作为抵押物用于本公司银行借款用途。

6、商誉

公司商誉系由发行人收购深圳美科泰、上海锐朗 100%股权形成。报告期各期末，公司商誉构成情况如下：

单位：万元

被投资单位	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	原值	净值	原值	净值	原值	净值
深圳美科泰	3,332.40	648.95	3,332.40	648.95	3,332.40	648.95
上海锐朗	331.23	-	331.23	-	331.23	-
合计	**3,663.63**	**648.95**	**3,663.63**	**648.95**	**3,663.63**	**648.95**

报告期各期末，商誉减值准备计提情况如下：

单位：万元

被投资单位	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
深圳美科泰	-	-	2,683.45
上海锐朗	-	-	331.23
合计	**-**	**-**	**3,014.68**

报告期各期末，公司对收购的子公司深圳美科泰、上海锐朗商誉进行了减值测试，在预计可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组合来预计未来现金流量现值，即依据管理层制定的未来五年财务预算预计未来现金流量的现值，超过五年财务预算之后年份的现金流量均预计保持稳定。经商誉减值测试，2023 年末，公司对深圳美科泰和上海锐朗计提商誉减值准备金额分别为 2,683.45 万元和

331.23 万元。

7、长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用账面价值构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
装修费	4,717.22	99.00%	4,593.41	99.48%	2,765.21	99.42%
软件服务费	47.55	1.00%	23.99	0.52%	16.25	0.58%
合计	**4,764.76**	**100.00%**	**4,617.40**	**100.00%**	**2,781.47**	**100.00%**

公司长期待摊费用系装修费及软件服务费。报告期各期末，公司长期待摊费用账面价值为 2,781.47 万元、4,617.40 万元和 4,764.76 万元，占各期末非流动资产的比例分别为 6.06%、7.26%和 6.99%，报告期各期末，长期待摊费用增长较快，主要系工程项目装修完工转入所致。2024 年末，长期待摊费用较 2023 年末增加 1,835.93 万元，主要系德聚北方总部产研一体化项目及如东研发中心项目装修工程完工转入所致。

8、递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产减值准备	254.28	194.05	194.28
内部交易未实现利润	206.33	139.87	58.68
可抵扣亏损	1,904.14	1,074.13	578.03
租赁负债	1,285.36	1,045.90	1,471.87
递延收益	66.08	3.45	5.07
合计	**3,716.19**	**2,457.41**	**2,307.92**
减：抵消递延所得税负债	1,170.90	956.89	1,398.64
抵消后的递延所得税资产净额	**2,545.29**	**1,500.51**	**909.28**

报告期各期末，公司递延所得税资产余额分别为 909.28 万元、1,500.51 万元和 2,545.29 万元，占各期末非流动资产的比例分别为 1.98%、2.36%和 3.73%。报告期内公司递延所得税资产持续增长，主要由于可抵扣亏损增加所致。

9、其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
预付设备及工程款	1,517.93	100.00%	1,644.14	27.85%	1,431.01	79.28%
定期存款及利息	-	-	4,260.00	72.15%	-	0.00%
预付土地购买款	-	-	-	0.00%	374.00	20.72%
合计	**1,517.93**	**100.00%**	**5,904.14**	**100.00%**	**1,805.01**	**100.00%**

公司其他非流动资产主要包括预付设备及工程款和定期存款及利息。报告期各期末，公司其他非流动资产账面价值分别为 1,805.01 万元、5,904.14 万元和 1,517.93 万元，占各期末非流动资产的比例分别为 3.93%、9.28%和 2.23%。2024 年末，公司其他非流动资产较 2023 年末增加 4,099.13 万元，增幅较大，主要系公司为提高资金使用效率，购入一年期以上的银行大额定期存单所致。截至 2024 年末，银行定期存单本金及计提利息为 4,260.00 万元。2025 年，公司其他非流动资产较 2024 年末减少 4,386.21 万元，主要系前述银行大额定期存单到期日缩短至一年以内，根据会计准则重分类至其他流动资产项下的“一年内到期的定期、定息存款及利息”进行列报。

（四）营运能力分析

1、资产周转能力

财务指标	2025 年度	2024 年度	2023 年度
存货周转率（次）	3.35	3.47	3.05
应收账款周转率（次）	3.06	2.63	2.49
总资产周转率（次）	0.37	0.36	0.40

报告期内，公司存货周转率分别为 3.05、3.47 和 3.35，应收账款周转率分别为 2.49、2.63 和 3.06，公司总资产周转率分别为 0.40、0.36 和 0.37，存货周转率、应收账款周转率和公司总资产周转率在报告期内保持相对稳定。

2、同行业上市公司比较情况

财务指标	公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
存货周转率（次）	德邦科技	5.85	5.03	4.15
	回天新材	6.34	6.15	5.75
	松井股份	2.94	3.51	3.95
	华海诚科	2.58	3.03	2.83
	世华科技	4.57	4.14	3.68
	可比公司平均	**4.46**	**4.37**	**4.07**
	本公司	**3.35**	**3.47**	**3.05**
应收账款周转率（次）	德邦科技	5.03	5.57	4.24
	回天新材	3.64	3.93	4.33
	松井股份	2.16	2.19	2.31
	华海诚科	2.05	2.62	2.37
	世华科技	3.94	3.51	2.98
	可比公司平均	**3.36**	**3.56**	**3.25**
	本公司	**3.06**	**2.63**	**2.49**
总资产周转率（次）	德邦科技	0.48	0.41	0.35
	回天新材	0.67	0.62	0.64
	松井股份	0.41	0.44	0.40
	华海诚科	0.20	0.25	0.33
	世华科技	0.43	0.38	0.29
	可比公司平均	**0.44**	**0.42**	**0.40**
	本公司	**0.37**	**0.36**	**0.40**

（1）存货周转率

报告期内，公司存货周转率分别为 3.05、3.47 和 3.35。公司存货周转率低于同行业可比公司，主要系公司以对账为主作为确认收入的时点，可比公司多数以签收确认为主，导致公司的发出商品占比较高。

（2）应收账款周转率

报告期内，公司应收账款周转率分别为 2.49、2.63 和 3.06，公司应收账款周转率低于行业可比公司平均值。公司基于发展战略考虑，重点布局高端品牌市场，给予主要客户月结 90-120 天的账期，该等客户多为境内外上市公司及其子公司，

其经营规模较大，应收账款不能及时收回的风险较低。报告期内，公司应收账款周转率处于上升趋势，收款能力在加强。报告期内，公司应收账款周转率低于可比上市公司主要系由于结算方式差异，相比可比公司，公司通过承兑汇票结算的方式较少，在考虑应收账款融资和应收票据后，公司应收类资产周转率和可比上市公司基本一致。

（3）总资产周转率

报告期内，公司总资产周转率分别为 0.40、0.36 和 0.37，与同行业可比公司不存在重大差异。

十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

（一）负债状况分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	13,033.73	40.24%	19,821.47	66.30%	10,293.70	45.45%
非流动负债	19,355.11	59.76%	10,077.04	33.70%	12,354.01	54.55%
合计	**32,388.84**	**100.00%**	**29,898.51**	**100.00%**	**22,647.72**	**100.00%**

报告期各期末，公司负债总额分别为 22,647.72 万元、29,898.51 万元和 32,388.84 万元，整体呈增长趋势，与公司业务规模扩张相匹配。

从负债结构来看，公司负债以非流动负债为主，但结构存在一定波动。2023 年末及 2025 年末，非流动负债占比均超过 50.00%，分别为 54.55%和 59.76%；而 2024 年末，非流动负债占比显著下降至 33.70%，主要系租赁负债按照企业会计准则重分类 5,866.04 万元至流动负债列报。

1、流动负债分析

报告期各期末，公司流动负债构成如下：

单位：万元

流动负债	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	-	-	169.86	0.86%	189.68	1.84%

流动负债	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应付票据	-	-	1,000.00	5.05%	-	-
应付账款	4,229.89	32.45%	5,630.42	28.41%	4,902.35	47.62%
合同负债	67.01	0.51%	491.45	2.48%	50.02	0.49%
应付职工薪酬	4,340.70	33.30%	3,971.45	20.04%	3,373.01	32.77%
应交税费	1,938.19	14.87%	1,112.91	5.61%	796.56	7.74%
其他应付款	245.45	1.88%	179.24	0.90%	226.05	2.20%
一年内到期的非流动负债	1,813.62	13.91%	6,876.42	34.69%	571.76	5.55%
其他流动负债	398.88	3.06%	389.72	1.97%	184.28	1.79%
合计	**13,033.73**	**100.00%**	**19,821.47**	**100.00%**	**10,293.70**	**100.00%**

公司流动负债主要包括应付账款、应付职工薪酬、应交税费、一年内到期的非流动负债。报告期各期末，该四类流动负债合计占各期末流动负债总额的比例分别为 93.68%、88.75%和 94.53%。

（1）短期借款

报告期各期末，公司短期借款构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
	金额	金额	金额
抵押借款	-	169.86	189.68
合计	**-**	**169.86**	**189.68**

报告期各期末，公司短期借款余额分别为 189.68 万元、169.86 万元和 0 万元，系子公司 CollTech Technology Co.,Ltd.于 2023 年 7 月为支付购房款向韩亚银行借入的 3.44 亿韩元借款，借款期限 12 个月。该笔借款于 2024 年 7 月续贷一年，后于 2025 年提前偿还完毕。

（2）应付票据

报告期各期末，公司应付票据余额分别为 0 万元、1,000.00 万元和 0 万元。2024 年末金额系支付中国建筑第二工程局有限公司工程款，由于开具应付票据需要存入保证金及支付手续费，为控制资金成本，公司后续减少了此类支付方式。

（3）应付账款

报告期各期末，公司应付账款构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应付材料款	1,083.44	25.61%	1,305.18	23.18%	1,247.81	25.45%
应付工程款	2,362.02	55.84%	3,589.84	63.76%	2,710.79	55.30%
应付设备款	151.59	3.58%	336.28	5.97%	524.90	10.71%
应付服务费	368.73	8.72%	155.89	2.77%	313.62	6.40%
应付其他款	264.11	6.24%	243.23	4.32%	105.23	2.15%
合计	**4,229.89**	**100.00%**	**5,630.42**	**100.00%**	**4,902.35**	**100.00%**

公司应付账款主要系应付材料款、应付工程款及设备款和应付服务费等，应付服务费主要系中介服务费、咨询费、物流费、检测费等。报告期各期末，公司应付账款的余额为 4,902.35 万元、5,630.42 万元和 4,229.89 万元，占流动负债的比例分别为 47.62%、28.41%和 32.45%。

2024 年末应付账款较 2023 年末增长 14.85%，主要系随着公司新厂房建设推进，应付工程款增加所致。2025 年末，应付账款较 2024 年末减少 1,400.53 万元，主要系随着德聚二期装修项目和德聚高端复合功能材料生产项目主体工程进入验收阶段，工程款支出同比减少，带动应付账款规模大幅下降。

报告期各期末，公司应付账款前五名情况如下：

单位：万元

序号	应付对象名称	账面余额	应付账款余额占比	款项性质	是否为关联方
2025 年 12 月 31 日					
1	中国建筑第二工程局有限公司	409.06	9.67%	应付工程款	否
2	深圳市天域空间设计研究院有限公司	327.98	7.75%	应付工程款	否
3	中国二十二冶集团有限公司	292.09	6.91%	应付工程款	否
4	广州亿菲迪电子科技有限公司	279.41	6.61%	应付材料款	否
5	深圳市淳源环保设计工程有限公司	239.14	5.65%	应付工程款	否
合计		**1,547.69**	**36.59%**		

序号	应付对象名称	账面余额	应付账款余额占比	款项性质	是否为关联方
2024 年 12 月 31 日					
1	中国建筑第二工程局有限公司	1,570.01	27.88%	应付工程款	否
2	中国二十二冶集团有限公司	1,018.30	18.09%	应付工程款	否
3	苏州安捷信环境技术工程有限公司	321.38	5.71%	应付工程款	否
4	广州亿菲迪电子科技有限公司	219.46	3.90%	应付材料款	否
5	苏州汇海环境技术工程有限公司	181.10	3.22%	应付工程款	否
合计		**3,310.25**	**58.79%**		
2023 年 12 月 31 日					
1	中国二十二冶集团有限公司	834.69	17.03%	应付工程款	否
2	山东中钰盛建设有限公司	506.27	10.33%	应付工程款	否
3	苏州汇海环境技术工程有限公司	296.10	6.04%	应付工程款	否
4	苏州安捷信环境技术工程有限公司	257.43	5.25%	应付工程款	否
5	洛德	217.36	4.43%	应付材料款	否
合计		**2,111.86**	**43.08%**		

注：洛德包括洛德国际贸易（上海）有限公司及 Lord Corporation。

（4）合同负债

公司合同负债均系预收货款，报告期各期末余额为 50.02 万元、491.45 万元和 67.01 万元，占流动负债的比例分别为 0.49%、2.48%和 0.51%。2024 年末，合同负债金额较 2023 年末增加了 441.43 万元，主要系公司预收客户 GTC 储能项目传热模块组装线进度款所致，该产线已于 2025 年完成验收确认收入。

（5）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬按性质构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期薪酬	4,320.21	99.53%	3,909.15	98.43%	3,343.36	99.12%
离职后福利-设定提存计划	20.49	0.47%	19.13	0.48%	21.39	0.63%

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
辞退福利	-	-	43.17	1.09%	8.27	0.25%
合计	**4,340.70**	**100.00%**	**3,971.45**	**100.00%**	**3,373.01**	**100.00%**

公司应付职工薪酬由短期薪酬、离职后福利和辞退福利构成。报告期各期末，公司应付职工薪酬的余额为 3,373.01 万元、3,971.45 万元和 4,340.70 万元，占流动负债的比例分别为 32.77%、20.04%和 33.30%。其中，公司计提的短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、社会保险费及住房公积金。报告期各期末，应付职工薪酬持续增加主要系随着收入规模的扩大，计提的奖金相应增加。

（6）应交税费

报告期各期末，公司应交税费按性质构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
增值税	359.64	18.56%	86.02	7.73%	200.47	25.17%
城市维护建设税	20.03	1.03%	6.19	0.56%	10.46	1.31%
教育费附加	10.78	0.56%	2.89	0.26%	4.66	0.59%
地方教育费附加	7.19	0.37%	1.93	0.17%	3.11	0.39%
企业所得税	1,437.72	74.18%	926.12	83.22%	503.69	63.23%
印花税	5.82	0.30%	5.03	0.45%	4.34	0.54%
销售税	17.35	0.90%	5.28	0.47%	8.11	1.02%
个人所得税	60.47	3.12%	55.32	4.97%	54.97	6.90%
土地使用税	3.90	0.20%	3.76	0.34%	0.41	0.05%
房产税	15.28	0.79%	20.25	1.82%	6.24	0.78%
其他	-	-	0.12	0.01%	0.10	0.01%
合计	**1,938.19**	**100.00%**	**1,112.91**	**100.00%**	**796.56**	**100.00%**

公司应交税费主要为企业所得税、增值税及其附加费等。报告期各期末，公司应交税费余额为 796.56 万元、1,112.91 万元和 1,938.19 万元，占流动负债的比例分别为 7.74%、5.61%和 14.87%。报告期各期末，应交税费余额呈逐年上升趋势，主要系随着公司销售规模持续扩大，收入增长带动税前利润增长使得应交企业所得税金额上升所致。

（7）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款余额构成如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
押金	7.00	2.85%	7.00	3.91%	9.79	4.33%
往来款	8.24	3.36%	4.64	2.59%	3.54	1.57%
应付费用	230.22	93.80%	167.60	93.51%	212.71	94.10%
合计	**245.45**	**100.00%**	**179.24**	**100.00%**	**226.05**	**100.00%**

公司其他应付款主要系应付费用、往来款、押金等，其中，应付费用主要系尚未结算的水电费、办公费、报销款及其他零星费用。报告期各期末，公司其他应付款的余额为 226.05 万元、179.24 万元和 245.45 万元，占流动负债的比例分别为 2.20%、0.90%和 1.88%，金额及占比均较小。

（8）一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债余额构成如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一年内到期的长期借款	1,516.97	83.64%	1,010.39	14.69%	3.79	0.66%
一年内到期的租赁负债	296.65	16.36%	5,866.04	85.31%	567.97	99.34%
合计	**1,813.62**	**100.00%**	**6,876.42**	**100.00%**	**571.76**	**100.00%**

公司一年内到期的非流动负债系一年内到期的长期借款及一年内到期的租赁负债。报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债余额为 571.76 万元、6,876.42 万元和 1,813.62 万元，占流动负债的比例分别为 5.55%、34.69%和 13.91%。

公司一年内到期的长期借款系向建设银行石排支行申请的专项固定资产贷款资金，根据还款计划将在一年以内偿还的贷款本金及利息。报告期内，随着固定资产项目建设推进，长期借款规模增加，导致一年内到期的长期借款相应增长。

一年内到期的租赁负债 2024 年末大幅增至 5,866.04 万元，主要系公司位于青岛高新区锦汇路 1 号蓝湾创业园的租赁物业原租赁期至 2025 年 12 月 31 日到期，故在 2024 年末将其对应的租赁负债金额重分类至“一年内到期的租赁负债”

列报。2025 年 5 月，公司与出租方签订补充协议，将租赁期延长至 2028 年 3 月，因此该部分租赁负债不再属于一年内到期，2025 年末相应减少至 296.65 万元。

（9）其他流动负债

公司其他流动负债系待转销项税额、已背书未终止确认的应收票据。报告期各期末，公司其他流动负债余额为 184.28 万元、389.72 万元和 398.88 万元，占流动负债的比例分别为 1.79%、1.97%和 3.06%，占比较小。

2、非流动负债分析

报告期各期末，公司非流动负债余额构成如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期借款	12,385.00	63.99%	8,712.00	86.45%	3,596.00	29.11%
租赁负债	6,114.03	31.59%	938.26	9.31%	8,355.35	67.63%
递延收益	440.54	2.28%	22.98	0.23%	33.80	0.27%
递延所得税负债	415.53	2.15%	403.81	4.01%	368.87	2.99%
合计	**19,355.11**	**100.00%**	**10,077.04**	**100.00%**	**12,354.01**	**100.00%**

公司非流动负债包括长期借款、租赁负债、递延收益和递延所得税负债。报告期各期末，非流动负债合计占各期末负债总额的比例分别为 54.55%、33.70%和 59.76%。2024 年末非流动负债占比下降，主要系一年内到期的租赁负债重分类至流动负债所致；2025 年末随着新租赁协议的签订及长期借款的增加，占比回升至 59.76%。

（1）长期借款

报告期各期末，公司长期借款构成如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
抵押借款	13,885.00	9,712.00	3,596.00
未到期应计利息	16.97	10.39	3.79
减：一年内到期的长期借款	1,516.97	1,010.39	3.79
合计	**12,385.00**	**8,712.00**	**3,596.00**

公司长期借款均为抵押借款，系银行机构发放的专项固定资产贷款，用于德

聚二期工程和德聚高端复合功能材料生产项目建设。报告期各期末，长期借款余额（不含一年内到期部分）分别为 3,596.00 万元、9,712.00 万元和 12,885.00 万元，呈持续增长趋势。长期借款的增加主要系随着项目建设进度推进，公司增加长期借款以满足资金需求。

（2）租赁负债

报告期各期末，公司租赁负债余额构成如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
租赁付款额总额	6,929.58	7,262.07	9,771.27
减：未确认融资费用	518.90	457.78	847.95
租赁付款额现值小计	6,410.68	6,804.30	8,923.32
减：一年内到期的租赁负债	296.65	5,866.04	567.97
合计	**6,114.03**	**938.26**	**8,355.35**

公司租赁负债主要核算经营场所租赁形成的长期应付租金。报告期各期末，租赁负债余额分别为 8,355.35 万元、938.26 万元和 6,114.03 万元，占非流动负债的比例分别为 67.63%、9.31%和 31.59%。

2024 年末租赁负债较 2023 年末减少 7,417.09 万元，主要系公司位于青岛高新区锦汇路 1 号蓝湾创业园的租赁物业原租赁期至 2025 年 12 月 31 日到期，故在 2024 年末将其对应的租赁负债全额重分类至“一年内到期的非流动负债”列报，相应减少长期租赁负债余额。2025 年 5 月，公司与出租方签订补充协议，将租赁期延长至 2028 年 3 月，根据租赁期变更后的租赁付款额重新计算租赁负债，原重分类至一年内到期的部分重新确认为非流动负债，导致 2025 年末租赁负债回升至 6,114.03 万元。

（3）递延收益

报告期各期末，公司递延收益余额分别为 33.8 万元、22.98 万元和 440.54 万元，占各期末非流动负债的比例分别为 0.27%、0.23%和 2.28%。2025 年末，递延收益增加较多主要系公司当年收到重点小巨人实施补助资金及 2024 年市重点领域研发项目补助——关键技术攻关项目中期评估资助资金共计 485.00 万元。

（二）偿债能力分析

1、主要偿债能力指标分析

报告期内，公司反映偿债能力的财务指标如下：

主要财务指标	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
流动比率（倍）	4.81	2.62	5.36
速动比率（倍）	4.56	2.47	5.11
资产负债率（合并）（%）	24.74	25.89	22.41
资产负债率（母公司）（%）	19.74	19.68	14.59
息税折旧摊销前利润（万元）	18,636.11	12,607.82	8,087.84
利息保障倍数（倍）	43.10	14.44	19.15

报告期各期末，公司流动比率分别为 5.36 倍、2.62 倍和 4.81 倍，速动比率分别为 5.11 倍、2.47 倍和 4.56 倍。报告期各期末，流动比率、速动比率均保持在较高水平，且远大于 1，表明公司短期偿债能力较强，资产流动性良好。

2024 年末，流动比率和速动比率较 2023 年末出现较大幅度下降，主要系公司根据企业会计准则规定，将原租赁期至 2025 年到期的青岛高新区租赁物业对应的租赁负债重分类至“一年内到期的非流动负债”，导致流动负债规模显著增加，从而拉低了流动比率和速动比率。2025 年 5 月，公司与出租方签订补充协议将租赁期延长至 2028 年 3 月，相关租赁负债重新确认为非流动负债，流动负债规模下降，流动比率和速动比率随之回升至较高水平。

报告期各期末，公司合并口径资产负债率分别为 22.41%、25.89%和 24.74%，母公司口径资产负债率分别为 14.59%、19.68%和 19.74%。公司资产负债率保持在较低水平，整体财务风险较小，偿债能力稳健。

报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 8,087.84 万元、12,607.82 万元和 18,636.11 万元，呈现出逐年增长的态势。

报告期内，公司利息保障倍数分别为 19.15 倍、14.44 倍和 43.10 倍。2025 年利息保障倍数较 2024 年度大幅度增长，主要系公司经营利润增长，覆盖利息支出的能力进一步增强。报告期内利息保障倍数均处于较高水平，表明公司盈利对利息支付的保障能力强，偿债风险较低。

2、偿债能力与同行业对比情况

报告期内，公司与同行业可比上市公司的偿债能力指标对比情况如下：

财务指标	公司名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	德邦科技	2.28	3.20	3.72
	回天新材	1.70	1.47	1.57
	松井股份	2.16	2.04	3.31
	华海诚科	4.36	1.87	1.86
	世华科技	9.21	4.77	4.85
	可比公司平均	**3.94**	**2.67**	**3.06**
	发行人	**4.81**	**2.62**	**5.36**
速动比率（倍）	德邦科技	2.02	2.92	3.27
	回天新材	1.50	1.26	1.36
	松井股份	1.68	1.71	2.97
	华海诚科	3.84	1.44	1.40
	世华科技	8.62	4.17	4.51
	可比公司平均	**3.53**	**2.30**	**2.70**
	发行人	**4.56**	**2.47**	**5.11**
资产负债率（合并，%）	德邦科技	31.80	22.20	16.57
	回天新材	52.86	56.16	53.43
	松井股份	20.60	25.40	16.88
	华海诚科	31.17	25.90	16.51
	世华科技	5.64	7.98	9.29
	可比公司平均	**28.41**	**27.53**	**22.54**
	发行人	**24.74**	**25.89**	**22.41**

报告期各期末，公司流动比率分别为 5.36 倍、2.62 倍和 4.81 倍，速动比率分别为 5.11 倍、2.47 倍和 4.56 倍。与同行业可比公司平均值相比，公司流动比率和速动比率在 2023 年末和 2025 年末均高于行业平均水平，2024 年末与行业平均水平相当。

报告期各期末，公司合并口径资产负债率分别为 22.41%、25.89%和 24.74%，与同行业可比公司平均值 22.54%、27.53%和 28.41%基本持平。公司资产负债率低于回天新材，与德邦科技、松井股份、华海诚科等公司处于相近水平，高于世

华科技。报告期内，公司资产负债率保持在较低水平，整体财务风险较小。

（三）报告期内的股利分配情况

2023 年 1 月 30 日，公司召开股东会，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，经统筹考虑公司资金使用情况，同意以 2023 年 1 月 20 日工商登记的实缴注册资本为基数，按照股东在工商登记的持股比例，以 2022 年末累计未分配利润进行分红，共计分配现金红利 7,600.00 万元（含税），不涉及送红股及公积金转增股本。

除上述事项外，报告期内公司未实施其他利润分配事项。

（四）现金流量表分析

报告期内，公司现金流量主要情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额	14,465.95	10,798.25	6,663.63
投资活动产生的现金流量净额	-16,410.84	-37,318.58	-20,934.83
筹资活动产生的现金流量净额	4,204.29	3,740.63	12,923.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39.11	55.06	109.27
现金及现金等价物净增加额	2,220.29	-22,724.64	-1,238.75
期末现金及现金等价物余额	7,118.29	4,898.00	27,622.64

1、经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	49,765.40	44,962.96	42,473.62
收到的税费返还	344.36	56.23	192.84
收到其他与经营活动有关的现金	1,134.07	932.16	1,111.57
经营活动现金流入小计	**51,243.84**	**45,951.35**	**43,778.03**
购买商品、接受劳务支付的现金	12,163.00	12,708.52	14,276.15
支付给职工以及为职工支付的现金	14,530.77	14,232.81	12,333.81
支付的各项税费	5,732.66	3,779.51	5,312.43
支付其他与经营活动有关的现金	4,351.46	4,432.26	5,192.01

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动现金流出小计	**36,777.89**	**35,153.10**	**37,114.40**
经营活动产生的现金流量净额	**14,465.95**	**10,798.25**	**6,663.63**

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 6,663.63 万元、10,798.25 万元和 14,465.95 万元，现金流净额报告期保持增长态势且均为正，现金流量情况良好，经营业绩具有较好的现金流支撑。

报告期内，公司经营活动现金流量净额与净利润存在差异，主要系存货及经营性应收应付项目变动、固定资产折旧、资产减值和信用减值带来的影响，具体调节过程如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
净利润	12,307.74	6,745.44	4,212.79
加：资产减值准备	660.77	454.24	3,496.43
信用减值损失	62.67	-1.44	60.76
投资性房地产折旧	50.54	50.54	50.54
固定资产折旧	2,952.18	2,151.03	1,270.04
使用权资产折旧	583.51	854.33	705.00
无形资产摊销	227.09	193.62	95.82
长期待摊费用摊销	700.64	1,085.31	427.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	10.20	-8.62	-11.40
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	90.07	3.03	8.95
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-254.50	-40.75	-13.26
财务费用（收益以“－”号填列）	327.69	586.77	295.55
投资损失（收益以“－”号填列）	-20.57	-128.56	-18.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,044.78	-591.23	-342.65
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	11.73	34.94	65.21
存货的减少（增加以“－”号填列）	-890.45	-765.90	-451.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,271.04	-1,580.35	-3,132.44
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,312.69	1,386.22	-903.94
其他	649.78	369.64	848.18
经营活动产生的现金流量净额	14,465.95	10,798.25	6,663.63

2、投资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
收回投资收到的现金	8,432.42	48,512.67	3,161.84
取得投资收益收到的现金	52.59	146.03	20.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26.54	-	19.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	21,368.68	6,096.93	1,749.36
投资活动现金流入小计	29,880.24	54,755.64	4,951.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,194.83	14,479.27	18,325.47
投资支付的现金	25,400.22	52,411.93	3,061.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	510.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,696.02	25,183.02	3,989.13
投资活动现金流出小计	46,291.07	92,074.22	25,886.44
投资活动产生的现金流量净额	-16,410.84	-37,318.58	-20,934.83

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-20,934.83 万元、-37,318.58 万元和-16,410.84 万元，投资活动产生的现金流入和流出主要系报告期内公司购买和到期赎回定期存款和理财产品，以及购买机器设备及厂房等支付的现金。

3、筹资活动现金流量分析

报告期内，公司筹资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
吸收投资收到的现金	124.00	-	21,619.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	124.00	-	-
取得借款收到的现金	5,173.00	6,116.00	6,532.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	6,297.00	6,116.00	28,151.06
偿还债务支付的现金	1,169.86	19.82	5,216.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	394.53	318.78	8,065.63

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	390.00
支付其他与筹资活动有关的现金	528.33	2,036.77	1,946.25
筹资活动现金流出小计	2,092.71	2,375.37	15,227.88
筹资活动产生的现金流量净额	4,204.29	3,740.63	12,923.18

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 12,923.18 万元、3,740.63 万元和 4,204.29 万元。筹资活动现金流入主要为公司增资扩股收到的股东投资款、银行借款等，筹资活动现金流出主要为股东分红、偿还银行借款及支付利息等。

（五）流动性风险分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 6,663.63 万元、10,798.25 万元和 14,465.95 万元，随着业务规模的持续增长，公司盈利能力不断增强，公司经营活动现金流净额较高，截至 2025 年 12 月 31 日，公司货币资金、交易性金融资产、其他流动资产下的“一年内到期的定期、定息存款及利息”和一年内到期的非流动资产合计余额为 38,884.43 万元，货币资金充足。

收入及利润方面，报告期内，公司业务规模不断增长，报告期各期分别实现营业收入 35,139.21 万元、38,489.05 万元及 45,786.50 万元，近三个完整年度的营业收入快速增加，扣非后归属母公司股东的净利润分别为 4,335.45 万元、7,724.90 万元及 12,457.28 万元，盈利能力稳健。

融资方面，报告期内公司累计吸收投资收到的现金分别为 21,743.06 万元。同时，公司信用状况较好，与银行保持着良好的合作关系，银行授信额度充足，借款融资渠道畅通，为公司正常生产经营提供了良好的外部资金保证。

综上所述，公司的流动比率和速动比率较为合理，资产负债率较低，整体财务状况相对稳健，资产流动性较好，公司所面临的流动性风险较低。

（六）公司持续盈利能力分析

公司专注于电子专用高分子材料的研发、生产和销售，主要为客户提供电子胶粘剂产品及配套应用方案。公司掌握从“原材料开发与修饰”到“配方及工艺开发”的全套技术工艺，深度布局智能终端、新能源、半导体、通信四大核心领

域，形成完善的产品矩阵。公司将持续推进高性能电子胶粘剂国产化应用，提升与国际主要厂商竞争的能力，并坚持以技术创新驱动产品持续迭代升级，目前已成长为国内主要的电子胶粘剂专业供应商之一。未来，公司将继续以技术开发为核心，丰富产品布局，扩充产能，进一步提升公司产品竞争力及品牌知名度。报告期内，公司不存在影响持续经营能力的重大不利因素。影响公司持续经营能力的风险因素具体情况参见本招股说明书之“第三节 风险因素”。

十三、报告期内的重大投资或资本性支出

（一）报告期内重大资本性支出情况

1、报告期内重大资本性支出

随着公司业务规模的发展，固定资产等项目的购置持续增加，构成公司资本性支出的主要组成部分。报告期各期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 18,325.47 万元、14,479.27 万元和 12,194.83 万元，主要系公司为扩充产能和改善工作环境而购建新厂区的房屋、车间以及生产设备，同时为满足研发项目增多和技术难度提升的需求，相应增加了研发设备的投入。

2、重大资本性支出计划

除前述报告期内重大资本性支出相关项目外，公司未来可预见的重大资本性支出项目主要为本次公开发行股票募集资金投资项目，具体请参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。

（二）重大资产业务重组或股权收购合并事项

报告期内，公司无重大资产业务重组或股权收购合并事项。

十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项

（一）重要的承诺事项

截至 2025 年 12 月 31 日，公司无其他应披露未披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

（三）资产负债表日后事项

截至本招股说明书签署日，公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

（四）其他重要事项

截至本招股说明书签署日，公司无应披露未披露的其他重要事项。

第七节 募集资金运用与未来发展规划

一、募集资金运用概况

（一）募集资金运用方案

公司本次发行募集资金均围绕主营业务进行投资安排，扣除发行费用后，全部用于公司主营业务相关的项目。公司于 2026 年 4 月 10 日召开第二届董事会第二次会议，于 2026 年 4 月 28 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。本次募集资金扣除发行费用后，公司将按照实际经营管理需要及市场情况有序实施以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	德聚高端复合功能材料生产项目	49,206.08	35,378.63
2	德聚北方总部产研一体化项目	21,114.57	13,498.55
3	东莞研发中心及信息化项目	16,517.05	16,517.05
4	营销服务及技术支持中心建设项目	14,653.90	14,653.90
5	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		**121,491.60**	**100,048.13**

公司将严格按照有关规定管理和使用募集资金。若募集资金不足时，缺口部分资金将由公司自筹解决。如本次发行实际募集资金净额超过预计募集资金数额的，公司将根据监管机构的有关规定使用。在完成本次公开发行前，公司将根据实际生产经营需要，以自有资金对上述项目进行前期投入，在募集资金到位后，将使用募集资金置换该部分自有资金。

公司关于本次发行募集资金拟投资项目获得相关主管部门备案或批复的具体情况如下：

序号	项目名称	投资项目备案编号	环评批复文号
1	德聚高端复合功能材料生产项目	2207-441900-04-01-379661	东环建〔2023〕10945 号
2	德聚北方总部产研一体化项目	2303-370271-89-02-694554	青环高新审〔2022〕4 号、青环审（高新）〔2023〕15 号
3	东莞研发中心及信息化项目	2605-441900-04-01-656462	不适用

序号	项目名称	投资项目备案编号	环评批复文号
4	营销服务及技术支持中心建设项目	2605-441900-04-01-249819	不适用
5	补充流动资金	不适用	

根据生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，“东莞研发中心及信息化项目”“营销服务及技术支持中心建设项目”和“补充流动资金”实施过程均不涉及对环境可能造成重大影响的因素，无需办理环境影响评价审批手续。

（二）募集资金使用管理制度

根据公司第二届董事会第二次会议以及 2026 年第三次临时股东会审议通过的《广东德聚技术股份有限公司募集资金管理制度》，募集资金到位后，公司将其存放于董事会决定开立的专项账户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。募集资金专户数量原则上不得超过募集资金投资项目的个数。公司应当在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。并严格按照《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，规范使用募集资金。

本次募集资金重点投向科技创新领域的具体安排参见本招股说明书之“第十二节 附件”之“附件四：募集资金具体运用情况”。

（三）募集资金对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响和业务创新创造创意性的支持作用

公司本次实施的募集资金投资项目均围绕主营业务开展，与公司未来经营战略方向一致，募集资金投资项目的成功实施将进一步加强公司的主营业务，提升公司产能，持续优化公司产品结构，提升公司研发能力和信息化水平，提升营销服务和技术支持能力。

（四）募集资金投资项目对同业竞争和独立性的影响

公司本次募集资金投资项目将围绕公司主营业务展开，实施主体均为公司，本次募集资金投资项目的实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产生同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。

（五）募集资金投资项目的确定依据

本次募集资金投资项目是在公司主营业务、现有生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力基础上，经过深入研究和评估，结合公司的发展目标做出的决策，具体分析如下：

公司主营业务为电子专用高分子材料的研发、生产与销售。本次募投项目均围绕公司现有核心业务开展，生产项目主要面向智能终端、新能源、半导体、通信等领域，提升高性能电子胶粘剂产品的规模化、稳定化供给能力，研发项目则进一步聚焦环氧树脂、丙烯酸酯、有机硅等体系前沿技术开发，旨在推动产品结构优化与业务创新。

现有生产经营规模方面，公司主营业务收入在报告期内持续增长，核心技术产品收入占比逐年提升，已具备一定的业务规模与成熟的经营模式。本次募集资金投资项目与公司现有的生产经营规模相适应。

财务状况与技术条件方面，公司财务状况稳健，拥有持续盈利能力，可为项目建设提供资金支持。且公司已形成覆盖六大化学体系、四大应用领域的 20 项核心技术，能够为项目的顺利实施提供可靠的技术保障。

管理能力方面，公司核心管理团队行业经验丰富，专业技术队伍稳定，具备推动项目落地所需的管理能力。募投项目与公司聚焦电子胶粘剂市场、提升市场覆盖能力的发展目标相契合，有助于提升公司整体竞争力。

二、未来发展规划

（一）发行人的发展战略和目标

公司将继续聚焦电子专用高分子材料领域，以电子胶粘剂为主线，围绕客户具体用胶场景推进产品迭代和产业化应用。未来，公司将依托原材料开发与修饰、产品配方设计、生产工艺优化“协同联动、交替迭代”的研发体系，持续提升连接、防护、导热散热、导电绝缘、应力缓冲等功能材料开发能力。

一方面，公司将巩固既有客户基础和应用经验积累，着力推进成熟产品迭代升级，并在现有客户体系内拓展新产品、新用胶点和新应用场景；另一方面，公司将围绕已通过或正在推进验证的智能终端、新能源、半导体、通信等领域客户，

积极把握先进封装自主配套加速、光模块和 AI 服务器等新兴应用带来的功能性材料需求提升机遇，加快相关产品的客户导入、量产验证和订单转化，推动公司技术储备和客户验证成果逐步转化为规模化收入贡献，持续提升公司在关键电子材料领域的技术储备和市场竞争力。

公司将长期致力于在电子专用高分子材料领域为客户提供“高技术难度、高附加值”的产品及应用方案，秉承“坦诚守诺、精益求精、直面挑战、合作互赢”的企业价值观，坚持自主技术创新，深度布局前沿技术，不断巩固在智能终端、新能源、半导体、通信等战略性新兴产业的技术优势。公司将以前瞻性的发展眼光、稳定的产品供应、高效专业的技术支持，持续跟踪并满足下游市场日益多样化的需求，为全球优质客户量身打造兼具创新性、竞争力、环保性的高性能电子胶粘剂解决方案，力争成为具备全球影响力的技术驱动型企业，与世界级品牌客户共同成长。

（二）报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果

1、建立高效可行的技术研发促进机制，全面提升公司技术实力

报告期内，公司加大人才和资金在研发创新方面的投入，经过多年发展，建立了“交互式”研发和自发性研发相结合的自主研发模式，持续完善团队建设与激励措施。研发实践中，公司一方面深度挖掘客户工艺需求和技术痛点，为其定制开发产品及应用方案；另一方面，基于自身对电子专用高分子材料技术的理解，对技术、产品、工艺、市场的发展趋势进行前瞻性研判并布局前沿技术的研发工作，丰富技术储备。公司于 2023 年经广东省工业和信息化厅认定为“省级企业技术中心”，于 2024 年经工业和信息化部认定为新一轮第一批国家重点“小巨人”企业，技术实力持续提升。

2、积极拓展市场并与知名客户建立长期稳定合作关系

作为一家业务遍布亚洲、美洲、欧洲的全球化企业，公司通过在东莞、深圳、上海、苏州、南通等国内主要城市，以及韩国、美国、德国等主要下游市场国家布局销售中心，建立了横跨亚洲、北美、欧洲的销售网络体系，数十位具有资深专业背景和丰富行业经验的技术应用工程师及销售人员分布各地，贴近客户，可以及时、高效地响应客户需求。公司设有多个研发中心，能够快速响应市场趋势

和客户定制化需求，与客户形成了“交互式”的研发模式，为公司带来了较高的客户粘性及市场拓展成功率。

经过多年发展和沉淀，公司主要向东山精密、鹏鼎控股、立讯精密、安费诺、旗胜电子、Sanmina、台郡科技、和硕、富士康等全球知名电子制造厂商直接供货；在智能终端领域，与苹果、OPPO、vivo、小米、三星等终端品牌商建立了稳定合作关系；在新能源领域，公司与特斯拉、宁德时代、阳光电源、比亚迪、汇川技术等知名企业形成深度产业合作；在半导体领域，公司已陆续通过卓胜微、通富微电、舜宇光学、恒诺微等国内外多家知名半导体行业客户的产品验证测试；在通信领域，公司已进入华为、中际旭创、MPS 等知名客户的供应链体系。上述长期合作关系一方面为公司提供了持续经营业绩基础和增长潜力，另一方面也帮助公司及时跟进各领域前沿技术和客户应用需求，反哺公司的研发工作，形成良性循环。

3、积极拓展产品应用领域，扩大生产规模

凭借对于电子专用高分子材料技术的深厚积累，报告期内公司产品品类持续增加。在智能终端领域，公司持续迭代升级元器件包封胶产品，同时开发了高可靠性环氧胶、耐无铅回流环氧胶、反应型聚氨酯热熔胶等智能终端电子胶粘剂产品，丰富自身产品矩阵；在新能源领域，随着新能源汽车行业的快速发展，公司磁芯粘接胶等产品快速放量，成为公司业绩增长的重要来源；在半导体、通信等领域，公司围绕先进封装、高速光模块、AI 电源模组等高附加值用胶场景推进产品导入和客户拓展，底部填充胶、导热界面材料、光模块密封胶、AI 电源粘接导热胶等产品已实现出货或通过验证测试，为公司后续业务增长提供产品储备。

（三）未来规划拟采取的措施

1、持续提升技术及产品研发能力

公司将继续采取“交互式”研发和自发性研发相结合的自主研发模式，辅以产学研联动的合作研发模式，持续进行研发投入。在智能终端领域，公司将在不断完善新用胶点突破的同时，针对 AR/VR、AI 智能眼镜等新兴设备对材料光学性能及可靠性的要求持续进行产品开发；在新能源领域，围绕新能源汽车电子、动力电池、储能及光伏组件等应用场景，开发高安全、高可靠性胶粘剂解决方案；

在半导体及通信领域，围绕芯片封装、5G 基站、高速光模块、AI 服务器等应用场景，持续推进底部填充、导热散热、密封防护、电磁屏蔽等功能性材料研发和客户验证，提高公司的产品竞争力和技术壁垒。

2、提高生产与供应链管理能力

公司围绕主营产品，拟建立新的生产基地，引进先进的生产设备，通过实现数字化、智能化生产，在扩大生产规模的同时提高生产效率，以应对未来市场挑战，满足快速增长、多样化的市场需求。同时，为确保原材料稳定供应及降低生产成本，公司将加强供应链管理，并不断完善采购、研发、生产流程，实现产品质量的有效控制，满足市场需求。

3、深耕国内市场，扩大海外布局

公司将继续深耕国内市场，持续为现有客户提供优质产品与服务；进一步开展全球市场调研，深入了解客户需求；同时加大海外市场投入及推广力度，为全球客户提供属地化售后支持服务，树立良好的企业口碑，增强品牌市场影响力，提高公司全球市场份额。

4、加强人才引入和培养

人才的引进和培养是公司持续发展的关键。公司将以企业文化为引领，根据企业发展规划和新项目建设的要求，坚持内部培养和外部招聘相结合的战略方针，完善绩效管理、薪酬管理等激励约束机制，全面提升员工素质及公司管理水平。

第八节 公司治理与独立性

一、概述

自股份公司设立以来，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定，建立了由股东会、董事会、审计委员会和高级管理层组成的健全、完善的公司治理框架，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

公司股东会由全体股东组成。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。此外，董事会还设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，为董事会重大决策提供咨询、建议，保证董事会议事、决策的专业化、高效化。公司根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等制度。

二、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况

（一）股东会制度的运行情况

自股份公司设立以来，公司历次股东（大）会在召集和召开程序、表决程序及表决结果等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）董事会制度的运行情况

自股份公司设立以来，公司历次董事会在召集和召开程序、表决程序及表决结果等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）独立董事制度的运行情况

自股份公司设立以来，公司独立董事能够按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关文件的要求，认真履行职责，出席公司董事会会议，独立董事的履职维护了全体股东权益，完善了公司治理结构。

（四）董事会专门委员会制度的运行情况

截至本招股说明书签署日，公司董事会专门委员会的人员组成如下：

名称	主任委员	委员名单
审计委员会	刘宁悦	刘宁悦、吴旭青、陈小云
薪酬与考核委员会	刘晓旸	刘晓旸、刘宁悦、姚进
战略委员会	黄成生	黄成生、马慷慨、张芬
提名委员会	吴旭青	吴旭青、刘晓旸、黄成生

自成立以来，各专门委员会按照相关制度要求召开，对公司的日常经营提供了合理有效的建议。

三、公司内部控制制度的自我评估和审计意见

（一）公司管理层对内部控制的自我评价

公司管理层对内部会计控制制度设计和执行的有效性进行自我评价认为：截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷、重要缺陷。

（二）注册会计师的审计意见

中兴华会计师出具的《关于广东德聚技术股份有限公司内部控制的审计报告》（中兴华内控审字（2026）第 00000225 号）认为，公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（三）财务内控不规范及整改情况

报告期内，公司不存在《发行监管指引第 5 号》5-8 所列的财务内控不规范情形。

四、公司报告期内违法违规情况

报告期内，公司不存在重大违法违规行为，未受到过国家行政机关及行业主管部门的重大处罚。

五、发行人报告期内的资金占用和违规担保情况

（一）报告期内资金占用情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款或其他方式占用的情况。

（二）报告期内对外担保情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

六、发行人独立性情况

公司设立以来，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的资产、业务体系和面向市场独立持续经营的能力。

（一）资产完整

公司系由德聚有限整体变更设立的股份有限公司，依法承继了原有限公司的所有资产及业务。整体变更后，股份公司依法办理了相关资产的产权变更登记手续，具有开展生产经营所必备的独立、完整的资产。报告期内，公司资产权属清晰、完整，不存在对实际控制人及其控制的其他企业存在依赖的情况。

（二）人员独立

公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员均未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，并根据现行会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况建立了独立、完整的财务核算体系，制定了符合上市公司要求的、规范的内部控制制度，能够独立作出财务决策。公司开

立独立的银行账户，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。

（四）机构独立

公司已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理权。公司依照《公司法》《公司章程》等规定，建立健全了股东会作为最高权力机构、董事会作为决策机构、审计委员会作为监督机构及高级管理人员作为执行机构的内部经营管理体系，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系，并制定了股东会议事规则、董事会议事规则和总经理工作细则等内部管理控制制度。公司拥有独立的经营、办公场所，各机构、各部门均按规定的职责独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形。

（五）业务独立

公司已建立了完整的业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行日常活动的情况，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

（六）发行人主营业务、控制权和管理团队稳定

公司主营业务、控制权和管理团队稳定，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持公司的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发生变更，不存在可能导致控制权变更的重大权属纠纷。

（七）不存在对持续经营有重大影响的事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，不存在重大偿债风险、重大担保、诉讼、仲裁等或有事项。公司不存在经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

七、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况

1、发行人的主营业务

公司专注于电子专用高分子材料的研发、生产和销售，主要为客户提供电子胶粘剂产品及配套应用方案，掌握从“原材料开发与修饰”到“配方及工艺开发”的全套技术工艺，紧密贴合客户定制化需求与下游行业发展趋势，持续为客户产品创新、技术迭代提供专业化、高适配性的综合配套服务。

2、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人为黄成生先生，其通过直接和间接方式合计控制公司 39.1600%的股份。除公司外，黄成生持有股份或财产份额的其他企业情况如下：

序号	企业名称	与控股股东、实际控制人的关系	实际经营业务	是否与公司存在同业竞争
1	赣州德熙	黄成生持有 25.3745%财产份额，并担任执行事务合伙人	员工持股平台	否
2	赣州德益	黄成生持有 0.0320%财产份额，并担任执行事务合伙人	员工持股平台	否
3	德森伯格	黄成生持有 0.7092%财产份额，并担任执行事务合伙人	员工持股平台	否

注：报告期内，黄成生曾持有伯乐通（发行人原控股股东）75%股权，伯乐通已于 2023 年 11 月 13 日注销；同时，报告期内，黄成生曾持有香港诺氏 75%股权及担任董事，并通过香港诺氏间接控制 CollTech GmbH，香港诺氏及 CollTech GmbH 分别于 2024 年 8 月、2023 年 6 月注销。

上述黄成生持有或曾持有股份或财产份额的其他企业情况如下：

赣州德熙、赣州德益及德森伯格系公司员工持股平台，与公司不存在同业竞争，详细情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（五）其他持有发行人 5%以上股份的主要股东”之“3、赣州德熙、德森伯格”。

综上，截至本招股说明书签署日，除发行人及其子公司、员工持股平台外，发行人控股股东、实际控制人黄成生未持有或控制其他企业，其控制的其他企业未实际从事与发行人构成同业竞争的业务。

（二）控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

为保障发行人及其他股东的合法权益，发行人控股股东、实际控制人黄成生已出具《关于避免同业竞争的承诺》，具体情况参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件二：与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”之“（九）控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺”。

八、关联交易情况

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》《企业会计准则》及中国证监会、深交所的相关规定，截至本招股说明书签署日，公司的主要关联方包括：

1、公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人

截至本招股说明书签署日，公司控股股东和实际控制人均为黄成生。黄成生直接持有公司 29.4863%的股份，通过担任赣州德熙、德森伯格的执行事务合伙人间接控制公司 9.2469%股份、0.4268%股份对应的表决权，合计控制公司39.1600%表决权。

2、其他直接或间接持有 5%以上股份的自然人及直接或间接持有 5%以上股份的法人或其他组织

截至本招股说明书签署日，其他直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人、法人或其他组织情况如下：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	余珩	直接持有公司 14.4919%股份
2	王延鲲	直接持有公司 9.7498%股份
3	赣州德熙	直接持有公司 9.2469%股份

3、公司董事、高级管理人员

公司董事、高级管理人员均为公司关联方。截至本招股说明书签署日的公司董事、高级管理人员情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“六、董事、监事会取消前监事、高级管理人员及其他核心人员”的相关内容。

4、与上述 1-3 条所述关联自然人关系密切的家庭成员

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，关系密切的家庭成员包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

5、直接或间接控制上市公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员

截至本招股说明书签署日，直接或者间接控制公司的主体为自然人黄成生，不存在直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员。

6、由上述关联法人或关联自然人直接或者间接控制的，或者由前述关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的法人或其他组织，但上市公司及其控股子公司除外

（1）公司实际控制人及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织

截至本招股说明书签署日，公司及其控股子公司以外，公司实际控制人及其关系密切的家庭成员直接或间接控制或具有重要影响的企业，或者担任董事、高级管理人员的企业情况如下：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	赣州市德熙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	黄成生持有 25.3745%财产份额，并任执行事务合伙人
2	赣州市德益企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	黄成生持有 0.0320%财产份额，并任执行事务合伙人
3	上海德森伯格企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	黄成生持有 0.7092%财产份额，并任执行事务合伙人
4	深圳市盛阳和顺实业有限公司	公司实际控制人黄成生配偶肖敏持股 25%的企业
5	沃为思控股（深圳）有限公司（曾用名：深圳市沃为思实业有限公司）	公司实际控制人黄成生配偶肖敏的胞弟持股 10%并担任董事兼经理、法定代表人的企业
6	沃为思信息（深圳）有限公司（曾用名：深圳市沃为思技术有限公司）	公司实际控制人黄成生配偶肖敏的胞弟担任董事兼经理、法定代表人的企业，沃为思控股（深圳）有限公司的全资子公司
7	掌览无限（北京）科技有限责任公司	公司实际控制人黄成生配偶肖敏的胞弟持股 51%并担任监事的企业
8	深圳市尚武英雄体育文化发展有限公司（曾用名：深圳市前海尚武英雄体育文	公司实际控制人黄成生配偶肖敏的胞弟合计持股 67.8%并担任执行董事兼总经理、法定代表人的企业

序号	关联方名称	关联关系说明
	化发展有限公司）	
9	深圳市驰宇体育产业有限公司	公司实际控制人黄成生配偶肖敏的胞弟持股 50%并担任总经理的企业
10	深圳市沃为思科技有限公司	公司实际控制人黄成生配偶肖敏的胞弟持股 70%并担任执行董事兼总经理、法定代表人的企业
11	深圳市学识网科技有限公司	公司实际控制人黄成生配偶肖敏的胞弟持股 20%并担任执行董事兼法定代表人的企业

（2）除实际控制人以外，直接或间接持股 5%以上的自然人股东及其关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的企业，以及直接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织直接或间接控制或具有重要影响的法人或其他组织

截至本招股说明书签署日，除实际控制人以外，直接或间接持股 5%以上的自然人股东及其关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的企业情况如下：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	Infinite Flex GmbH	余珩的配偶及董事马慷慨持股 80%，并担任总经理的企业
2	德怡科技（太仓）有限公司	余珩的配偶及董事马慷慨持股 100%，并担任执行董事兼总经理、法定代表人的企业
3	苏州德顿石墨烯新材料研究院有限公司	余珩的配偶及董事马慷慨持股 100%，并担任执行董事兼总经理、法定代表人的企业
4	International Graphene Product Certification Center GmbH	余珩的配偶及董事马慷慨担任总经理的企业
5	Sixonia Tech GmbH	余珩的配偶及董事马慷慨持股 15.0060%的企业
6	江苏德鼎能源科技有限公司	余珩的配偶及董事马慷慨持股 29.3235%，并担任执行董事兼总经理的企业
7	德鼎健生物技术（太仓）有限公司	余珩的配偶及董事马慷慨担任执行董事兼总经理的企业（江苏德鼎能源科技有限公司持股 36%）
8	西安市禾之语果业合作社	余珩的配偶及董事马慷慨的胞妹持股 80%的农民专业合作社
9	深圳市科美太文化创意有限公司	公司持股 5%以上的自然人股东王延鲲的父亲持股 100%并担任执行董事兼总经理的企业

截至本招股说明书签署日，除公司本身外，直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织未直接或间接控制其他法人或其他组织。

（3）公司董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的或具有重要影响的，或者前述人员（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的除公司及其子公司以外的法人或其他组织

截至报告期末，公司董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员目前直接或间接控制的或具有重要影响的法人或其他组织如下：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	吴中区金庭华汇美贸易商行	公司董事陈小云为该个体工商户的经营者
2	紫光展锐（上海）科技股份有限公司	公司董事王天琳担任董事的企业
3	宁波隔空智能科技有限公司	公司董事王天琳担任董事的企业
4	浙江三时纪科技股份有限公司	公司董事王天琳担任董事的企业
5	珠海亿智电子科技有限公司	公司董事王天琳担任董事的企业
6	浙江三时纪新材科技有限公司	公司董事王天琳担任董事的企业浙江三时纪科技股份有限公司的子公司
7	上海阿雅娜尚品贸易有限公司	公司董事姚进的配偶持有 100%股权的企业

7、公司的控股子公司

公司控股子公司情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、发行人股权结构及控股子公司、分公司、参股公司情况”之“（二）发行人控股子公司、分公司、参股公司情况”。

8、其他关联方

报告期内公司曾经存在的关联方或根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，以及遵循实质重于形式的原则认定的其它与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的关联方如下：

序号	关联方名称	关联关系说明
1	邱国明	报告期内董事、财务负责人
2	张文彬	报告期内独立董事
3	王忠利	报告期内监事会取消前监事会主席
4	郑微	报告期内监事会取消前职工代表监事
5	深圳市伯乐通企业管理咨询有限公司（德聚（深圳）胶接技术有限公司）	黄成生持股 75%并担任执行董事兼总经理的企业，已于 2023 年 11 月注销
6	诺氏（香港）控股有限公司	黄成生持股 75%并担任董事的企业，已于 2024 年 8 月注销
7	CollTech GmbH	黄成生曾经控制的企业，2023 年 6 月注销
8	德聚化学材料（深圳）有限公司	江苏德聚全资子公司，已于 2024 年 12 月注销
9	广州德聚埔材半导体技术有限公司	发行人控股子公司，已于 2024 年 11 月注销
10	Infinite Flex Limited	余珩的配偶及董事马慷慨控制并担任董事的企业，

序号	关联方名称	关联关系说明
		已于 2023 年 11 月注销
11	岳阳楼区玖点半食品经营部	黄成生配偶的胞弟担任经营者的个体工商户，已于 2025 年 11 月 4 日注销
12	东莞市诚铭自动化科技有限公司	原董事邱国明配偶持股 98%并担任执行董事兼经理的企业
13	东莞市企石华贸家具经营部	原董事邱国明的母亲担任经营者的个体工商户
14	上海世盾企业管理咨询中心	原董事邱国明配偶持股 100%的企业，已于 2023 年 5 月注销
15	南康区腾新万源副食超市	原董事邱国明胞弟的配偶为该个体工商户的经营者
16	萍乡市启迪企业管理咨询中心	原董事邱国明的母亲持股 100%的企业，已于 2023 年 10 月注销
17	美科泰科技有限公司（MCOTI TECHNOLOGY LIMITED）	王延鲲持股 100%的企业，已于 2023 年 4 月注销
18	北京安拓因企业管理咨询中心（有限合伙）	报告期内独立董事张文彬的配偶担任执行事务合伙人并持有 99.00%出资份额的企业
19	北京吉拓因企业管理咨询中心（有限合伙）	报告期内独立董事张文彬的配偶担任执行事务合伙人并持有 35.8064%出资份额的企业
20	北京昕拓因企业管理咨询中心（有限合伙）	报告期内独立董事张文彬的配偶担任执行事务合伙人并持有 0.0652%出资份额的企业
21	北京拓因合生科技有限公司（曾用名：北京拓因生物科技有限公司）	报告期内独立董事张文彬的配偶担任董事长、经理及财务负责人并持有 39.3983%股权的企业
22	天津拓因化成科技有限公司	北京拓因合生科技有限公司（曾用名：北京拓因生物科技有限公司）的全资子公司
23	江苏贝奥泰克生物科技有限公司	报告期内独立董事张文彬持股 30%并担任执行董事的企业，已于 2025 年 4 月退出，并于 2025 年 8 月起不再担任执行董事
24	常州市添越科技有限公司	报告期内监事会取消前监事会主席王忠利的配偶的弟弟曾担任执行董事兼法定代表人并持股 80%的企业，已于 2025 年 6 月退出并不再担任执行董事兼法定代表人
25	深圳市煜顺新材料有限公司	报告期内监事会取消前监事会主席王忠利的配偶的弟弟曾担任董事并持股 100%的企业，已于 2025 年 12 月退出并不再担任董事

（二）报告期内关联交易情况

报告期内，公司关联交易汇总情况如下：

单位：万元

分类	项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一般经常性关联交易	购买商品、接受劳务的关联交易额	13.93	44.78	117.11
	销售商品、提供劳务的关联交易额	-	2.05	4.16
	发行人作为出租方于	-	-	-

分类	项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
	当期确认的租赁收入			
	发行人作为承租方于当期确认的租赁费	21.09	21.09	21.09
	关键管理人员薪酬	1,630.72	1,461.34	1,225.63
一般偶发性关联交易	发行人作为被担保方的关联担保	参见本节之“（二）报告期内关联交易情况”之“2、一般偶发性关联交易”之“（1）公司作为被担保方的关联担保”		
	关联方资金往来	-	-	-
	其他关联交易	-	-	3.48

注：上表中关联交易金额均不含税额（包括关税），下同。

1、一般经常性关联交易

（1）购买商品、接受劳务的关联采购

报告期内，公司因购买商品、接受劳务产生的关联采购如下：

单位：万元

关联交易内容	关联方	关联交易金额		
		2025 年度	2024 年度	2023 年度
采购货物	浙江三时纪新材料科技有限公司	13.93	44.78	116.71
	德怡科技（太仓）有限公司	-	-	0.40
	小计	**13.93**	**44.78**	**117.11**
	占当期物料采购额的比例	**0.13%**	**0.40%**	**1.01%**

1）浙江三时纪科技股份有限公司

浙江三时纪科技股份有限公司是公司董事王天琳担任董事的企业，为公司关联方，浙江三时纪科技股份有限公司的全资子公司浙江三时纪新材料科技有限公司为公司的供应商，报告期内公司向其采购少量填料。

2）德怡科技（太仓）有限公司

德怡科技（太仓）有限公司成立于 2019 年，专注于柔性电子、增材制造材料的研发和产业化。

公司向其采购的物料主要为液态金属，仅在 2023 年存在少量零星采购，交易金额较小。根据市场价格协商定价，未有明显偏离合理价格的情形。

（2）销售商品、提供劳务的关联销售

报告期内，公司因销售商品、提供劳务产生的关联销售如下：

关联交易内容	关联方	关联交易金额（万元）		
		2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售电子胶粘剂	德怡科技（太仓）有限公司	-	2.05	-
处置机器设备	德怡科技（太仓）有限公司	-	-	4.16
占当期销售总额的比例		-	0.01%	0.01%

公司向德怡科技（太仓）有限公司销售电子胶粘剂产品及处置机器设备，上述关联销售额占比较小，销售定价参考同类产品，价格较同类产品第三方售价也无明显差异，2025 年相关关联销售已不再发生。

（3）发行人作为承租方的关联租赁

报告期内，公司因承租场地导致的关联租赁如下：

单位：万元

关联方	交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
王延鲲	办公租赁	21.09	21.09	21.09

公司向王延鲲租赁场地主要系深圳美科泰租赁位于苏州吴江区松陵镇开平路 3333 号德博商务大厦 A#1604、1605 的房产用于日常办公，出租面积分别为 202.84 平方米、207.35 平方米（含公摊面积），其月租金与该商务楼其他公开招租报价无显著差异。

（4）关键管理人员薪酬

报告期各期，公司关键管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
关键管理人员薪酬	1,630.72	1,461.34	1,225.63

报告期各期，公司向关键管理人员支付的薪酬分别为 1,225.63 万元、1,461.34 万元及 1,630.72 万元，关键管理人员指公司董事、监事会取消前监事、高级管理人员。

2、一般偶发性关联交易

（1）公司作为被担保方的关联担保

报告期内，公司及子公司作为被担保方的关联担保情况如下：

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
黄成生、肖敏	1,000.00	2022 年 7 月 1 日	2023 年 12 月 31 日
黄成生、肖敏	1,000.00	2022 年 8 月 3 日	2023 年 8 月 2 日

上述担保系实际控制人及其配偶为公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行的贷款合同做出的担保。公司未对上述担保支付其他费用。

（2）其他关联交易

报告期内，公司其他关联交易包括股东豁免债权债务，具体如下：

单位：万元

交易类型	关联方名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度	定价方式及决策程序
债务豁免	诺氏(香港)控股有限公司	-	-	3.48	股东豁免债权债务

2023 年因 CollTech Corporation,Inc.原租房的押金 0.50 万美元，折合人民币 3.48 万元，被退回至北美德聚，经 CollTech Corporation,Inc.股东香港诺氏同意豁免该款项。

（三）关联方往来款项余额

1、应付账款

单位：万元

关联方名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
浙江三时纪新材科技有限公司	2.00	-	9.8

2、其他应付款

单位：万元

关联方名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
黄成生	1.79	1.73	1.00
王延鲲	2.42	5.02	-
姚进	1.39	0.42	0.80
马慷慨	0.22	-	-
陈小云	0.09	-	3.10
邱国明	-	-	2.09
王忠利	11.39	8.93	2.68
郑微	1.22	2.44	4.03

关联方名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
张芬	3.51	3.59	3.54
合计	**22.03**	**22.13**	**17.24**

上述款项为各期末发行人待支付的员工报销款。

3、租赁负债（含一年内到期的）

单位：万元

关联方名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
王延鲲	19.94	40.05	8.72

上述款项系发行人因租赁关联方房产所产生的应付租金现值。

（四）报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见

1、发行人关联交易制度的执行情况

公司报告期内的关联交易已分别第二届董事会第二次会议、2026 年第三次临时股东会审议通过。关联董事、关联股东均回避了表决。

公司报告期内的关联交易事项在董事会审议前已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

公司现行有效的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》及上市后适用的《公司章程（草案）》规定了股东会、董事会在审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事回避表决制度及其他公允决策程序，且有关议事规则及决策制度已经公司股东会审议通过，符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。公司报告期内的关联交易经由发行人董事会及股东会审议，确认相关关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形。关联董事、关联股东依法进行了回避。

2、独立董事对关联交易的意见

2026 年 4 月 10 日，公司独立董事召开第二届董事会第三次独立董事专门委员会，审议通过了《关于对公司报告期内关联交易进行确认的议案》。报告期内公司发生的关联交易系公司正常经营行为，关联交易的决策、批准程序符合公司章程及有关法律、法规、规范性文件的规定，未违背公平、公正、合理的原则，

不存在利益转移或交易有失公允的情况，不存在损害公司和其他中小股东合法利益的情形。

（五）规范和减少关联交易的措施

1、公司制定了《关联交易管理制度》，对关联交易的决策程序、审批权限等进行了规定。公司将严格遵守相关规范，进一步规范关联交易。

2、为规范和减少与公司发生关联交易，更好地维护中小股东的利益，保证公司长期稳定发展，公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其一致行动人出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺如下：

“一、本人/本企业及本人/本企业所控制的企业将尽可能避免与公司及其控股子公司之间发生关联交易。

二、在进行确属必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允定价原则执行，确保关联交易的公平合理，并严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的要求，履行有关授权与批准程序及信息披露义务，避免损害公司及其他股东的利益。

三、本人/本企业将忠实履行承诺，若因本人/本企业违反上述承诺而导致公司权益受到损害的，本人/本企业将依法承担相应的赔偿责任。”

第九节 投资者保护

一、本次发行完成前滚存利润的分配和已履行的决策程序

2026 年 4 月 28 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》，若公司本次公开发行股票（A 股）并在创业板上市方案经深交所审核同意并报中国证监会履行发行注册程序并得以实施，首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并在创业板上市后由新老股东按发行后的持股比例共享。

二、本次发行前后股利分配政策的差异情况

（一）本次发行前的股利分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

公司现金股利政策目标为稳定增长股利。

公司实施如下利润分配政策：

公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规

定。

公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。

（二）本次发行后的股利分配政策

为充分考虑全体股东的利益，公司已在《广东德聚技术股份有限公司章程（草案）》中制定利润分配政策，具体如下：

“（一）利润分配的原则

公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行积极、持续稳定的利润分配政策。

（二）利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采取现金方式分配股利。

（三）利润分配的期间间隔

在符合条件的情况下，公司原则上每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

（四）现金分红条件及分红比例

1、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：

（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正；

（2）公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；

（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

2、现金分红比例的规定

公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以同时派发红股。公司进行现金分红时，现金分红的比例也应遵照以下要求：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

上述重大资金支出安排（募集资金投资项目除外）是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元。

公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

（五）股票股利分配条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（六）利润分配的决策程序

1、董事会提交股东会的股利分配具体方案，应经董事会全体董事过半数表决通过，并经全体独立董事 2/3 以上表决通过。

2、独立董事应对利润分配方案发表独立意见。

3、审计委员会应当对董事会拟定的股利分配具体方案进行审议，并经审计委员会全体成员过半数表决通过。

4、董事会审议通过利润分配方案后由股东会审议，公告董事会决议时应同时披露独立董事的审核意见。

5、公司当年盈利董事会未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表审核意见。

6、公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）听取、接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。

（七）现金分红的决策程序

董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件等事宜，董事会提交股东会的现金分红的具体方案，应经董事会全体董事过半数表决通过，经全体独立董事 2/3 以上表决通过，并由股东会审议通过。独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（八）利润分配政策调整决策程序

公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性。如因公司自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，提交股东会审议并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，在股东会提案时须进行详细论证和说明原因。

董事会拟定调整利润分配政策议案的过程中，应当充分听取股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见。董事会审议通过调整利润分配政策议案的，应经董事会全体董事过半数表决通过，经全体独立董事 2/3 以上表决通过。独立董事须发表独立意见，并及时予以披露。

审计委员会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，并经审计委员会全体成员过半数表决通过。

股东会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。

（九）利润分配政策的披露

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

1、是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；

2、分红标准和比例是否明确和清晰；

3、相关的决策程序和机制是否完备；

4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对未分红原因、未分红的资金留存公司的用途发表独立意见，有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东会批准，并在股东会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（十）股利分配方案的实施时间

公司股利分配具体方案由公司董事会提出，公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。出现派发延误的，公司董事会应当就延误原因及时披露。”

（三）本次发行前后股利分配政策对比

与发行前的股利分配政策相比，本次发行后的股利分配政策主要系根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，对利润分配的原则、利润分配的形式和比例、利润分配的期间

间隔等内容进行了明确，进一步完善股利分配政策。

（四）董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况及安排理由，以及本次发行上市后三年内现金分红等利润分配计划、长期回报规划

1、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况及安排理由

公司董事会对上市后股东回报事宜进行了专项研究论证，制定了《公司上市后前三年股东分红回报规划》，并经第二届董事会第二次会议、2026 年第三次临时股东会审议通过。

董事会制定上述股东分红回报规划系从可持续发展的角度出发，综合考虑未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段及规划、资金需求、社会资金成本等方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，对利润分配作出积极、明确的制度性安排，从而保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

2、本次发行上市后三年内现金分红等利润分配计划

根据《公司上市后前三年股东分红回报规划》，公司上市后三年内现金分红等利润分配政策主要如下：

“（三）现金分红条件及分红比例

1、公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正；

（2）公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；

（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

2、现金分红的比例和间隔

公司原则上每年进行一次现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议进行中期现金分红。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章程（草案）》规定的程序，提出差异化的现金分红

政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

上述重大资金支出安排（募集资金投资项目除外）是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元。”

3、股东分红回报规划的制定原则

股东分红回报规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程（草案）》有关利润分配的相关规定，公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和公众投资者的意见和诉求，确定合理的利润分配方案。

三、公司关于特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排及尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份、协议控制架构或其他类似特殊安排。公司不属于尚未盈利或存在未弥补亏损的情形。

第十节 其他重要事项

一、发行人重大合同

（一）重大销售合同

公司与主要客户之间的销售合同通常采取签署框架协议或直接通过订单方式进行，在框架协议中不涉及产品的具体型号、销售数量、价格等，在实际业务发生时，客户根据其需求向公司发送订单，约定产品的具体型号、数量、价格等。

结合公司上述业务特点，确定重大销售合同的标准为：报告期内与同一交易主体发生总交易金额在 2,000 万元（不含税）以上、且已签署框架协议的已履行和正在履行的合同。

截至2025年12月31日，公司报告期内已履行和正在履行的交易金额在2,000万元（不含税）以上的重大销售合同如下：

序号	客户名称	合同类型	主要产品	合同金额（万元）	合同期限	公司签约主体	执行状态
1	苏州紫翔电子科技有限公司	框架协议+订单	环氧及丙烯酸酯类胶粘剂和相关设备	以订单为准	2020年9月21日签约，2021年9月20日到期，到期后双方无异议自动续期	德聚技术	履行完毕
					2024年7月18日签约，2025年7月17日到期，到期后双方无异议自动续期	德聚技术	正在履行
					2022年3月22日签约，2023年3月21日到期，到期后双方无异议自动续期	深圳美科泰	正在履行
2	盐城维信电子有限公司	框架协议+订单	环氧及丙烯酸酯类胶粘剂和相关设备	以订单为准	2020年9月17日签约，无固定履行期限	德聚技术	正在履行
					2020年10月30日签约，无固定履行期限	深圳美科泰	
3	苏州维信电子有限公司	框架协议+订单	环氧及丙烯酸酯类胶粘剂和相关设备	以订单为准	2019年5月6日签约，2021年5月30日到期，到期后双方无异议自动续期	深圳美科泰	正在履行
					2020年9月17日签约，无固定履行期限	德聚技术	
4	昆山联滔电子有限公	框架协议+订	环氧及丙烯酸酯类胶粘剂和	以订单为准	2022年9月26日签约，2023年9月26日到期，到期后双方无异议自动	德聚技术	正在履行

序号	客户名称	合同类型	主要产品	合同金额（万元）	合同期限	公司签约主体	执行状态
	司	单	相关设备		续期		
5	深圳市米麒科技有限公司	框架协议+订单	环氧及丙烯酸酯类胶粘剂和相关设备	以订单为准	2022 年 6 月 9 日签约，2023 年 6 月 8 日到期	德聚技术	履行完毕
					2023 年 7 月 18 日签约，2024 年 7 月 17 日到期，到期后双方无异议自动续期		正在履行
6	和硕联合科技股份有限公司	框架协议+订单	环氧及有机硅类胶粘剂和相关设备	以订单为准	2021 年 4 月 8 日签约，无固定履行期限	美科泰贸易	正在履行
					2021 年 4 月 15 日签约，无固定履行期限	德聚技术	
7	安费诺永亿（海盐）通讯电子有限公司	框架协议+订单	环氧及丙烯酸酯类胶粘剂和相关设备	以订单为准	2020 年 8 月 20 日签约，2023 年 8 月 19 日到期，到期后双方无异议自动续期	德聚技术	正在履行
8	鹏鼎控股（深圳）股份有限公司	框架协议+订单	环氧及丙烯酸酯类胶粘剂	以订单为准	2023 年 1 月 13 日签约，2028 年 1 月 12 日到期，到期后双方无异议自动续期	深圳美科泰	正在履行
9	阳光电源股份有限公司	框架协议+订单	丙烯酸酯及有机硅类胶粘剂	以订单为准	2022 年 8 月 22 日签约，无固定履行期限	苏州美科泰	正在履行
				以订单为准	2021 年 12 月 29 日签约，无固定履行期限	深圳美科泰	

（二）重大采购合同

公司与主要供应商之间的采购合同通常采取签署框架协议或直接通过订单方式进行，在框架协议中不涉及产品的具体采购型号、数量、价格等，在实际业务发生时，公司根据自身需求向供应商发送订单，约定产品的具体采购型号、数量、价格等。

结合公司上述业务特点，确定重大采购合同的标准为：报告期内与同一交易主体发生总交易金额在 1,000 万元（不含税）以上、且已签署框架协议的已履行和正在履行的合同。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司报告期内已履行和正在履行的交易金额在 1,000 万元（不含税）以上的重大采购合同如下：

序号	供应商名称	合同类型	主要产品	合同金额（万元）	合同期限	公司签约主体	执行状态
1	蓝浦新材料科技（南通）	框架协议+	聚氨酯类胶粘剂	以订单为准	2019 年 5 月 10 日签约，2023 年	深圳美科泰	履行完毕

序号	供应商名称	合同类型	主要产品	合同金额（万元）	合同期限	公司签约主体	执行状态
	有限公司	订单			4 月 30 到期		
					2023 年 8 月 9 日签约，2024 年 8 月 8 日到期		履行完毕
					2025 年 1 月 1 日签约，2025 年 12 月 31 日到期，到期后双方无异议自动续期	苏州美科泰	正在履行
2	广州亿菲迪电子科技有限公司	框架协议+订单	内包装针筒类辅材	以订单为准	2018 年 7 月 17 日签约，无固定履行期限	德聚技术	正在履行
3	北京福思深德贸易有限公司	框架协议+订单	填料	以订单为准	2022 年 6 月 29 日签约，无固定履行期限	德聚技术	履行完毕
					2023 年 7 月 18 日签约，无固定履行期限		正在履行

（三）授信及借款合同

截至 2025 年 12 月 31 日，公司报告期内已履行完毕及正在履行的，借款金额 1,000 万元人民币及以上的银行贷款合同及其对应的担保情况如下：

序号	贷款合同名称	贷款人	借款人	贷款金额（万元）	借款期限	担保情况	履行情况
1	《人民币流动资金贷款合同》	中国建设银行股份有限公司东莞市分行	德聚技术	1,000.00	2022.6.20-2023.6.19	1、深圳美科泰提供连带责任保证，最高担保金额为 4,500 万元； 2、青岛德聚提供连带责任保证，最高担保金额为 4,500 万元； 3、黄成生提供连带责任保证，最高担保金额为 4,500 万元； 4、肖敏提供连带责任保证，最高担保金额为 4,500 万元； 5、德聚技术以一种压料机过滤系统（专利号 ZL201720041245.8）和一种混合动力搅拌装置（专利号 ZL201720041349.9）为质押物进行质押担保，最高担保金额为 4,500 万元。	履行完毕
2	《人民币流动资金贷款合同》	中国建设银行股份有限公司东莞市分行	德聚技术	1,000.00	2022.7.25-2023.7.24		履行完毕

序号	贷款合同名称	贷款人	借款人	贷款金额（万元）	借款期限	担保情况	履行情况
3	《固定资产贷款合同》	中国建设银行股份有限公司东莞市分行	德聚技术	10,000.00	2023.9.14-2033.9.13	1、深圳美科泰提供连带责任保证，最高担保金额为 16,500 万元； 2、青岛德聚提供连带责任保证，最高担保金额为 16,500 万元； 3、上海锐朗提供连带责任保证，最高担保金额为 16,500 万元； 4、德聚技术厂房 A、2 号厂房、3 号厂房、4 号宿舍、5 号地下室抵押担保，担保责任的最高限额为 16,848.1728 万元	正在履行
4	《德聚高端复合功能材料生产项目固定资产银团贷款合同》	中国建设银行股份有限公司东莞市分行、中信银行股份有限公司东莞分行	德聚技术	29,000.00	2025.1.24-2035.1.23	1、深圳美科泰提供连带责任保证，最高担保金额为 29,000 万元； 2、青岛德聚提供连带责任保证，最高担保金额为 29,000 万元； 3、上海锐朗提供连带责任保证，最高担保金额为 29,000 万元； 4、德聚技术位于东莞市石排镇水贝村国有建设用地使用权（粤（2023）东莞不动产权第 0137590 号）抵押担保，抵押担保的最高限额为 1,895.2661 万元	正在履行

（四）银行承兑协议

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已履行完毕、正在履行的金额在 1,000 万元以上的银行承兑合同情况如下表所示：

承兑人	承兑金额（万元）	出票日期	到期日期	履行情况
中国建设银行东莞石排支行	1,000.00	2024 年 11 月 18 日	2025 年 5 月 18 日	履行完毕

（五）工程合同

截至 2025 年 12 月 31 日，公司（作为发包人）正在履行的、总交易金额在 5,000 万元（不含税）以上的工程合同如下：

序号	承包人	合同内容	合同金额（万元）	签订日期	履行情况
1	中国建筑第二工程局有限公司	募投项目-德聚高端复合功能材料生产项目-建筑工程-总承包工程总承包合同	13,992.5	2023 年 8 月 25 日	正在履行
2	中国二十二冶集团有限公司	德聚二期工程增资扩产项目施工总包	9,258.00	2022 年 9 月 6 日	正在履行

二、对外担保情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在对外担保情况。

三、诉讼或仲裁事项

（一）公司的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。

（二）控股股东或实际控制人、子公司、董事、监事会取消前监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对公司产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，控股股东或实际控制人、子公司、董事、监事会取消前监事、高级管理人员和其他核心人员不存在作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。

第十一节 声明

一、发行人及其全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签字：

黄成生	马慷慨 Kangkai Ma	张　芬
姚　进	陈小云	王天琳
刘晓旸	刘宁悦	吴旭青

全体审计委员会成员签字：

刘宁悦	吴旭青	陈小云

其他高级管理人员签字：

Junjun Wu
（吴俊珺）

广东德聚技术股份有限公司

2026 年 6 月 25 日

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本人承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东、实际控制人签字：

黄成生

广东德聚技术股份有限公司

2026 年 6 月 25 日

三、保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：

黄耀文

保荐代表人：

吴恢宇　　刘　坚

法定代表人：

张佑君

申信证券股份有限公司

2020 年 6 月 25 日

四、保荐人（主承销商）董事长声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任

董事长：

张佑君

中信证券股份有限公司

2021 年 6 月 25 日

五、保荐人（主承销商）总经理声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

总经理：

邹迎光

中信证券股份有限公司

2016 年 6 月 25 日

六、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

经办律师签字：

王在海　　游锦泉　　何嘉美

律师事务所负责人签字：

高　树

广东华商律师事务所

2026 年 6 月 25 日

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

注册会计师：

刘伟明 查中超

会计师事务所负责人：

李尊农

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2026 年 6 月 25 日

验资复核机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

注册会计师：

刘伟明

查中超

会计师事务所负责人：

李尊农

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2026 年 6 月 25 日

出资复核机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的出资复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的出资复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

注册会计师：

刘伟明

查中超

会计师事务所负责人：

李尊农

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2026 年 6 月 25 日

承担评估业务的资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

经办资产评估师签字：

邵雅淇　　梁金秋（已离职）

资产评估机构负责人签字：

胡东全

中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司

2026 年 6 月 25 日

关于签字评估师离职的声明

本公司于 2023 年 4 月 26 日为广东德聚技术股份有限公司出具了《资产评估报告》（中联国际评字[2023]第 XHMPB0362 号），签字评估师为邵雅淇女士和梁金秋先生。

梁金秋先生已从本公司离职，故无法在《广东德聚技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》之“承担评估业务的资产评估机构声明”中签字，其离职不影响本公司出具的资产评估报告的法律效力。

特此说明。

资产评估机构负责人签字：胡东全

中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司

2026 年 6 月 25 日

第十二节 附件

一、备查文件目录

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：

（一）发行保荐书；

（二）上市保荐书；

（三）法律意见书；

（四）财务报告及审计报告；

（五）公司章程（草案）；

（六）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况；

（七）与投资者保护相关的承诺；

（八）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项；

（九）内部控制审计报告；

（十）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；

（十一）股东会、董事会、监事会（取消前）、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明；

（十二）审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明；

（十三）募集资金具体运用情况；

（十四）其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件查阅

投资者可于本次发行承销期间赴公司和保荐机构（主承销商）办公地点查阅，查阅时间为除法定节假日以外的每日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。

除以上查阅地点外，投资者可以登录中国证监会和深交所指定网站，查阅《招股说明书》正文及相关附录。

附件一：投资者关系的主要安排及股东投票机制的建立情况

（一）投资者关系的主要安排

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，发行人制定了上市后适用的《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，并于 2026 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，对规范公司信息披露工作，加强发行人与投资者之间的信息沟通，促进发行人与投资者之间的联系关系做了详细的规定，以保障投资者依法享有获取发行人信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等各方面的权利。

1、信息披露制度和流程

为加强发行人的信息披露工作的管理，保证真实、准确、完整、及时和公平的披露信息，保护发行人、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，发行人制定并审议通过的上市后适用的《信息披露管理制度》，对信息披露的一般规定、信息披露的内容及披露标准、信息披露的审核与披露程序、信息披露的责任划分、信息披露的保密措施等事项都进行了详细规定。

2、投资者沟通渠道的建立情况

公司负责信息披露及投资者关系的部门为证券事务部，具体联系方式为：

联系人：姚进

电话：0769-89066909

传真：0769-89066901

电子信箱：ir@colltech.cn

地址：广东省东莞市石排镇向沙路石排段 14 号

3、未来开展投资者关系管理的规划

为加强公司与投资者之间的信息沟通，确保更好地为投资者提供服务，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《创业板股票上市规

则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了上市后适用的《投资者关系管理制度》。根据该制度，公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。公司可以通过公司官方网站、深圳证券交易所网站和深圳证券交易所投资者关系互动平台、新媒体平台、电话、传真、邮箱、投资者教育基地等方式，采取股东会、投资者说明会、路演、投资者调研、证券分析师调研等形式，建立与投资者的重大事件沟通机制。

（二）股东投票机制的建立情况

根据上市后适用的《公司章程（草案）》《股东会议事规则》等相关规定，公司将通过建立和完善累积投票制度、股东会网络投票机制、征集投票权等各项制度安排，保证投资者尤其是中小投资者参与公司重大决策和选择管理者等事项的权利。

1、累积投票制

股东会就选举董事进行表决时，应当采用累积投票制；累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。

2、股东会网络投票机制

公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东会提供便利。

3、中小投资者单独计票机制

股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

4、征集投票权

公司董事会、独立董事和持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

附件二：与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项

（一）关于本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺

1、控股股东、实际控制人、董事长、总经理黄成生承诺

“一、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

二、上述锁定期届满后，本人在担任发行人董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。

三、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人股票上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。自发行人股票上市之日起至本人减持期间，若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价将相应进行除权除息调整。

四、发行人上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准，下同）下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期 6 个月。“届时所持股份”是指本人上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有的股份。

五、在本人作为发行人控股股东、实际控制人期间，本人将向发行人申报本人持有发行人的股份数量及相应变动情况；本人减持发行人股份将严格遵守相关法律、法规、规章及规范性文件的规定。

六、本人将忠实履行承诺，如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。”

2、实际控制人的一致行动人赣州德熙、德森伯格承诺

“一、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

二、本企业所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人股票上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本企业持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。自发行人股票上市之日起至本企业减持期间，若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价将相应进行除权除息调整。

三、发行人上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准，下同）下滑 50%以上的，延长本企业届时所持股份锁定期限 6 个月；发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本企业届时所持股份锁定期限 6 个月；发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本企业届时所持股份锁定期 6 个月。“届时所持股份”是指本企业上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有的股份。

四、在本企业持股期间，本企业将向发行人申报本企业持有发行人的股份数量及相应变动情况；本企业减持发行人股份将严格遵守相关法律、法规、规章及规范性文件的规定。

五、本企业将忠实履行承诺，如违反上述承诺，本企业将承担相应的法律责任。”

3、实际控制人近亲属黄钰喆承诺

“一、本人通过宁波高易三期创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有发行人的股份，自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

二、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人股票上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有发行人股票的

锁定期限自动延长 6 个月。自发行人股票上市之日起至本人减持期间，若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价将相应进行除权除息调整。

三、发行人上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准，下同）下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期 6 个月。“届时所持股份”是指本人上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有的股份。

四、如果中国证监会和证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会和证券交易所的规定执行。

五、本人将忠实履行承诺，如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。”

4、本次发行申报前 12 个月内入股的新增股东承诺

“一、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

二、自本企业所持公司股份取得之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

三、本企业将忠实履行承诺，如果违反上述承诺，本企业将承担由此引发的一切法律责任。”

5、其他股东承诺

“一、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

二、本人/本企业将忠实履行承诺，如果违反上述承诺，本人/本企业将承担由此引发的一切法律责任。”

（二）关于持股及减持意向的承诺

本次发行前持股 5%以上股份的股东黄成生及其一致行动人德森伯格、赣州德熙、王延鲲、余珩承诺：

“一、对于本次发行上市前持有的发行人股份，本人/本企业将严格遵守已作出的关于所持发行人股份限售安排及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前持有的发行人股份。

二、本人/本企业所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，并应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定。在本人/本企业持有发行人 5%以上股份期间，本人/本企业减持时应提前三个交易日予以公告。

三、本人/本企业减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

四、本人/本企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。如本人/本企业因未履行上述承诺出售股票，本人/本企业同意将该等股票减持实际所获得的收益（如有）归发行人所有。

五、如未来相关监管规则发生变化，本承诺载明事项将相应修订，修订后的承诺事项亦满足届时监管规则的要求。 ”

（三）关于稳定股价的措施和承诺

1、公司股份发行上市后稳定公司股价的预案

为保护投资者利益，根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，公司制定了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案》。具体如下：

（1）启动稳定股价措施的条件

公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（公司发生利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况，收盘价相应进行调整，下同）均低于公司上一会计年度经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同），非因不可抗力

因素所致，则公司及控股股东、实际控制人、董事（不包括独立董事）和高级管理人员将按下述规则启动稳定公司股价的相关措施。

公司将在触发稳定股价义务之日起十五个交易日内制定关于稳定股价的议案，稳定股价议案经董事会、股东会审议通过并履行相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对公司有约束力的规范性文件所规定的相关程序后，由公司在六个月内实施稳定股价方案。公司将在启动上述股价稳定措施时提前公告具体实施方案。

（2）稳定股价的具体措施

公司及相关责任主体稳定股价的具体措施实施顺序如下：

1）公司回购

①公司为稳定股价之目的回购股票，应符合《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

②公司董事会对回购股票作出决议，公司全体董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。

③公司股东会对回购股票作出决议，该决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东黄成生（以下简称“控股股东”）承诺就该等回购事宜在股东会中投赞成票。

④每 12 个月内，公司需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。

⑤公司为稳定股价进行股票回购时，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：

A、公司回购股份的资金为自有资金，回购价格不高于上一会计年度经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如股份回购方案实施前公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案；

B、公司单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的 10%，单一会计年度用于回购股份的资金金额合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的 30%；

2）控股股东增持

①下列任一条件发生时，公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：

A、公司回购股票方案实施完毕之次日起的连续 10 个交易日的收盘价均低于上一会计年度经审计的每股净资产。

B、公司回购股票方案实施完毕之次日起的 3 个月内启动条件被再次触发。

②控股股东将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定股价，通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的，买入价格不高于上一会计年度经审计的每股净资产。但如公司披露其买入计划后 3 个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，控股股东可不再实施上述买入公司股份计划。

③公司控股股东、实际控制人单次用于增持股份的资金金额不低于控股股东最近一次自公司获得的税后现金分红金额的 20%，单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不超过控股股东最近一次自公司获得的税后现金分红金额的 50%。

④公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持。每 12 个月内，控股股东需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。

⑤控股股东承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股票。

⑥为避免疑问，在黄成生为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事的情况下，黄成生应基于其控股股东、实际控制人身份，按照上述“控股股东、实际控制人增持”的要求履行稳定股价义务，但无需基于其董事身份，履行“董事、高级管理人员增持”项下的义务。

3）董事、高级管理人员增持

①下列任一条件发生时，公司董事（不包括独立董事和不在公司领取薪酬的董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：

A、控股股东增持股票方案实施完毕之次日起的连续 10 个交易日的收盘价

均低于上一会计年度经审计的每股净资产。

B、控股股东增持股票方案实施完毕之次日起的 3 个月内启动条件被再次触发。

②有增持义务的公司董事、高级管理人员将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定股价，通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的，买入价格不高于上一会计年度经审计的每股净资产。但如公司披露其买入计划后 3 个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，可不再实施上述买入公司股份计划。

③有增持义务的公司董事、高级管理人员单次用于增持股份的资金金额不低于有增持义务的公司董事、高级管理人员在任职期间的最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的 10%，单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不超过有增持义务的公司董事、高级管理人员在任职期间的最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的 30%。

④有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺，在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股票。

⑤公司不得为董事、高级管理人员实施增持公司股票提供资金支持。每 12 个月内，董事、高级管理人员需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。

⑥公司上市后 3 年内拟新聘任董事和高级管理人员时，公司将促使该新聘任的董事和高级管理人员根据稳定公司股价预案和相关措施的规定签署相关承诺。

（3）稳定股价方案的终止

自稳定股价方案公告之日起，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

①公司股票连续十个交易日的收盘价均高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。

②继续回购或增持公司股票将导致公司股权分布不符合上市条件。

（4）约束措施

在启动条件满足时，如公司、控股股东、有增持义务的董事、高级管理人员

未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、有增持义务的董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：

①公司、控股股东、有增持义务的董事、高级管理人员将在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

②如控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的，则公司有权将与控股股东拟增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

③如有增持义务的董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，则公司有权将与该等董事、高级管理人员拟增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

④如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致公司、控股股东、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其稳定股价义务的，相关责任主体可免于前述约束措施，但其亦应积极采取其他合理且可行的措施稳定股价。

（5）股价稳定预案的法律程序

股价稳定预案经公司股东会审议通过后，自公司完成首次公开发行股票并上市之日起生效。如因法律法规修订或政策变动等情形导致本预案与相关规定不符，公司董事会应对本预案进行调整的，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2、关于股份发行上市后三年内稳定公司股价的承诺函

（1）发行人承诺

“一、在公司上市后三年内，若公司连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，公司将按照《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》回购公司股票。

二、如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低

持股比例的规定导致本公司在一定时期内无法履行稳定股价义务的，则本公司可免于上述约束措施，但本公司亦应积极采取其他合理且可行的措施稳定股价。

三、如本公司未履行招股说明书披露的稳定股价措施，本公司将在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

四、本公司将忠实履行承诺，如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任。”

（2）发行人控股股东、实际控制人黄成生承诺

“一、在公司上市后三年内，若公司连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，本人将按照《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》增持公司股票；本人将根据公司股东会批准的《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》中的相关规定，在公司就回购股票事宜召开的股东会上，对回购股票的相关决议投赞成票。

二、如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致本人在一定时期内无法履行稳定股价义务的，则本人可免于上述约束措施，但本人亦应积极采取其他合理且可行的措施稳定股价。

三、如本人未采取上述稳定股价的具体措施的，则公司有权将与本人拟增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，直至本人按上述稳定股价预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

四、如本人未采取上述稳定股价的具体措施的，本人将在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

五、本人将忠实履行承诺，如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。”

（3）发行人董事（不包括独立董事）黄成生、马慷慨、张芬、陈小云、姚进、王天琳承诺

“一、在公司上市后三年内，若公司连续 20 个交易日的收盘价均低于最近

一期经审计的每股净资产，本人将根据公司股东会批准的《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对回购股份的相关决议投赞成票；将根据公司股东会批准的《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》中的相关规定，履行相关的各项义务。

二、如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致本人在一定时期内无法履行稳定股价义务的，则本人可免于上述约束措施，但本人亦应积极采取其他合理且可行的措施稳定股价。

三、如本人有义务采取但未采取上述稳定股价的具体措施的，则公司有权将与本人拟增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，直至本人按上述稳定股价预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。本条承诺不适用于独立董事和不在公司领取薪酬的董事。

四、如本人未采取上述稳定股价的具体措施的，本人将在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

五、本人将忠实履行承诺，如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。”

（4）发行人高级管理人员 Junjun Wu（吴俊珺）承诺

“一、在公司上市后三年内，若公司连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，本人将根据公司股东会批准的《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》中的相关规定，履行相关的各项义务。

二、如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致本人在一定时期内无法履行稳定股价义务的，则本人可免于上述约束措施，但本人亦应积极采取其他合理且可行的措施稳定股价。

三、如本人未采取上述稳定股价的具体措施的，则公司有权将与本人拟增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，直至本人按上述稳定股价预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

四、如本人未采取上述稳定股价的具体措施的，本人将在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

五、本人将忠实履行承诺，如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。”

（四）股份回购和股份买回的措施和承诺

1、发行人承诺

“一、如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购本次发行并上市中发行的全部新股（如发行人本次发行并上市后发生除权事项的，上述回购数量相应调整）。发行人将在有权部门出具有关违法事实的认定结果后及时进行公告，并根据相关法律法规及《公司章程》的规定及时召开董事会审议股份回购具体方案，并提交股东会审议。发行人将根据股东会决议及有权部门的审批启动股份回购措施。

二、如发行人违反上述承诺，发行人将在股东会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按有权部门最终认定的实际损失向投资者进行赔偿。”

2、控股股东、实际控制人黄成生承诺

“一、如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促发行人依法回购本次发行并上市中发行的全部新股，同时本人也将购回发行人本次发行并上市后本人已转让的原限售股份。

二、如本人违反上述承诺，则将在发行人股东会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起停止在发行人处分红（如有），同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至承诺人按照上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。”

（五）对欺诈发行上市的股份购回承诺

1、发行人承诺

“一、本公司保证本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形；

二、本公司首次公开发行股票并在创业板上市后，如本公司因存在欺诈发行被证券监管机构或司法部门认定不符合发行上市条件、以欺骗手段骗取发行注册的，本公司承诺在上述违法违规行为被证券监管机构等有权机构确认后 5 个工作日内启动股份回购程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。回购价格按照中国证监会、深圳证券交易所颁布的规范性文件依法确定，本公司将根据届时有效的相关法律法规的要求履行相应股份回购义务；

三、上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。”

2、控股股东、实际控制人黄成生承诺

“一、本人保证公司本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形；

二、公司首次公开发行股票并在创业板上市后，如公司因存在欺诈发行被证券监管机构或司法部门认定不符合发行上市条件、以欺骗手段骗取发行注册的，本人承诺在上述违法违规行为被证券监管机构等有权机构确认后 5 个工作日内启动股份回购程序，购回公司本次公开发行的全部新股。回购价格按照中国证监会、深圳证券交易所颁布的规范性文件依法确定，本人将根据届时有效的相关法律法规的要求履行相应股份回购义务；

三、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。”

（六）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

1、填补被摊薄即期回报的措施

为降低公司本次发行摊薄即期回报的影响，公司拟强化和规范募集资金的管理，提升募集资金的利用效率，加快募集资金投资项目的建设进度，进一步加强

品牌建设和管理，提升本公司的核心竞争力，优化投资者回报机制，实施积极的利润分配政策等措施，提升股东回报以填补本次公开发行对即期回报的摊薄。具体如下：

（1）强化和规范募集资金的管理，提升募集资金的使用效率

在首次公开发行股票募集资金到位后，发行人将在募集资金的使用、核算、风险防范等方面强化管理，确保募集资金严格依照招股说明书中披露的募集资金用途，科学、合理地投入使用；发行人将严格按照《募集资金管理制度》的相关规定，签订和执行募集资金三方监管协议，保证依法、合规、规范地使用募集资金；在符合上述募集资金管理要求的基础上，发行人将结合当时的市场状况、资产价格、资金成本等多种因素，对募集资金使用的进度方案进行科学规划，以最大限度提升募集资金的使用效率。

（2）加快募集资金投资项目建设，尽早实现预期效益

本次募集资金将用于德聚高端复合功能材料生产项目、德聚北方总部产研一体化项目、东莞研发中心及信息化项目、营销服务及技术支持中心建设项目和补充流动资金，募集资金用途符合国家产业政策，公司的主要产品产能和技术实力将得到进一步扩大，有助于未来增加主要产品的市场份额。在募集资金到位前，发行人将牢牢把握市场契机，视项目具体需要采取包括但不限于先期以部分自有资金投入项目建设等措施进行积极布局；募集资金到位后，在符合法律、法规、规范性文件以及募集资金管理制度规定的前提下，并在确保募集资金规范、科学、合理运用的基础上，尽最大可能地加快募集资金投资项目的建设进度，力求加快实现募集资金投资项目的预期经济效益。

（3）继续加大研究开发与技术创新，提升公司竞争优势

公司将继续加大研究开发力度，加强技术人才队伍的建设，增强公司在新产品开发、生产工艺及设备自动化改进等方面的技术创新，并通过技术创新促进公司生产工艺水平、产品品质和生产效率的提高，有效带动公司客户综合服务能力，提升公司市场份额和行业地位，提升公司竞争优势，为公司保持持续盈利能力奠定坚实基础。

（4）进一步完善公司利润分配政策，强化投资者回报机制

公司将依照本次发行上市后适用的公司章程以及股东分红回报规划的相关内容，积极推进实施持续、稳定的利润分配政策，在符合发行人发展战略、发展规划，紧密结合发行人发展阶段、经营状况并充分考虑投资者利润分配意愿的基础上，不断优化对投资者的回报机制，确保及时给予投资者合理回报。

上述各项措施为公司本次发行募集资金有效使用的保障措施及防范本次发行摊薄即期回报风险的措施，不代表公司对未来利润做出的保证。

2、填补被摊薄即期回报的承诺

（1）发行人承诺

“本公司承诺，将严格执行填补被摊薄即期回报的措施，并接受投资者及监管部门的监督。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司将因此承担相应的法律责任。”

（2）控股股东、实际控制人黄成生承诺

“一、在任何情形下，本人均不会滥用控股股东、实际控制人地位，均不会越权干预发行人经营管理活动，不会侵占发行人利益；

二、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

三、本人将严格遵守公司的预算管理，本人任何职务消费行为均应在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费；

四、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动；

五、本人将尽责促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

六、本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行使条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

七、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现，将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案并愿意投赞成票（如有投票权）。

八、本承诺函出具后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规

定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。”

（3）发行人董事、高级管理人员承诺

“一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

二、本人承诺对本人职务消费行为进行约束。

三、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

四、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。

五、如公司未来推出股权激励计划，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的公司股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。

六、本承诺函出具日后，如中国证监会作出关于填补本次发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

（七）关于利润分配政策的承诺

1、发行人承诺

“根据相关法律、法规、规范性文件等规定的相关要求，公司制定了本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》以及《广东德聚技术股份有限公司上市后前三年股东分红回报规划》等，对利润分配政策进行了具体安排，完善了公司利润分配制度。公司承诺将严格履行利润分配方案的审议程序，按照规定的利润分配政策向股东进行利润分配。如相关法律、法规及规范性文件进行修订，公司将及时根据相关修订调整公司利润分配政策并严格执行。

如届时公司未按照上述承诺执行相关利润分配政策，则公司将遵照签署的《关于未能履行公开承诺事项时采取约束措施的承诺函》，承担相应的法律责任并采取相关后续措施。”

2、控股股东、实际控制人黄成生承诺

“根据相关法律、法规、规范性文件等规定的相关要求，公司制定了本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》以及《广东德聚技术股份有限公司上市后前三年股东分红回报规划》等，对利润分配政策进行了具体安排，完善了公司利润分配制度。公司承诺将严格履行利润分配方案的审议程序，按照规定的利润分配政策向股东进行利润分配。如相关法律、法规及规范性文件进行修订，公司将及时根据相关修订调整公司利润分配政策并严格执行。

如届时本人未按照上述承诺执行相关利润分配政策，则本人将遵照签署的《关于未能履行公开承诺事项时采取约束措施的承诺函》，承担相应的法律责任并采取相关后续措施。”

3、全体董事、高级管理人员承诺

“根据相关法律、法规、规范性文件等规定的相关要求，公司制定了本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》以及《广东德聚技术股份有限公司上市后前三年股东分红回报规划》等，对利润分配政策进行了具体安排，完善了公司利润分配制度。公司承诺将严格履行利润分配方案的审议程序，按照规定的利润分配政策向股东进行利润分配。如相关法律、法规及规范性文件进行修订，公司将及时根据相关修订调整公司利润分配政策并严格执行。

如届时本人未按照上述承诺执行相关利润分配政策，则本人将遵照签署的《关于未能履行公开承诺事项时采取约束措施的承诺函》，承担相应的法律责任并采取相关后续措施。”

（八）关于依法承担赔偿责任的承诺函

1、发行人承诺

“一、本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书及其他信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

二、若有权部门认定本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书及其他信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，致使投资者在证券

交易中遭受损失的，并已由中国证券监督管理委员会、人民法院等有权部门作出本公司存在上述事实的最终认定或生效判决的，本公司将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者损失。”

2、发行人控股股东、实际控制人、董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺

“一、发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书及其他信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

二、若有权部门认定发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书及其他信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由中国证券监督管理委员会、人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，本人将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者损失。

三、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。”

3、证券服务机构作出的承诺

（1）公司保荐机构中信证券承诺

“一、本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

二、上述承诺为本公司的真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。”

（2）公司律师华商律所承诺

“一、本所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所为发行人首次公开发行股票并上市制作出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，

本所将依法赔偿投资者损失。

二、上述承诺为本所的真实意思表示，本所自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本所将依法承担相应责任。”

（3）公司审计机构、验资复核机构及出资复核机构中兴华承诺

“本所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。”

（4）公司资产评估机构中联国际承诺

“本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。”

（九）控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争或潜在同业竞争，维护公司利益，保障公司正常经营，公司控股股东、实际控制人黄成生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：

“一、截至本承诺函签署之日，本人及本人直接或间接控制的其他企业未直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

二、自本承诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制的其他企业将不会以任何方式（包括但不限于在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式）从事与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

三、自本承诺函签署之日起，凡本人及本人直接或间接控制的其他企业有任

何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予发行人。

四、自本承诺函签署之日起，如本人及本人直接或间接控制的其他企业进一步拓展业务范围，本人及本人直接或间接控制的其他企业将不与公司及其下属子公司拓展后业务相竞争；若与公司及其下属子公司拓展后业务产生竞争，则本人及本人直接或间接控制的其他企业将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

五、本人将忠实履行承诺，若因本人违反上述承诺而导致公司权益受到损害的，本人将依法承担相应的赔偿责任。”

（十）其他承诺事项

1、关于减少及避免关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动人、全体董事、高级管理人员承诺如下：

“一、本人/本企业及本人/本企业所控制的企业将尽可能避免与公司及其控股子公司之间发生关联交易。

二、在进行确属必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允定价原则执行，确保关联交易的公平合理，并严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的要求，履行有关授权与批准程序及信息披露义务，避免损害公司及其他股东的利益。

三、本人/本企业将忠实履行承诺，若因本人/本企业违反上述承诺而导致公司权益受到损害的，本人/本企业将依法承担相应的赔偿责任。”

2、关于股东信息披露的专项承诺函

公司就其首次公开发行股票并在创业板上市相关股东身份及股权结构清晰事项，承诺如下：

“一、公司已在招股说明书中真实、准确、完整地披露了股东信息。

二、公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形，不存在股权争议或

潜在纠纷等情形。

三、公司不存在法律、法规或其他规范性法律文件规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的情形。

四、本次发行上市的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员未直接或间接持有公司股份。

五、公司股东不存在以公司股权进行不当利益输送的情形。

六、公司不存在证监会系统离职人员入股的情形。

七、公司已及时向本次发行上市的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行上市的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行上市的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，并依法履行了信息披露义务。”

3、关于在审期间不进行现金分红的承诺函

公司就在审期间不进行现金分红的事项承诺如下：

“公司本次发行上市前的滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。

自本承诺函出具日起至本次发行上市完成前，本公司将不再提出新的现金分红方案。

上述承诺为本公司的真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。”

4、发行人、保荐人及相关主体保证不影响和干扰审核的承诺函

发行人及其全体董事、审计委员会成员、高级管理人员，控股股东、实际控制人，保荐人及保荐代表人、项目协办人，均已知悉《承诺人廉洁自律规范须知》相关要求，保证严格遵守法律法规、中国证监会的规定和深圳证券交易所的业务规则，诚实守信、忠实勤勉、廉洁自律，不以任何方式影响和干扰审核工作，并郑重作出以下承诺：

“（一）遵守发行上市审核有关沟通、接待接触、回避等相关规定，不私下与审核人员、监管人员以及深圳证券交易所上市审核委员会（以下简称上市委）

委员、并购重组审核委员会（以下简称重组委）委员、行业咨询专家库专家等进行可能影响公正执行公务的接触；认为可能存在利益冲突的关系或者情形时，及时按相关规定和流程提出回避申请。

（二）不组织、指使或者参与以下列方式向审核人员、监管人员、深圳证券交易所上市委委员、重组委委员、行业咨询专家库专家或者其他利益关系人输送不正当利益：

1、以各种名义赠送或者提供资金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权等财物，或者为上述行为提供代持等便利；

2、提供旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益，或者提供就业、就医、入学、承担差旅费等便利；

3、安排显著偏离公允价格的结构化、高收益、保本理财产品等交易；

4、直接或者间接提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息，明示或者暗示从事相关交易活动；

5、其他输送不正当利益的情形。

（三）不组织、指使或者参与打探审核未公开信息，不请托说情、干扰审核工作。不自行或委托地方有关部门、相关人员向审核部门、行业主管部门“打招呼”，不打听审核工作进展和征求意见情况，不以汇报、交流等名义请求审核部门或行业主管部门对企业上市给予支持。

（四）遵守法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有关保密的规定，不泄露审核过程中知悉的内幕信息、未公开信息、商业秘密和国家秘密，不利用上述信息直接或者间接为承诺人或者他人谋取不正当利益。

如违反上述承诺，承诺人自愿接受深圳证券交易所依据其业务规则采取的终止审核、一定期限内不接受申请文件、公开认定不适合担任相关职务等措施。承诺人相关行为违反法律法规的，将承担相应法律责任。”

5、关于招股书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

公司控股股东、实际控制人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺如下：

“一、本人承诺公司首次公开发行股票招股说明书及其他信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

二、如中国证券监督管理委员会、人民法院等有权部门认定本次首次公开发行股票的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，并已由中国证券监督管理委员会、人民法院等有权部门作出公司存在上述事实的最终认定或生效判决的，本人将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者损失。

三、本承诺函自本人签署之日即行生效，本人不因持股情况变化、不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。”

6、关于未能履行承诺的约束措施

（1）发行人承诺

“一、如本公司未履行在首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项，将在本公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向本公司的股东和社会公众投资者道歉。

二、本公司将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、有效的补充承诺或替代性承诺。

三、因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由中国证券监督管理委员会、人民法院等有权部门作出本公司存在上述事实的最终认定或生效判决的，本公司将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等向投资者承担赔偿责任。”

（2）控股股东、实际控制人黄成生及一致行动人赣州德熙、德森伯格承诺

“一、如本人/本企业未履行在首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项，将在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。

二、本人/本企业将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、

有效的补充承诺或替代性承诺。

三、因本人/本企业未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由中国证券监督管理委员会、人民法院等有权部门作出公司存在上述事实的最终认定或生效判决的，本人/本企业将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等向投资者承担赔偿责任。”

（3）持股 5%以上的股东余珩、王延鲲承诺

“一、如本人未履行在首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项，将在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。

二、本人将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、有效的补充承诺或替代性承诺。

三、因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由中国证券监督管理委员会、人民法院等有权部门作出公司存在上述事实的最终认定或生效判决的，本人将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等向投资者承担赔偿责任。”

（4）全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺

“一、如本人未履行在本人签署的各项承诺函中的承诺事项，将在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。

二、本人将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、有效的补充承诺或替代性承诺。

三、因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由中国证券监督管理委员会、人民法院等有权部门作出公司存在上述事实的最终认定或生效判决的，本人将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等向投资者承担赔偿责任。”

（5）实际控制人亲属黄钰喆承诺

“一、如本人未履行在首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项，将在

发行人股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。

二、本人将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、有效的补充承诺或替代性承诺。

三、因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由中国证券监督管理委员会、人民法院等有权部门作出公司存在上述事实的最终认定或生效判决的，本人将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等向投资者承担赔偿责任。”

附件三：股东会、董事会、监事会（取消前）、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

（一）报告期内发行人公司治理概况

本公司自股份公司设立以来，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定，建立了由股东会、董事会、审计委员会和高级管理层组成的健全、完善的公司治理框架，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

公司股东会由全体股东组成。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。此外，董事会还设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，为董事会重大决策提供咨询、建议，保证董事会议事、决策的专业化、高效化。公司根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等制度。

（二）股东会、董事会、监事会（取消前）、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

1、股东会制度的建立健全及运行情况

2023 年 5 月 12 日，公司召开创立大会，审议通过了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关议案，选举产生了公司第一届董事会，建立了规范的股东（大）会制度。同时，公司于 2026 年 1 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会，并修订《公司章程》及相关制度。

自股份公司设立以来，公司历次股东（大）会在召集和召开程序、表决程序及表决结果等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、董事会制度的建立健全及运行情况

公司董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，维护公司和全体股

东的利益。董事会按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定行使职权，在股东（大）会闭会期间对内管理公司事务，对外可代表公司。董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。

自股份公司设立以来，公司历次董事会在召集和召开程序、表决程序及表决结果等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、监事会制度的建立健全及运行情况

2023 年 5 月 12 日，公司召开创立大会，审议通过了《监事会议事规则》，选举了 2 名非职工代表监事，与 1 名职工代表监事共同组成公司第一届监事会，监事任期三年。自监事会制度建立以来，公司严格依照有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定执行监事会制度，规范运作。

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规规定，公司于 2026 年 1 月召开 2026 年第一次临时股东大会，决议调整公司内部监督机构，由董事会审计委员会承接原监事会的法定职权。

4、独立董事制度的建立健全及运行情况

2023 年 5 月 12 日，公司召开创立大会，选举刘晓旸、刘宁悦和张文彬为公司第一届董事会独立董事，审议通过了《独立董事工作制度》。2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会，对《独立董事工作制度》中部分条款进行修改。2026 年 1 月 23 日，公司召开 2026 年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

自股份公司设立以来，公司独立董事能够按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关文件的要求，认真履行职责，出席公司董事会会议，独立董事的履职维护了全体股东权益，完善了公司治理结构。

5、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司股东（大）会和董事会会议及其专门委员会会议、取消监事会前监事会会议的筹备、文件保管，公司股东资料管理以及信息披露等事宜。

自公司董事会秘书制度设立以来，公司董事会秘书有效履行了《公司法》《公司章程》《董事会秘书工作制度》等规定的职责，认真筹备公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会取消前监事会会议和股东（大）会会议，促进了公司治理结构的完善和董事会、股东（大）会职权的正常行使。

6、董事会专门委员会制度的建立健全及运行情况

截至本招股说明书签署日，公司董事会专门委员会的人员组成如下：

名称	主任委员	委员名单
审计委员会	刘宁悦	刘宁悦、吴旭青、陈小云
薪酬与考核委员会	刘晓旸	刘晓旸、刘宁悦、姚进
战略委员会	黄成生	黄成生、马慷慨、张芬
提名委员会	吴旭青	吴旭青、刘晓旸、黄成生

各委员会制度建设及运行情况如下：

（1）战略委员会

公司已制定了《董事会战略委员会工作细则》，董事会战略委员会规范运行。董事会战略委员会委员严格按照《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》的规定行使权利和履行义务，结合公司的实际情况，研究和确定公司发展规划与长期发展战略，致力于提高公司重大投资决策的效益和决策的质量，对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，以加强决策的科学性。

董事会战略委员会设立至招股说明书签署日，公司董事会战略委员会共召开4次会议，董事会战略委员会会议的召开及表决均符合相关的规则。

（2）审计委员会

公司已制定了《董事会审计委员会工作细则》，董事会审计委员会规范运行。董事会审计委员会委员严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的规定行使权利和履行义务，并结合公司的实际情况，组织公司内部审计部门认真履行职责，审阅公司编制的财务报表；协助制定和审查公司的内部控制制度；积极与审计机构做好沟通，督促审计工作按要求及时完成；审核公司的财务信息及披露。

董事会审计委员会设立至招股说明书签署日，公司董事会审计委员会共召开

14 次会议。公司董事会审计委员会会议的召开及表决均符合相关的规则。

（3）提名委员会

公司已制定了《董事会提名委员会工作细则》，董事会提名委员会规范运行。董事会提名委员会委员严格按照《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》的规定行使权利和履行义务，结合公司的实际情况，研究对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，为优化董事会组成、规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作提供建议，以进一步完善公司治理结构。

董事会提名委员会设立至招股说明书签署日，公司董事会提名委员会共召开 5 次会议，董事会提名委员会会议的召开及表决均符合相关的规则。

（4）薪酬与考核委员会

公司已制定了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，董事会薪酬与考核委员会规范运行。薪酬与考核委员会委员严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定行使权利和履行义务，结合公司的实际情况，研究制定公司董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度执行情况。

董事会薪酬与考核委员会设立至招股说明书签署日，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，董事会薪酬与考核委员会会议的召开及表决均符合相关的规则。

附件四：募集资金具体运用情况

（一）德聚高端复合功能材料生产项目

1、项目概况

本项目实施地位于广东省东莞市石排镇专精特新产业园区，通过新建生产厂房、员工宿舍及地下室等配套工程设施，并采购先进生产设备及辅助设备，打造自动化程度更高的智能生产基地。项目建成后主要面向智能终端、新能源、半导体等领域用电子胶粘剂的生产，项目设计产能为年产电子胶粘剂 5,790.40 吨。

2、资金概况

本项目计划总投资 49,206.08 万元，其中，建设投资 43,857.30 万元，铺底流动资金 5,348.78 万元。

3、项目必要性

（1）抓住市场快速增长的机遇，提高市场地位

随着信息化、智能化、新能源化等趋势持续推进，电子胶粘剂应用场景不断丰富，呈现出较大的市场潜力和广阔的发展前景。一方面，手机、个人电脑、平板、可穿戴设备等智能终端产品持续向轻薄化、集成化、多功能化方向迭代，为电子胶粘剂带来稳定需求；另一方面，新能源汽车、半导体封装材料、AI 算力设备和高速光模块等领域对粘接、密封、导热散热、结构增强和可靠性防护材料提出更高要求，推动高性能电子胶粘剂需求持续提升。根据 Fortune Business Insights 数据，2025 年全球电子胶粘剂的市场规模达到了 68.80 亿美元，2026 年预计将达到 74.40 亿美元，未来 2034 年将增长至 138.90 亿美元，年均复合增长率达 8.11%。本项目的实施有助于公司把握电子胶粘剂行业增长机遇，提高市场地位。

（2）我国电子胶粘剂市场本土化配套水平有待提高

在高性能电子胶粘剂领域，国际化工材料企业起步较早，在技术、品牌、客户认证和规模化交付方面形成了一定先发优势。随着我国下游客户供应链安全、快速响应和成本优化需求增强，国内电子胶粘剂企业在配方开发、工艺适配、可靠性验证和稳定量产等方面持续进步，国产化应用空间预计将持续扩大。本项目

的实施有助于公司提升高性能电子胶粘剂生产能力和稳定供给能力，进一步推动相关产品国产化应用，助力我国电子胶粘剂市场国产化率的提升。

（3）打破产能瓶颈，提升经营业绩

相比同行业公司，公司目前产能规模较小，限制了公司经营业绩的增长。与公司目前最主要的收入来源智能终端领域相比，公司正在拓展的新能源领域电子胶粘剂的整体用胶量更大，通信、半导体等领域对产品性能、产能规模、交付稳定性和技术响应速度要求更高，公司现有生产基地和设备资源已难以充分满足业务拓展，尤其是新能源领域的需要。通过本项目建设，公司将围绕主营业务扩充电子胶粘剂产能，提高产品供给能力、优化产品结构，实现经营业绩增长。

4、项目可行性

（1）国家政策支持电子胶粘剂产业发展

近年来，我国持续通过产业规划、鼓励类目录和重点新材料目录等政策支持电子材料和新材料产业高质量发展。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》及《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出，加快发展新材料等战略性新兴产业，推动相关产业集群发展。《产业结构调整指导目录（2024 年本）》将低 VOCs 含量胶粘剂、环保型水处理剂、新型高效环保催化剂和助剂，以及功能性膜材料和先进封装材料等电子化学品及关键原料开发与生产列为鼓励类方向；《鼓励外商投资产业目录（2025 年版）》亦将高性能涂料、胶粘剂等列入全国鼓励外商投资产业目录。

同时，国家政策在电子胶粘剂上下游行业提供了全面指引。《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》将电子级环氧树脂、异方性导电胶膜、半导体芯片封装导热有机硅凝胶等列为重点新材料方向；《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》提出发展人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端，并加强人工智能与 6G 等领域技术协同创新。全产业链、多场景的支持政策为我国电子胶粘剂行业发展奠定了良好的政策基础。

（2）公司拥有完善的产品及技术体系

经过多年的技术积累和产品开发，公司形成了丙烯酸酯、环氧树脂、聚氨酯、有机硅、改性硅烷和杂化六大化学体系产品技术平台，掌握 20 项核心技术，应

用领域覆盖智能终端、新能源、半导体、通信等多个战略性新兴产业。公司可为客户提供元器件包封胶、磁芯粘接胶、结构粘接胶、底部填充胶、导热界面材料、电磁屏蔽材料、芯片固晶胶膜（DAF）、AA 制程胶、光学胶等各种产品品类及 UV 固化、热固化、湿气固化、双重固化等多种固化方式的产品，能够满足多领域客户的应用需求，为本项目实施建立了坚实的产品及技术基础。

（3）公司与下游客户建立了稳定的合作关系

经过多年发展和沉淀，公司凭借自身产品的优秀性能和稳定供应能力获得下游知名客户认可，并与其建立长期、稳定的合作关系，具有较高客户粘性。公司主要向东山精密、鹏鼎控股、立讯精密、安费诺、旗胜电子、Sanmina、台郡科技、和硕、富士康等全球知名电子制造厂商直接供货；在智能终端领域，与苹果、OPPO、vivo、小米、三星等终端品牌商建立了稳定合作关系；在新能源领域，公司与特斯拉、宁德时代、阳光电源、比亚迪、汇川技术等知名企业形成深度产业合作；在半导体领域，公司已陆续通过卓胜微、通富微电、舜宇光学、恒诺微等国内外多家知名半导体行业客户的产品验证测试；在通信领域，公司已进入华为、中际旭创、MPS 等知名客户的供应链体系。公司多年来的客户积累为本项目实施提供了丰富客户资源。

5、项目实施主体

本项目由德聚技术实施。

6、项目投资测算

本项目投资总额为 49,206.08 万元，拟使用募集资金投入 35,378.63 万元，具体投资情况如下表所示：

序号	投资项目	投资金额	占项目总资金比例	拟使用募集资金
1	建设投资	43,857.30	89.13%	30,029.85
1.1	建筑工程费	23,006.39	46.76%	9,837.39
1.2	设备购置费	17,869.01	36.31%	17,869.01
1.3	设备安装费	893.45	1.82%	893.45
1.4	预备费	2,088.45	4.24%	1,430.00
2	铺底流动资金	5,348.78	10.87%	5,348.78
合计		**49,206.08**	**100.00%**	**35,378.63**

7、项目实施规划

本项目的建设期为 3.5 年（42 个月），具体实施进度安排如下表所示：

进度阶段	建设期（月）													
	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42
清理场地	■													
工程及设备招标		■												
基础建设及装修工程			■	■	■	■	■	■						
设备采购及安装调试							■	■	■	■	■	■		
人员招聘及培训								■	■	■	■	■	■	
试生产													■	■
验收竣工														■

8、项目备案及审批情况

本项目已取得东莞市发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2207-441900-04-01-379661）。

本项目已取得东莞市生态环境局出具的《关于德聚高端复合功能材料生产项目环境影响报告书的批复》（东环建〔2023〕10945 号）。

9、项目环境保护情况

本项目建设及运营过程中可能产生少量废气、废水、固体废物和噪声。公司将按照环境影响报告书批复及相关环保法律法规要求，配套建设并规范运行废气收集处理、废水收集处理、固体废物分类收集贮存及依法处置、噪声控制等环保设施和措施，相关环保设施及治理费用已纳入项目建设及运营安排，确保污染物达标排放或合规处置。项目实施不会对周围环境产生重大不利影响。

10、项目用地情况

本项目实施地位于广东省东莞市石排镇专精特新产业园区，通过新建生产厂房、员工宿舍及地下室等配套工程设施，并采购一系列先进的生产设备及其他辅助设备，以打造自动化程度更高的智能生产基地。

项目用地已取得证号为“粤（2023）东莞不动产权第 0137590 号”的不动产

权证。

（二）德聚北方总部产研一体化项目

1、项目概况

本项目实施地址位于山东省青岛市高新区锦汇路 1 号蓝湾创业园 D2-III、D3-III 座及 A5 座，公司拟通过购买该等房产的方式取得经营用房用于本项目的实施。本项目建设期为 42 个月，计划总投资 21,114.57 万元。

本项目建成后，主要面向智能终端、新能源、半导体等应用领域，从事高性能电子胶粘剂产品生产，项目设计产能为年产电子胶粘剂 1,314.00 吨；并建设研发试验区、产品测试区、办公区，购置先进研发和测试设备，引进高层次研发人才。公司拟围绕高可靠性半导体封装胶粘剂、半导体用高性能胶膜、高端原料自主合成、生物基胶粘剂研究、新能源用高性能胶粘剂等各项预研课题开展研发工作，以期提升现有产品性能、开发核心原材料合成技术并拓展更多商用场景。本项目建成后，该产研基地将成为公司新技术储备、量产测试以及引进技术消化吸收和创新的重要平台，将具备国内先进的研发和测试水平。

2、资金概况

本项目建设期为 42 个月，计划总投资 21,114.57 万元，建设投资 17,316.64 万元，技术研发费用 2,410.93 万元，铺底流动资金 1,387.00 万元。

3、项目必要性

（1）扩大高性能电子胶粘剂产能，提升我国高性能电子胶粘剂产品国产化水平

电子胶粘剂是电子专用高分子材料的重要产品形态之一，可作为封装材料、导热材料、电磁屏蔽材料、光刻胶等使用。在高性能电子胶粘剂领域，国际化工材料企业起步较早，在技术、品牌、客户认证和规模化交付方面形成了一定先发优势，市场仍主要由汉高、陶氏化学、3M 等世界级巨头主导，国内高性能电子胶粘剂市场供给存在一定的缺口。

在此背景下，我国持续重视战略性新兴产业供应链的自主供给能力，产业政策的支持和下游客户供应链的本土化需求，为国内企业提升高性能产品产能创造

了有利条件。智能终端、新能源汽车、半导体封装材料、AI 算力设备和高速光模块等领域对材料的性能提出更高要求，国内电子胶粘剂企业在高性能领域技术研发的同时，规模化生产需求日益迫切，自主配套进程正逐步加速。与此同时，国内电子胶粘剂企业在生产能力与技术研发上持续进步，部分领域的技术水平已接近或达到国际先进水平。

随着国家政策支持、国内企业技术及工艺水平提升，以及国产电子胶粘剂企业本土化服务的快速响应优势，高性能电子胶粘剂的国产化应用空间预计将持续扩大。本项目实施将助力公司有效提升高性能电子胶粘剂产品的产能规模，实现规模化、稳定化供应，增强国内电子材料供应链韧性，并满足下游客户对本地化、稳定化和快速响应供应的需求。

（2）抓住下游应用市场快速发展带来的市场机遇

随着全球电子信息产业持续升级与数字化转型加速，电子胶粘剂作为关键配套材料，其应用场景已向高可靠制造领域不断延伸。当前，智能终端、新能源、半导体等领域的产业快速发展，对电子胶粘剂在粘接强度、耐高温性、绝缘性能、导热散热和长期可靠性等方面提出了更高要求，市场需求日益强劲。

根据 QY Research 数据，新能源汽车市场的快速扩张推动新能源汽车胶粘剂市场增长。同时，安全法规的严格要求以及自动化制造工艺的赋能，亦是行业发展的重要推动力。2025 年全球电车胶粘剂市场销售额约 34.67 亿美元，预计 2032 年增长至 113.30 亿美元，2026 年至 2032 年复合增长率为 18.7%。根据 Grand View Research 数据，2024 年全球半导体封装市场规模为 396 亿美元，预计 2025 年进一步增长至 433 亿美元，至 2030 年市场规模将超 700 亿美元，2025 年至 2030 年复合增长率为 10.4%，预计半导体领域电子胶粘剂市场规模也将随之快速增长。此外，TWS 耳机、智能手表及 AR/VR 头显等新兴智能终端产品出货量呈现快速增长态势，为智能终端领域电子胶粘剂市场提供了较大的增长潜力。

本项目顺利实施后，将助力公司在智能终端、新能源、半导体等领域进一步扩大高性能电子胶粘剂产品产能，丰富公司产品矩阵并提升技术服务水平。通过积极把握下游新兴产业发展带来的市场增量机遇，公司能够有效扩大市场份额，强化核心竞争力，为未来可持续增长奠定坚实基础。

（3）增强研发实力，满足客户不断提升的应用需求

由于电子胶粘剂是电子元器件可靠连接、功能防护和性能承载的关键功能性材料，对终端产品的生产良率、运行可靠性和使用寿命具有直接影响。因此，电子胶粘剂与电子产业的技术和工艺发展呈现相互依赖、相互促进的特点。一方面，电子胶粘剂的性能要求与具体应用场景高度相关，不同电子产品在用胶位置、制程条件及可靠性要求等方面存在差异，电子胶粘剂企业需要在充分理解下游客户应用需求的基础上，统筹考虑产品的电性能、化学性能、物理性能、光学性能、热性能及工艺性能等指标，研发形成满足客户需求的产品配方。另一方面，电子产品升级换代速度较快，相关技术和生产工艺持续迭代，对电子胶粘剂的性能和功能不断提出新的要求，电子胶粘剂产品亦需根据下游行业技术和工艺演进持续升级。本项目建设完成后，将有助于公司提升研发实力，持续开发新产品，更好满足下游客户不断提高的应用需求，提升市场占有率。

（4）扩大区域覆盖，加速研发成果产业化

为进一步强化区域生产覆盖能力与客户服务效率，公司已在东莞、深圳、上海、苏州、南通、美国、韩国、德国等地设立销售中心，市场开拓范围持续扩大。目前公司高性能电子胶粘剂产品产能主要集中于东莞基地，可快速响应华南地区客户需求，但对于华东、华北、华中区域的客户而言，现有生产布局难以充分匹配全国市场的发展需求。

在此背景下，公司拟在青岛新设总部基地，兼具生产与研发功能，进一步完善战略布局，一方面，有助于加强华东地区客户的生产配套覆盖，同时辐射华北、华中区域，提升上述区域客户的订单响应速度与交付效率，在提升客户满意度的同时，显著降低跨区域运输及仓储成本；另一方面，青岛德聚作为公司核心研发子公司，拥有高效的研发团队与丰富的技术成果，总部基地将生产与研发功能统筹布局，可实现生产与研发的紧密协作，加速研发成果产业化，推动量产工艺优化改进。青岛总部基地的设立，将通过生产布局的战略性完善与产研协同的高效联动，助力公司经营效益稳步提升。

4、项目可行性

（1）深厚的技术产品积累与研发能力为项目实施奠定技术基础

经过多年技术积累与产品开发，公司构建了丙烯酸酯、环氧树脂、有机硅、聚氨酯、改性硅烷、杂化六大化学体系产品技术平台，掌握 20 项核心技术，截至本招股说明书签署日，已获发明专利授权 65 项、实用新型专利授权 49 项。公司产品广泛应用于智能终端、新能源、半导体、通信等战略性新兴产业，可提供元器件包封胶、结构粘接胶、底部填充胶、导热界面材料等多品类产品及 UV 固化、热固化等多种固化方式解决方案，丰富的产品矩阵能够精准匹配下游各领域客户的规模化采购需求，为扩产产能的市场承接筑牢产品根基。

公司及本项目的实施主体青岛德聚的核心技术团队具备丰富的技术研发与产业化落地经验，深度参与多项专利研发能够高效推动研发与生产协同，保障扩产过程中生产工艺的稳定性与产品质量的一致性。公司深厚的技术产品积累与强劲的研发实力将为项目顺利实施、产能稳步扩张以及产品研发升级奠定坚实技术基础。

（2）高质量的客户群体为公司研发工作提供市场基础

公司凭借自身产品的优秀性能和稳定供应能力，获得了下游客户的广泛认可，成功建立起长期、稳定的合作关系，客户粘性较高。具体来看，公司主要向东山精密、鹏鼎控股、立讯精密、安费诺、旗胜电子、Sanmina、台郡科技、和硕、富士康等全球知名电子制造厂商直接供货；在智能终端领域，与苹果、OPPO、vivo、小米、三星等终端品牌商建立了稳定合作关系；在新能源领域，公司与特斯拉、宁德时代、阳光电源、比亚迪、汇川技术等知名企业形成深度产业合作；在半导体领域，公司已陆续通过卓胜微、通富微电、舜宇光学、恒诺微等国内外多家知名半导体行业客户的产品验证测试；在通信领域，公司已进入华为、中际旭创、MPS 等知名客户的供应链体系。

公司与上述客户建立的长期稳定合作关系，有助于公司拓展订单需求并促进项目新增产能消化，同时使公司能够持续对接下游前沿应用需求，为产品研发升级提供方向。相关客户基础将为项目推进提供市场支撑。

（3）完善的研发体系为扩产项目高效落地提供有力支撑

公司当前构建了高效研发模式与经验丰富的研发团队，形成了完善的研发体系。研发模式方面，公司建立了“交互式”研发和自发性研发相结合的自主研发模式。一方面，公司深度挖掘客户工艺需求和技术痛点，定制开发产品及应用方案；另一方面，公司基于对电子专用高分子材料技术的深刻理解，前瞻性研判技术、产品、工艺及市场发展趋势，提前布局前沿生产工艺与适配产品的研发，丰富技术储备。研发团队方面，公司拥有较为稳定的研发团队，核心技术人员具备专业背景与产品研发及产业化落地经验，能够衔接研发与生产环节。截至 2025 年末，公司拥有 120 名研发人员，研发人员占总员工人数比例为 26.03%。

公司完善的研发体系将持续为项目的生产工艺流程控制与产品研发升级提供有力支撑，助力项目的高效落地与稳定运营。

（4）成熟的管理体系和丰富的管理经验保障项目开展

公司现有生产基地已运行多年，形成了成熟的生产流程以及生产部门与研发、采购、销售等其他各部门之间的配合机制。生产部根据销售订单及销售预测情况滚动制定生产月计划及周计划并按生产计划进行领料和生产实施；品质部负责进行制程控制；计划部结合生产计划、库存水平等因素进行原材料采购申请，采购部根据申请实施采购。此外，公司管理层也具有多年的管理经验。公司完善的生产管理体系和管理层丰富的管理经验，有利于保障本项目的高效开展。

5、项目实施主体

本项目由青岛德聚实施。

6、项目投资测算

本项目投资总额为 21,114.57 万元，拟使用募集资金投入 13,498.55 万元，具体投资情况如下表所示：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占项目总资金比例	拟使用募集资金
1	建设投资	17,316.64	82.01%	12,111.55
1.1	场地购置费	6,705.63	31.76%	6,258.60
1.2	装修工程费	3,515.57	16.65%	-

序号	投资项目	投资金额	占项目总资金比例	拟使用募集资金
1.3	设备购置费	6,276.34	29.73%	5,276.34
1.4	设备安装费	313.82	1.49%	281.28
1.5	预备费	505.29	2.39%	295.34
2	研发费用投资	2,410.93	11.42%	1,549.11
3	铺底流动资金	1,387.00	6.57%	1,387.00
合计		**21,114.57**	**100.00%**	**13,498.55**

7、项目实施规划

本项目的建设期为 3.5 年（42 个月），具体实施进度安排如下表所示：

进度阶段	建设期（月）													
	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42
购买及清理场地	■								■					
工程及设备招标		■												
装修工程			■	■	■	■								
设备采购及安装调试					■	■	■	■	■	■	■			
人员招聘及培训							■	■	■	■	■	■	■	
试生产													■	■
验收竣工														■

8、项目备案及审批情况

本项目已取得青岛高新区管委行政审批服务部出具的《企业投资项目备案变更证明》（项目统一编码：2303-370271-89-02-694554）。

本项目已取得青岛市生态环境局高新区分局出具的《关于青岛德聚胶接技术有限公司德聚北方总部产研一体化项目环境影响报告表的批复》（青环高新审〔2022〕4 号）及《关于青岛德聚胶接技术有限公司德聚北方总部产研一体化项目（二期）环境影响报告表的批复》（青环审（高新）〔2023〕15 号）。

9、项目环境保护情况

本项目建设及运营过程中可能产生少量废气、废水、固体废物和噪声。公司将按照环境影响报告表批复及相关环保法律法规要求，采取废气收集处理、废水分类处理、固体废物分类收集贮存及依法处置、低噪声设备及减振隔声等环保措

施，相关环保设施及治理费用已纳入项目建设及运营安排，确保污染物达标排放或合规处置。项目实施不会对周围环境产生重大不利影响。

10、项目用地情况

本项目选址于山东省青岛市高新区锦汇路 1 号蓝湾创业园 D2-III、D3-III 座及 A5 座，公司拟通过购买该等房产的方式取得经营用房用于本项目的实施。

（三）东莞研发中心及信息化项目

1、项目概况

本项目实施地址位于广东省东莞市石排镇向沙路石排段 14 号现有场地内，通过加大对研发测试设备、高层次研发人员等的投入，提升公司的自主研发能力和科技成果转化能力的同时，搭建公司综合信息化体系，进一步增强公司整体研发水平及技术实力，以全面提升公司对主营业务数据的集成管理与科学应用能力，全面提升企业综合竞争力。

2、资金概况

本项目计划总投资 16,517.05 万元，具体金额及资金使用计划如下表所示：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占项目总资金比例	拟使用募集资金
1	装修工程费	815.00	4.93%	815.00
2	软硬件设备购置费	7,949.00	48.13%	7,949.00
3	研发费用投资	6,369.85	38.57%	6,369.85
4	系统开发及实施费	945.00	5.72%	945.00
5	预备费	438.20	2.65%	438.20
合计		**16,517.05**	**100.00%**	**16,517.05**

3、项目必要性

（1）提升公司产品性能，强化公司技术研发实力

随着新能源汽车、先进封装、算力基础设施等战略性新兴产业快速发展，电子胶粘剂的下游市场对其需求日益强劲。同时，由于电子元器件及电子产品功能丰富、生产工艺多样、工作环境复杂，行业对电子胶粘剂的电性能、化学性能、力学性能等各项指标要求持续提升，从而倒逼相关企业加快技术创新与升级步伐。

公司深耕电子胶粘剂领域多年，拥有深厚的技术积累与突出的创新能力。为顺应电子行业的发展趋势与技术进步需求，公司亟需在现有技术基础上进一步加大研发投入，提升电子胶粘剂产品综合性能，强化技术研发实力。本项目计划引入先进的软硬件设备与高素质研发人才，重点围绕高可靠性半导体封装胶粘剂、半导体用高性能胶膜、新能源用高性能胶粘剂、高端原料自主合成等方向开展研发工作，加速核心技术成果转化，从而进一步增强公司技术研发实力，提升产品性能，巩固公司在电子胶粘剂领域的核心竞争力及可持续发展能力。

（2）改善研发环境，吸引高层次研发人才

近年来，公司始终保持快速发展态势。随着业务规模扩大与研发需求的增长，结合公司发展战略，现有研发条件仍需进一步完善。与此同时，电子胶粘剂技术水平的持续进步，也对公司研发能力提出了更高要求。目前，公司现有研发设备与环境难以充分适配新产品、新技术研发需求。为更好地契合客户需求、把握行业发展趋势，公司需进一步加大研发投入，改善研发环境，购置先进的研发及检测测试设备，为研发人员搭建环境优良、功能完备的研发与试验平台，吸引高层次研发人才，全面提升公司研发能力。

本项目拟通过升级研发设备、改善研发环境，系统构建与公司战略发展相匹配的高效技术创新平台；同时进一步吸引行业优秀研发人才，优化现有研发团队结构，增强公司研发实力，助力公司精准把握电子胶粘剂技术的演变趋势，持续开发并优化可满足客户日益提升的性能需求的产品，进一步提升公司市场竞争力。

（3）加强信息化建设，提高公司经营效率

电子胶粘剂业务呈现出多品类定制化、生产工艺精细化以及下游客户需求响应高效化的显著特征，对产品研发的灵活性、生产流程的精确控制，以及客户服务的快速反馈能力均有较高要求。目前，公司的信息化建设水平在信息安全合规性保障、核心业务全流程数字化支持、生产环节与智能仓储的高效协同以及客户运营管理的精细化水平等多个维度，仍存在明显的提升空间。随着行业市场竞争的持续加剧，以及企业数字化转型的不断深入，公司亟需进一步加强信息化建设，提升公司经营效率，打造统一的业务与管理平台，支撑企业战略发展。

公司拟通过引进 IT 经理、系统开发工程师、软件系统运维工程师等专业的

信息化人才，购置软硬件系统设备，推进 IT 基础设施建设、信息安全合规工作、核心业务系统升级及生产仓储数字化等系列项目的建设与升级，实现研发、生产、销售、管理全流程的数据贯通与协同优化，有效缩短研发周期、降低生产损耗、提升订单交付效率，进而全面提高公司经营效率，助力公司在行业竞争中巩固市场地位。

4、项目建设可行性

（1）坚实的技术研发储备为项目实施提供技术基础

公司自成立以来，始终深耕电子胶粘剂行业。通过持续的研发投入与技术创新，公司在产品研发领域已形成显著技术优势，构建起涵盖丙烯酸酯、环氧树脂、有机硅、聚氨酯、改性硅烷及杂化的六大化学体系产品技术平台，并掌握 UV 湿气双重固化丙烯酸酯预聚物合成技术等 20 项核心技术。同时，公司积累了丰富的知识产权资源，截至本招股说明书签署日，已获得发明专利授权 65 项、实用新型专利授权 49 项。公司可提供元器件包封胶、结构粘接胶、底部填充胶、导热界面材料等多品类产品，以及 UV 固化、热固化等多种固化方式的解决方案，产品广泛应用于智能终端、新能源、半导体、通信等战略性新兴产业，为技术深化与产业应用筑牢根基。此外，公司还与广东粤港澳大湾区黄埔材料研究院、上海交通大学、中科院广州化学有限公司等高校及科研机构建立了产学研合作关系，确保研发精准高效。综上所述，这些技术储备为公司项目建设提供了坚实的技术保障。

（2）完善的研发体系为项目实施提供了制度保障

电子胶粘剂应用领域具有应用终端品类繁多、工艺复杂以及产品更新迅速等特点。公司采取“交互式”研发和自发性研发相结合的研发模式。一方面，电子胶粘剂的应用领域具有终端品类众多、工艺复杂、产品更新速度较快等特点，为了满足各种客户不断迭代的需求，公司采取“交互式”的研发模式，贴近客户所在地，保持密切的技术交流，深度了解客户的工艺设计方案，挖掘其工艺需求和技术痛点，从而根据市场及客户需求开发相关产品或改进公司的产品设计；另一方面，公司基于自身对电子专用高分子材料技术的理解，对技术、产品、工艺、市场的发展趋势进行前瞻性研判并布局前沿技术的研发工作，增强技术实力、丰

富技术储备。在注重自主研发的同时，公司也充分利用科研院所资源开展产学研合作，补充公司在树脂等原材料量产工艺方面的技术积累，与公司自主研发形成互补的作用。

此外，为提高广大研发人员的工作积极性和创造性，公司配备了先进的技术研发、检测设备，持续为研发人员创造良好的研发环境。公司还建立了完善的研发激励机制，鼓励研发创新与技术升级，积极营造创新氛围。公司将不断地完善研发体系，持续推动公司研发水平和能力的提升，公司完善的研发体系为项目实施提供了制度保障。

（3）良好的运营管理经验为项目实施提供经验支撑

公司自成立以来，始终深耕电子胶粘剂领域，已积累丰富的运营管理经验与扎实的生产研发数据基础。多年来，研发部门沉淀的配方数据、生产环节积累的关键工艺参数、销售端持续收集的客户需求及反馈信息等各类基础数据，可通过信息化系统实现统一规范的整合管理与高效复用，从而打通信息孤岛、提升跨部门协作效率。同时，公司在各主要业务环节已形成成熟稳定的标准化操作流程，为后续系统流程的梳理、优化及线上化迁移奠定了良好管理基础。此外，本项目拟规划的 IT 基建及信息安全合规、核心业务系统升级、生产与仓储数字化等项目，均紧密围绕研发、生产、仓储物流、协同办公等企业核心工作场景展开，项目内容与公司业务需求高度契合。公司良好的运营管理经验为本项目信息化建设的顺利推进与高效运行提供了坚实可靠的经验支撑。

5、项目实施规划

本项目的建设期为 3 年（36 个月），具体实施进度安排如下表所示：

进度阶段	建设期（月）											
	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
清理场地	■											
装修工程		■	■	■								
设备采购及安装调试			■	■	■	■	■	■	■	■		
人员招聘及培训				■	■	■	■	■	■	■	■	
技术课题研发及 IT 系统建设					■	■	■	■	■	■	■	■
验收竣工												■

6、项目备案及审批情况

本项目已取得东莞市石排镇经济发展局出具的《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2605-441900-04-01-656462）。

7、项目环境保护情况

本项目属于非生产性项目，项目运营过程中对周围环境影响较小。项目实施及运营过程中可能会产生员工生活废水、生活垃圾。经妥善处理后，废水排入市政排水管道，生活垃圾经收集后交由环卫部门处理。

（四）营销服务及技术支持中心建设项目

1、项目概况

本项目建设目标为强化公司营销服务能力及提升品牌知名度，具体包括以下两方面内容：

一是强化营销服务体系布局。公司计划在上海、武汉、北京、重庆、合肥、长沙等国内主要高性能电子胶粘剂区域市场，通过购买或租赁方式建设办事处或技术服务中心，以完善市场、销售和售后服务支持体系，提升产品市场占有率、客户满意度与品牌知名度。二是完善品牌营销与渠道推广。公司将通过短视频/直播、虚拟展厅等线上方式进行品牌曝光与商机获取，并加大在 LinkedIn、微信公众号、视频号、抖音等国内外平台的广告投放，以提升品牌曝光量、触达潜在客户，实现品牌宣传与用户转化。同时，公司将通过积极参加海内外行业展会、研讨会、经销商大会、产品技术介绍会及行业论坛等线下活动进行推广，以提升品牌曝光，获取前沿信息，实现品牌、业务与资源的多维突破。

2、资金概况

本项目计划总投资 14,653.90 万元，具体金额及资金使用计划如下表所示：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占项目总资金比例	拟使用募集资金
1	场地购置费	4,400.00	30.03%	4,400.00
2	场地租赁费	160.20	1.09%	160.20
3	装修工程费	588.00	4.01%	588.00
4	设备购置费	2,058.36	14.05%	2,058.36

序号	投资项目	投资金额	占项目总资金比例	拟使用募集资金
5	市场推广费用	4,435.00	30.26%	4,435.00
6	人员薪酬投资	2,652.00	18.10%	2,652.00
7	预备费	360.34	2.46%	360.34
合计		**14,653.90**	**100.00%**	**14,653.90**

3、项目必要性

（1）提升公司品牌影响力，增强公司市场拓展能力

在电子专用高分子材料领域，尤其是新能源汽车、先进封装、算力基础设施等高性能电子胶粘剂细分市场，长期以来技术与市场主要由汉高、陶氏化学、3M等世界级巨头主导。公司致力于打破这一市场竞争格局，成为具备全球竞争力的供应商，而品牌影响力正是实现这一战略目标的关键支撑。目前，公司产品已覆盖智能终端、新能源、半导体、通信等战略性新兴产业，业务遍及亚洲、美洲及欧洲，但品牌认知度与国际头部企业仍存在差距，一定程度上制约了公司市场拓展步伐。在关键材料自主化成为国家战略导向的背景下，拥有高辨识度与良好口碑的品牌，更易赢得下游核心客户信任，助力公司在新兴应用增长机遇抢占先机。

本项目拟通过制作公司品牌形象介绍内容、积极参与海内外展会、组织产品技术介绍会和经销商大会等推广方式，打造公司品牌形象；通过布局短视频与直播、新媒体广告投放、建设官方网站和虚拟展厅等方式，强化品牌推广力度，完善线上线下联动的推广体系。同时，公司将引入优质营销服务人才，健全营销服务网络，进一步提升品牌影响力和市场拓展能力，为公司开拓国内外市场、打破世界级巨头垄断的市场格局奠定坚实基础。

（2）扩展公司销售渠道，提升公司市场份额

公司现已在东莞、深圳、苏州、上海、南通以及美国、德国、韩国等地设立销售中心，但从市场布局的深度与广度来看，仍存在优化空间。当前，公司产品下游应用领域的智能终端、新能源、半导体、通信正处于快速发展阶段，终端产品迭代、先进封装自主配套加速及新兴算力基础设施建设等需求提升亦带来新的市场需求。由于公司现有销售渠道难以全面覆盖国内核心产业聚集区，不仅导致潜在客户资源未能得到有效挖掘，也使公司无法及时响应客户的采购需求与技术服务支持，公司市场份额的提升因此受到一定影响。

本项目计划在国内多个大型城市设立销售与技术服务中心及办事处，以实现对核心产业聚集区的精准覆盖，缩短与客户的地理距离，提升市场渗透能力。与此同时，公司将进一步完善线上线下推广渠道，构建“线上引流+线下体验+本地化服务”的一体化销售网络，有效弥补现有营销渠道短板，增强公司对市场营销及技术服务需求的快速响应能力，提升市场份额，为公司业务持续增长提供坚实保障。

（3）加强技术服务水平，满足客户多元化需求

电子胶粘剂产品的应用场景具有高度专业性和多样性，下游客户行业领域和生产工艺各异。公司已形成丙烯酸酯、环氧树脂等六大化学体系产品平台，能够为客户提供多元化的产品选择，但随着公司下游智能终端、新能源、半导体、通信等战略性新兴产业的快速发展，客户对产品配套应用方案的专业性、及时性要求不断提升。当前，公司的技术支持体系尚不完善，在满足客户在技术、商务、体验等方面的多元化需求存在提升空间，一定程度上影响了客户体验和合作粘性。

本项目将重点提升公司技术服务水平。通过建立本地化技术服务中心，公司可与周边客户开展技术交流、商务洽谈及产品展示；同时，通过引进优秀技术服务团队并搭建分析实验室，开展产品性能测试，深入挖掘客户实际应用场景，针对性优化配套解决方案，快速响应客户从售前到售后全流程的各类问题，提升公司技术服务水平，有效满足客户多元化需求，增强客户对公司的认可度与忠诚度，进一步提升公司服务能力。

4、项目建设可行性

（1）广阔的产品应用市场空间为项目实施提供市场基础

公司产品主要应用于智能终端、新能源、半导体、通信等战略性新兴产业，具有广阔的市场发展前景。随着全球数字化进程加速以及新能源、半导体等产业的快速发展，下游产业对电子胶粘剂等关键材料的需求持续增长。

根据 Fortune Business Insights 数据，2025 年全球电子胶粘剂的市场规模达到了 68.80 亿美元，2026 年预计将达到 74.40 亿美元，未来 2034 年将增长至 138.90 亿美元，年均复合增长率达 8.11%。

新能源汽车市场的快速扩张将有效推动新能源汽车胶粘剂市场增长，同时，

安全法规的严格要求以及自动化制造工艺的赋能，亦是行业发展的重要推动力。根据 Research and Markets 预测，全球新能源汽车专用胶粘剂市场规模将从 2025 年的 12.10 亿美元增长至 2026 年的 15.70 亿美元，预计 2032 年将达到 78.60 亿美元。根据 Yole 预测，2024 年全球先进封装市场规模约为 450 亿美元，预计 2030 年将达到 800 亿美元，2024 年至 2030 年年复合增长率为 9.4%，先进封装在整个封装行业中的市场占比有望在 2027 年超过 50%。作为先进封装的关键材料，电子胶粘剂的市场规模预计也将随先进封装渗透率的不断提高而快速增长。

电子胶粘剂是下游产业不可或缺的关键材料，其市场需求与下游产业发展深度绑定，将伴随下游产业的扩张实现稳步增长，为项目建成后新增产能的消化及市场份额的提升提供保障。同时，国家针对战略性新兴产业及关键材料自主化的政策支持，也为项目实施创造了良好的政策环境，进一步增强了项目的可行性。

（2）公司具备丰富的营销管理经验

自成立以来，公司始终专注于电子胶粘剂产品的研发、生产与销售。经过多年的市场深耕，已积累了丰富的营销管理经验。公司业务遍及亚洲、美洲及欧洲多个地区，通过在国内东莞、深圳、上海、苏州、南通等主要城市，以及美国、韩国、德国等主要下游市场国家布局销售中心，构建了初步的全球营销网络，对不同区域的市场环境、行业政策及客户需求特点有着深入理解。在营销团队建设方面，公司培养了一批具备专业素养与市场洞察力的营销人才和技术应用工程师，能够精准把握市场动态，高效开展客户开发与维护工作。

公司拟组建的营销和技术团队可快速适配新建销售与技术服务中心及办事处的运营需求。一方面，公司将销售服务与技术应用相结合，能够快速、高效、准确地根据客户需求提供相应的产品和服务；另一方面，公司技术应用工程师承担着了解、收集、分析市场技术应用需求及产品开发方向，并向产品开发人员反馈的职能。此外，公司设有多个研发中心，能够快速响应市场趋势与客户定制化需求，与客户形成了“交互式”的研发模式，为公司带来了良好的客户粘性及市场拓展成功率，为项目实施后的市场开拓工作奠定了坚实基础。

（3）优质的客户群体为营销网络拓展提供市场基础

凭借深厚的技术储备、优异的产品性能、稳定的产品质量和多元的产品矩阵，

公司已赢得多个行业领域知名客户的广泛认可，积累了一批优质客户资源，建立了长期、稳定的合作关系，具有较高客户粘性。公司主要向东山精密、鹏鼎控股、立讯精密、安费诺、旗胜电子、Sanmina、台郡科技、和硕、富士康等全球知名电子制造厂商直接供货；在智能终端领域，与苹果、OPPO、vivo、小米、三星等终端品牌商建立了稳定合作关系；在新能源领域，公司与特斯拉、宁德时代、阳光电源、比亚迪、汇川技术等知名企业形成深度产业合作；在半导体领域，公司已陆续通过卓胜微、通富微电、舜宇光学、恒诺微等国内外多家知名半导体行业客户的产品验证测试；在通信领域，公司已进入华为、中际旭创、MPS 等知名客户的供应链体系。

现有客户的业务拓展需求将直接催生对公司产品及服务的增量需求，为新启动的本项目提供初始业务支撑。此外，依托现有优质客户的行业影响力，公司可形成良好示范效应，吸引更多潜在客户开展合作，降低新市场开拓难度。同时，基于长期客户合作经验，公司能够深入洞悉行业客户的需求痛点，针对性优化营销服务策略与产品研发设计，提升新市场拓展成功率，保障项目实施效果。

5、项目实施规划

本项目的建设期为 3 年（36 个月），具体实施进度安排如下表所示：

进度阶段	实施进度（月）											
	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
实施方案设计	■											
选址考察及商务洽谈	■	■										
租赁及购买场地		■	■	■	■	■	■	■	■			
装修工程建设			■	■	■	■	■	■	■	■		
设备采购及安装			■	■	■	■	■	■	■	■		
人员招聘及培训		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
营销服务及技术支持中心网点试营业			■				■				■	
营销服务及技术支持中心网点正式营业				■				■				■

6、项目备案及审批情况

本项目已取得东莞市石排镇经济发展局出具的《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2605-441900-04-01-249819）。

7、项目环境保护情况

本项目属于非生产性项目，项目实施及运营过程中可能会产生员工生活废水、生活垃圾。经妥善处理后，废水排入市政排水管道，生活垃圾经收集后交由环卫部门处理。

（五）补充流动资金

1、项目建设内容

本次发行募集资金在满足上述项目资金需求的同时，综合考量行业未来发展趋势、公司所处发展阶段、自身经营特点、财务状况以及业务发展规划等要素，拟使用 20,000.00 万元募集资金用于补充流动资金，以满足公司战略发展和业务经营对流动资金的需求，提升公司抗风险能力与市场竞争力。

2、项目建设的必要性

当前，公司正处于规模扩张、业务拓展的关键阶段，在生产活动、研发投入以及营销渠道建设布局等方面产生了较大的资金需求，公司资本结构风险有所提升。随着公司生产经营规模的持续扩大，公司需要充足的流动资金以满足日常生产运营过程中所需的原材料采购、人员工资支出等资金需求。同时，公司所处行业属于技术密集型行业，公司亟需持续进行新产品开发和技术升级迭代，不断加大研发费用和资源投入，深度布局前沿技术，丰富产品矩阵，持续进行产品创新迭代并拓展应用场景及客户资源，进而不断巩固在智能终端、新能源、半导体、通信等战略性新兴产业的技术优势。本次部分募集资金用于补充流动资金能够有效补充运营资金，满足公司持续研发投入及业务规模扩大的需求，将有利于优化改善资本结构，促进公司经营效率的提升，增强公司的业务灵活性及抗风险能力。